Panel PC 800

Anwenderhandbuch

Version: **1.25 (Februar 2014)** Bestellnr.: **MAPPC800-GER**

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Drucklegung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines

Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 4: Software

Kapitel 5: Normen und Zulassungen

Kapitel 6: Zubehör

Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Kapitel 1 Allgemeines	
1 Handbuchhistorie	
2 Sicherheitshinweise	16
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	16
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen	
2.2.1 Verpackung	16
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung	
2.3 Vorschriften und Maßnahmen	
2.4 Transport und Lagerung	17
2.5 Montage	
2.6 Betrieb.	17

2.3 Vorschriften und Maßnahmen	
2.4 Transport und Lagerung	17
2.5 Montage	
2.6 Betrieb	17
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	17
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase	17
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme	
2.7 Umweltgerechte Entsorgung	
2.7.1 Werkstofftrennung	
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen	
4 Richtlinien	
5 Übersicht	

Kapitel 2 Technische Daten	
1 Einleitung	
1.1 Features	
1.2 Aufbau / Konfiguration	
1.2.1 Konfiguration - Grundsystem	
1.2.2 Konfiguration - optionale Komponenten	
2 Gesamtgerät	
2.1 Temperaturangaben	
2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur.	
2.1.2 Minimale Umgebungstemperaturen	
2.1.3 Temperaturüberwachung.	
2.1.4 Temperatursensorpositionen	
2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben	
2.3 Leistungshaushalt	
2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung	
2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC820.1505-00	
2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC820.1906-00	
2.4 Blockschaltbilder	
2.4.1 Buseinheit 5AC803.BX01-00	
2.4.2 Buseinheit 5AC803.BX01-01	
2.4.3 Buseinheit 5AC803.BX02-00	
2.4.4 Buseinheit 5AC803.BX02-01	
2.5 Serialnummernaufkleber	40
2.6 Geräteschnittstellen und Einschübe	41
2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC	
2.6.2 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)	42
2.6.3 Serielle Schnittstelle COM1	
2.6.4 Ethernet 1 (ETH1)	45
2.6.5 Ethernet 2 (ETH2)	46
2.6.6 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)	
2.6.7 CompactFlash Slot 1	
2.6.8 CompactFlash Slot 2	
2.6.9 MIC, Line IN, Line OUT	49
2.6.10 Add-on USV Steckplatz	
2.6.11 Power Taster	
2.6.12 Reset Taster	50
2.6.13 Status LEDs	51

2.6.14 CMOS Profile Schalter	51
2.6.15 Batterie	52
2.6.16 Slide-in compact Slot	53
2.6.17 PClec Steckplatz (Card Slot)	53
3 Einzelkomponenten	54
3.1 Systemeinheiten	54
3.1.1 5PC820.1505-00	54
3.1.2 5PC820.1906-00	60
3.2 CPU Boards 945GME	66
3.2.1 Aligemeines	66
3.2.2 Bestelldaten.	66
3.2.3 Technische Daten SPC800.B945-0X.	67
3.2.4 Technische Dalen SPC600.0945-1X	07
3.3 Kurlikorper	69
2.2.2 Technicolo Doton	09 60
3.4 Hourtspeicher	09
	70
3.4.2 Bestelldaten	70
3/4.3 Technische Daten	70
3.5 Expansions	70
3.5.1 Allaemeines	71
3.5.2 Restelldaten	71
3 5 3 Finschübe	71
3 5 4 Technische Daten	71
3 5 5 Abmessungen 5AC803 SX01-00	72
3 5 6 Abmessungen 5AC803 SX02-00	73
3 5 7 Steckplatz für Buseinheiten	70
3 5 8 Slide-in Slot 1	75
3 6 Buseinheiten	70
3.6.1 Allgemeines	
3.6.2 Bestelldaten	
3.6.3 Technische Daten	
3.7 Adapter	
3.7.1 5AC803.BC01-00	
3.7.2 5AC803.BC02-00	
3.8 PClec Einsteckkarten.	
3.8.1 Allgemeines	79
3.8.2 Abmessungen	79
3.8.3 5ACPCC.ETH0-00	80
3.8.4 5ACPCC.MPL0-00	82
3.9 Laufwerke	86
3.9.1 5AC801.HDDI-00	86
3.9.2 5AC801.HDDI-02	89
3.9.3 5AC801.HDDI-03	91
3.9.4 5AC801.HDDI-04	94
3.9.5 5AC801.SSDI-00	96
3.9.6 5AC801.SSDI-01	100
3.9.7 5AC801.SSDI-02	103
3.9.8 5AC801.SSDI-03	106
3.9.9 5AC801.SSDI-04	108
3.9.10 5AC801.SSDI-05	111
3.9.11 5MMSSD.0060-00	114
3.9.12 5MMSSD.0060-01	116
3.9.13 5MMSSD.0128-01	118
3.9.14 5MMSSD.0180-00	121
3.9.15 5MMSSD.0256-00	123

3.9.16 5AC801.ADAS-00	125
3.9.17 5AC801.HDDS-00	126
3.9.18 5AC801.DVDS-00	129
3.9.19 5AC801.DVRS-00	132
3.9.20 5ACPCI.RAIC-03	
3.9.21 5ACPCI.RAIC-04	
3.9.22 5ACPCI.RAIC-05	141
3.9.23 5ACPCI.RAIC-06	
3.9.24 5MMHDD.0250-00	147
3.9.25 5MMHDD.0500-00	
3.10 Lüfter Kit	
3.10.1 5AC803.FA01-00	
3.10.2 5AC803.FA02-00	
3.10.3 5AC803.FA03-00	
Kapitel 3 Inbetriebnahme	
1 Montage	
1.1 Wichtige Informationen zur Montage	157
1.2 Montage mit Klemmblöcken	
1.3 Einbaulagen	
1.3.1 Einbaulage 0° und +/- 45°	
1.3.2 Einbaulage mit 5AC801.DVRS-00	
1.3.3 Einbaulage mit 5AC801.DVDS-00	
1.4 Luftzirkulationsabstände	161
2 Anschluss von Kabeln	162
3 Erdungskonzept	163
4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests	164
4.1 Vorgehensweise	164
4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen	
4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center	
4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark	165
4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen	
4.4 Auswertung der Messergebnisse	
5 Anschlussbeispiele	
5.1 Auswahl der Displayeinheiten	
5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard	
5.2.1 Voraussetzung Grundsystem	
5.2.2 Linkbaugruppe	
5.2.3 Kabel	169
5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte. Auflösungen und Segmentlängen	
5.2.5 BIOS Einstellungen	
5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard	
5.3.1 Voraussetzung Grundsvstem	
5.3.2 Linkbaugruppe	
5.3.3 Kabel	171
5.3.4 BIOS Finstellungen	172
5.4 Fin Automation Panel 800 über SDL onboard	173
5 4 1 Voraussetzung Grundsystem	173
5.4.2 Kahel	173
5 4 3 BIOS Finstellungen	174
5 5 Fin AP900 und ein AP800 über SDL onboard	
5.5.1 Voraussetzung Grundsystem	175
5.5.2 Linkhaugrunne	
5.5.2 Enitodagrappe	
5.5.4 RIOS Finstellungen	
5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard	
5.6.1 Voraussetzung Grundsvetem	1//
o.o. i voraussoizung orunusystem	177

5.6.2 Linkbaugruppen	177
5.6.3 Kabel	
5.6.4 BIOS Einstellungen	
6 Touchkalibrierung	
6.1 Windows XP Professional	
6.2 Windows XP Embedded	
6.3 Windows Embedded Standard 2009	
6.4 Windows 7 Professional / Ultimate	
6.5 Windows Embedded Standard 7 Embedded / Premium	180
6.6 Windows CE	
6.7 Automation Runtime / Visual Components	
7 Anschluss von USB Peripheriegeräten	
7.1 Lokal am PPC800	181
7.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI	
7.3 Remote am Automation Panel 800/900 über SDL	183
8 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes	
8.1 Create RAID Set	
8.2 Create RAID Set - Striped	
8.3 Create RAID Set - Mirrored	
8.4 Delete RAID Set	
8.5 Rebuild Mirrored Set	
8.6 Resolve Conflicts	
8.7 Low Level Format	
9 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer	
9.1 Backlight	
9.1.1 Wie kann die Lebenszeit von Backlights verlängert werden?	
9.2 Image Sticking	
9.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?	
9.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?	
10 Pixelfehler	
11 Bekannte Probleme / Eigenheiten	
5	
Kapitel 4 Software	
1 BIOS Optionen	191
1.1 Allgemeines	
1.2 BIOS Setup und Startvorgang	
1 2 1 BIOS Setun Tasten	193
1.3 Main.	
1.4 Advanced	195
1 4 1 ACPL Configuration	196
1.4.2 PCI Configuration	
1 4 3 Graphics Configuration	202
1.4.4 CPU Configuration	202
1 4 5 Chipset Configuration	205
1.4.6 I/O Interface Configuration	200
1 4 7 Clock Configuration	200
1 4 8 IDE Configuration	207
1 4 9 USB Configuration	207
1 4 10 Keyboard/Mouse Configuration	
1 4 11 Remote Access Configuration	215

1.4.12 CPU Board Monitor.2161.4.13 Baseboard/Panel Features.2171.5 Boot.2211.6 Security.2221.7 Hard Disk Security User Password.2231.8 Hard Disk Security Master Password.2241.9 Power.224

1.10 Exit	226
1.11 BIOS Defaulteinstellungen	.227
1.11.1 Main	227
1.11.2 Advanced	.227
1.11.3 Boot	231
1.11.4 Security	.231
1.11.5 Power.	.232
1.12 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)	.233
1.13 Ressourcenaufteilung	234
1.13.1 RAM-Adressbelegung	234
1.13.2 I/O-Adressbelegung	.234
1.13.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode	.234
1.13.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode	235
2 Upgradeinformationen	.236
2.1 BIOS Upgrade	236
2.1.1 Was muss ich wissen?	236
2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS	237
2.2 Firmwareupgrade	.239
2.2.1 Vorgangsweise	.239
2.2.2 Mögliche Upgradeprobleme und Softwareabhängigkeiten (für V1.02)	240
2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP	.241
2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files	243
2.4.1 Was wird benötigt	243
2.4.2 Vorgangsweise	243
2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?	243
2.5 So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files	244
2.5.1 Was wird benötigt?	244
2.5.2 Vorgangsweise	.244
2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?	244
3 Microsoft DOS	.245
3.1 Bestelldaten	245
3.2 Bekannte Probleme	245
4 Windows XP Professional	.246
4.1 Allgemeines	246
4.2 Bestelldaten	246
4.3 Übersicht	.246
4.4 Installation	.247
4.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06.	247
4.5 Treiber	.247
5 Windows 7	.248
5.1 Allgemeines	248
5.2 Bestelldaten	248
5.3 Übersicht	.248
5.4 Installation	.249
5.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06.	250
5.5 Eigenheiten, Einschränkungen	250
5.6 Treiber.	.250
6 Windows XP Embedded	251
6.1 Aligemeines	251
	251
6.3 UDErSICNT.	251
6.4 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007)	251
	252
0.0 Heibel	.202
0.0.1 I OUCHSCREENTREIDER.	.252
/ Windows Embedded Standard 2009	∠03 250
	∠03

7.2 Bestelldaten	
7.3 Übersicht	
7.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)	
7.5 Installation	
7.6 Treiber	
7.6.1 Touch Screen Treiber	
8 Windows Embedded Standard 7	
8.1 Allgemeines	255
8.2 Bestelldaten	
8.3 Übersicht	
8.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)	
8.5 Installation	
8.6 Treiber	
8.6.1 Touch Screen Treiber	
9 Windows CE	
9.1 Allgemeines	
9.2 Bestelldaten	
9.3 Übersicht	
9.4 Features Windows CE 6.0	
9.5 Was wird benötigt	
9.6 Installation	
9.7 B&R Embedded OS Installer	
10 Automation Runtime	
10.1 Allgemeines	
10.2 Bestelldaten	
10.3 Automation Runtime Windows (ARwin)	
10.4 Automation Runtime Embedded (ARemb)	
11 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center	
11.1 Funktionen	
11.2 Installation	
11.3 SDL Equalizer Einstellung	
11.4 USV Parametrierung	
11.4.1 Installation des USV Dienstes für die B&R Add-on USV	
11.4.2 Statuswerte der USV anzeigen	
11.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten	
11.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren	
11.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern	
11.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren	
11.4.7 Weitere USV Einstellungen ändern	
11.4.8 Ablauf bei einem Powerfail	
12 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit	
13 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK	
14 B&R Key Editor	
Kanital C Namman und Zulassungen	077
kapitel 5 Normen und Zulassungen	Z//
1 Richtlinien und Erklärungen	
1.1 CE- Kennzeichnung	
1.3 Niederspannungsrichtlinie	
2 Zulassungen	
2.2 GUS1-R	
Kapitel 6 Zubehör	270
1 Frestz CMOS Ratterien	270
1 1 0AC201 91 / 4A0006 00-000	
1 1 1 Allgemeines	

1.1.2 Bestelldaten	279
1.1.3 Technische Daten	279
2 Spannungsversorgungsstecker	281
2.1 0TB103.9x	281
2.1.1 Allgemeines	281
2.1.2 Bestelldaten	281
2 1 3 Technische Daten	281
3 DVI - Monitor Adapter	282
	282
3.2 Allgemeines	282
3.2 Augemeines	202
3.3 Destelluaten	202
	283
4.1 5AC900.1201-00	283
4.1.1 Aligemeines	283
	283
4.2 5AC900.1201-01	283
4.2.1 Allgemeines	283
4.2.2 Bestelldaten	283
5 Klemmblöcke	284
5.1 5AC900.BLOC-00	284
5.1.1 Allgemeines	284
5.1.2 Bestelldaten	284
6 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	285
6.1 Features	285
6.2 Was wird benötigt	285
6.3 5AC600.UPSI-00.	286
6.3.1 Allgemeines	286
6.3.2 Bestelldaten	286
6.3.3 Technische Daten	286
6.3.4 Montage	
6.4 5AC600.UPSB-00.	
6.4.1 Allgemeines	
6 4 2 Restelldaten	288
6.4.3 Technische Daten	288
6.4.4 Temperatur Lebensdauerdiagramm bis 20% Batteriekanazität	289
6 4 5 Tiefentladezyklen	289
6.4.6 Abmessungen	200
6.4.7 Pohresbahlana	200
6.4.9 Montagovorashriftan	200
	290
	291
0.5. I Aligemeines	291
	291
	291
6.6 5AC600.UPSF-00	292
6.6.1 Allgemeines	292
6.6.2 Bestelldaten	292
6.7 5AC600.UPSF-01	292
6.7.1 Allgemeines	292
6.7.2 Bestelldaten	292
7 Externe USV	293
7.1 Allgemeines	293
7.2 Bestelldaten	293
8 PCI Einsteckkarten	295
8.1 5ACPCI.ETH1-01	295
8.1.1 Allgemeines	295
8.1.2 Bestelldaten	295

8.1.4 Treibersupport	. 296
8.1.5 Abmessungen	297
8.2 5ACPCI.ETH3-01	298
8.2.1 Allgemeines	. 298
8.2.2 Bestelldaten	298
8.2.3 Technische Daten	. 298
8.2.4 Treibersupport	. 299
8.2.5 Abmessungen	300
9 CompactFlash Karten	. 301
9.1 Allaemeines	. 301
9 2 Grundlagen	301
9 2 1 Elashtechnologie	301
9.2.2 Wear Leveling	301
0.2.3 Feblerkorrektur ECC	301
9.2.5 TEHEROTERIULEG	202
9.2.4 S.IVI.A.R. 1Support	202
	303
9.3.1 Aligemeines	303
9.3.2 Bestelldaten	303
9.3.3 Technische Daten	. 303
9.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	305
9.3.5 Abmessungen	305
9.3.6 Benchmark	. 306
9.4 5CFCRD.xxxx-04	307
9.4.1 Allgemeines	307
9.4.2 Bestelldaten	307
9.4.3 Technische Daten	. 307
9.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	309
9.4.5 Abmessungen	309
9.4.6 Benchmark	. 310
9.5 5CFCRD.xxxx-03	311
9.5.1 Allaemeines	311
952 Bestelldaten	311
953 Technische Daten	311
954 Temperatur Luftfeuchtediagramm	313
9.5.5 Abmessungen	313
9.6 Bekannte Probleme / Figenheiten	314
10 LISB Memory Sticks	315
10 1 5MMUSE 2048.00	215
10.1.1 Allgemeines	215
10.1.2 Postelldeten	215
10.1.2 Destelluaten	
10.1.3 Technische Daten	. 315
10.1.4 Temperatur Luttreuchtediagramm.	316
10.2 5MMUSB.xxxx-01	. 317
10.2.1 Allgemeines	317
10.2.2 Bestelldaten	317
10.2.3 Technische Daten	. 317
10.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	318
11 USB Media Drive	. 319
11.1 5MD900.USB2-02	. 319
11.1.1 Allgemeines	. 319
11.1.2 Bestelldaten	319
11.1.3 Schnittstellen	. 319
11.1.4 Technische Daten	. 319
11.1.5 Abmessungen	321
11.1.6 Abmessungen mit Frontklappe	. 321

11.2.1 Allgemeines	
11.2.2 Bestelldaten	
11.2.3 Technische Daten	
11.2.4 Abmessungen	
11.2.5 Lieferumfang	
11.2.6 Montage	
12 HMI Drivers & Utilities DVD	
12.1 5SWHMI.0000-00	
12.1.1 Allgemeines	
12.1.2 Bestelldaten	
12.1.3 Inhalt (V2.20)	
13 Kabel	
13.1 DVI Kabel	
13.1.1 5CADVI.0xxx-00	
13.2 SDL Kabel	
13.2.1 5CASDL.0xxx-00	
13.3 SDL Kabel mit 45° Stecker	
13.3.1 5CASDL.0xxx-01	
13.4 SDL Kabel flex	
13.4.1 5CASDL.0xxx-03	
13.5 SDL Kabel flex mit Extender	
13.5.1 5CASDL.0xx0-13	
13.6 USB Kabel	
13.6.1 5CAUSB.00xx-00	
13.7 RS232 Kabel	
13.7.1 9A0014.xx	
13.8 Versorgungskabel intern	
13.8.1 5CAMSC.0001-00	
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung	348
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung	348 348
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung.	348
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9 1 Vorgangsweise	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9.1 Vorgangsweise.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9.1 Vorgangsweise. 10 Buseinheit Einbau / Tausch. 10.1 Vorgangsweise.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9.1 Vorgangsweise. 10 Buseinheit Einbau / Tausch. 10.1 Vorgangsweise. 11 Adapter Einbau / Tausch 11 Adapter Einbau / Tausch	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9.1 Vorgangsweise. 10 Buseinheit Einbau / Tausch. 10.1 Vorgangsweise. 11 Adapter Einbau / Tausch. 11 Adapter Einbau / Tausch. 11 Vorgangsweise.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9.1 Vorgangsweise. 10 Buseinheit Einbau / Tausch. 10.1 Vorgangsweise. 11 Adapter Einbau / Tausch. 12.1 Vorgangsweise. 13 Adapter Einbau / Tausch. 14 Adapter Einbau / Tausch. 15.1 Vorgangsweise. 16 Buseinheit Einbau / Tausch. 17.1 Vorgangsweise. 18 Adapter Einbau / Tausch. 19 Vorgangsweise bei dem Adapter 5AC803.BC01-00. 11.1 Vorgangsweise bei dem Adapter 5AC803.BC01-00.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel. 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9.1 Vorgangsweise. 10 Buseinheit Einbau / Tausch. 10.1 Vorgangsweise. 11 Adapter Einbau / Tausch. 12 PCIec, Einsteckkarte Einbau / Tausch. 12 PCIec, Einsteckkarte Einbau / Tausch.	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9.1 Vorgangsweise. 10 Buseinheit Einbau / Tausch. 10.1 Vorgangsweise. 11 Adapter Einbau / Tausch. 11.1 Vorgangsweise bei dem Adapter 5AC803.BC01-00. 11.2 Vorgangsweise bei dem Adapter 5AC803.BC02-00. 12 PClec Einsteckkarte Einbau / Tausch. 12 Vorgangsweise	
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung. 1 Batteriewechsel 1.1 Batteriestatusermittlung. 1.2 Vorgangsweise. 2 Reinigung. 3 CompactFlash Tausch. 4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 4.1 Vorgangsweise. 5 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch. 5.1 Vorgangsweise. 6 Slide-in compact Adapter Montage. 6.1 Vorgangsweise. 7 Lüfter Kit Einbau / Tausch. 7.1 Vorgangsweise. 8 Montage des USV Moduls. 8.1 Montageanleitung. 9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit. 9.1 Vorgangsweise. 10 Buseinheit Einbau / Tausch. 10.1 Vorgangsweise. 11.1 Vorgangsweise bei dem Adapter 5AC803.BC01-00. 11.2 Vorgangsweise bei dem Adapter 5AC803.BC02-00. 12 PClec Einsteckkarte Einbau / Tausch. 12.1 Vorgangsweise.	348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 350 351 352 352 352 353 353 353 354 355 356 356 358 358 360 360 361 362 363 363 363 364 365

13 Seitendeckeldemontage	
13.1 PPC800 ohne Expansion	
13.2 PPC800 mit Expansion	
14 Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1	
14.1 Vorgangsweise	
Anhang A	369
1 Maintenance Controller Extended (MTCX)	360
1 1 Tomporaturübonyachung Lüfterregelung	
2 Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basishoard	371
3 Touch Screen AMT 5-Draht	372
3.1 Technische Daten	372
3.2 Temperatur Luftfeuchtediagramm	372
3.3 Reinigung	373
4 Dekorfolie	374
5 Blickwinkel	
6 Einbaukompatibilitäten	
6.1 Kompatibilitätsübersicht	
6.2 Kompatibilitätsdetails	
6.2.1 Beispiel	
6.2.2 5,7" Geräte	
6.2.3 10,4" Geräte	
6.2.4 12,1" Geräte	
6.2.5 15" Geräte	
6.2.6 17" Geräte	
6.2.7 19" Geräte	
6.2.8 21,3" Geräte	
7 Glossar	

Kapitel 1 • Allgemeines

1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
0.10 Preliminary	10.11.2009	Erste Version
1.00	10.05.2010	Abmessungszeichnungen der PPC800 Systemeinheiten korrigiert.
		Abschnitt "Temperatursensorpositionen" auf Seite 31 wurde erweitert.
		Abschnitt 11 "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 190 um einen weiteren Punkt ergänzt.
		Abschnitt 2.2 "Firmwareupgrade" auf Seite 239 wurde ergänzt.
		Abschnitt 2.1 "Temperaturangaben" auf Seite 28 wurde ergänzt.
		Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 32 wurde ergänzt.
		Abschnitt 2.3 "Leistungshaushalt" auf Seite 33 wurde ergänzt.
		 Abschnitt 2.4 "Blockschaltbilder" auf Seite 36 wurde ergänzt.
		Abschnitt 10 "Automation Runtime" auf Seite 260 wurde ergänzt.
		Abschnitt 2.5 "Serialnummernaufkleber" auf Seite 40 wurde ergänzt.
		Abschnitt 3.10 "Lüfter Kit" auf Seite 152 wurde ergänzt.
		 Abschnitt 1.1 "Temperaturüberwachung Lüfterregelung" auf Seite 369 wurde ergänzt.
		Abschnitt 11 "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 261 wurde ergänzt.
		 Abschnitt 6 "Touchkalibrierung" auf Seite 180 wurde ergänzt.
		Abschnitt 7 "Anschluss von USB Peripheriegeräten" auf Seite 181 wurde ergänzt.
		 Abschnitt 1.4 "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 161 wurde ergänzt.
		Abschnitt 1.3 "Einbaulagen" auf Seite 158 wurde ergänzt.
		Abschnitt 7 "Windows Embedded Standard 2009" auf Seite 253 wurde ergänzt.
		Abschnitt 5 "Anschlussbeispiele" auf Seite 168 wurde ergänzt.
		 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 277 wurde ergänzt.
		Der Dongle 1A4300.LZ1U wurde ergänzt, siehe Abschnitt B&R Automation Runtime USB Dongle.
		Technische Daten der Systemeinheiten 5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00 ergänzt.
		 Technische Daten der Abschnitte 13.2 "SDL Kabel" auf Seite 331, 13.3 "SDL Kabel mit 45° Stecker"
		auf Seite 334, 13.4 "SDL Kabel flex" auf Seite 337 und 13.5 "SDL Kabel flex mit Extender" auf Seite
		340 überarbeitet.
		 Warnung bezüglich dem Tausch von Batterien in Abschnittt 1.1 "0AC201.91 / 4A0006.00-000" auf Seite
		279 und 1 "Batteriewechsel" auf Seite 348.
		Abbildungen der Expansions, Optionen und Buseinheiten ergänzt.
		 CPU Boards 5PC800.B945-05, 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13 und 5PC800.B945-14 wurden ergänzt.
		• Beschreibung der Spannungsversorgung +24 VDC auf Seite 41 geändert USB Schnittstellenabde-
		ckungen (unverlierbar) 5AC900.1200-01, 5AC900.1200-02 und 5AC900.1200-03 im 6 "Zubehör" ergänzt.
		• Der PCI SATA RAID Controller 5ACPCI.RAIC-03 und die Ersatz PCI SATA RAID HDD 5ACPCI.RAIC-04
		wurde ergänzt.
		Abschnitt 8 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 184 wurde ergänzt.
1.01	04.02.2011	Die Bezeichnung "AR010" wurde auf "ARwin" geändert.
		Der Abschnitt "B&R Automation Studio 3.0 USB Dongle" wurde geändert in B&R Automation Runtime
		USB Dongle.
		• Die Bestellnummern 9A0003.02U, 1A4600.10, 1A4600.10-2, 1A4600.10-3 und 1A4600.10-4 wurden er-
		gänzt.
		Die Bestellnummer 1A4300.LZ1U wurde entfernt.
		B&R USB Memory Stick 5MMUSB.2048-01 wurde ergänzt, siehe Seite USB Memory Sticks.
		 "5AC801.HDDI-03" auf Seite 91 wurde ergänzt.
		 "5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 141 wurde ergänzt.
		 "5MMHDD.0250-00" auf Seite 147 wurde ergänzt.
		Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 27 wurde überarbeitet.
		5AC801.HDDI-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5MMHDD.0250-00 in den Abbildungen zu Umgebungstempe-
		raturen und in Tabelle "Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten" auf Seite 32 er-
		gänzt.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.02	20.05.2011	 Bestellnummern in Abbildung "1 Slot Buseinheiten" auf Seite 76, in Abbildung "2 Slot Buseinheiten" auf Seite 76 und in Abbildung 31 "Optionen", auf Seite 88 korrigiert. Abschnitte "Windows 7" auf Seite 248, "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 255, "Windows CE" auf Seite 258, "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 273 ergänzt. SRAM Information für "5ACPCC.MPL0-00" auf Seite 82 ergänzt. BIOS Version aktualisiert (1.15 -> 1.17) Abschnitte "Automation Runtime" auf Seite 260, "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 271, "B&R Key Editor" auf Seite 275 und "HMI Drivers & Utilities DVD" auf Seite 325 überarbeitet. Lebensdauer der Batterie korrigiert. Chipset Information der "CPU Boards 945GME" auf Seite 27 überarbeitet. Information zu "Pixelfehler" auf Seite 189 ergänzt.
1.03	25.07.2011	 USB 5 in Überschrift ergänzt ("USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)" auf Seite 47). Kurzbeschreibung von 5AC801.HDDI-02 und 5AC801.HDDI-03 in Tabelle Tab. 31 "Slide-in compact Slot" auf Seite 53 korrigiert. Tabelleneintrag "typ. Ladezeit bei Low Battery" in Tabelle Tab. 220 "5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten" auf Seite 288 ergänzt. Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 261, "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 271 und "B&R Automation Device Interface (ADI) NET SDK" auf Seite 273 überarbeitet. Abschnitt "Windows XP Professional" auf Seite 246 überarbeitet. "Information:" zur Installation in Abschnitt "Windows 7" auf Seite 248 ergänzt. Information zu "Windows XP Mode" in Abschnitt "Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)" auf Seite 256 korrigiert. Verweis auf die externe USV 24 VDC in Abschnitt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" auf Seite überarbeitet. Abschnitte "Seitendeckeldemontage" auf Seite 366, "5CAMSC.0001-00" auf Seite 347 und "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 371 ergänzt. "Leistungskalkulation PPC800 15"" auf Seite und "Leistungskalkulation PPC800 19"" auf Seite überarbeitet. Abschnitt "CompactElash Tausch" auf Seite 361 ergänzt
1.04	29.09.2011	 Die Temperaturen beim Betrieb ohne Lüfter wurden bei den CPU Boards 5PC800.B945-10 und 5PC800.B945-11 auf 35°C, bei den CPU Boards 5PC800.B945-12 und 5PC800.B945-13 auf 45°C korri- giert, siehe "Umgebungstemperatur für CPU Boards 5PC800.B945-1x und 5PC800.B945-05" auf Seite 30.
1.05	21.10.2011	Der Abschnitt "Kartennummernschalter" auf Seite 85 der POWERLINK Einsteckkarte 5ACPCC.MPL0-00 wurde überarbeitet.
1.10	24.04.2012	 Abschnitt 9 "CompactFlash Karten" auf Seite 301 wurde überarbeitet. Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" in 4 "Software" verschoben. Abschnitt "Temperatursensorpositionen" in 2 "Technische Daten" verschoben. Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 168 wurde aktualisiert. Folgende Abschnitte wurden in 7 "Wartung / Instandhaltung" ergänzt: "Montage des USV Moduls" auf Seite 358, "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 356, "SAC900.BLOC-00" auf Seite 284, "Adapter Einbau / Tausch" auf Seite 363, "Buseinheit Einbau / Tausch" auf Seite 362, "Vorgangsweise" auf Seite 365, "Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch" auf Seite 353, 354, "Vorgangsweise" auf Seite 352, "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 367; Das Kapitel "Normen und Zulassungen" auf Seite 372 wurde aktualisiert. Abschnitt "Reinigung" auf Seite 350 ergänzt. Abschnitt 3 "Touch Screen AMT 5-Draht" auf Seite 372 wurde im A "Anhang A" ergänzt. Neue CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden im 6 "Zubehör" ergänzt - die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 wurden abgekündigt. BIOS Version aktualisiert (1.13 -> 1.18). Die Informationen zum Automation Device Interface und Key Editor wurden aktualisiert. Gesamtes Handbuch gemäß den aktuellen Formatierungsvorgaben überarbeitet.
1.11	13.07.2012	Der Abschnitt "Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung" auf Seite 42 wurde ergänzt. "Option" wurde in "Adapter" umbenannt.
1.12	06.09.2012	Die Tabelle Tab. 10 "Leistungskalkulation PPC800 19"" auf Seite 35 wurde korrigiert (Text Backlight Display 15" auf Backlight Display 19" geändert).

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung								
1.15	04.02.2013	 Der Abschnitt "Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests" auf Seite 164 wurde ergänzt. Windows 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows 7" auf Seite 248). Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 255). SSD Laufwerke "5AC801.SSDI-01" auf Seite 100 und "5AC801.SSDI-02" auf Seite 103 wurden ergänzt. Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 261 wurde aktualisiert. Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 271 wurde auf Version 3.40 aktualisiert. Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 273 wurde auf Version 1.80 aktualisiert. Der "B&R Key Editor" auf Seite 275 wurde auf Version 3.30 aktualisiert. Die Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 27 wurde geändert. Die Technischen Daten der CPU Boards wurden aktualisiert - siehe "CPU Boards 945GME" auf Seite 66. Die CompactFlash Karte 5CFCRD.032G-06 wurde ergänzt, siehe Abschnitt "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite 303. Das USB Media Drive "5MD900.USB2-02" auf Seite 319 wurde ergänzt. 								
1.16	13.03.2013	 Folgende Laufwerke wurden ergänzt: "5AC801.HDDI-04" auf Seite 94, "5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 144, "5MMHDD.0500-00" auf Seite 149. Die allgemeinen Informationen der Laufwerke "5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 141 sowie "5MMHDD.0250-00" auf Seite 147 wurden überarbeitet. Die Bestelldaten der Systemeinheiten "5PC820.1505-00" auf Seite 54 und "5PC820.1906-00" auf Seite 60 wurden ergänzt. 								
1.17	18.03.2013	 Der Abschnitt "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 255 wurde überarbeitet. Neue CompactFlash Karten (8 GBvte) wurden im 6 "Zubehör" ergänzt. 								
1.18	15.05.2013	 Das Add-on Sicherungs Kit "5AC600.UPSF-00" auf Seite 292 sowie die Ersatz Sicherungen "5AC600.UPSF-01" auf Seite 292 für die USV Batterieeinheit wurden ergänzt. Das Laufwerk"5AC801.SSDI-03" auf Seite 106 wurde hinzugefügt. Die Ersatz SSDs"5MMSSD.0060-00" auf Seite 114, "5MMSSD.0060-01" auf Seite 116 und "5MMSSD.0180-00" auf Seite 121 wurden ergänzt. Die technischen Daten der HDD "5AC801.HDDI-04" auf Seite 94 wurden aktualisiert. Änderung der Umgebungstemperaturtabellen im Abschnitt "Temperaturangaben" auf Seite 28 								
1.20	20.08.2013	 Der USB Memory Stick 5MMUSB.4096-01 wurde ergänzt, siehe "USB Memory Sticks" auf Seite 315. Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-04" auf Seite 108 wurde ergänzt. Die Ersatz SSD "5MMSSD.0128-01" auf Seite 118 wurde ergänzt. Das Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben im Abschnitt "Kabel" auf Seite 328 wurde ergänzt. Die Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 271 und "B&R Automation Device Interface (ADI). NET SDK" auf Seite 273 wurden aktualisiert. 								
1.25	17.02.2014	 Die Beschreibung "Montage des USV Moduls" auf Seite 358 wurde überarbeitet. Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-05" auf Seite 111 wurde ergänzt. Die Ersatz SSD "5MMSSD.0256-00" auf Seite 123 wurde ergänzt. Die technischen Daten sowie die Temperatur-Luftfeuchtediagramme der SSDs "5AC801.SSDI-04" auf Seite 108 und "5MMSSD.0128-01" auf Seite 118 wurden erweitert. Die Information zur Abkündigung für den Support des Betriebssystems "Windows XP Professional" auf Seite 246 wurde hinzugefügt. Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 261 wurde aktualisiert. Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 271 wurde aktualisiert. Das "B&R Automation Device Interface (ADI) NET SDK" auf Seite 273 wurde aktualisiert. Der "B&R Key Editor" auf Seite 275 wurde auf Version 3.40 aktualisiert. Die Abschnitte Kabellängen und Auflösungen wurden erweitert, siehe "Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung" auf Seite 42 und "Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung" auf Seite 43. Die GOST-R Zertifizierung wurde bei den Technischen Daten ergänzt. Der Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 168 wurde aktualisiert. Der Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 168 wurde aktualisiert. 								

Tabelle 1: Handbuchhistorie

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- Elektrische Baugruppen mit Gehäuse ... benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse ... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!
- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

2.5 Montage

- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedienund Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Allgemeines • Sicherheitshinweise

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterien & Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Karton/Papier Verpackung	Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial	Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sach- schäden.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

4 Richtlinien



Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
über 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

Tabelle 4: Nennmaßbereiche

5 Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
	Adapter	
5AC803.BC01-00	PPC800 Adapter 1 PCI Express compact.	78
5AC803.BC02-00	PPC800 Adapter 1 Slide-in compact.	78
	Automation Runtime	
1A4600.10-2	B&R Automation Runtime ARwin, ARNC0	260
1A4600.10-3	B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	260
1A4600.10-4	B&R Automation Runtime ARwin+ARNC0+PVIControls	260
1A4600.10-5	B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber	260
1A4601.06-5	B&R Automation Runtime ARemb, inkl. Lizenzaufkleber	260
9A0003.02U	USB Port Button Holder DS9490B	260
	Batterieeinheiten	
9A0100.12	USV Batterieeinheit Typ A, 24 V, 7 Ah, inkl. Batteriekäfig	293
9A0100.14	USV Batterieeinheit Typ B, 24 V, 2,2 Ah, inkl. Batteriekäfig	293
9A0100.16	USV Batterieeinheit Typ C, 24 V, 4,5 Ah, inkl. Batteriekäfig	293
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this	279
	shipment qualify as "partly regulated". Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact	
	cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	279
	Buseinheiten	
5AC803.BX01-00	PPC800 Bus 1 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.	76
5AC803.BX01-01	PPC800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.	76
5AC803.BX02-00	PPC800 Bus 2 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.	76
5AC803.BX02-01	PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.	76
	CPU Boards	
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME;	66
	2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME;	66
	2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME;	66
	2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-03	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2	66
	Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller R1L8111B.	
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo 1/400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 66/ MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME;	66
500000 0045 05	2 Sockel für SO-Dilvim DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realter Einemet Controller R1L8111B.	00
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHZ, Single-Core, 533 MHZ FSB, 512 KByte L2 Cache, Chipsatz 945GME; 2 Sockal für SO DIMM DDP2 Modula (max, Auchau in Summa 3 GByte), Poaltak Ethernet Controller PTI 8111C	66
5PC800 P045 10	Intel Core Duo L 2400 CDI L Board 1.66 CHz, Dual Core .667 MHz ESB, 2 MByte L 2 Cache: Chipsatz 945CME: 2	66
JF C000.B943-10	Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max Ausbau in Summe 3 GBvte) Realtek Ethernet Controller RTI 8111C	00
5PC800 B945-11	Intel Core2 Duo I 7400 CPU Board 1 5 GHz Dual-Core 667 MHz ESB 4 MByte I 2 Cache: Chinsatz 945GME: 2	66
01 0000.0040 11	Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GBvte). Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	00
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1.06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MBvte L2 Cache: Chipsatz 945GME:	66
	2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2	66
	Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME;	66
	2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	CompactFlash	
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	311
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	311
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	307
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	303
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	311
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	303
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	311
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	307
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	303
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	311
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	307
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	303
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	311
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	307
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	303
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	311
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	307
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	303
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	311
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	307
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	303
	DVI Kabel	
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1.8 m.	328
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	328
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	328

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung Einsteckkarten	auf Seite
5ACPCC ETH0-00	PCIec Ethemet Card 1x 10/100/1000 Für APC820 und PPC800	80
5ACPCC MPI 0-00	PCIec POWERI INK Card 2 POWERI INK Schnittstellen 512 kByte SRAM: für APC820 und PPC800	82
	Ersatzbatterien	
9A0100.13	USV Batteriesatz Typ A (Ersatzteil), 2x 12 V, 7 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.12	293
9A0100.15	USV Batteriesatz Typ B (Ersatzteil), 2x 12 V, 2,2 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.14	293
9A0100.17	USV Batteriesatz Typ C (Ersatzteil), 2x 12 V, 4,5 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.16	293
5AC803.SX01-00	PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus 5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforder- lich)	71
5AC803.SX02-00	PPC800 Expansion 2 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus 5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforder- lich).	71
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	281
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	281
	nauptspeicner	70
	SO-DIMM DDR2 RAW 121 WByte PC23500	70
5MMDDR 2048-01	SO-DIMIN DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	70
50000DDT.2040-01	Kühlkörper	10
5AC803.HS00-00	PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	69
5AC803.HS00-01	PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	69
5AC803.HS00-02	PPC800 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	69
5AC801 ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot	125
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk. Slide-in.	129
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk. Slide-in.	132
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	86
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	89
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	91
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	94
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	126
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	96
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	100
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	103
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	106
5AC801.55DI-04	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	100
5ACPCI RAIC-03	PCI RAID System SATA 2x 160 GByte: Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk	136
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hardnick	139
5ACPCI RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte: Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk	141
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte: Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	144
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	147
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	149
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	114
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	116
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	118
5MMSSD.0180-00	180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	121
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	123
5AC803.FA01-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten ohne Expansion.	152
5AC803.FA02-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX01-00.	153
5AC803.FA03-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX02-00.	155
	MS-DOS	
9S0000.01-010	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	245
9S0000.01-020	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. RS232 Kabel	245
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displaveinheit mit Touch Screen. 1.8 m.	345
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displaveinheit mit Touch Screen. 5 m.	345
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m. SDL Kabel	345
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	331
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	331
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	331

Produkthezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Soito
		aul Seite
5CASDL.0150-00		331
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, Zu m.	331
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	331
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	331
	SDL Kabel 45° Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	334
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	334
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	334
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	334
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	337
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	337
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	337
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	337
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex. 20 m.	337
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex. 25 m.	337
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex. 30 m.	337
5CASDL 0300-13	SDI Kabel flex mit Extender 30 m	340
5CASDL 0400-13	SDI Kabel flex mit Extender 40 m	340
5CASDL 0/30-13	SDL Kabal flav mit Extender, 13 m	340
5CASDE.0450-15	Sobertage	340
54 C000 1000 00	Adapter DV// (Stiff) auf CBT (Bushas). Zum Apashluss since Standard Menitem an since DV// I Schnittetalle	202
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Sill) au CKT (buchse). Zum Anschuss eines Standard-Nonitors an eine DVI-I Schnittsteile.	202
55VVHIVII.0000-00		325
50,000,1505,00		- 1
5PC820.1505-00	Panel PC 820 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistu); Anschlusse für 1x RS232, 5x USB 2:0, Smart	54
	oder 2 PCI / PCI Express Steckplätzen, ontionaler PCI Express compact und Slide in compact Steckplatz:	
	Schutzart IP65 (frontseitig): 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme)	
	0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	
5PC820.1906-00	Panel PC 820 19" SXGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv): Anschlüsse für 1x RS232, 5x USB 2.0.	60
	Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x Ethernet 10/100/1000, HDA Sound, Add-On USV Steckplatz, erweiterbar	
	mit 1 oder 2 PCI / PCI Express Steckplätzen, optionaler PCI Express compact und Slide-in compact Steckplatz;	
	Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme:	
	0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	344
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	344
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00,	323
	5MD900.0582-01 und 5MD900.0582-02.	
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Lautwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactHash Slot (Typ II), USB	319
	Anschluss (Typ A frontsettig, Typ B rucksettig); 24 VDC, (Schraubklemme UTB103.9 oder Federzügklemme	
EMMUED 2048 00	UID 103.91 gesoliteit bestelleri)	215
5MMUO3B.2048-00	USD 2.0 Memory Study, 2040 MDyte DBD	313
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	317
5MIMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	317
	USV Modul 24 VDC	
9A0100.11	USV 24 VDC, 24 VDC Eingang, 24 VDC Ausgang, serielle Schnittstelle	293
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	288
5AC600.UPSF-00	USV Sicherungs Kit für Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision D0.	292
5AC600.UPSF-01	USV Sicherung, 5 Stück	292
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0),	286
	5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0),	
	SPC600.SAU5-01 (db Rev. F0), SPC600.SF05-00 (db Rev. A0), SPC610.SA . SPC620.IS05-00, SPC820.1006-00 Kabal (SCALIPS 0005.00 hzw SCALIPS 0030.00) und Batteriepinetit (SCAC00.IDSP.00).	
	sind senarat zu bestellen	
5CAUPS 0005-00	UISV Kabel 0.5 m. für UISV 5AC600 UPSI-00	291
5CALIPS 0030-00	USV Kabel 3 m fir USV 50-600 UPSL00	291
	Windows 7 Professional/Illitimate	201
5SWW17.0100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit DVD. Englisch Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	248
55WW17.0100 CEP	Microsoft CEM Windows 7 Professional 32 bit, DVD, Englisher: Elefenting nur in Verbindung mit einem Gerät.	240
55WW17.0100-GER	Microsoft OEM Wildows 7 Professional 62 bit DVD, Bedisch Lieferung nur in Verbindung mit ainem Grat	240
55WW17.0200-ENG	Microsoft CEM Wildows / Floressional 64 Dit, DVD, Englisch, Elefening null in Verbindung mit einem Gerät.	240
55WWWI7.0200-GER	INITIOUSUIT OLIVI VVIITUOWS / FTUIESSIUTAL04-DIT, DVD, DEUTSUIT, LIETETUNG NUF IN VErbindung mit einem Gerat.	240
	Initio Sont OLIVI Windows 7 Ontinate 32-Dit, DVD, Wultilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.	240
55VVVI7.0400-IVIUL	INIGIOSON OEINI VVIIIGOWS / Olumate о4-ыт, DVD, Multilanguage. Liererung nur in Verbindung mit einem Gerat.	248
5SWW17.1100-ENG	MICrosoft OEM Windows / Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung	248
58\444/17 1100 CEP	Microsoft OEM Windows 7 Professional 22 Bit, Sanviss Deak 1, DVD, Deutsch, Lieferung nur in Verhindung	249
53WW17.1100-GER	mit einem Gerät	240
5SWWI7 1200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit Service Pack 1 DVD Englisch Lieferung nur in Verbindung	248
	mit einem Gerät.	210
5SWWI7.1200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung	248
	mit einem Gerät.	
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung	248
	mit einem Gerät.	
5SWWI7.1400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung	248
	mit einem Gerat.	

Allgemeines • Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
	Windows CE 6.0	
5SWWCE.0827-ENG	Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MByte).	258
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0727-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; Compact- Flash separat bestellen (mind. 1 GByte).	253
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0527-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; Compact- Flash separat bestellen (mind. 8 GByte).	255
5SWWI7.0627-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; Compact- Flash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.0727-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; für PPC800 mit 945GME Chip- satz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	255
5SWWI7.0827-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Multilanguage; für PPC800 mit 945GME Chip- satz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.1527-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.1627-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.1727-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.1827-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
	Windows XP Embedded	
5SWWXP.0427-ENG	Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; Com- pactFlash separat bestellen (mind. 512 MByte).	251
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0500-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	246
5SWWXP.0500-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	246
5SWWXP.0500-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	246
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	246
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	246
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	246
	Zubehör	
5AC900.1201-00	USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 flach	283
5AC900.1201-01	USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 bombiert	283
5AC900.BLOC-00	Klemmblock mit Schwingen, 10Stk; Ersatzteil	284
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	295
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	298
5CAMSC.0001-00	Versorgungskabel intern	347

Kapitel 2 • Technische Daten

1 Einleitung

Der Panel PC 800 deckt einen weiten Performancebereich vom effizienten Intel Atom N270 Prozessor bis hin zu Core2 Duo Prozessoren für Applikationen mit höchsten Performanceansprüchen ab. Brillante 15" XGA und 19" SXGA Displays ermöglichen in Verbindung mit Touch Screens eine intuitive und einfache Benutzerführung. Die Flexibilität bei der Zusammenstellung des PPC800 wurde auf eine neue Stufe gestellt. So können auf Basis des kostenoptimierten Grundgerätes eine Vielzahl von Optionen gewählt werden. Dazu gehören bis zu zwei PCI und PCI Express Steckplätze, modulare Laufwerke, zusätzliche Interfaces und eine integrierte USV. Chipset, Prozessor und weitere Komponenten werden über wärmeleitfähige Materialien unmittelbar mit dem Kühlkörper verbunden. Dadurch ist es möglich, nicht nur die Atom Prozessoren lüfterlos zu betreiben, sondern auch ausgewählte Dual Core Prozessoren.



1.1 Features

- 15" und 19" Diagonale
- Neueste Prozessortechnologien Core Duo, Core 2 Duo, Celeron M und Atom N270
- Bis zu 3 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)
- 2 CompactFlash Steckplätze (Typ I)
- Erweiterbare Expansion mit 1 oder 2 Steckplätzen für PCI / PCI Express (PCIe) Karten und einem Slide-in Laufwerk Steckplatz
- 1 optionaler PCIec (PCI Express compact) Card Slot (durch Adapter erweiterbar)
- 1 optionaler Slide-in compact Steckplatz (durch Adapter erweiterbar)
- 5x USB 2.0
- 2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen
- 1x RS232 Schnittstelle, modemfähig
- 24 VDC Versorgungsspannung
- BIOS (AMI)
- Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)
- Einfacher Slide-in Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fähig)
- HDA Sound
- Add-on USV Steckplatz

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist möglich das PPC800 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustellen.

Für den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

- Systemeinheit
- CPU Board
- Kühlkörper (CPU Board abhängig)
- Hauptspeicher
- Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) für das Betriebssystem
- Software

1.2.1 Konfiguration - Grundsystem



Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem

Kapitel 2 Technische Daten

	Konfiguration - optionale Ko	omponenten						
Adapter ¹⁾	Konfiguration einer System 1 oder beide auswählen	einheit mit Adapte	er					
	540000 000							
	5AC803.BC01	-00	5	AC803.BC02-00				
				_ \				
	PClec Einsteckkarten, 1 au	swählen	Slide-in compa	act Laufwerke, 1 auswäh				
	5ACPCC.ETH0-00		5AC80	1.HDDI-00 (40 GByte)				
	(PClec Ethernet Card 10/10	0/1000)	5AC80	1.SSDI-03 (60 GByte)				
	(PCIec POWERLINK MN 2)	port)	5AC80	1.SSDI-04 (128 GByte)				
Sal -	(*		5AC80	1.SSDI-05 (256 GByte)				
	Konfiguration einer System	einheit mit Expans	sion					
Expansion	keine Expansion	1 PCI/PCIe + 1 Slide-in Slot 2 PCI/PCIe + 7						
		5AC803	.SX01-00	5AC803.SX02-00				
Buseinheiten		1 auswählen		1 auswählen				
in in	/							
		5AC803	.BX01-00	5AC803.BX02-00				
		5AC803	.BX01-01	5AC803.BX02-01				
Lüfter Kit ²⁾	1 auswählen	1 auswählen		1 auswählen				
	5AC803.FA01-00	5AC803	.FA01-00	5AC803.FA01-00				
Slide-in Laufwerke		1 auswählen						
		5AC801.HDDS-00 (40 GByte)						
		5AC801.DVDS-0 5AC801 DVBS-0) (DVD Laufwerk)				
		5/	5AC801.ADAS-00 (Adapter)					
RAID System		1 auswählen						
- 199 B	/	EACDO		0 GByta balact (DOL O				
		5ACPCI. 5MMHDI	D.0500-00 (ZX 50	SATA-HDD 500 GRvtr				
CompactFlash	1 auswählen							
Successor	5CFCRD.0512-06, 5C	FCRD.1024-06,	5CFCRD.00	064-03, 5CFCRD.0128-0				
	5CFCRD 8192-06 5C	FCRD.4096-06,	50FCRD 10	200-03, 5CFCRD.0512-0)24-03, 5CFCRD 2048-0				
	5CFCRD.032G-06	5	5CFCRD.4	096-03, 5CFCRD.8192-0				
USV Batterie	1 auswählen							
	5AC600 UPSI-00 (Add	-on USV Modul)	5AC600 UPSB	00 (USV Batterieeinheit				
	Verbindungskabel: 5C	Verbindungskabel: 5CAUPS.0005-00 (0.5 Meter) oder 5CAUPS.0030-00 (3 Me						
		(*	,					
Spannungsversorgungsst.	1 auswahlen							
		0TB103.9 (S	Schraubklemme)				
		018103.91 (rederzugklemn	ne)				
Software	1 auswählen							
	Windows XP	Vindows Embed	ded Standard 2	2009 Automation Run				
Windows	55WWXP.0500-ENG 5	50000AP.U/2/-El	NG	1A4001.06-5 1A4600 10-5				
Nindows Embedded	5SWWXP.0500-MUL	Vindows XP Emb	bedded					
Standard 2009	5SWWXP.0600-ENG	0600-ENG 5SWWXP.0427-ENG Microsoft DOS						
Vindows Embedded	5SWWXP.0600-GER	Vindows CE		9S0000.01-010				
	SVVVXP.0600-MUL	SWWCE.0827-E	NG	9\$0000.01-020				
Windows ⁷	5SWWI7.1100-ENG	Vindows Embed	ded Standard 7	,				
Automation Runtime	5SWWI7.1100-GER 5	SWWI7.1527-EN	G					
Automation Automation	5SWWI7.1200-ENG 5	SWWI7.1627-EN	G					
	5SWWI7.1200-GER 5	SWWI7.1727-MU	JL					
	5S\A/\A/I7 1300_MUU 5	SWWI7 1827-ML	JL .					
	5SWWWW.1500-WOL	0111111021 1110						

Abbildung 2: Konfiguration - optionale Komponenten

2 Gesamtgerät

2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Möglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. in Abhängigkeit von Systemeinheit und Lüfter Kit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Tabellen bedingt durch diese Komponenten, einen Überblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resultierenden, maximal möglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen für den Betrieb mit und ohne Lüfter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows höhere Umgebungstemperaturen erzielt werden können. Die diesbezügliche Prüfung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

- Thermal Analysis Tool (TAT V3.8) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung
- BurnIn Testtool (BurnIn V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenauslastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Slide-in Laufwerke, USB Schnittstellen, Audioausgänge)
- Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

· Betrieb des Gesamtgerätes mit oder ohne Lüfter Kit

2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur

Information:

Die erlaubten Einbaulagen sind zu beachten, siehe Kapitel "Inbetriebnahme", Abschnitt "Einbaulagen" auf Seite 158.

2.1.1.1 Umgebungstemperatur für CPU Boards 5PC800.B945-0x

		Be	Betrieb ohne Lüfter Kit		Betrieb mit Lüfter Kit								
		ET	ETH1: bis 100 MBit Betrieb				ETH1: bis 100 MBit Betrieb						
		E	H2: Dis					<u>- 1H2: b</u>		it Betrie	eD		
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN.	.B945-00	.B945-01	.B945-02	.B945-03	.B945-04	.B945-00	.B945-01	.B945-02	.B945-03	.B945-04		
	Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungs- temperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800	5PC800		
	Maximale Umgebungstemperatur	30	30	35	35	1	45	45	50	50	35	c.	eich
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?											Temperaturgrenze	Sensor(en) im Ber
	On-Board CompactFlash ¹⁾	1	✓	1	✓		1	1	1	1	1	80	
	5AC801.HDDI-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	80	
	5AC801.HDDI-02	1	1	1	1		1	1	1	1	1	80	
	5AC801.HDDI-03	1	✓	1	✓		1	1	1	1	1	60)))))))))))))))))))
	5AC801.HDDI-04	1	✓	1	√		1	1	1	1	1	60	
Slide-in com-	5AC801.SSDI-00	1	✓	1	√		1	1	1	1	1	70	
pact Laufwerke	5AC801.SSDI-01	1	✓	1	✓		1	1	1	✓	1	70	ard F
	5AC801.SSDI-02	1	✓	1	1		1	1	1	✓	1	70	Bog
	5AC801.SSDI-03	1	1	1	1		1	1	1	✓	1	70	
	5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0	1	✓	1	√		1	1	1	1	1	70	
	5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. D0	1	✓	1	√		1	1	1	1	1	80	
	5AC801.SSDI-05	1	✓	1	√		1	1	1	1	1	80	
	5AC801.HDDS-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	80	c –
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	1	✓	1	√		1	1	1	1	1	50	ive .
	5AC801.DVRS-00	1	1	1	✓		1	1	1	1	1	50	12 L
	5MMDDR.0512-01	1	1	1	1		1	1	1	1	1	-	
Hauptspeicher	5MMDDR.1024-01	1	✓	1	√		1	1	1	1	1	-	
	5MMDDR.2048-01	1	1	1	✓		1	1	1	1	1	-	
	5PC820.1505-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	80	teil
Systemeinheiten	5PC820.1906-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	80	Vetz
	5ACPCC.ETH0-00	1	✓	1	✓		1	1	1	✓	1	-	
	5ACPCC.MPL0-00	1	1	1	1		1	1	1	✓	1	-	Inter
Zusatzsteckkarten	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	1	✓	1	√		1	1	1	✓	1	-	ckka
PCIec Card Slot	5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		1	1	1	1	1	-	zstei
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		1	1	1	1	1	-	Isatz
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		1	1	1	1	1	-	Ъ.

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 5: Umgebungstemperaturen

2.1.1.2 Umgebungstemperatur für CPU Boards 5PC800.B945-1x und 5PC800.B945-05

Information:

Die erlaubten Einbaulagen sind zu beachten, siehe Kapitel "Inbetriebnahme", Abschnitt "Einbaulagen" auf Seite 158.

		Betrieb ohne Lüfter Kit				Betrieb mit Lüfter Kit									
		ETH1: bis 1 GBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb				ETH1: bis 1 GBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb									
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN.	3945-10	3945-11	3945-12	3945-13	3945-14	3945-05	3945-10	3945-11	3945-12	3945-13	3945-14	3945-05		
	Herabsenkung (Derating) der maxi- malen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5PC800.E	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F	5PC800.F		
	Maximale Umgebungstemperatur	35	35	45	45	1	55	45	45	55	55	45 ¹⁾	60	5	eich
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?													Temperaturgrenze	Sensor(en) im Ber
	On-Board CompactFlash ²⁾	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	80	
	5AC801.HDDI-00	1	1	1	1		1	1	1	1	\checkmark	1	1	80	
	5AC801.HDDI-02	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	80	Board Power
	5AC801.HDDI-03	1	1	1	1		45	1	1	50	50	1	50	60	
	5AC801.HDDI-04	1	1	1	1		45	1	1	50	50	1	50	60	
Slide-in com-	5AC801.SSDI-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	70	
pact Laufwerke	5AC801.SSDI-01	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	70	
pact Laufwerke	5AC801.SSDI-02	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	70	
	5AC801.SSDI-03	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	70	
	5AC801.SSDI-04 ≤ Rev. C0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	70	
	5AC801.SSDI-04 ≥ Rev. D0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	80	
	5AC801.SSDI-05	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	80	
	5AC801.HDDS-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	80	
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	1	1	1	1		50	1	1	50	50	1	50	50	ive-ii
	5AC801.DVRS-00	1	1	1	1		50	1	1	50	50	1	50	50	19 P
	5MMDDR.0512-01	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	-	
Hauptspeicher	5MMDDR.1024-01	1	1	1	1		1	1	1	1	✓	1	1	-	
	5MMDDR.2048-01	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	-	
	5PC820.1505-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	80	teil
Systemeinheiten	5PC820.1906-00	30	30	35	35		45	1	1	50	50	1	50	et 08 0	
	5ACPCC.ETH0-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	-	
	5ACPCC.MPL0-00	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	-	Itten
Zusatzsteckkarten	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		1	1	1	1	√	1	1	-	skka
PClec Card Slot	5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	ste
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		45	1	1	50	50	1	50	-	satz
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard)	1	1	1	1		45	1	1	50	50	1	50	-	Zu

1) Die angegebene Temperatur ist nur für das CPU Board 5PC800.B945-14 mit dem Kühlkörper 5AC803.HS00-01 Rev > A5 gültig.

Wird ein Kühlkörper kleinerer Revision verwendet, so ist die maximale Umgebungstemperatur des CPU Boards 5PC800.B954-04 anzuwenden. 2) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 6: Umgebungstemperaturen

2.1.1.3 Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur?

- 1. Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Lüfter Kit).
- 2. Die Zeile "Maximale Umgebungstemperatur" zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern ü. NN.

3. Sind im PPC800 System zusätzlich Laufwerke (Slide-in), Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschränkung besteht.

lst bei der verbauten Komponente ein "✓" (Häkchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. "50", so darf die Umgebungstemperatur des gesamten PPC800 Systems diese nicht überschreiten.

2.1.2 Minimale Umgebungstemperaturen

Die minimalste Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten bei +5°C: 5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00. Wird keine der genannten Komponenten verwendet so liegt die minimalste Umgebungstemperatur bei 0°C.

2.1.3 Temperaturüberwachung

Sensoren überwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (Board I/O, Board ETH2, Board Power, Power Supply, Slide-in Laufwerk 1, IF-Slot) im PPC800. Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung "Temperatursensorpositionen" auf Seite 31 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle dar. Beim Überschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausgelöst. Die Temperaturen¹) können im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhältlichen Hard Disks für PPC800 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es können verschiedene Parameter, wie z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen (außer Windows CE) ausgelesen werden.

2.1.4 Temperatursensorpositionen

Sensoren überwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen im PPC800. Die Temperaturen können im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) oder unter Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center²⁾ ausgelesen werden.

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.



Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position	Messpunkt für Messung					
1	Board I/O	Temperatur des Board I/O Bereiches (Sensor am Baseboard).	80°C			
2	Board ETH2	Temperatur des Baseboards im Bereich des ETH2 Controllers (Sensor am Baseboard).	80°C			
3	Board Power	Temperatur des Board Netzteils (Sensor am Baseboard).	80°C			
4	Power Supply	Temperatur des Netzteils.	80°C			
-	Slide-in Drive 1	Temperatur eines Slide-in Laufwerks (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert).	abhängig vom verwen- deten Slide-in Laufwerk			
-	IF-Slot	Temperatur des PCIec-Einschubs; der Sensor befindet sich direkt auf der Einsteckkarte.	abhängig von der ver- wendeten Einsteckkarte			

Tabelle 7: Temperatursensorpositionen

¹⁾ Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

²⁾ Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die für die Einschränkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerätes von Bedeutung sind. Für die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch größte Wert zu verwenden.

Komponente		Betrieb	Lagerung / Transport		
CPU Boards 945GME COM Express		10 bis 90%	5 bis 95%		
Hauptspeicher für CPU Boards		10 bis 90%	5 bis 95%		
	5AC801.HDDI-00	5 bis 90%	5 bis 95%		
	5AC801.HDDI-02	8 bis 80%	5 bis 95%		
	5AC801.HDDI-03	5 bis 95%	5 bis 95%		
	5AC801.HDDI-04	5 bis 95%	5 bis 95%		
Slide in compact Laufworks	5AC801.SSDI-00	5 bis 95%	5 bis 95%		
Side-in compact Laurwerke	5AC801.SSDI-01	5 bis 95%	5 bis 95%		
	5AC801.SSDI-02	5 bis 95%	5 bis 95%		
	5AC801.SSDI-03	8 bis 95%	8 bis 95%		
	5AC801.SSDI-04	8 bis 95%	8 bis 95%		
	5AC801.SSDI-05	8 bis 95%	8 bis 95%		
	5AC801.HDDS-00	5 bis 90%	5 bis 90%		
Slide-in Laufwerke	5AC801.DVDS-00	8 bis 90%	5 bis 95%		
	5AC801.DVRS-00	8 bis 90%	5 bis 95%		
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%		
	5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%		
Zupotzotookkortop	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%		
	5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%		
	5MMHDD.0250-00 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%		
	5MMHDD.0500-00 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%		
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06	85%	85%		
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04	85%	85%		
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03	8 bis 95%	8 bis 95%		
Zubehör	Memory Stick 5MMUSB.2048-00	10 bis 90%	5 bis 90%		
	Memory Stick 5MMUSB.xxxx-01	85%	85%		
	USB Media Drive 5MD900.USB2-01	20 bis 80%	5 bis 90% / 5 bis 95%		
	USB Media Drive 5MD900.USB2-02	20 bis 80%	5 bis 90% / 5 bis 95%		

Tabelle 8: Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.

Kapitel 2 Technische Daten

2.3 Leistungshaushalt

2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der PPC800 Spannungsversorgung dar.



Abbildung 4: Blockschaltbild Spannungsversorgung

Erläuterung

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese galvanisch getrennten 15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3 und 5 V auf den Bus gelegt. Beim 5 V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und legt diese auf den Bus. Ein zusätzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschließbare Add-on USV inklusive Batterieeinheit wird über 15 V versorgt und gewährleistet bei Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des 15 V Bus.

2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC820.1505-00

Information:				CPU	Vorliegendes System				
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Anga- ben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.			5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
		Add on LISV Modul, ontional	7.5	7.5				axiiiiai)	130
		Add-off 05V Modul, optional	1.5	1.5	7.5	1.5	1.5	1.0	
			14	14	14	14	14	14	75
		CDU Deard Finnerbraucher	26	20	10			14 TIZ V	19
		Arbeiteanaicher 542 MB may 2 Stück is 1 5 W	20	- 30	10	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 1024 MD max. 2 Stuck je 1,5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stuck je 2,5 W							
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stuck je 3 W		0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	
	>		2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	
	12	Externer Verbraucher, optional (uber Baseboard)	10	10	10	10	10	10	
	÷	Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W ²							
		Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
				1	1	Verbr	aucher ·	+12 V ∑	
				maximal möglich bei +5 V					65
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	4	4	4	4	
eil		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
stzt		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,)	4	4	4	4	4	4	
Itne		USB Peripherie USB1 und USB3 je 2,5 W							
sam		USB Peripherie USB2, USB4 und USB5 je 5 W							
Geo		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
	>	Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W ²)	-						
	+2	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max, 3 W ohne Lüfter Kit, max, 20 W mit Lüfter Kit))							
					may	vimal m	öalich h	oi -12 V	1 2
		Leistungsangabe PCLKarte, entional	-		ina/				1.4
		(max. 1,2 W ohne und mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		5 ·				Verb	raucher	-12 V ∑	
		Verbraucher +5 V ∑						•+5 V ∑	
		maximal möglich bei							40
		Systemeinheit, Fixverbraucher	9	9	9	9	9	9	
:		CompactFlash, je 1 W							
		Leistungsangabe PClec Karte, optional, max. 4 W ²⁾							
	3V3	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 15 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 10 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
			1	1	1	Ver	brauche	r 3V3 ∑	
		·			_		Verbrau	ucher Σ	

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

2) Die Gesamtleistung einer PClec Karte pro PClec Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 9: Leistungskalkulation PPC800 15"

Information: Die PClec Karte darf insgesamt (12V/5V/3V3) nur 4 W verbrauchen!

2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC820.1906-00

Information:		CPU Board						Vorliegendes System	
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Anga- ben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.			5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05	Werte in dieser Spalte Eintragen
			7.5	Leist	ung Ge	samtnet	zteli (m	aximai)	130
		Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
		Backlight Display 19	32	32	32	32	32	32	75
	Г	CDLL Board Eiverstrausbar	26	20	10			11 TIZ V	/5
		Arbeitespeicher 512 MB may 2 Stück in 1.5 W	20	- 30	10	14	43	11	
		Arbeitsspeicher 1024 MP may 2 Stück is 2 5 W							
		Arbeitsspeicher 1024 MB max, 2 Stück je 2,3 W							
		Albeitsspeichel 2040 MB Max. 2 Stuck je 5 W	24	24	24	24	24	2.4	
2	> -	Euter Rit, optional	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	
13	2	Leistungsangabe PClec Karte, entional max 4 W2	10	10	10	10	10	10	
	•	Leistungsangabe PCIEC Raite, optional							
		(max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 6 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCIe x1 Karte, optional (max. 3 W ohne Lüfter Kit, max. 20 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
			Verbraucher +12 V ∑						
				maximal möglich bei +5 V				ei +5 V	65
		Systemeinheit, Fixverbraucher	12	12	12	12	12	12	
teil		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	4	4	4	4	
etz		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,)	4	4	4	4	4	4	
mtu		USB Peripherie USB1 und USB3 je 2,5 W							
sai		USB Peripherie USB2, USB4 und USB5 je 5 W							
ŭ		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	5	5	5	5	
	>	Leistungsangabe PCIec Karte, optional, max. 4 W ²⁾							
1	÷	Leistungsangabe PCI Karte, optional							
	-	(max. 3 W onne Lutter Kit, max. 20 W mit Lutter Kit)				• •			10
		Little constants DOLIG to contract	1	1	max	limai mo	bgiich b	ei -12 V	1.2
		(max 1.2 W ohne und mit Lüffer Kit)							
						Vorbr	auchor	12 V T	
	H								
			maximal möglich hei 3V3						40
	Γ	Systemeinheit Fixverbraucher	9	9	9	9	9	9	- V
		CompactFlash ie 1 W		-					
		Leistungsangabe PClec Karte, optional, max, 4 W ²							
5/10	۰ <u>۲</u>	Leistungsangabe PCI Karte, optional (max 3 W ohne Lüfter Kit max 15 W mit Lüfter Kit) ¹⁾							
		Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional							
	-					Vort	rauche	r 2\/2 ⊤	
						ven	Verbrau	i Sv3 2	

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

2) Die Gesamtleistung einer PClec Karte pro PClec Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit und ohne Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 10: Leistungskalkulation PPC800 19"

Information: Die PClec Karte darf insgesamt (12V/5V/3V3) nur 4 W verbrauchen!

2.4 Blockschaltbilder

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten (5PC820.1505 / 5PC820.1906-00) mit einem 945GME CPU Board in Abhängigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.4.1 Buseinheit 5AC803.BX01-00



Abbildung 5: Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX01-00
2.4.2 Buseinheit 5AC803.BX01-01



Abbildung 6: Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX01-01

2.4.3 Buseinheit 5AC803.BX02-00



Abbildung 7: Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX02-00

2.4.4 Buseinheit 5AC803.BX02-01



Abbildung 8: Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX02-01

2.5 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerät wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um eine eindeutige Identifizierung des Gerätes zu ermöglichen. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem System verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lieferdatum und Garantieende) abgebildet.



Abbildung 9: Serialnummernaufkleber Rückseite

Diese Information kann auch über die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der Startseite <u>www.br-automation.com</u> die Serialnummer des Gesamtgerätes im Suchfeld einzugeben auf den Tab "Serialnummer" zu wechseln. Nach der Suche erhält man eine detaillierte Auflistung der verbauten Komponenten.

		Sprache (Österre	ich) Kontakt	Login	₩ AF210168454	📕 🚍 — Serialnummerneingabe
Unternehmen Branchen	Technologie Produkte	Veranstaltungen Ak	ademie K	arriere D	Materialnummer	z.B.: AF210168454
Produkte > Industrie PCs > Panel PC 800	> Systemeinheiten > 5PC820.1505-0	0		1	Serialnummer	wechseln auf den Tab
Produkte	Technische Daten	Basisinformationen	Zubehör	Dov	wnloads Serialnum	^{ner} "Serialnummer"
Industrie PCs						<i>n</i>
Automation PC 510	REKLAMATION ERS	TELLEN				
Automation PC 511						
Automation PC 810	Serialnummer:	AF210168454				
Automation PC 820	Materialnummer:	5PC820.1505	-00			
Automation Pagel 800	Revision:	A2				
Automation Panel 900	Auslieferungsdatur	n: *N/A				
Multitouch	Gewährleistungser	nde: *N/A				
Panel PC 300	"Kundenvereinbaru	ing untersagt die Ausgabe d	les Datums			
Dec al DO 700						
Panel PC 725	Dieses Material ist	Bestandteil eines konfigurie	erten Materials u	nd wurde in folge	ender Konfiguration ausgeliefert	
Panel PC 725 Panel PC 800	Dieses Material ist	Bestandteil eines konfigurie	erten Materials u	nd wurde in folge	ender Konfiguration ausgeliefert	_
Panel PC 725 Panel PC 800 Power Panel 300 Power Panel 500	Dieses Material isl	Bestandteil eines konfigurie MATERIAL	erten Materials u REVISION	nd wurde in folge LIEFERUNG	ender Konfiguration ausgeliefert GEWÄHRLEISTUNGSENDE	Auflistung der verbaute
Panel PC 725 Panel PC 800 Power Panel 300 Power Panel 500 Visualisieren und Bedienen	Dieses Material ist SERIAL B15B0168428	Bestandteil eines konfigurie MATERIAL 5PC8:220198.001-00	REVISION	nd wurde in folge LIEFERUNG *N/V	ender Konfiguration ausgeliefert GEWÄHRLEISTUNGSENDE *N/A	Auflistung der verbaute Komponenten nach der
Panel PC 725 Panel PC 800 Power Panel 300 Power Panel 500 Visualisieren und Bedienen Steuerungssysteme	Dieses Material isl SERIAL B15B0168428 AF210168454	Bestandteil eines konfigurie MATERIAL 5PC8:220198.001-00 5PC820.1505-00	REVISION C0 A2	nd wurde in folge LIEFERUNG *N/V *N/V	ender Konfiguration ausgeliefert GEWÄHRLEISTUNGSENDE *N/A *N/A	Auflistung der verbaute Komponenten nach der Serialnummernsuche
Panel FC 725 Panel FC 700 Power Panel 300 Power Panel 500 Visualisieren und Bedienen Steuerungssysteme V O Systeme VO Systeme	Dieses Material isl SERIAL B15B0168428 AF210168454 A3CA0169483	MATERIAL 5PC8:220198.001-00 5PC820.1505-00 5PC800.B945-00	REVISION C0 A2 C0	nd wurde in folge LIEFERUNG *N/V *N/V *N/V	ender Konfiguration ausgeliefert GEWÄHRLEISTUNGSENDE *N/A *N/A *N/A	Auflistung der verbaute Komponenten nach der Serialnummernsuche
Premer PC 725 Panet PC 600 Power Panet 300 Power Panet 300 Visualisieren und Bedienen Stauerungssysteme UG Systeme Sicherheltstechnik	Dieses Material Ist SERIAL B15B0168428 AF210168454 A3CA0169483 A3E50168807	Bestandteil eines konfiguri MATERIAL 5PC8:220198.001-00 5PC820.1505-00 5PC800.B945-00 5MMDDR.0512-01	REVISION C0 A2 C0 B0	nd wurde in folge LIEFERUNG *N/V *N/V *N/V *N/V	ender Konfiguration ausgeliefert GEWÄHRLEISTUNGSENDE *N/A *N/A *N/A *N/A	Auflistung der verbaute Komponenten nach der Serialnummernsuche
Premer PC / 25 Panel PC 800 Power Panel 300 Power Panel 300 Visualiseren und Bedienen Steuerungssysteme Uo Systeme Sicherheltstechnik Antriebstechnik	Dieses Material Ist SERIAL B15B0168428 AF210168454 A3CA0169483 A3C50168807 AF270168430	MATERIAL 5PC8:220198.001-00 5PC820.1505-00 5PC800.1945-00 5MMDDR.0512-01 5AC803.3X01-00	REVISION C0 A2 C0 B0 A0	LIEFERUNG *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V	ender Konfiguration ausgeliefert	Auflistung der verbaute Komponenten nach der Serialnummernsuche
Panel PC / 25 Panel PC 800 Power Panel 300 Power Panel 500 Yaualaiseren und Bedienen Steuerungssysteme Vio Systeme Sicherhelstechnik Antriebstechnik Netzwerke und Peldbus Module Software	Dieses Material Isl SERIAL B15B0168428 AF210168454 A3CA0169483 A3E50168807 AF270168430 AF290168515	MATERIAL 5PC8:220198.001-00 5PC820.1505-00 5PC800.8945-00 5MMDDR.0512-01 5AC803.8X01-00 5AC803.8X01-00	REVISION C0 A2 C0 B0 A0 A5	ILIEFERUNG *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V	ender Konfiguration ausgeliefert	Auflistung der verbaute Komponenten nach der Serialnummernsuche
Panel PC //25 Panel PC //25 Power Panel 300 Power Panel 500 Visualisieren und Bedienen Stelterungssysteme VO Systeme Sicherhelstechnik Antriebstechnik Netzwerke und Peldbus Module Software Prozessielflichenik	Dieses Material Isl SERIAL B1580168428 AF210168454 A3CA0169483 A3C50168007 AF270168430 AF290168515 AF220168475	Bestandlell eines konfiguri MATERIAL 5PC8 220198.001-00 5PC8220198.001-00 5PC800.1505-00 5PC800.1505-00 5PC800.1505-00 5PC800.1505-00 5PC800.1505-00 5PC800.1505-00 5PC800.1505-00 5AC803.8X01-00 5AC803.8X01-00 5AC803.0202-00	REVISION C0 A2 C0 B0 A0 A5	nd wurde in folge LIEFERUNG *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V	ender Konfiguration ausgeliefert	Auflistung der verbaute Komponenten nach der Serialnummernsuche
Panel PC / 25 Panel PC 600 Power Panel 500 Visualisieren und Bedienen Stateurungssysteme VO Systeme Sicherheitstechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Software Prozessleittechnik Stomwersorgungen	Dieses Material Isl SERIAL B15B0168428 AF210168454 A3CA0169483 A3E50168807 AF270168430 AF290168515 AF290168456 AF201168456	Bestandlell eines konfiguri MATERIAL SPC8 220198 001-00 SPC8 220198 001-00 SPC800 B945-00 SMMDDR 0512-01 SAC803 SX01-00 SAC803 SX01-00 SAC803 BC02-00 SAC803 BC02-00	REVISION C0 A2 C0 B0 A0 A5 A5	nd wurde in tolge LIEFERUNG *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V	ander Konfiguration ausgeliefert GEWÄHRLEISTUNGSENDE "N/A "N/A "N/A "N/A "N/A "N/A "N/A "N/A "N/A	Auflistung der verbaute Komponenten nach der Serialnummernsuche
Preiter FC / ZS Panel PC 200 Power Panel 300 Power Panel 300 Visualistere und Bedienen Steuerungssysteme VO Systeme Sicherheitstechnik Antriebstechnik Netzwerke und Feldbus Module Software Prozessleitlechnik Stromersorgungen Zubehör	Dieses Material Isl SERIAL B15B0168428 AF210168454 A3CA0169483 A3E50168807 AF270168430 AF290168515 AF220168456 AF200168456 AF200168456	MATERIAL SPC8-220198.001-00 SPC8-220198.001-00 SPC820.1506-00 SPC8000.08945-00 SMMDDR.0512-01 SAC803.8X01-00 SAC803.8X01-00 SAC803.8X01-00 SAC803.02.00 SAC803.02.00 SAC803.02.00	REVISION C0 A2 C0 B0 A0 A5 A5 A0	nd wurde in folge LIEFERUNG *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V *N/V	ender Konfiguration ausgeliefert GEWAHRLEISTUNGSENDE *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	Auflistung der verbaute Komponenten nach der Serialnummernsuche

Abbildung 10: Beispiel Serialnummernsuche

2.6 Geräteschnittstellen und Einschübe

2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best. Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem PPC800 Gehäuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (15A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung, keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

	Spannungsversorg	ung
	verpolungssicher	3-polig, male
Pin	Beschreibung	
1	+	Spannungsversorgung + 24 VDC
2	Funktionserde	
3	-	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	321

Tabelle 11: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

2.6.1.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist möglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu empfehlen, den größt möglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Die PPC800 Systeme besitzen auf der Hinterseite rechts oben einen Erdungsanschluss.



Abbildung 11: Erdungsanschluss

Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes oder der Anlage in der der PPC800 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5 mm²) gewählt werden.

2.6.2 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

	Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link) / DVI						
Die nachfolgende Übersicht ze	eigt einen Überblick der möglichen verfügbaren Videosi-						
gnale beim Monitor / Panel Au	sgang. Details siehe Technische Daten des verwende-						
ten CPU Boards.							
CPU Board	Videosignale mit allen Systemeinheitenvarianten						
5PC800.B945-00 / -10	RGB, DVI, SDL						
5PC800.B945-01 / -11	RGB, DVI, SDL						
5PC800.B945-02 / -12	RGB, DVI, SDL						
5PC800.B945-03 / -13	RGB, DVI, SDL						
5PC800.B945-04 / -14	RGB, DVI, SDL						
5PC800.B945-05	RGB, DVI, SDL						

Tabelle 12: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegeräte am Monitor / Panel Anschluss wird nicht unterstützt.

Information:

Bei der RGB- Schnittstelle handelt es sich um ein analoges Signal, die mögliche Leitungslänge ist von der Auflösung sowie den herrschenden Umwelteinflüssen abhängig. Daher wird der Einsatz dieser Schnittstelle nur für Servicezwecke empfohlen.

2.6.2.1 Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung	
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect	
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)	
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)	
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1	
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)	
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)	
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair	DVI 24-polig, female
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)	
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)	
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	ANALOG RED	Analog Red	
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	ANALOG GREEN	Analog Green	
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	ANALOG BLUE	Analog Blue	
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	ANALOG HORZ SYNC	Analog Horizontal Synchro- nization	
14	+5 V Power ¹⁾	+5V Power Supply	C5	ANALOG GND	Analog ground (Return for R, G and B signals)	
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground				

Tabelle 13: Pinbelegung DVI Anschluss	s
---------------------------------------	---

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

2.6.2.2 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel	Auflösung					
Sogmontlängo [m]	VGA		XGA	SXGA	UXGA	FHD
Segmentiange [m]	640 X 480	800 X 600	1024 X 768	1280 X 1024	1600 X 1200	1920 X 1080
	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
1,8	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
5	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03

Tabelle 14: Kabellängen	und Auflösungen bei SDL	Übertragung
-------------------------	-------------------------	-------------

SDL Kabel	Auflösung					
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03		- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	-	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	-	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 14: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

2.6.2.3 Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des DVI Kabels:

DVI Kabel	Auflösung					
	VGA SVGA		XGA	SXGA	UXGA	FHD
Segmentlänge [m]	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080
1,8	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00
5	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00

Tabelle 15: Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

Die maximale Kabellänge bei der DVI Übertragung ist aufgrund der USB Spezifikation auf 5 m begrenzt.

2.6.3 Serielle Schnittstelle COM1

	Serielle Schnittstelle COM1 ¹⁾						
	RS232						
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt						
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO						
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 115 kBaud						
Kabellänge	max. 15 Meter	9-poliger DSUB Stecker					
Pin	Belegung						
1	DCD						
2	RXD	0 0					
3	TXD						
4	DTR	9 0 0					
5	GND	5					
6	DSR						
7 RTS							
8	CTS						
9	RI						

Tabelle 16: Pinbelegung COM1

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.4 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

	Ethernet 1 Anschluss (ETH1 ¹⁾)						
Controller	Realtek RT	L8111B/C ²⁾	RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female				
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)					
Übertragungsgeschwindig- keit	10/100/1000 MBit/s ³⁾						
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)					
Speed LED	Ein	Aus					
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s4)					
Orange	1000 MBit/s	-					
Link LED	Ein	Aus					
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netz- werk ist vorhanden) Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)		Link LED				



1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Bei den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 ist der Realtek 8111B integriert.

Bei den CPU Boards 5PC800.B945-05 und 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 ist der Realtek 8111C integriert.

3) Umschaltung erfolgt automatisch.

4) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Realtek Ethernet-Controllers RTL8111B/C ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.5 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

Ethernet 2 Anschluss (ETH2 ¹)						
Controller	Intel 8	82574	RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female			
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)				
Übertragungsgeschwindig- keit	10/100/1000 MBit/s ²⁾		1			
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)				
Speed LED	Ein	Aus				
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ³⁾				
Orange	1000 MBit/s	-				
Link LED	Ein	Aus				
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netz- werk ist vorhanden)	Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)	Link LED			



1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.

3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.6 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)

Die PPC800 Geräte verfügen über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 5 nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1,2,3,4

Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4 ¹⁾)			
Тур	USB 2.0	4x USB Typ A, female	
Ausführung	Тур А	USB1 USB2	
Übertragungsgeschwindig- keit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)		
Strombelastbarkeit ²⁾			
USB1, USB3	max. 1 A	The second secon	
USB2, USB4	max. 500 mA		
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	USB3	
		USB1 USB2	
		A STATE AND A STATE OF	
		the second designed	
		USB3 USB4	
		00000	
		USB4	
· · ·		·	

Tabelle 19: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.

USB5

Universal Serial Bus (USB5) ¹⁾			
Тур	USB 2.0	1x USB Typ A, female	
Ausführung	Тур А		
Übertragungsgeschwindig-	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12	LISB front	
keit	MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	USB HOIL	
Strombelastbarkeit ²⁾			
USB5	max. 1 A		
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)		

Tabelle 20: USB5 Anschluss

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 1 A) abgesichert.

2.6.7 CompactFlash Slot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines PPC800 Systems und ist intern über IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF1)				
Anschluss	PATA Master			
CompactFlash				
Тур	Тур І			
Bestellnummer	Kurzbeschreibung			
	CompactFlash			
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R			
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1024 MByte B&R	CompactFlash Slot 1		
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2048 MByte B&R			
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4096 MByte B&R			
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8192 MByte B&R			
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R			
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R			
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte WD			
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte WD	-===		
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte WD			
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte WD			
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1024 MByte WD			
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2048 MByte WD			
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4096 MByte WD			
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8192 MByte WD			

Tabelle 21: CompactFlash Slot (CF1)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.8 CompactFlash Slot 2

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines PPC800 Systems und ist intern über IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF2)			
Anschluss	PATA Slave		
CompactFlash			
Тур	Тур І		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung		
	CompactFlash		
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R		
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1024 MByte B&R	CompactFlash Slot 2	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2048 MByte B&R	Compact hash oldr 2	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4096 MByte B&R		
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8192 MByte B&R		
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R		
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R		
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte WD		
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte WD		
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte WD	HEESSAGGGG P	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte WD		
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1024 MByte WD		
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2048 MByte WD		
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4096 MByte WD		
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8192 MByte WD		

Tabelle 22: CompactFlash Slot (CF2)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.9 MIC, Line IN, Line OUT

Bei allen PPC800 Systemen ist ein HDA kompatibler Soundchip vorhanden bei dem die Kanäle MIC, Line IN und Line OUT von außen zugänglich sind.

MIC, Line IN, Line OUT			
Controller	Realtek ALC 662	3,5 mm Klinkenanschluss, female	
MIC	Anschluss eines Mono Mikro- fon über 3,5 mm Klinkenstecker.		
Line IN	Einspeisung eines Stereo Line In Si- gnals über 3,5 mm Klinkenstecker.		
Line OUT	Anschluss eines Stereo Wiedergabegerätes (z.B. Verstärker) über einen 3,5 mm Klinkenstecker.	Line OUT Line IN MIC	

Tabelle 23: MIC, Line IN, Line OUT

Treibersupport

Für den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.10 Add-on USV Steckplatz

An diesem Steckplatz kann ein optionales Automation PC Add-on USV Modul montiert werden.

Add-on USV Steckplatz			
Pinbelegung bei montierten	n Add-on USV Modul		
1	+	$0^{-0^{-0^{-0^{-0^{-0^{-0^{-0^{-0^{-0^{-$	
2	+	r\$\$" + +	
3	-		
4	-		
5	NTC (für Batterietemperaturmessung)		
6	NTC (für Batterietemperaturmessung)	And a state of the	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	and the second	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung		
5AC600.UPSI-00	Add-on USV Modul		
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5 Ah		
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m		
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m		

Tabelle 24: Add-on USV Steckplatz

Informationen zum USV Modul siehe "Zubehör" auf Seite 279.

2.6.11 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstützung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitäten.



Tabelle 25: Power Taster

2.6.12 Reset Taster



Tabelle 26: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.6.13 Status LEDs

Die Status LEDs befinden sich auf der Rückseite der Systemeinheit.

Status LEDs			
LED	Farbe	Status	Bedeutung
Power	Grün	Ein	Spannungsversorgung OK
	Rot	Ein	Das System befindet sich im Stromspar- Stand- by Modus (S5: Soft-off Modus; S4: Hibernate Mo- dus-Suspend-to-Disk oder S3: Suspend-to-RAM)
	Orange ¹⁾	Ein	Spannungsversorgung nicht OK; das System läuft im Batteriebetrieb.
	Rot-Grün	Blinkend	Servicefunktion für MTCX Upgrade: ein rot- grün blinkendes Power LED signalisiert einen fehler- haften oder unvollständigen MTCX Upgrade. Der MTCX läuft mit dem Firmwarestand zum Zeit- punkt der Auslieferung des Gerätes. Kann z.B.: durch einen Power Fail während eines MTCX Up- grades auftreten. Ein MTCX Upgrade ist erneut auszuführen.
HDD	Gelb	Ein	Signalisiert einen IDE Laufwerkszugriff (CF, HDD, CD, usw.)
Link	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Monitor / Panel Stecker an.
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung wurde durch ei- nen Spannungsverlust der Displayeinheit unter- brochen.
Run	Grün	Ein	Applikation läuft
		Aus	Applikation läuft nicht



Kapitel 2 Technische Daten

Tabelle 27: Status LEDs

1) Leuchtet nur bei installierter Add-on USV.

2.6.14 CMOS Profile Schalter

CMOS Profile Schalter			
Mit dem 16 stelligen CMOS F profile eingestellt werden.	Profile Schalter können verschiedene BIOS Defaultwerte-		
Schalterstellung	Beschreibung		
0	Profil 0: Defaultprofil reserviert.	6 9 9 4	
1	Profil 1: Optimiert für die Systemeinheiten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX03-00	ink	
2	Profil 2: Optimiert für die Systemeinheit 5PC810.SX05-00	103 °	
3	Profil 3: Optimiert für die Systemeinheiten 5PC820.SX01-00 und 5PC820.SX01-01		
4	Profil 4: Reserviert	Drofile	
5	Profil 5: Optimiert für die Systemeinheiten 5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00	Profile	

Tabelle 28: CMOS Profile Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte für dieses System dar und sollte daher nicht geändert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im B&R ADI Control Center angezeigt.

2.6.15 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) sowie die individuell gespeicherten BIOS Einstellungen sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie beträgt mindestens 2½ Jahre (bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie			
Batterie		Batterie	
Тур	Renata 950 mAh		
Tauschbar	Ja, von außen zugänglich		
Lebensdauer	2½ Jahre ¹⁾		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Line OU ^r	
	Batterien	MOS	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	rofile	
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	Battery	
L			

Tabelle 29: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung	
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.	
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.	
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.	

Tabelle 30: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

2.6.16 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern über SATA I mit dem Chipset verbunden.

Slide-in compact Slot			
Anschluss	SATA I		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung		
	Adapter		
5AC803.BC02-00	PPC800 Adapter 1 Slide-in compact		
	Laufwerke		
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	Slide-in compact	
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	Ladiwerk	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.		
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact, 24/7 Hard Disk Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.		
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact		
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact		
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact		
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact		
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact		
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact		

Tabelle 31: Slide-in compact Slot

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

2.6.17 PCIec Steckplatz (Card Slot)

PCIec Steckplatz		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	PCIec Card Slot
	Adapter	
5AC803.BC01-00	PPC800 Adapter 1 PCI Express compact	
	Einsteckkarten	
5ACPCC.ETH0-00	PCIec Ethernet Card 1x 10/100/1000	
5ACPCC.MPL0-00	PClec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen,	Anne
	512 KByte SRAM	
		and the second s

Tabelle 32: PCIec Steckplatz

Information:

Für die Verwendung von PClec Einsteckkarten ist der Adapter 5AC803.BC01-00 zwingend erforderlich.

Information:

Es dürfen nur B&R PCIec Karten verwendet werden, welche speziell für den Automation PC 820 und Panel PC 800 konstruiert wurden.

Nähere Informationen siehe "PCIec Einsteckkarten" auf Seite 79.

3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

3.1.1 5PC820.1505-00

3.1.1.1 Allgemeines

- 15" TFT XGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Robustes Design
- Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- 1 optionaler PCI express compact Slot
- 1 optionaler Slide-in compact Slot
- Optionale PCI und PCIe Steckplätze sowie optionale Slide-in Laufwerke, erweiterbar durch Expansions

3.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC820.1505-00	Panel PC 820 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 5x USB 2.0, Smart Display Link/DVI/ Monitor, 2x Ethernet 10/100/1000, HDA Sound, Add-On USV Steckplatz, erweiterbar mit 1 oder 2 PCI / PCI Express Steck- plätzen, optionaler PCI Express compact und Slide-in com- pact Steckplatz; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklem- me: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	- 0
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Kühlkörper	
5AC803.HS00-00	PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC803.HS00-01	PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC803.HS00-02	PPC800 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Lüfter Kit	
5AC803.FA01-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten ohne Expansion.	

Tabelle 33: 5PC820.1505-00 - Bestelldaten

Kapitel 2 Technische Daten

Bostollnummor	Kurzhoschroihung
Desteinnunnner	Ontionalos Zubobör
	Adaptor
5AC803 BC01 00	PPC800 Adapter 1 PCI Express compact
5AC803.BC01-00	PPC800 Adapter 1 PCI Expless compact.
5AC603.BC02-00	PPC800 Adapter 1 Silde-In compact.
54 0000 DV04 00	Duseinneiten DD0000 Dire 4 D01 4 Olide in Stanbulate
5AC803.BX01-00	PPC800 Bus 1 PCI, 1 Silde-In Steckplatz.
5AC803.BX01-01	PPC800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-In Steckplatz.
5AC803.BX02-00	PPC800 Bus 2 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.
5AC803.BX02-01	PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.
	Einsteckkarten
5ACPCC.ETH0-00	PCIec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Für APC820 und PPC800.
5ACPCC.MPL0-00	PCIec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512 kByte SRAM; für APC820 und PPC800.
	Expansions
5AC803.SX01-00	PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus 5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforderlich).
5AC803.SX02-00	PPC800 Expansion 2 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus 5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforderlich).
	Laufwerke
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in,
5AC801.HDDI-00	40 GBvte SATA Hard Disk. Slide-in compact: 24/7 Hard Disk
	mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
	tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
	Lüfter Kit
5AC803.FA02-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX01-00.
5AC803.FA03-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX02-00.
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinhei- ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
	G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
	(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Tabelle 33: 5PC820.1505-00 - Bestelldaten

3.1.1.3 Schnittstellen



Abbildung 12: 5PC820.1505-00 - Vorderansicht



Abbildung 13: 5PC820.1505-00 - Rückansicht

Warnung!

Die Befestigungsschrauben des Kühlkörpers dürfen keinesfalls gelöst werden, da der Kühlkörper über eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbunden ist. Wird diese Verbindung zerstört, muss der B&R Industrie PC ins Werk zur Reparatur geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch gelöst (gesichert durch ein Siegel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist möglich, dass die Oberflächentemperatur des Kühlkörpers im Betrieb auf 70°C (Warnhinweis "Heiße Oberfläche") ansteigen kann.

3.1.1.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC820.1505-00
Allgemeines	
LEDs	Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code	\$AF21
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power-Taster	Ja
Reset-Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS

Tabelle 34	: 5PC820	.1505-00 -	Technische Daten
------------	----------	------------	------------------

Kapitel 2 Technische Daten

Produkthezeichnung	5PC820 1505-00
Power Fail Logik	
Controller	MTCY 1)
Dufforzoit	10 ms
	10 115
Galik	abbängig vom versupridaten CDU Daard
Speicher	
lyp	abhangig vom verwendeten CPU Board
Größe	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
CompactFlash Slot 2	
Тур	Тур І
USB	
Anzahl	5
Тур	USB 2.0
Ausführung	Τγρ Α
Übertragungsrate	Low Speed (1.5 MBit/s). Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	ie Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter R.145 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Typ	HDA Sound
Fingänge	Mikrofon Lino In
Diamley	
Display	
Тур	IFI Farbe
Diagonale	15" (381 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Kontrast	550:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 60°
vertikal	Richtung U = 45° / Richtung D = 55°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	250 cd/m ²
Half Brightness Time 2)	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Түр	Accu Touch
Technologie	analog, resistiv
Controller	Elo. seriell. 12 Bit
Transmissionsgrad	81% +3%
Einschübe	
PCI Slots	
Anzahl	1 bzw 2 (optional) 4)
PCIe Slots	
Anzahl	1 5)
PCIec Slots	
Δητομ	ontional 6)
	Uptivital **
	komponentenaphangig (von der verwendeten Expansion und Buseinneit)
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 10 A, max. 50 A für < 300 µs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Fallhöhe	1 m auf Industrieboden (in Originalverpackung)
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig
	IP65, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig

Tabelle 34: 5PC820.1505-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5PC820.1505-00	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	komponentenabhängig	
Lagerung	-20 bis 60°C	
Transport	-20 bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	10 bis 85%, nicht kondensierend	
Lagerung	$T \leq 40^{\circ}C$: 5 bis 90%, nicht kondensierend	
	$T > 40^{\circ}C$: < 90%, nicht kondensierend	
Transport	$T \le 40^{\circ}C$: 5 bis 90%, nicht kondensierend	
	T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 0,5 g	
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 1 g	
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g	
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g	
Schock		
Betrieb	15 g, 11 ms	
Lagerung	30 g, 15 ms	
Transport	30 g, 15 ms	
Mechanische Eigenschaften		
Gehäuse		
Material	Metall	
Front		
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert	
Design	grau	
Dekorfolie		
Material	Polyester	
Farbe heller Hintergrund	ähnlich Pantone 427CV	
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung	
Abmessungen		
Breite	435 mm	
Höhe	330 mm	
Tiefe	komponentenabhängig	
Gewicht	5500 g (komponentenabhängig)	

Tabelle 34: 5PC820.1505-00 - Technische Daten

1) Maintenance Controller Extended.

2) 3)

Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken. Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

4) Die PCI Slots sind abhängig von der verwendeten Expansion und Buseinheit.

5) Die PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Expansion und Buseinheit.

6) 7) Optional mit dem PClec Adapter 5AC803.BC01-00.

Optional mit dem Slide-in compact Adapter 5AC803.BC02-00.

3.1.1.5 Abmessungen



Abbildung 14: 5PC820.1505 - Abmessungen

3.1.1.6 Wanddurchbruch



Abbildung 15: 5PC820.1505-00 - Wanddurchbruch

3.1.2 5PC820.1906-00

3.1.2.1 Allgemeines

- 19" TFT SXGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Robustes Design
- Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- 1 optionaler PCI express compact Slot
- 1 optionaler Slide-in compact Slot
- Optionale PCI und PCIe Steckplätze sowie optionale Slide-in Laufwerke, erweiterbar durch Expansions

3.1.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC820.1906-00	Panel PC 820 19" SXGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 5x USB 2.0, Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x Ethernet 10/100/1000, HDA Sound, Add- On USV Steckplatz, erweiterbar mit 1 oder 2 PCI / PCI Express Steckplätzen, optionaler PCI Express compact und Slide-in compact Steckplatz; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Ste- cker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraub- klemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	
	CPU Reards	
5DC900 D045 05	Lintel Atom N270 CDU Reard 1.6 CHz, Single Core, 522 MHz	
JF C000.B943-03	FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	0
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5WIMDDR.0512-01	SU-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR 2048-01	SO-DIMINI DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
JWWDDR.2040-01	Kühlkörner	
5AC803.HS00-00	PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC803.HS00-01	PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC803.HS00-02	PPC800 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
5AC803.FA01-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten ohne Expansion	
	Optionales Zubehör	
	Adapter	
5AC803.BC01-00	PPC800 Adapter 1 PCI Express compact.	
5AC803.BC02-00	PPC800 Adapter 1 Slide-in compact.	
	Buseinheiten	

Tabelle 35: 5PC820.1906-00 - Bestelldaten

Kapitel 2 Technische Daten

Kurzbeschreibung
PPC800 Bus 1 PCI 1 Slide-in Steckplatz
PPC800 Bus 1 PCI Express 1 Slide-in Steckplatz
PPC800 Bus 2 PCI. 1 Slide-in Steckplatz.
PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.
Einsteckkarten
PClec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Für APC820 und PPC800.
PCIec POWERLINK Card. 2 POWERLINK Schnittstellen. 512
kByte SRAM; für APC820 und PPC800.
Expansions
PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforderlich).
PPC800 Expansion 2 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforderlich).
Laufwerke
SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.
DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.
DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.
40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.
500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
40 CPuto SATA Hord Diak. Slido in: 24/7 Hord Diak mit onuoi
40 GByle SATA Hard Disk, Silde-III, 24/7 Hard Disk Till erwei- tertem Temperaturbereich, Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.
128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
Lüfter Kit
PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX01-00.
PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion
5AC803.SX02-00.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinhei-
ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
FU), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. FU), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
(5CALIPS 0005-00 hzw 5CALIPS 0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Tabelle 35: 5PC820.1906-00 - Bestelldaten

3.1.2.3 Schnittstellen



Abbildung 16: 5PC820.1906-00 - Vorderansicht



Abbildung 17: 5PC820.1906-00 - Rückansicht

Warnung!

Die Befestigungsschrauben des Kühlkörpers dürfen keinesfalls gelöst werden, da der Kühlkörper über eine thermische Kopplung mit Prozessor und Chipset verbunden ist. Wird diese Verbindung zerstört, muss der B&R Industrie PC ins Werk zur Reparatur geschickt werden. Werden die Schrauben dennoch gelöst (gesichert durch ein Siegel) erlischt jegliche Garantie.

Es ist möglich, dass die Oberflächentemperatur des Kühlkörpers im Betrieb auf 70°C (Warnhinweis "Heiße Oberfläche") ansteigen kann.

3.1.2.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC820.1906-00
Allgemeines	
LEDs	Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code	\$AF22
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power-Taster	Ja
Reset-Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS

Tabelle 36: 5PC820.1906-00 - Technische Daten

Kapitel 2 Technische Daten

Produkthezeichnung	5PC820 1906-00
Power Fail Logik	
Controller	
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board
Speicher	
Tvn	abhängig vom verwendeten CPU Board
Größe	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Τνρ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
CompactFlash Slot 2	
Тур	Тур І
USB	
Anzahl	5
Тур	USB 2.0
Ausführung	Тур А
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Austührung	geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Audio	
Typ	HDA Sound
Eingange	Mikroton, Line in
Ausgange	Line Out
Display	
Typ Diagonals	
Diagonale	19" (480 mm)
Farben	16 MIO.
Autiosung	SXGA, 1280 X 1024 Bildpunkte
Kontrast	900:1
Blickwinkei	Diabturg D / Diabturg L = 95°
nonzonia	Richlung R / Richlung L = 65
	Kichtung 0 / Kichtung D – 65
Helligkeit	300 cd/m ²
Half Brightness Time 2)	50 000 h
Tvn	Accu Touch
Technologie	analog, resistiv
Controller	Elo, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	81% ±3%
Einschübe	
PCI Slots	
Anzahl	1 bzw. 2 (optional) 4)
PCIe Slots	
Anzahl	1 5)
PCIec Slots	
Anzahl	optional ⁶⁾
Slide-in Laufwerke	komponentenabhängig (von der verwendeten Expansion und Buseinheit)
Slide-in compact Laufwerke	optional 7)
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 10 A, max. 50 A für < 300 μs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Fallhöhe	1 m auf Industrieboden (in Originalverpackung)
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig
	IP65, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig

Tabelle 36: 5PC820.1906-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5PC820.1906-00	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	komponentenabhängig	
Lagerung	-20 bis 60°C	
Transport	-20 bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	10 bis 85%, nicht kondensierend	
Lagerung	T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend	
	T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend	
Transport	$T \le 40^{\circ}C$: 5 bis 90%, nicht kondensierend	
	$T > 40^{\circ}C$: < 90%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 0,5 g	
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 1 g	
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g	
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g	
Schock		
Betrieb	15 g, 11 ms	
Lagerung	30 g, 15 ms	
Transport	30 g, 15 ms	
Mechanische Eigenschaften		
Gehäuse		
Material	Metall	
Front		
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert	
Design	grau	
Dekorfolie		
Material	Polyester	
Farbe heller Hintergrund	ähnlich Pantone 427CV	
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung	
Abmessungen		
Breite	527 mm	
Höhe	421 mm	
Tiefe	komponentenabhängig	
Gewicht	10000 g (komponentenabhängig)	

Tabelle 36: 5PC820.1906-00 - Technische Daten

1) Maintenance Controller Extended.

2) 3)

Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken. Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

4) Die PCI Slots sind abhängig von der verwendeten Expansion und Buseinheit.

5) Die PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Expansion und Buseinheit.

6) 7) Optional mit dem PClec Adapter 5AC803.BC01-00.

Optional mit dem Slide-in compact Adapter 5AC803.BC02-00.

Kapitel 2 Technische Daten

3.1.2.5 Abmessungen



Abbildung 18: 5PC820.1906-00 - Abmessungen

3.1.2.6 Wanddurchbruch





3.2 CPU Boards 945GME

3.2.1 Allgemeines

- AMI BIOS
- Intel[®] 945GME Chipsatz
- 2x DDR2 Speichersockel
- Dual Channel Memory
- Intel® GMA 950
- Gigabit Ethernet

3.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-03	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 37: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 38: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Bestelldaten

3.2.3 Technische Daten 5PC800.B945-0x

Produktbezeichnung	5PC800.B945-00	5PC800.B945-01	5PC800.B945-02	5PC800.B945-03	5PC800.B945-04	5PC800.B945-05
Allgemeines						
Zertifizierungen						
CE			J	а		
cULus	-	-	-	-	-	Ja
GOST-R	-	-	-	Ja	-	Ja
GL	-	-	-	-	-	Ja ²⁾
Controller	_					
Boot-Loader			embedded	AMI BIOS		
Prozessor						
Тур	Intel® Core™	Intel® Core™2	Intel® Core™2	Intel® Cele-	Intel® Core™2	Intel®
	Duo L2400	Duo L7400	Duo U7500	ron® M 423	Duo T7400	Atom™ N270
Taktfrequenz	1660 MHz	1500 MHz	1060 MHz	1060 MHz	2160 MHz	1660 MHz
Anzahl der Kerne	2	2	2	1	2	1
Architektur	65 nm	65 nm	65 nm	65 nm	65 nm	45 nm
L1 Cache	32 kByte	32 kByte	32 kByte	32 kByte	32 kByte	24 kByte
L2 Cache	2 MByte	4 MByte	2 MByte	1 MByte	4 MByte	512 kByte
Externer Bus	667 MHz	667 MHz	533 MHz	533 MHz	667 MHz	533 MHz
Intel® 64 Architecture	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Enhanced Intel SpeedStep® Tech-	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
nology						
Chipsatz			Intel® 9 Intel® 82801 GF	45GME IM (ICH7M-DH)		
Echtzeituhr						
Genauigkeit		b	ei 25°C: typ. 12 ppm	i (1 Sekunde) pro Ta	g	
batteriegepuffert			J	а		
Speichersockel						
Тур			DD	R2		
Größe			max. 3	GByte		
Grafik						
Controller			Intel® Graphics Me	dia Accelerator 950		
Speicher			bis zu 224	4 MByte 1)		
Farbtiefe	max. 32 Bit					
Auflösung						
DVI	2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080					
RGB	400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)					
Massenspeicherverwaltung	2x SATA, 1x IDE					
Power Management		ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)				

Tabelle 39: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Technische Daten

1) Wird im Hauptspeicher allokiert.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.2.4 Technische Daten 5PC800.B945-1x

Produktbezeichnung	5PC800.B945-10	5PC800.B945-11	5PC800.B945-12	5PC800.B945-13	5PC800.B945-14
Allgemeines					
Zertifizierungen					
CE			Ja		
cULus			Ja		
GOST-R			Ja		
Controller					
Boot-Loader			embedded AMI BIOS		
Prozessor					
Тур	Intel® Core™ Duo L2400	Intel® Core™2 Duo L7400	Intel® Core™2 Duo U7500	Intel® Cele- ron® M 423	Intel® Core™2 Duo T7400
Taktfrequenz	1660 MHz	1500 MHz	1060 MHz	1060 MHz	2160 MHz
Anzahl der Kerne	2	2	2	1	2
Architektur	65 nm				
L1 Cache			32 kByte		
L2 Cache	2 MByte	4 MByte	2 MByte	1 MByte	4 MByte
Externer Bus	667 MHz	667 MHz	533 MHz	533 MHz	667 MHz
Intel® 64 Architecture	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Enhanced Intel SpeedStep® Tech- nology	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Chipsatz			Intel® 945GME		

Tabelle 40: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten					
			500000 0045 40		
Produktbezeichnung	5PC800.B945-10	5PC800.B945-11	5PC800.B945-12	5PC800.B945-13	5PC800.B945-14
Echtzeituhr					
Genauigkeit		bei 25°C	typ. 12 ppm (1 Sekunde	e) pro Tag	
batteriegepuffert			Ja		
Speichersockel					
Тур			DDR2		
Größe	max. 3 GByte				
Grafik					
Controller		Intel®	Graphics Media Accelera	itor 950	
Speicher	bis zu 224 MByte ¹⁾				
Farbtiefe	max. 32 Bit				
Auflösung					
DVI		2x Intel co	ompliant SDVO Ports, 19	20 x 1080	
RGB	400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)				
Massenspeicherverwaltung	2x SATA, 1x IDE				
Power Management		ACPI 2.	0, S3 Support (suspend	to RAM)	

Tabelle 40: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

1) Wird im Hauptspeicher allokiert.

3.3 Kühlkörper

3.3.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Kühlkörper	
5AC803.HS00-00	PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC803.HS00-01	PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC803.HS00-02	PPC800 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PC800.B945-00	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-01	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-02	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-03	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	

Kapitel 2 Technische Daten

Tabelle 41: 5AC803.HS00-00, 5AC803.HS00-01, 5AC803.HS00-02 - Bestelldaten

3.3.2 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC803.HS00-00	5AC803.HS00-01	5AC803.HS00-02
Allgemeines			
geeignet für CPU Boards	5PC800.B945-00 5PC800.B945-01 5PC800.B945-02 5PC800.B945-03	5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	5PC800.B945-05
geeignet für die Systemeinheiten	5PC820.1505-00 5PC820.1906-00		
Zertifizierungen			
CE		Ja	
Mechanische Eigenschaften			
Material	Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes		
Abmessungen			
Breite	143 mm		
Höhe	183,5 mm		
Tiefe	60 mm		
Gewicht	1200 g		

Tabelle 42: 5AC803.HS00-00, 5AC803.HS00-01, 5AC803.HS00-02 - Technische Daten

3.4 Hauptspeicher

3.4.1 Allgemeines

Diese 200-poligen DDR2 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 677 MHz und sind mit einer Speichergröße von 512 MByte, 1 GByte und 2 GByte verfügbar.

Werden zwei gleich große (z.B. 1 GByte) Module gesteckt so wird die Dual-Channel Memory Technologie unterstützt. Werden zwei ungleich große (z.B. 1 GByte und 2 GByte) Module gesteckt, so wird diese Technologie nicht unterstützt.

Werden zwei 2 GByte Module gesteckt, so sind nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar.

3.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 43: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten

3.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMDDR.0512-01	5MMDDR.1024-01	5MMDDR.2048-01
Allgemeines			
Тур		SO-DIMM DDR2 SDRAM	
Speichergröße	512 MByte	1 GByte	2 GByte
Bauart	200 Pin		
Organisation	64M x 64 Bit	128M x 64 Bit	256M x 64 Bit
Geschwindigkeit	DDR2-667 (PC2-5300)		
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja ¹⁾		

Tabelle 44: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Information:

Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.5 Expansions

3.5.1 Allgemeines

Die Expansion ist eine optionale Erweiterung für den PPC800 und besitzt Einschübe für bis zu 2 PCI/PCIe Slots (nur in Verbindung mit einer Buseinheit) und ein Slide-in Laufwerk.

3.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Expansions
5AC803.SX01-00	PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
	5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforderlich).
5AC803.SX02-00	PPC800 Expansion 2 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus
	5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforderlich).
	Erforderliches Zubehör
	Buseinheiten
5AC803.BX01-00	PPC800 Bus 1 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.
5AC803.BX01-01	PPC800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.
5AC803.BX02-00	PPC800 Bus 2 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.
5AC803.BX02-01	PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.
	Lüfter Kit
5AC803.FA02-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX01-00.
5AC803.FA03-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX02-00.
	Optionales Zubehör
	Laufwerke
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
	Hard Disk in einem Slide-in Slot.
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
	tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
	zum Einsatz der Hard Disk.
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie
	das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
	das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 45: 5AC803.SX01-00, 5AC803.SX02-00 - Bestelldaten

3.5.3 Einschübe



Abbildung 20: 5AC803.SX01-00, 5AC803.SX02-00 - Einschübe

3.5.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC803.SX01-00	5AC803.SX02-00
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	J	a
GOST-R	J	a
Einschübe		
PCI / PCIe Slots		
Anzahl	1	2
Slide-in Laufwerke		1

Tabelle 46: 5AC803.SX01-00, 5AC803.SX02-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten					
Produktbezeichnung	5AC803.SX01-00	5AC803.SX02-00			
Mechanische Eigenschaften					
Abmessungen					
Breite	167	mm			
Höhe	222	mm			
Tiefe	60 mm	80 mm			
Gewicht	ca. 1	000 g			

Tabelle 46: 5AC803.SX01-00, 5AC803.SX02-00 - Technische Daten

3.5.5 Abmessungen 5AC803.SX01-00



Abbildung 21: 5AC803.SX01-00 - Abmessungen
3.5.6 Abmessungen 5AC803.SX02-00



Abbildung 22: 5AC803.SX02-00 - Abmessungen

3.5.7 Steckplatz für Buseinheiten

3.5.7.1 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)

Je nach Variante der Buseinheit können Standard PCI 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCIe) half-size Karten gesteckt werden. Diese dürfen die nachfolgenden Abmessungen nicht überschreiten.



Abbildung 23: Abmessungen Standard half-size PCI Karte

Technische Daten • Einzelkomponenten



Abbildung 24: Abmessungen Standard half-size PCIe Karte

3.5.8 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist intern über SATA I und USB mit dem Chipset verbunden.

	Slide-in Slot 1
Anschluss	SATA I und USB
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Laufwerke
5AC801.ADAS-00	APC810 und PPC800 Slide-in compact Adapter
5AC801.HDDS-00	APC810 und PPC800 Slide-in HDD EE25
5AC801.DVRS-00	APC810 und PPC800 Slide-in DVDR/ RW
5AC801.DVDS-00	APC810 und PPC800 Slide-in DVDROM
1	



Kapitel 2 Technische Daten

Tabelle 47: Slide-in Slot 1

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

3.6 Buseinheiten

3.6.1 Allgemeines

Die Buseinheiten sind passend zu den Expansions in 1 bzw. 2 Card Slot Größen mit PCI und / oder PCI Express Unterstützung erhältlich.



Abbildung 25: 1 Slot Buseinheiten



Abbildung 26: 2 Slot Buseinheiten

3.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Buseinheiten	~
5AC803.BX01-00	PPC800 Bus 1 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.	
5AC803.BX01-01	PPC800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.	
5AC803.BX02-00	PPC800 Bus 2 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.	An 12
5AC803.BX02-01	PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.	

Tabelle 48: 5AC803.BX01-00, 5AC803.BX01-01, 5AC803.BX02-00, 5AC803.BX02-01 - Bestelldaten

3.6.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC803.BX01-00	5AC803.BX01-01	5AC803.BX02-00	5AC803.BX02-01
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE		J	а	
GOST-R		J	а	

Tabelle 49: 5AC803.BX01-00, 5AC803.BX01-01, 5AC803.BX02-00, 5AC803.BX02-01 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC803.BX01-00	5AC803.BX01-01	5AC803.BX02-00	5AC803.BX02-01
Einschübe				
PCI Slots				
Anzahl	1	-	2	1
Тур	32 Bit	-	32 Bit	32 Bit
Ausführung	PCI half-size	-	PCI half-size	PCI half-size
Standard	2.2	-	2.2	2.2
Bus Speed	33 MHz	-	33 MHz	33 MHz
PCIe Slots				3
Anzahl	-	1	-	1
Ausführung	-	PCIe half-size	-	PCle half-size
Standard	-	1.0a	-	1.0a
Bus Speed	-	x1 (250 MByte/s)	-	x1 (250 MByte/s)

Tabelle 49: 5AC803.BX01-00, 5AC803.BX01-01, 5AC803.BX02-00, 5AC803.BX02-01 - Technische Daten

3.7 Adapter

3.7.1 5AC803.BC01-00

3.7.1.1 Allgemeines

Mit diesem Adapter kann eine PCI Express compact Einsteckkarte in der PPC800 Systemeinheit betrieben werden.

3.7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Adapter	
5AC803.BC01-00	PPC800 Adapter 1 PCI Express compact.	
	Erforderliches Zubehör	
	Einsteckkarten	
5ACPCC.ETH0-00	PCIec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Für APC820 und PPC800.	
5ACPCC.MPL0-00	PCIec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512 kByte SRAM; für APC820 und PPC800.	

Tabelle 50: 5AC803.BC01-00 - Bestelldaten

3.7.2 5AC803.BC02-00

3.7.2.1 Allgemeines

Mit diesem Adapter kann ein Slide-in compact Laufwerk in der PPC800 Systemeinheit betrieben werden.

3.7.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Adapter	
5AC803.BC02-00	PPC800 Adapter 1 Slide-in compact.	
	Erforderliches Zubehör	15
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	and the second
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	

Tabelle 51: 5AC803.BC02-00 - Bestelldaten

3.8 PClec Einsteckkarten

3.8.1 Allgemeines

Auf den PCIec Einsteckkarten befindet sich ein Sensor, welcher die Temperatur der Karte überwacht. Diese wird im BIOS und im ADI ausgelesen.

3.8.2 Abmessungen



Abbildung 27: PCI express compact Einsteckkarten - Abmessungen

Information:

Es dürfen nur B&R PClec Karten verwendet werden, welche speziell für den Automation PC 820 und Panel PC 800 konstruiert wurden.

3.8.3 5ACPCC.ETH0-00

3.8.3.1 Allgemeines

Die PCI Express compact Ethernet Karte verfügt über einen 10/100/1000 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem PCI Express compact Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- PClec Ethernet Karte
- 1 Netzwerkanschluss (10/100/1000 MBit/s)

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von PCIec Einsteckkarten ist der Adapter 5AC803.BC01-00 zwingend erforderlich.

3.8.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Einsteckkarten	
5ACPCC.ETH0-00	PClec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Für APC820 und PPC800.	

Tabelle 52: 5ACPCC.ETH0-00 - Bestelldaten

3.8.3.3 Technische Daten

5ACPCC.ETH0-00
\$AB25
Ja, per Status LED
Ja
Ja
1
Intel 82574
geschirmter RJ45 Port
10/100/1000 MBit/s
max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
PCIec Modul

Tabelle 53: 5ACPCC.ETH0-00 - Technische Daten

3.8.3.3.1 Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.



Tabelle 54: 5ACPCC.ETH0-00 - Ethernet Schnittstelle

1) Umschaltung erfolgt automatisch.

2) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die IF-Slot Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

Technische Daten • Einzelkomponenten

3.8.4 5ACPCC.MPL0-00

3.8.4.1 Allgemeines

Die PCI Express compact POWERLINK Karte verfügt über zwei POWERLINK-Anschlüsse sowie zwei Stationsnummernschalter und einem Kartennummernschalter zur Unterscheidung der Module. Die PCI Express compact POWERLINK Karte kann als zusätzliche POWERLINK- Schnittstelle in einem PCI Express compact Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- PCIec POWERLINK Karte
- 2 POWERLINK- Anschlüsse
- 2 Stationsnummernschalter
- Kartennummernschalter

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von PCIec Einsteckkarten ist der Adapter 5AC803.BC01-00 zwingend erforderlich.

3.8.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Einsteckkarten	
5ACPCC.MPL0-00	PCIec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512 kByte SRAM; für APC820 und PPC800.	8 y 💼 💼 🔊

Tabelle 55: 5ACPCC.MPL0-00 - Bestelldaten

3.8.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCC.MPL0-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$AB27
Diagnose	
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
GOST-R	Ja
Controller	
SRAM	
Größe	512 kByte
Remanente Variablen im Power Fail Mode	128 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Schnittstellen	
POWERLINK	
Anzahl	2
Übertragung	100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3)
Ausführung	Interner 2fach Hub, 2x geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	100 MBit/s
Knotenschalter	2
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Mechanische Eigenschaften	
Steckplatz	PClec Modul

Tabelle 56: 5ACPCC.MPL0-00 - Technische Daten

3.8.4.3.1 POWERLINK Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.



Tabelle 57: 5ACPCC.MPL0-00 - POWERLINK Schnittstelle

3.8.4.3.2 LED STATUS

Die Status/Error LED ist als Dual LED in den Farben grün und rot ausgeführt. Je nach Betriebsmodus haben die LED Stati eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet TCP/IP Modus

Die Schnittstelle kann als reine Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrieben werden.

Farbe grün - Status	Beschreibung
Ein	Die POWERLINK Schnittstelle wird als reine Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrieben.

Tabelle 58: Status/Error LED - Betriebsmodus Ethernet TCP/IP

POWERLINK V1

Statu	s LED	
Grün	Rot	Zustand, in dem sich die POWERLINK Station befindet
Ein	Aus	Die POWERLINK Station läuft fehlerfrei.
Aus	Ein	Ein fataler Systemfehler ist aufgetreten. Die Art des Fehlers kann über das SPS Logbuch ausgelesen werden. Es handelt sich um ein nicht reparables Problem. Das System kann seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen. Dieser Zustand kann nur durch einen Reset des Moduls verlassen werden.
Abwechsel	nd blinkend	Der POWERLINK Managing Node ist ausgefallen. Dieser Fehlercode kann nur im Betrieb als Controlled Node auftreten.
Aus	Blinkend	System Stopp. Die rot blinkende LED zeigt durch den Blinkcode einen bestimmten Fehler an (siehe Abschnitt "System Stopp Fehlercodes" auf Seite 84).

Tabelle 59: Status/Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V1

POWERLINK V2



Tabelle 60: Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V2

Farbe Grün - Status	Beschreibung
Aus	Managing Node (MN)
NOT_ACTIVE	Der Bus wird auf POWERLINK Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre- chender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Elast)
	Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand BASIC_ETHERNET über (flackernd).
	Controlled Node (CN) Der Bus wird auf POWERLINK Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre- chender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand BASIC_ETHERNET über (flackernd). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
grün flackernd (ca. 10 Hz) BASIC_ETHERNET	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als reine Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrieben.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle verlassen werden.
	Controlled Node (CN) Wird während dieses Zustandes eine POWERLINK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Single Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_1	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_1.
	Managing Node (MN) Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Am Bus dürfen Kollisionen auftreten. Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt.
	Controlled Node (CN) Der CN wartet auf den Empfang eines SoC Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash).
Double Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_2	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2.
	Managing Node (MN) Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet). In diesem Zustand werden die CNs konfiguriert.
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand wird die Schnittstelle üblicherweise vom Manager konfiguriert. Danach wird per Kommando in den Zustand PRE_OPERATIONAL_3 weitergeschaltet (Tripple Flash).
Tripple Flash (ca. 1 Hz) READY_TO_OPERATE	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY_TO_OPERATE.
	Managing Node (MN) Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO Daten werden ignoriert.
	Controlled Node (CN) Die Konfiguration der Schnittstelle ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die gesendeten PDO Daten entsprechen dem PDO Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht aus- gewertet.
Ein OPERATIONAL	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand OPERATIONAL.
Blinkend (ca. 2,5 Hz) STOPPED	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand STOPPED.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich.
	Controlled Node (CN) Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Zustand kann nur durch ein entsprechendes Kommando vom Manager erreicht und wieder verlassen werden.

Tabelle 61: Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK

System Stopp Fehlercodes

Ein System Stopp Fehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird über die rot leuchtende Error LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Legende:	•	150 ms
		600 ms
	Pause	2 s Pausenzeit

Fehlerbeschreibung				Fehlercode durch rote Status LED								
RAM Fehler	•	•	•	-	Pause	•	•	•	-	Pause		
Hardwarefehler	-	•	•	-	Pause	-	•	•	-	Pause		

Tabelle 62: Status/Error LED als Error LED - System Stopp Fehlercodes

3.8.4.3.3 POWERLINK Stationsnummer

POWERLINK Stationsnummer (x1, x16)						
Mit den beiden Hex Schaltern (x16, x1) wird die POWERLINK Stationsnummer einge-			Stationsnummer			
stellt. Stationsnummern im Bereich #00 bis #FD sind erlaubt.		0 bis #FD sind erlaubt.	x1			
Schalterstellung		halterstellung	Stationsnummer			
x1	x16	Beschreibung	×16			
0	0	Betrieb als Managing Node	CLEOI A LEOI			
1 D	0 F	Stationsnummer. Betrieb als Controlled Node				
E	F	reserviert				
F	F	reserviert	Sector and the sector of the			

Tabelle 63: POWERLINK Stationsnummer (x1, x16)

3.8.4.3.4 Kartennummernschalter

Mit dem Kartennummernschalter wird die einstellige Kartennummer (\$1 - \$F) eingestellt. Diese Nummer dient zur Unterscheidung der Module.



Abbildung 28: POWERLINK Card 2port Kartennummernschalter

Wird die Karte mit Automation Runtime betrieben, muss der Kartennummernschalter mit der Slotnummer im Automation Studio übereinstimmen.

Bestellnr.	Steckplatz	Version	Beschreibung
🗆 🏥 PLC1			
É-1 5PC820.1906-00	SU1	2.0.0.4	PPC820 TFT C SXGA 19in T 1CS 1SI
🔂 🕁 USB 1	IF5		USB1
🖶 🚓 USB 2	IF6		USB2
🗄 🚓 USB 3	IF7		USB3
🖶 🚓 USB 4	IF8		USB4
🗄 🚓 USB 5	IF9		USB5
- Display	DS1	2.0.0.4	PPC820 TFT C SXGA 19in T
- SPC800.B945-04	AR	2.0.0.0	CPU Intel Core2 Duo T7400 2,16 GHz, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache, Chipset 9450
- 10	SL1		
- 10 SACPCC.MPL0-00	SL3 (PClec)	1.0.1.1	PCIe POWERLINK V1/V2, 512kB SRAM
L La	SK1		

Abbildung 29: Einbinden der POWERLINK Einsteckkarte in Automation Studio

3.8.4.3.5 SRAM

Die POWERLINK Card 2port - 5ACPCC.MPL0-00 verfügt über 512 kByte SRAM.

3.9 Laufwerke

3.9.1 5AC801.HDDI-00

3.9.1.1 Allgemeines

Diese 40 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten

3.9.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja 1)
Hard Disk	
Kapazität	40 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	78.140.160
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH ²)
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,6 ms

Tabelle 65: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-00	
Datentransferrate		
intern	max. 450 MBits/s	
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)	
Positionierzeit		
minimal (Spur zu Spur)	1 ms	
nominal (Lesezugriff)	12,5 ms	
maximal (Lesezugriff)	23 ms	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur ³⁾		
Betrieb 4)	-30 bis 85°C	
Betrieb - 24 Stunden 5)	-30 bis 85°C	
Lagerung	-40 bis 95°C	
Transport	-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit 6)		
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Schock		
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
N 4 L 9 L .	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht benebbaren Fehier	
Meeresnone		
Betrieb	-300 bis 5000 m	
	-300 bis 12192 m	
Mechanische Eigenschaften	£., 7)	
Montage		
Abmessungen	10	
Breite	13 mm	
Hone	98 mm	
	105 mm	
Gewicht	134 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Seagate	
Herstellerbezeichnung	ST940817SM	

Tabelle 65: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.

2) 3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 30: 5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.2 5AC801.HDDI-02

3.9.2.1 Allgemeines

Diese 160 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten

3.9.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-02	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
GL	Ja ¹⁾	
Hard Disk		
Kapazität	160 GByte	
Anzahl der Köpfe	3	
Anzahl der Sektoren	312.581.808	
Bytes pro Sektor	512	
Cache	8 MByte	
Drehzahl	5400 rpm ±1%	
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)	
MTBF	300.000 POH ²⁾	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Zugriffszeit	12 ms	
Datentransferrate		
intern	max. 84,6 MBits/s	
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)	

Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-02	
Positionierzeit		
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms	
nominal (Lesezugriff)	12 ms	
maximal (Lesezugriff)	22 ms	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur 3)		
Betrieb	-15 bis 80°C	
Betrieb - 24 Stunden 4)	-15 bis 80°C	
Lagerung	-40 bis 95°C	
Transport	-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit 5)		
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend ⁶⁾	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend 7)	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend 7)	
Vibration		
Betrieb	5 bis 500 Hz: 1 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	5 bis 500 Hz; 5 a, keine Beschädigung	
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschädigung	
Schock		
Betrieb	325 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	900 g, 1 ms; keine Beschädigung	
	120 g, 11 ms; keine Beschädigung	
Transport	900 g, 1 ms; keine Beschädigung	
	120 g, 11 ms; keine Beschädigung	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 3000 m	
Lagerung	-300 bis 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Montage	fix ⁸⁾	
Abmessungen		
Breite	13 mm	
Höhe	98 mm	
Tiefe	105 mm	
Gewicht	135 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Fujitsu	
Herstellerbezeichnung	MHY2160BH-ESW	

Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. 1)

Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur. 2)

3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) 5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

6) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.

7) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

8) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 31: 5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.3 5AC801.HDDI-03

3.9.3.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	200
	Optionales Zubehör	Ve v
	Laufwerke	u v
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein- satz der Hard Disk.	

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten

3.9.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja 1)
ATEX Zone 22	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
GL	Ja ¹⁾
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH ²⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
	PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-03
Datentransferrate	
intern	max_1175 MBit/s
zum / vom Host	max, 150 MBvte/s (SATA I), max, 300 MBvte/s (SATA II)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	14 ms
maximal (Lesezugriff)	30 ms
Umaebunasbedingungen	
Temperatur ³⁾	
Betrieb 4)	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 5)	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 6)	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Iransport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Maaraahöba	ooo g und 0,5 ms Dader, keine nicht benebbaren i einer
Betrieb	-300 bis 3048 m
	-300 bis 3040 m
Mechanische Figenschaften	
Montage	fix 7)
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seanate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. 1)

2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

- 4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
- 6) 7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 32: 5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.4 5AC801.HDDI-04

3.9.4.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

- 500 GByte Hard Disk
- Slide-in compact
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-04	500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.	
	Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	and the second s
	Optionales Zubehör	Contraction of the second s
	Laufwerke	200
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04,	
	5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten	
	Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-04 - Bestelldaten

3.9.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-04
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja 1)
Hard Disk	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH ²⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	
intern	max. 147 MByte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)

Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

Kapitel 2 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-04
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ³⁾	
Betrieb ⁴⁾	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 5)	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 6)	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-305 bis 3048 m
Lagerung	-305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁷)
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 33: 5AC801.HDDI-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.5 5AC801.SSDI-00

3.9.5.1 Allgemeines

Dieses 32 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Single Level Cell (SLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	

Tabelle 72: 5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten

3.9.5.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja 1)
Solid State Drive	
Kapazität	32 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	2.000.000 Stunden
Power On/Off Cycles	50.000
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine

Tabelle 73: 5AC801	.SSDI-00 -	Technische Daten
--------------------	------------	------------------

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-00
kontinuierliches Lesen	max. 250 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 170 MByte/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	35.000
4k schreiben	3 300
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	700 TByte
ergibt bei 5 Jahren	350 GBvte/Zag
SI C-Flash	la
Wear Leveling	statisch
Error Correction Coding (ECC)	
Kompatibilität	SATA Revision 2.6 compliant kompatible mit SATA 1.5 CRit/s und 3 CRit/s Interface Raten
Kompatolitat	ATA/ATAPI-7
	SSD Enhanced SMART ATA feature set
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	7 bis 800 Hz: 2,17 g
Lagerung	10 bis 500 Hz: 3,13 g
Transport	10 bis 500 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1000 g, 0,5 ms
Lagerung	1000 g, 0,5 ms
Transport	1000 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ³⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSA2SH032G1
v	1

Tabelle 73: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second Montageweise auf Slide-in compact. 1) 2) 3)

3.9.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 34: 5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.5.5 Benchmark

Die nachfolgenden zwei Benchmarks zeigen einen Vergleich der Intel Solid State Drive (5AC801.SSDI-00) und der Seagate Hard Disk (5AC801.HDDI-00) beim zyklischen lesen bzw. schreiben.





Abbildung 36: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben

Kapitel 2 Technische Daten

3.9.6 5AC801.SSDI-01

3.9.6.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 74: 5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten

3.9.6.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja ¹⁾
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s



Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-01
kontinuierliches Schreiben	max. 475 MBvte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS ²⁾	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4k lesen	15.000
4k schreiben	
typisch	23.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient
	ACS-2
	SSD Enhanced SMART ATA feature set
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Iransport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Iransport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Iransport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	TIX ³
Abmessungen	10
Breite	13 mm
Hone	98 mm
	mm cui
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW060A3

Tabelle 75: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

1) 2) 3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.6.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 37: 5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.7 5AC801.SSDI-02

3.9.7.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0180-00	180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 76: 5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten

3.9.7.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-02	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GOST-R	Ja	
GL	Ja ¹⁾	
Solid State Drive		
Kapazität	180 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.200.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s	
	max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s	

Tabelle 77: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-02	
kontinuierliches Schreiben	max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s	
IOPS ²⁾		
4k lesen	50.000	
4k schreiben		
typisch	60.000	
maximal	80.000	
Endurance		
MLC-Flash	Ja	
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient	
	ACS-2	
	SSD Enhanced SMART ATA feature set	
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-55 bis 95°C	
Transport	-55 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g	
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g	
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g	
Schock		
Betrieb	1500 g, 0,5 ms	
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Montage	fix ³⁾	
Abmessungen		
Breite	13 mm	
Höhe	98 mm	
Tiefe	105 mm	
Gewicht	118 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Intel	
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW180A3	

Tabelle 77: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

1) 2) 3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.7.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 38: 5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.8 5AC801.SSDI-03

3.9.8.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.8.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-03	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	and the second s
	Optionales Zubehör	2 11 100
	Laufwerke	e · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis;	· · · 67
	Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 78: 5AC801.SSDI-03 - Bestelldaten

3.9.8.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-03	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GOST-R	Ja	
GL	Ja ¹⁾	
Solid State Drive		
Kapazität	60 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.500.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s	
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s	
IOPS ²⁾		
4k lesen	max. 55.000 (random)	
4k schreiben	max. 25.000 (random)	
Endurance		
garantierte Datenmenge		
garantiert	35 TBW ³⁾	
MLC-Flash	Ja	

Tabelle 79: 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-03	
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient	
	ACS-2	
	SSD Enhanced SMART ATA feature set	
II		
Umgebungsbedingungen		
lemperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-40 bis 95°C	
Transport	-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock		
Betrieb	1500 g, 0,5 ms	
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Montage	fix ⁴)	
Abmessungen		
Breite	13 mm	
Höhe	98 mm	
Tiefe	105 mm	
Gewicht	118 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Toshiba	
Herstellerbezeichnung	THNSNH060GBST	

Tabelle 79: 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

1) 2) 3) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

TBW: Terabyte written

4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.8.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 39: 5AC801.SSDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.9 5AC801.SSDI-04

3.9.9.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.9.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-04	128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	Commission of the local division of the loca
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 80: 5AC801.SSDI-04 - Bestelldaten

3.9.9.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-04	
Revision	CO	D0
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
GOST-R	Ja	
GL	Ja ¹⁾	
Solid State Drive		
Kapazität	128 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.500.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	

Tabelle 81: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten
Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-04		
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s		
kontinuierliches Schreiben	max. 450 MByte/s		
IOPS ²⁾			
4k lesen	max. 85.000 (random)		
4k schreiben	max. 35.000 (random)		
Endurance			
garantierte Datenmenge			
garantiert	74 TBW ³⁾		
MLC-Flash	Ja		
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient		
	ACS-2		
	SSD Enhanced SMART ATA feature set		
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C -30 bis 85°C		
Lagerung	-40 bis 95°C		
	-40 bis 95°C		
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend		
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend		
I ransport	8 bis 95%, nicht kondensierend		
Vibration			
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g		
	10 bis 2000 Hz: 20 g		
	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Schock			
Betried	1500 g, 0,5 ms		
	1500 g, 0,5 ms		
Maaraabäha	1500 g, 0,5 ms		
Potrich	200 bio 12 102 m		
	-300 bis 12,192 m		
Transport	-300 bis 12 192 m		
Mechanische Figenschaften	000 013 12.102 111		
Montage	fiv 4)		
Abmessungen	IIX " ⁷		
Breite	13 mm		
Höhe	13 IIII Q8 mm		
Tiefe	105 mm		
Gewicht	118 α		
Herstellerinformation	10 y		
Hersteller	Toshiba		
Herstellerbezeichnung	THNSNH128GBST THNSNJ128WCST		
insistence bezeichnung			

Tabelle 81: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

1) 2) 3) 4) TBW: Terabyte written

Montageweise auf Slide-in compact.





Abbildung 40: 5AC801.SSDI-04 Rev. ≤ C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 41: 5AC801.SSDI-04 Rev. ≥ D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.10 5AC801.SSDI-05

3.9.10.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in compact Laufwerken ist der Adapter 5AC803.BC02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.9.10.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-05	256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	

Tabelle 82: 5AC801.SSDI-05 - Bestelldaten

3.9.10.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-05
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja 1)
Solid State Drive	
Kapazität	256 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s

Tabelle 83: 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-05		
kontinuierliches Schreiben	max. 460 MByte/s		
4k lesen	max. 90.000 (random)		
4k schreiben	max. 35.000 (random)		
Endurance			
garantierte Datenmenge			
garantiert	148 TBW ³⁾		
MLC-Flash	Ja		
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient		
•	ACS-2		
	SSD Enhanced SMART ATA feature set		
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	-30 bis 85°C		
Lagerung	-40 bis 95°C		
Transport	-40 bis 95°C		
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend		
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend		
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend		
Vibration			
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Schock			
Betrieb	1500 g, 0,5 ms		
Lagerung	1500 g, 0,5 ms		
Transport	1500 g, 0,5 ms		
Meereshöhe			
Betrieb	-300 bis 12.192 m		
Lagerung	-300 bis 12.192 m		
Transport	-300 bis 12.192 m		
Mechanische Eigenschaften			
Montage	fix ⁴⁾		
Abmessungen			
Breite	13 mm		
Höhe	98 mm		
Tiefe	105 mm		
Gewicht	118 q		
Herstellerinformation			
Hersteller	Toshiba		
Herstellerbezeichnung	THNSNJ256WCST		

Tabelle 83: 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second 1) 2) 3) 4)

TBW: Terabyte written Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.10.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 42: 5AC801.SSDI-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.11 5MMSSD.0060-00

3.9.11.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-01 bzw. 5AC901.CSSD-01
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.9.11.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 84: 5MMSSD.0060-00 - Bestelldaten

3.9.11.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-00	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾	
GOST-R	Ja	
Solid State Drive		
Kapazität	60 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.200.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s	
	max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s	
kontinuierliches Schreiben	max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s	
	max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s	
IOPS ²)		
4k lesen	15.000	
4k schreiben		
typisch	23.000	
maximal	80.000	
Endurance		
MLC-Flash	Ja	

Tabelle 85: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-00	
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient	
	ACS-2	
	SSD Enhanced SMART ATA feature set	
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-55 bis 95°C	
Transport	-55 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g	
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g	
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g	
Schock		
Betrieb	1500 g, 0,5 ms	
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	9,5 mm	
Höhe	69 mm	
Tiefe	100 mm	
Gewicht	78 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Intel	
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW060A3	

Tabelle 85: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.9.11.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 43: 5MMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.12 5MMSSD.0060-01

3.9.12.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-03 bzw. 5AC901.CSSD-03
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.9.12.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 86: 5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten

3.9.12.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾	
GOST-R	Ja	
Solid State Drive		
Kapazität	60 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.500.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s	
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s	
IOPS ²⁾		
4k lesen	max. 55.000 (random)	
4k schreiben	max. 25.000 (random)	
Endurance		
garantierte Datenmenge		
garantiert	35 TBW ³⁾	
MLC-Flash	Ja	
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient	
	ACS-2	
	SSD Enhanced SMART ATA feature set	
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando	

Tabelle 87: 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-40 bis 95°C	
Transport	-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g	
Schock		
Betrieb	1500 g, 0,5 ms	
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis 12.192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	9,5 mm	
Höhe	69 mm	
Tiefe	100 mm	
Gewicht	78 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Toshiba	
Herstellerbezeichnung	THNSNH060GBST	

Tabelle 87: 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

Ja, jedoch nur zutreffen
 IOPS: Random Read ar
 TBW: Terabyte written

3.9.12.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 44: 5MMSSD.0060-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.13 5MMSSD.0128-01

3.9.13.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-04 bzw. 5AC901.CSSD-04
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.9.13.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 88: 5MMSSD.0128-01 - Bestelldaten

3.9.13.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0128-01	
Revision	C0 D0	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE		Ja
cULus		Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2		Ja ¹⁾
GOST-R		Ja
Solid State Drive		
Kapazität	128 GByte	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen	
MTBF	1.500.000 Stunden	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Schnittstelle	SATA	
Wartung	keine	
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s	
kontinuierliches Schreiben	max. 450 MByte/s	
IOPS ²⁾		
4k lesen	max. 85.000 (random)	
4k schreiben	max. 35.000 (random)	
Endurance		
garantierte Datenmenge		
garantiert	74 TBW ³⁾	
MLC-Flash	Ja	

Tabelle 89: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten

Kapitel 2 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSI	D.0128-01
Kompatibilität	SATA Revisio	n 3.0 complient
	AC	CS-2
	SSD Enhanced SM	ART ATA feature set
	Native Command Que	uing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bi	s 95°C
Transport	-40 bi	s 95°C
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	8 bis 95%, nich	t kondensierend
Lagerung	8 bis 95%, nich	t kondensierend
Transport	8 bis 95%, nich	t kondensierend
Vibration		
Betrieb	10 bis 200	00 Hz: 20 g
Lagerung	10 bis 200	00 Hz: 20 g
Transport	10 bis 200	00 Hz: 20 g
Schock		
Betrieb	1500 g	, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms	
Transport	1500 g, 0,5 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 12.192 m	
Lagerung	-300 bis 12.192 m	
Transport	-300 bis	12.192 m
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	9,5 mm	7 mm
Höhe	69	mm
Tiefe	100 mm	
Gewicht	78 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Toshiba	
Herstellerbezeichnung	THNSNH128GBST	THNSNJ128WCST

Tabelle 89: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. 1)

2) 3) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

TBW: Terabyte written

3.9.13.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 45: 5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≤ C0



Abbildung 46: 5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≥ D0

3.9.14 5MMSSD.0180-00

3.9.14.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Erstzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-02 bzw. 5AC901.CSSD-02
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.9.14.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0180-00	180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 90: 5MMSSD.0180-00 - Bestelldaten

3.9.14.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0180-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja 1)
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	180 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
	max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	50.000
4k schreiben	
typisch	60.000
maximal	80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja

Tabelle 91: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Dradukébarajabrung	ENNESD 0400.00
Produktbezeichnung	5MM55D.0180-00
Kompatibilitat	SATA Revision 3.0 compliant
	ACG-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW180A3

Tabelle 91: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.9.14.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 47: 5MMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.15 5MMSSD.0256-00

3.9.15.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-05 bzw. 5AC901.CSSD-05
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

3.9.15.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	

Tabelle 92: 5MMSSD.0256-00 - Bestelldaten

3.9.15.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0256-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja 1)
Solid State Drive	
Kapazität	256 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 460 MByte/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	max. 90.000 (random)
4k schreiben	max. 35.000 (random)
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	148 TBW ³⁾
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 complient
	ACS-2
	SSD Enhanced SMART ATA feature set
	Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0256-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	7 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Toshiba
Herstellerbezeichnung	THNSNJ256WCST

Tabelle 93: 5MMSSD.0256-00 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. 1) 2) 3)

IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

TBW: Terabyte written

3.9.15.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 48: 5MMSSD.0256-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.16 5AC801.ADAS-00

3.9.16.1 Allgemeines

Der Hard Disk Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man Slide-in compact Laufwerke stecken und somit am B&R Industrie PC betreiben kann. Dieser Adapter kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in Laufwerken ist die Expansion 5AC803.SX01-00 oder 5AC803.SX02-00 zwingend erforderlich.

3.9.16.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	

Tabelle 94: 5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten

3.9.16.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.ADAS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja 1)
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	328 g

Tabelle 95: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.9.17 5AC801.HDDS-00

3.9.17.1 Allgemeines

Diese 40 GByte Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in Laufwerken ist die Expansion 5AC803.SX01-00 oder 5AC803.SX02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 als SATA und USB angesprochen.

3.9.17.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei- tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 96: 5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten

3.9.17.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja 1)
Hard Disk	
Kapazität	40 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	78.140.160
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH ²)
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA

Tabelle 97: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDS-00
Zugriffszeit	5,6 ms
Datentransferrate	
intern	max. 450 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1 ms
nominal (Lesezugriff)	12,5 ms
maximal (Lesezugriff)	23 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ³⁾	
Betrieb 4)	-30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden 5)	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit 6)	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 5000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁷)
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	387 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST940817SM

Tabelle 97: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.

2) 3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

- 4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- , 5) 6) 7) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

Montageweise auf Slide-in compact.

3.9.17.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 49: 5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.18 5AC801.DVDS-00

3.9.18.1 Allgemeines

Das DVD-ROM Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in Laufwerken ist die Expansion 5AC803.SX01-00 oder 5AC803.SX02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 als SATA und USB angesprochen.

3.9.18.2 Bestelldaten

Tabelle 98: 5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten

3.9.18.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.DVDS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja 1)
CD / DVD Laufwerk	
Datentransferrate	max. 1,5 GBit/s
Drehzahl	max. 5090 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
	CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
	Photo CD (single/multi-session)
	Enhanced CD, CD-Text
	DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Sing-
	le/Multi-border), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R
	DL (Single/Multi session), DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)

Tabelle 99: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5AC801.DVDS-00	
Schnittstelle	SATA	
Hochlaufzeit		
CD	max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)	
DVD	max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)	
Zugriffszeit		
CD	durchschnittlich 130 ms	
DVD	durchschnittlich 140 ms	
Lesbare Medien		
CD	CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW	
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM	
Lesegeschwindigkeit		
CD	24x	
DVD	8x	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur ²⁾		
Betrieb	5 bis 55°C ³⁾	
Lagerung	-20 bis 60°C	
Transport	-40 bis 65°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	8 bis 80%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0.2g	
Lagerung	5 bis 500 Hz: 2g	
Transport	5 bis 500 Hz: 2g	
Schock		
Betrieb	5 g und 11 ms Dauer	
	60 g und 11 ms Dauer	
Lagorang	200 g und 2 ms Dauer	
Transport	60 g und 11 ms Dauer	
	200 g und 2 ms Dauer	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	22 mm	
Höhe	172,5 mm	
Tiefe	150 mm	
Gewicht	455 g	

Tabelle 99: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ü. NN. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.

3) Oberflächentemperatur des Laufwerks.

3.9.18.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 50: 5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.18.5 Hot-Plug Fähigkeit

Hardwarerevision B0 des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfähigkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugfähig.

3.9.19 5AC801.DVRS-00

3.9.19.1 Allgemeines

Das DVD-R/RW Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem PPC800

Information:

Für die Verwendung von Slide-in Laufwerken ist die Expansion 5AC803.SX01-00 oder 5AC803.SX02-00 zwingend erforderlich.

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 als SATA und USB angesprochen.

3.9.19.2 Bestelldaten



Tabelle 100: 5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten

3.9.19.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.DVRS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja ¹⁾
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5160 rpm ±1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
	CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
	Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
	DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video
	DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
	DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)



Technische Daten • Einzelkomponenten

Draduktharaiahauna	
Cebrittatelle	
	541A
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	durchschnittlich 140 ms (24x)
DVD	durchschnittlich 150 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm 8 cm) CD-R CD-RW
	DVD-ROM DVD-R (Double Laver) DVD-RW DVD-RAM
DVD	DVD-ROW, DVD-ROUGHELayer, DVD-RW, DVD-RAM
Raashraibhara Madian	
מעם	DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	24x, 16x, 10x und 4x
CD-RW	24x 16x 10x und 4x
DVD+R	
D/D+P (Double Layer)	
DVD-R	8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer)	6x, 4x und 2x
DVD-RAM ²⁾	5x, 3x und 2x
DVD-RW	6x, 4x und 2x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ³⁾	
Betrieb	5 bis $55^{\circ}C^{-4}$
Transport	
Luttreuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,2g
Lagerung	5 bis 500 Hz: 2g
Transport	5 bis 500 Hz; 2g
Schock	
Betrieb	bei max 5 g und 11 ms Dauer
	bei max. 5 y unu 11 ms Dauci
Layerung	bei max, ou y ullu 11 IIIs Dauer
Transport	bei max. 60 g und 11 mg Dauer
Παιορυτ	bei max, 200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Figenschaften	bei max. 200 g und 2 ms Dadei
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höbo	172 5 mm
	172,0 11111
	150 mm
Gewicht	400 g

Tabelle 101: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Unterstützung der RAM Funktion durch die Brennsoftware "Nero" (Best. Nr. 5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.

 Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern ü. NN.

4) Oberflächentemperatur des Laufwerks.

3.9.19.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 51: 5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.20 5ACPCI.RAIC-03

3.9.20.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bieten zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET).

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s



Abbildung 52: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 160 GByte ca. 160 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

3.9.20.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-03	PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	1 () A CONTRACTOR
	Optionales Zubehör	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Laufwerke	B ()
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hin- weis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 102: 5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten

3.9.20.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-03	
Allgemeines		
Anzahl der Hard Disks	2	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
Controller		
Тур	Sil 3512 SATA Link	
Spezifikation	Serial ATA 1.0	
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)	
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1	
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte	
Hard Disk		
Kapazität	160 GByte	
Anzahl der Köpfe	3	
Anzahl der Sektoren	312.581.808	
Bytes pro Sektor	512	
Cache	8 MByte	
Drehzahl	5400 rpm ±1%	
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)	
Lebensdauer	5 Jahre	
S.M.A.R.T. Support	Ja	
Zugriffszeit	5,56 ms	
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5	
Datentransferrate		
intern	max. 84,6 MBits/s	
zum / vom Host	max. 150 MByte/s	
Positionierzeit		
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms	
nominal (Lesezugriff)	12 ms	
maximal (Lesezugriff)	22 ms	
Elektrische Eigenschaften		
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)	
	1 A bei 5 V (PCI Bus)	
Umgebungsbedingungen		
	-15 bis 80°C	
Betrieb - 24 Stunden 3)	-15 DIS 80°C	
Lagerung	-40 bis 95 C	
	-40 DIS 95 C	
	0 his 000/ night (and ansistend 4)	
	8 DIS 90%, NICHT KONGENSIERENG 7/	
	5 bis 05%, filch kondensierend 5	
Папэрон		

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-03
Vibration 6)	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock	
Betrieb	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
	max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
	max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Transport	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
	max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
	max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage 7)	fix
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 103: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

- 1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.

Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
 Montageweise auf PCI Einschub.

3.9.20.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 53: 5ACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.20.5 Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.9.20.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 8 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 184.

3.9.20.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 160GB 5ACPCI.RAIC-04 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 14 "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 367.

Kapitel 2 Technische Daten

3.9.21 5ACPCI.RAIC-04

3.9.21.1 Allgemeines

Die Hard Disk kann als Ersatzteil für eine HDD des PCI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 verwendet werden.

3.9.21.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hin- weis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 104: 5ACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten

3.9.21.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-04
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate	
intern	max. 84,6 MBits/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s
Positionierzeit	
minimal (Spur zu Spur)	1,5 ms
nominal (Lesezugriff)	12 ms
maximal (Lesezugriff)	22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)
	1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾	
Betrieb ²⁾	-15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden 3)	-15 bis 80°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend 4)
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend 5)
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend 5)
Vibration 6)	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung

Tabelle 105: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-04
Schock	
Betrieb	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
	max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
	max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Transport	max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
	max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
	max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	70 mm
Länge	100 mm
Höhe	9,5 mm
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 105: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-1) und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.

2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

3) 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.

5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).

3.9.21.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 54: 5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.22 5ACPCI.RAIC-05

3.9.22.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten 250 GByte Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s



Abbildung 55: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 250 GByte ca. 250 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

3.9.22.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	1 () () () () () () () () () (
	Optionales Zubehör	A DE AND A DE ANT
	Laufwerke	Sold Harris
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein- satz der Hard Disk.	

Tabelle 106: 5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten

3.9.22.3 Technische Daten

Algencies 2 Avail der Hard Daks 2 Scellicourogen 3a CE Ja OUtus Ja COST R Ja Controller Ja Specification Statistication Cache Statistication Determonino	Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-05
Acaral der Hard Dieks CE CE Cettridiserungen CE	Allgemeines	
Zettrizenurgen Ja CE Ja cUtus Ja Controller Ja Status Ja Controller Status Spezification Status Spezification Status Descriptoringurgate untentizit RAD.0.1 RAD Level untentizit RAD.0.1 RAD Level untentizit RAD.0.1 RAD Level 240 GStyle Arcall dir Korpf 1 Arcall dir Korpf 3 Arcall dir Korpf 1 Arcall dir Korpf 3	Anzahl der Hard Disks	2
International Ja Collus Ja GOST-R Ja Obstrate Ja Typ Sil 3512 SATA Link Specification Sil S512 SATA Link Specification Sil S512 SATA Link Specification Sil S512 SATA Link Specification Generation Able Level unterstatic RAID 0.1 BIOS Extension ROM Bodart Ca. 32 Byte Hard Disk Call Coll Call Control 483.397 1661 Synta possibility Sil S512 SATA Link Azaral Cont Seatonn 483.397 1661 Synta possibility Sil Statisty Statisty Sil Statisty Syntap possibility Ja Call Statisty Sil Statisty Syntap possibility Sil Statisty Syntap possibility Ja Call Statisty Sil Statisty Syntap possibility Sil Statisty Syntap possibility Sil Statisty Syntap possibility Sil Statisty	Zertifizierungen	
Utum Ja Controller Ja Controller Status Sperification Status Sperification Serial XIA 1.0 Dateributeringuigrate max.15.6 Status (158 Mkyrels) RAD Lovel unterstuict RAD 0.1 BIOS Extension ROM Bodarf Gata 28 Kkyre Hard Dick 200 GByre Anzahl der Stetkoren 400.37 r.88 Byres processor 600 (pm 40.2%) Dentaahl 512 Cache 8 Mkyre Dentaahl 5400 (pm 40.2%) Dentaatsermend 1/8 Zum / vom Host max.1175 MBk/s Dentaatsermend 1/8 Destaatsermend 1/8 Destaatsermend 1/8 Destaatsermend 1/8 Destaatsermend	CE	Ja
COSTR Image: Control of the second seco	cULus	Ja
Controller Description Typ Sits 12 AATA Link Specification Serial ATA 10 Description Serial ATA 10 Specification Serial ATA 10 Description motional Control Controller Level uniterature RAID 0.1 Diol Extension ROM Bodarf c. 32 kByta Hard Diak 250 GByta Anzahl der Kopfe 1 Anzahl der Kopfe 1 Anzahl der Kopfe 1 Anzahl der Kopfe 612 Cache 6 MByta Detkant 6400 (pm e 0.2% Hochlaubzeit (b.8.0 cm of pm at 0.2% Jogardizati S.6.6 m e Strant S.6.6 m e Jagestrant 6400 (pm e 0.2% Jogardizati S.6.6 m e Jogardizati S.6.7 m e Jogardizati	GOST-R	la
Strig 312 Start Link Specification Determinent of the second start AFA 10 Determinent Start RAND 0, 1 BIOS Extension ROM Bedarf Arazal der Köpfe Arazal der Köpfe Arazal der Sektoren System Start RAND Brös Extension ROM Bedarf Kapaztilt Arazal der Sektoren System Start RAND Start Start Köpfe Arazal der Sektoren System Start RAND Bertrant Start RAND Level Dehrant Start RAND Level System Start RAND Bertrant Start RAND Level Start RAND Level Start RAND Level Dehrant Restore RAND RAND RAND RAND RAND RAND RAND RAND	Controller	uu uu
Jos Dis Series XIA 10 Discription max. 16 GBUs (100 m) DATE Leval Lines (100 m) Description Lines (100 m) State And Lines (100 m) Lines (100 m) Description Lines (100 m) Description (100 m) Lines (100 m) State (100 m) Lines (100 m) Description (100 m) Lines (100 m) Date (100 m) <td></td> <td>Sil 3512 SATA Link</td>		Sil 3512 SATA Link
operational of the set	Spazifikation	Sorial ATA 1.0
Land Level Intex. 1, 20 July (15% Marynes) RAD Level uniteriture RAUD, 1 BIOS Exersion ROM Bedarf ca. 32 Repla Hard Diax 250 GByte Kapaziti 780 Stepse Arzan der Kopfe 1 Arzan der Kopfe 1 Arzan der Kopfe 612 Arzan der Kopfe 612 Obratant 640 Opn au Zesenuprift) Bortant 90 Mayne Detratant 100 Kours D-4, Multword DNA Modus D-2, UDMA Modus D-6 Querificatei 100 Modus D-4, Multword DNA Modus D-6 Datestransferrate 100 Modus D-4, Multword DNA Modus D-6 International Transferrate 100 Modus D-4, Multword DNA Modus D-6 Datestransferrate 11 ms molimal (Lesszugrift) 1 ms Datestransferrate 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Destronsferrate 0 bis 60°C Destronsferrate 0 bis 60°C Bertice -2 Stunden ¹⁰ 0 bis 60°C Bertice -2 Stunden ¹⁰ 0 bis 60°C Bertice -1 Stunden ¹⁰ 5 bis 500 H.c. rax. 125 g. Dauer 1 Oktawa pro Minute: kinten eicht behebbaren Fehler	Detenühertregungerete	Sendi ATA 1.0
NAUL Cave unifer State Hard Dick 0.8.3 £ Krş/re Hard Dick 200 GByte Arzahl der Kopte 1 Arzahl der Kopte 1 Arzahl der Kopte 1 Arzahl der Kopte 512 Cache 3.8492 Derbrahl 5400 pm ±0,2% Derbrahl 5.50 ms Zugffiszelt 0.50 ms Jagestrahl 5.50 ms Zugffiszelt 0.50 ms Datentransferrate max. 100 Modus 0-4. Multword DNA Modus 0-2. UDMA Modus 0-6 Datentransferrate max. 100 Mbyte's mismal (Spar zu Spin) 1 ms montrad (Leszaguff) 1 ms montrad (Leszaguff) 1 ms montrad (Leszaguff) 3 ms Betraber 24 Sunden 31 0 ms 60°C Betraber 24 Sunden 31 0 ms 60°C Betraber 24 Sunden 31 0 ms 60°C Datentransferrate 0 ms 60°C Datentransferrate 0 ms 60°C Betrabe 24 Sunden 31 0 ms 60°C Betrabe 24 Sunden 31 0 ms	Datenubertragungsrate	max. 1,5 GBIVS (150 MByte/s)
BLOS Extension KOM Bedant cs. 32 Ktyle Kapazitat 260 GByte Arzahi der Kopfe 1 Arzahi der Soktoren 488.397.168 Bytes pro Sektor 512 Cache 8 MByte Derkzahl 5400 pm a0.2% Hochlaufzelt 1,92,36 s (von 0 pm auf Lesezugntf) S.M.R.T. Support .a Zugriffiszaht 6,56 nm intern max. 1175 MB4/s zum / vom host max. 1175 MB4/s Datentransferrate max. 1175 MB4/s intern max. 1175 MB4/s zum / vom host max. 100 MB4/s /s Positionizzett 1 ms nominal (Lesezugntf) 1 ms Dotentransferrate 1 A bel 5 V (PCI Bus) Listingsaufnahme 0.3 A bel 3.3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 A bel 5 V (PCI Bus) Ungebungsbedingungen 1 A bel 5 V (PCI Bus) Unflexitive f.** 0 bis 60°C Betriteb 2 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Unflexitive f.** 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g, Dauer 1 Oktave pro Minute, keine nicht behebbaren Fehler Edertiob 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g, Dauer 1 Oktave pro Minute, keine nicht behebbaren Fehler Edering	RAID Level	unterstutzt RAID 0, 1
Hard Disk 250 GByte Anzahl der Köpfe 1 Anzahl der Skötern 1 Bytes pro Sektor 512 Cache 8 Mölyte Derbzahl 5400 rpm 10.2% Derbzahl 5400 rpm 10.2% Derbzahl 5.95 ms Jugffiszeit 1/p.3.6 kvon 0 rpm and Lesezugriff) S.M.A.T. Support Ja Zugffiszeit 5.95 ms Unterstützte Transfermodi PIO Modus 0.4, Multhword DAL Modus 0.2, G Datentransferrate max. 1175 MBits minernal (Spur zu Spur) 1 ms mornial (Lesezugriff) 1 ms Destonerzeit 1 ms mornial (Lesezugriff) 1 ms Existriphe Bigenschaften 0 bis 60°C Leistungsaufnahme 0 bis 60°C Umgebrungbedingungen 0 bis 60°C Transport -40 bis 70°C Lagerung 5 bis 950 Hz: msx 0.125 (D suuer 10 ktowensierend Lagerung 5 bis 950 Hz: msx 0.125 (D suuer 10 ktowe pro Minute: keine nicht behebbaren Fehler Bettieb 5 bis 950 Hz: msx 0.125 (D suuer 10 ktowe pro Minute: k	BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Kapaziti der Sektoren 1 Anzahl der Sektoren 488.397.168 Bytes prö Sektor 512 Cache 8 MByte Derkzahl 5400 gm 40.2% Hochsluzzt 1,93.5 e von 0 gm auf Lesezught) S.M. A.T. Support Ja Zugriffizzeit 5.56 ms interstützt Transfermodi SATA 1.0. Serial ATA Revision 2.6 Dietntransfermate max. 1125 MBUs intern max. 1125 MBUs zum / vom Host max. 1125 MBUs Destintransfermate max. 1125 MBUs intern max. 1125 MBUs zum / vom Host max. 1125 MBUs Destintransfermate max. 1125 MBUs intern max. 1125 MBUs zum / vom Host max. 1125 MBUs Destintransfermate max. 1125 MBUs intern max. 1125 MBUs zum / vom Host max. 1125 MBUs Destintransfermate max. 1125 MBUs intern 30 ms Elektrische Elepenschaften 0.3 A bel 3.3 V (PCI Bus) Listingsaufnahme 0.3 A bel 5 V	Hard Disk	
Anzahl der Köpie 1 Anzahl der Köpie 1 Anzahl der Köpie 1 Körternen 488.397.168 Bytes pro Sektor 6 Bytes pro Sektor 7 Bytes pro	Kapazität	250 GByte
Anzahl der Sektoren 488.397.168 Bytes pro Sektor 512 Cache 8 MByte Dehzanl 5400 pm auf Lessugriff) KAR ET. Support	Anzahl der Köpfe	1
Bytes pro Sektor 512 Cache 8 MByte Drehzah 5400 rpm a0.2% Hochlaufzeit typ.3.6 s/con 0 rpm a0.2% S M.A. T. Support Ja Zugriffszeit 5.56 ms Interstützt Transfermodi PIO Modus 0-4, Muttword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6 Datentransferrate max. 1175 MBit/s Intern max. 1175 MBit/s zum / vom Host max. 1175 MBit/s Postfonterzeit max. 1175 MBit/s minimal (Spur zu Spur) 1 ms nominal (Lescugriff) 30 ms Elektrische Eigenschaften 0 bis 60°C Leistungsaufnahme 0.3.4 bel 5.3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 0 bis 60°C Bertieb ¹¹ 0 bis 60°C Lagerung 6 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0.125 g; Dauer 1 O Kave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0.125 g; Dauer 1 O Kave pro Minute; keine Eeschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0.125 g; Dauer 1 O Kave pro Minute; keine Eeschädigung	Anzahl der Sektoren	488.397.168
Cache 8 M8/yte Derbaral 5400 pm al.2x% Hochalzeit 1yp.3.6 k (von 0 rpm auf Lescugntft) SM AF.T. Support .4a Zugriffszeit 5.56 ms unterstützte Transfermodi PIO Modus 0-4, Muttword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6 Datentransferrate max. 1175 MBit/s zum / vom Hoat max. 1175 MBit/s Postionierzeit nms minimal (Supr zu Suur) 1 ms minimal (Supr zu Suur) 14 ms maximal (Lescugntft) 30 ms Elektrische Eligenschaften 0.3a heil 3.3 V (PCI Bus) Lestungsaufnahme 0.3a heil 3.7 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 0 bis 60°C Eleriteb 2 S bis 95%, nicht kondensierend Lagerung -40 bis 70°C Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0.125 g; Dauer 1 O Kave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb Lagerung 5 bis 500 Hz: S g; Dauer 0.5 K	Bytes pro Sektor	512
Drehzahl 5400 rpm 10.2% Hochlautzeit 1yp.3.6 s (or no rpm auf Lesezugrift) S M.A.R.T Support Ja Zugriffszeit 55.6 ns unterstützte Transfermodi PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6 Datentransferrate max. 1175 MBit/s intern max. 1175 MBit/s zum / vom Host max. 1175 MBit/s Postforierzeit 1 ms nominal (Sezugrift) 1 ms nominal (Sezugrift) 30 ms Elektrische Eigenschaften 1 Lestungsaufmahme Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 A bei 5 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 0 bis 60°C Temperatur ¹⁰ 0 bis 60°C Betrieb ²¹ 0 bis 60°C Lagerung 40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Unffeuchtigkeit ¹⁰ 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschäd	Cache	8 MByte
Hochauzeit typ. 3.6 g (von 0 rm auf lessezugrift) SM A.R.T. Support Ja Zugrifszeit 5.66 ms Datentransferrate PIO Modus 0.4, Multiword DMA Modus 0.2, UDMA Modus 0.6 Datentransferrate max. 1175 MBi/s intern max. 1175 MBi/s zum / vom Host max. 150 MByte/s Positionierzeit 1 ms mornial (Lesszugrift) 1 ms Bektrische Eigenschaften 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Temperatur "" 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport 5 bis 50%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 50%, nicht kondensierend Transport 5 bis 500 Hz:: ns. 0.125, g. Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz:: ms. 0.125, g. Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz:: ms. 0.125, g. Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz:: ms. 0.125, g. Dauer 0.5 Oktaven pro	Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
S.M.A.R.T.Support Ja Zugriffszeit 5.56 ms uinterstuizte Transfermodi PIO Modus 0-4, Muttiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6 Datentransferrate max. 1175 MBU/s intern max. 1175 MBU/s zum / vom Host max. 1175 MBU/s Positionierzeit max. 1175 MBU/s maximal (Leszugriff) 1 ms maximal (Leszugriff) 14 ms maximal (Leszugriff) 30 ms Elektrische Eigenschaften 0.3 A bel 3.3 V (PCI Bus) Leistungsaufnahme 0.3 A bel 3.3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen Temperatur " Betrieb 2 0 bis 60°C Betrieb 2 O bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Unflexuchtgiket " 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler S bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler S bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 0 Staven pro Minute; keine Beschädigung Transport max. 125 g; Dauer 0.5 Oktaven pro Minute	Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugfförzet 9.56 ms unterstützte Transfermodi PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2 Datentransferrate max. 1175 MBit/s intern max. 1175 MBit/s zum / vom Host max. 1175 MBit/s Positionierzet nmax. 150 MByte/s positionierzet 1 ms mominal (Esezugriff) 30 ms Edektrische Eigenschaften 0 Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Transport 0 bis 60°C Lagerung 40 bis 70°C Transport 0 bis 60°C Lagerung 5 bis 50%, nicht kondensierend Transport 5 bis 500 Hz:: ms. 0, 125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb / dauerhaft) 5 bis 500 Hz:: ms. 0, 125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz:: ms. 0, 125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine eicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz:: ms. 0, 125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine eicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz:: ms. 0, 125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz:: ms. 0, 125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport<	S.M.A.R.T. Support	Ja
SATA 1.0. Serial ATA 2.0. Serial 2.0. Serial 2.0. Serial 2.0. Serial 2.0. Serial 2.0. Serial ATA 2.0. Serial Seriad 2.0. Serial Serial Serial Serial Serial Serial Seri	Zugriffszeit	5.56 ms
PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6 Datentransferrate intern max. 1175 MBi/s max. 1175 MBi/s zum / vom Host max. 1175 MBi/s positionierzet 1 ms minimal (Spur zu Spur) 1 ms nomial (Leszzugriff) 30 ms Elektrische Eigenschaften 1 Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 A bei 5 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport 5 bis 50%, nicht kondensierend Vibraton ³ 5 bis 500 Hz: max. 0.125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Stis 50%, nicht kondensierend 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 0.5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport max	unterstützte Transfermodi	SATA 1.0 Serial ATA Revision 2.6
Datentransferrate max. 1175 MBH/s intern max. 1175 MBH/s zum / vom Host max. 1175 MBH/s Positionierzeit max. 1175 MBH/s minimal (Spur zu Spur) 1 ms nominal (Leszugriff) 1 ms maximal (Leszugriff) 30 ms Elektrische Eigenschaften 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Tamperatur 0 0 bis 60°C Betrieb 21 0 bis 60°C Betrieb 24 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 500 Hz: max. 0.125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0.125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Stis 500 Hz: max. 0.25 g; Jauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport max. 125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 202 g; D Staven pro Minute; keine Bes		PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
intern max. 1175 MBU/s zum / vom Host max. 105 MByte/s Positionierzeit 1 ms moimial (Spur zu Spur) 1 ms nominal (Lesezugriff) 30 ms Elektrische Eigenschaften 1 Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 Temperatur ¹⁰ 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (galegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (galegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g. 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Stis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g. 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g. 2 ms; keine	Datentransferrate	
zum / vom Host max. 150 MByte/s Positionierzeit 1 ms minima (Lesezugriff) 1 4 ms maxima (Lesezugriff) 30 ms Elektrische Eigenschaften 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 A bei 5 V (PCI Bus) Temperatur ¹) 0 bis 60°C Betrieb 2 ³ 0 bis 60°C Lagerung 0 bis 70°C Lagerung 40 bis 70°C Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 50%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 500 Hz: s g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler S bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: s g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: s g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Reicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: s g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Reireb (gelegentlich) max	intern	max. 1175 MBit/s
Positionierzeit 1 ms mominal (Lesezugriff) 1 ms maximal (Lesezugriff) 30 ms Elektrische Elegenschaften 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 hs Temperatur ¹⁰ 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Utriteuchtigkeit ¹⁰ 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Sterieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Schock ⁿ max. 125 g; 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 125 g; 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0.5 ms; keine Beschädigung Schock ⁿ max. 300 g, 0.5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0.5 ms; keine Beschädigung Transport -300 bis 3048 m Lagerung -300 bis 3048 m	zum / vom Host	max. 150 MBvte/s
minimal (Spur zu Spur) 1 ms nominal (Lesezugrift) 30 ms Elektrische Eigenschaften 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 A bei 5 V (PCI Bus) Temperatur ¹ 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit ⁴ 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 500 Hz: max, 0.25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebaren Fehler Betrieb (gauentaht) 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0.5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0.5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0.5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0.5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport max. 400 g; Z ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g; 0, 5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g; 0, 5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g; 0, 5 ms; keine Beschädigung Max. 300 g; 0, 5 ms; keine Beschädigung max. 300 g; 0, 5 ms; keine Beschädigung <	Positionierzeit	
mominal (Lesezugiff) 14 ms mominal (Lesezugiff) 30 ms Elektrische Elegneschaften 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Leistungsaufnahme 1 A bei 5 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 A bei 5 V (PCI Bus) Temperatur ¹⁰ 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit ⁴⁰ 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ³⁰ max. 125 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport max. 400 g; 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g; 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g; 2 ms; keine Beschädigung Max. 400 g; 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g; 0, 5 ms; keine Beschädigung Max. 400 g; 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g; 0, 5 ms; keine Beschädigung<	minimal (Spur zu Spur)	1 ms
maximal (Lesezugnif) 30 ms Elektrische Eigenschaften 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Leistungsaufnahme 1 A bei 5 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 1 A bei 5 V (PCI Bus) Temperatur ¹⁰ 0 bis 60°C Betrieb - 24 Stunden ³⁰ 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit ⁴⁰ 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 0 S Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 0 S Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ³⁰ max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 0 S Oktaven pro Minute; keine Fehler Lagerung max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0.5 ms; keine Beschädigung Merenshöhe -300 bis 1212 m	nominal (Lesezugriff)	14 ms
Transport Other Section Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) Ungebungsbedingungen 1 A bei 5 V (PCI Bus) Umgebungsbedingungen 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Betrieb ² 0 bis 60°C Lagerung 40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit ⁴ 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport -20 bis 70°C Luffeuchtigkeit ⁴ 5 bis 95%, nicht kondensierend Sterieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g: Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Sterieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g: Dauer 0.5 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g: Dauer 0.5 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g: Dauer 0.5 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g: Dauer 0.5 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g: Dauer 0.5 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport max. 125 g. 2 ms; keine Beschädigung Transport	maximal (Lesezugriff)	30 ms
Leistungsaufnahme 0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus)	Elektrische Eigenschaften	
Construction Construction Umgebungsbedingungen 1 A bei 5 V (PCI Bus) Temperatur % 0 bis 60°C Betrieb 2% 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit % 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 500 Hz; max, 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz; max, 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz; 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz; 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz; 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz; 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 0,0 s m; keine Beschädigung Transport 0,0 s m; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 m; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 m; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 m; keine Beschädigu	Leistungsaufnahme	0.3 A bei 3.3 V (PCI Bus)
Ungebungsbedingungen Output		1 A bei 5 V (PCI Bus)
Temperatur ') 0 bis 60°C Betrieb - 24 Stunden *> 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Utiffeuchtigkeit *) 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration *> 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung Itagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0, 5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung Mereshöhe -300 bis 3048 m Lagerung -300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften -300 bis 12192 m Montage fix % Gewicht	Umgebungsbedingungen	
Betrieb ?? 0 bis 60°C Betrieb - 24 Stunden 3° 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit 4° 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration 9° 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Schock ^(h) max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung Betrieb max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung Marka 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung Marka 400 g, 2 ms; keine Beschädigung	Temperatur ¹⁾	
Betrieb 0 bis 60°C Lagerung -40 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Laffeuchtigkeit ⁴) 5 bis 95%, nicht kondensierend Batrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ⁹ 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ⁵⁰ max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe -300 bis 3048 m Lagerung -300 bis 3048 m Lagerung -300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften -300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften -300 bis 350 g </td <td>Betrieb²⁾</td> <td>0 bis 60°C</td>	Betrieb ²⁾	0 bis 60°C
Lagerung 440 bis 70°C Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit */ 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock */ max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb max. 300 g, 1 ms; keine Beschädigung Transport	Betrieb - 24 Stunden 3)	0 bis 60°C
Transport -40 bis 70°C Luffeuchtigkeit *0 5 bis 95%, nicht kondensierend Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration *0 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock *0 max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 3048 m Lagerung<		-40 bis 70°C
Interport 1000000000000000000000000000000000000	Transport	-40 bis 70°C
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ⁵) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ⁵⁰ max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Mecreshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Metreshöle - 300 bis 12192 m Herstellerinformation - 300 bis 12192 m He	Luftfeuchtigkeit 4)	
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend Vibration ⁵ 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ⁵⁰ max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0, 5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 3048 m Montage fx ⁶) Gewicht 350 g Herstellerinformation - 300 bis 3048 m Herstellerinformation Stag250 g	Betrieb	5 his 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 500, mich kondensierend Vibration 5) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: s g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock 5) max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Mereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 3048 m Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 3048 m Herstellerinformation - 305 g		5 bis 95% nicht kondensierend
Transport 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ⁵) max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 3048 m Meeranische Eigenschaften - 300 bis 3048 m Herstellerinformation - 305 g Herstellerbezeichnung Sto 9	Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Schock ⁵⁰ 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ⁵⁰ max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 125 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Mecreasibe - 300 bis 3048 m Lagerung - 30	Vibration 5)	
Betrieb (dateman) 5 bis 500 Hz: max. 0, 225 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 0, 25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Schock ⁶) 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Mereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 3048 m Betrieb - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 350 g Herstellerinformation Sto 9 Herstellerbezeichnung Sto 9 J	Retrieb (dauerbaft)	5 bis 500 Hz; max, 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behehbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktave pro Minute; keine Beschädigung Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung Schock ⁵⁾ max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 g Montage fix ⁶) Gewicht 350 g Herstellerhormation Stagate Herstellerhormation Stagate	Betrieb (daternan)	5 bis 500 Hz; max 0.25 g; Dater 1 Oktave pro Minute, keine nicht behabbaren Fahler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute, keine Beschädigung Schock ⁵⁾ max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 3048		5 bis 500 Hz; Fig: Dauer 1 Oktave pro Minute, keine Richt benebbaren riehen
Schock ⁽⁵⁾ Betrieb Lagerung max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften fix ⁽⁶⁾ Gewicht 350 g Herstellerinformation Sto 350 g	Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock ** max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung Meereshöhe max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung Betrieb - 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Montage fix ⁶) Gewicht 350 g Herstellerinformation - Hersteller Seagate Herstellerbezeichnung ST9250315AS		5 bis 500 Hz. 5 g, Dauel 0,5 Oklavell plo Millule, kelle Beschaulgung
Betreb max. 125 g, 2 ms, kerre micht berrebaten Perifer Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Montage fix ⁶) Gewicht 350 g Herstellerinformation - 100 Seagate Hersteller Seagate ST9250315AS	Detrich	may 125 a 2 may keine nicht hehehharen Fahler
Lagerung max. 400 g, 2 ms, keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung Meereshöhe max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Betrieb - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Montage fix ⁶) Gewicht 350 g Herstellerinformation	Legerung	Hidk. 125 g. 2 His, Keile Hidli beliebbaler Feiller
Transport max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Montage fix ⁶) Gewicht 350 g Herstellerinformation	Lagerung	max. 400 g, 2 ms, keine Beschädigung
Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 3048 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Montage fix ⁶) Gewicht 350 g Herstellerinformation - Hersteller Seagate Herstellerbezeichnung ST9250315AS		max. 300 g, 1 ms, keine Beschädigung
Hansport max. 500 g, 1 ms, keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe Betrieb Lagerung Montage Gewicht Montage Herstellerinformation Hersteller Stragete Hersteller Stragete	Transport	max, 400 g, 2 ms, keine Beschädigung
Meereshöhe max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung Meereshöhe - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Montage fix % Gewicht 350 g Herstellerinformation - Hersteller Seagate Herstellerbare ST9250315AS	Tanoport	max 500 g 1 ms, keine Beschädigung
Meereshöhe - 300 bis 3048 m Betrieb - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Montage fix % Gewicht 350 g Herstellerinformation - Hersteller Seagate Herstellerbezeichnung ST9250315AS		max. 300 g. 0.5 ms; keine Beschädigung
Betrieb - 300 bis 3048 m Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - 300 bis 12192 m Montage fix % Gewicht 350 g Herstellerinformation - 300 bis 3048 m Hersteller Seagate Herstellerbezeichnung ST9250315AS	Meereshöhe	
Lagerung - 300 bis 12192 m Mechanische Eigenschaften - Montage fix ⁶ Gewicht 350 g Herstellerinformation - Hersteller SEgagate Herstellerbezeichnung ST9250315AS	Betrieb	- 300 bis 3048 m
Mechanische Eigenschaften Montage Gewicht 350 g Herstellerinformation Herstellerbezeichnung		- 300 bis 12192 m
Montage fix 6) Gewicht 350 g Herstellerinformation Hersteller Seagate Herstellerbezeichnung	Mechanische Eigenschaften	
Gewicht 350 g Herstellerinformation Hersteller Seagate Herstellerbezeichnung	Montage	fix ⁶)
Herstellerinformation Seagate Herstellerbezeichnung ST9250315AS	Gewicht	350 m
Hersteller Seagate Herstellerbezeichnung ST9250315AS	Herstellerinformation	
Herstellerbezeichnung ST9250315AS	Hersteller	Seanate
	Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 107: 5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

- 4) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
- 5) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
- 6) Montageweise auf PCI Einschub.





Abbildung 56: 5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.22.5 Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.9.22.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 8 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 184.

3.9.22.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 250GB 5MMHDD.0250-00 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 367.

3.9.23 5ACPCI.RAIC-06

3.9.23.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten 500 GByte Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2x 500 GByte SATA Hard Disk (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s



Abbildung 57: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)" eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel bei einer Speichergröße von 500 GByte ca. 500 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

3.9.23.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5ACPCI.RAIC-06	PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	A DECEMBER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER
	Optionales Zubehör	A STATE OF STATE
	Laufwerke	S of a
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 108: 5ACPCI.RAIC-06 - Bestelldaten
3.9.23.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-06
Allgemeines	
Kapazität	2x 500 GByte
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Controller	
Тур	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk ²⁾	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0.2%
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH ³⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5.5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	-
intern	max. 147 MBvte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ⁴	
Betrieb ⁵⁾	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 6)	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 7)	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration ⁸⁾	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Iransport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Iransport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-305 bis 3048 m
Lagerung	-305 DIS 12192 M
Mechanische Eigenschaften	
Wontage	

Tabelle 109: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-06
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 109: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) Technische Daten für eine Hard Disk.
- 3) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 4) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 5) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 6) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 7) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde
- 8) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
- 9) Montageweise auf PCI Einschub.

3.9.23.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 58: 5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.9.23.5 Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.9.23.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 8 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 184.

3.9.23.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 500 GByte 5MMHDD.0500-00 als Ersatzteil für eine Hard Disk verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 367.

Kapitel 2 Technische Daten

3.9.24 5MMHDD.0250-00

3.9.24.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.

- 250 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk f
 ür die Hard Disk 5AC801.HDDI-03 oder f
 ür den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-05
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)

- f
 ür 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

3.9.24.2 Bestelldaten

Bestellnummer

5MMHDD.0250-00

Kurzbeschreibung	Abbildung
Laufwerke	
250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein- satz der Hard Disk.	

Tabelle 110: 5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten

3.9.24.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja
GOST-R	Ja
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
	PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate	
intern	max. 1175 MBit/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)

Tabelle 111: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00	
Positionierzeit		
minimal (Spur zu Spur)	1 ms	
nominal (Lesezugriff)	14 ms	
maximal (Lesezugriff)	30 ms	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur ²⁾		
Betrieb ³⁾	0 bis 60°C	
Betrieb - 24 Stunden 4)	0 bis 60°C	
Lagerung	-40 bis 70°C	
Transport	-40 bis 70°C	
Luftfeuchtigkeit 5)		
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler	
Schock		
Betrieb	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler	
Meereshöhe		
Betrieb	-300 bis 3048 m	
Lagerung	-300 bis 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	9,5 mm	
Höhe	69 mm	
Tiefe	100 mm	
Gewicht	100 g	
Herstellerinformation		
Hersteller	Seagate	
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS	

Tabelle 111: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

3.9.24.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm





3.9.25 5MMHDD.0500-00

3.9.25.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.

- 500 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk f
 ür die Hard Disk 5AC801.HDDI-04 bzw. 5AC901.CHDD-01 oder f
 ür den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-06
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

3.9.25.2 Bestelldaten

-	Kapitel 2 Technische Daten
	_

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 112: 5MMHDD.0500-00 - Bestelldaten

3.9.25.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0500-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Hard Disk	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm ±0,2%
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH ²⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja

Tabelle 113: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0500-00
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate	
intern	max. 147 MByte/s
zum / vom Host	max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit	
nominal (Lesezugriff)	11 ms
maximal (Lesezugriff)	21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ³⁾	
Betrieb ⁴⁾	0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 5)	0 bis 60°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 6)	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-305 bis 3048 m
Lagerung	-305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	7 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	100 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 113: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zuund Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

3.9.25.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 60: 5MMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.10 Lüfter Kit

Information:

Lüfter sind notwendig, wenn Komponenten eingesetzt werden, die eine eingeschränkte Umgebungstemperatur aufweisen, z.B. DVD Combo, PCI Karten.

Die Lüfter bzw. Staubfilter stellen ein Verschleißteil dar und müssen in angemessenem Abstand kontrolliert und bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Verschmutzung) gereinigt oder ausgetauscht werden.

3.10.1 5AC803.FA01-00

3.10.1.1 Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten ohne Expansion eingebaut werden.



Abbildung 61: 5AC803.FA01-00 - Lüfter Kit

3.10.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5AC803.FA01-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten ohne Expansion.	

Tabelle 114: 5AC803.FA01-00 - Bestelldaten

3.10.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC803.FA01-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	3
Drehzahl	max. 6100 rpm
Geräuschpegel	21 dB
Lebensdauer	29000 Stunden bei 70°C
	95000 Stunden bei 20°C
Тур	doppelt kugelgelagert

Tabelle 115: 5AC803.FA01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC803.FA01-00
Zertifizierungen	
CE	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	10 mm



3.10.2 5AC803.FA02-00

3.10.2.1 Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten mit der 1 Slot Expansion eingebaut werden.



Abbildung 62: 5AC803.FA02-00 - Lüfter Kit

3.10.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5AC803.FA02-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX01-00.	

Tabelle 116: 5AC803.FA02-00 - Bestelldaten

3.10.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC803.FA02-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	3
Drehzahl	Lüfter 1, 2: max. 6100 rpm
	Lüfter 3: 4300 rpm ± 10%
Geräuschpegel	Lüfter 1, 2: 21 dB
	Lüfter 3: 5 dB
Lebensdauer	Lüfter 1, 2: 29000 Stunden bei 70°C, 95000 Stunden bei 20°C
	Lüfter 3: 60000 Stunden bei 40°C
Тур	doppelt kugelgelagert

Tabelle 117: 5AC803.FA02-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponer	nten
Produktbezeichnung	5AC803.FA02-00
Zertifizierungen	
CE	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	Lüfter 1, 2: 40 mm
	Lüfter 3: 70 mm
Höhe	Lüfter 1, 2: 40 mm
	Lüfter 3: 70 mm
Tiefe	Lüfter 1, 2: 10 mm
	Lüfter 3: 15 mm

Tabelle 117: 5AC803.FA02-00 - Technische Daten

3.10.3 5AC803.FA03-00

3.10.3.1 Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten mit der 2 Slot Expansion eingebaut werden.



Abbildung 63: 5AC803.FA03-00 - Lüfter Kit

3.10.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5AC803.FA03-00	PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX02-00.	

Tabelle 118: 5AC803.FA03-00 - Bestelldaten

3.10.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC803.FA03-00			
Allgemeines				
Anzahl der Lüfter	4			
Drehzahl	Lüfter 1, 2, 3: max. 6100 rpm			
	Lüfter 4: 4300 rpm ± 10%			
Geräuschpegel	Lüfter 1, 2, 3: 21 dB			
	Lüfter 4: 5 dB			
Lebensdauer	Lüfter 1, 2, 3: 29000 Stunden bei 70°C, 95000 Stunden bei 20°C			
	Lüfter 4: 60000 bei 40°C			
Тур	doppelt kugelgelagert			
Zertifizierungen				
CE	Ja			
GOST-R	Ja			

Tabelle 119: 5AC803.FA03-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten				
Produkthozoichnung	54/202 5403 00			
Mechanische Eigenschaften	540005.1405-00			
Abmessungen				
Lüfter				
Breite	Lüfter 1, 2, 3: 40 mm Lüfter 4: 70 mm			
Höhe	Lüfter 1, 2, 3: 40 mm Lüfter 4: 70 mm			
Tiefe	Lüfter 1, 2, 3: 10 mm Lüfter 4: 15 mm			

Tabelle 119: 5AC803.FA03-00 - Technische Daten

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1 Montage

Die B&R Industrie PCs werden mit den am Gehäuse befindlichen Montageklammern bzw. Klemmblöcken (verschiedene Ausführungen möglich) vorzugsweise in Wanddurchbrüchen montiert.

1.1 Wichtige Informationen zur Montage

- Es müssen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.
- Beim Einbau in ein geschlossenes Gehäuse, muss ausreichend Volumen zur Luftumwälzung vorhanden sein.
- Das Gerät muss auf planer, sauberer und gratfreier Oberfläche montiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt werden.
- Bei der Montage des Geräts sind unbedingt die zulässigen Einbaulagen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des Geräts tragen kann.
- Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.
- Das Gerät muss so montiert werden, dass Reflexionen auf dem Bildschirm weitestgehend vermieden werden.
- Das Gerät muss so montiert werden, dass es vom Anwender optimal einsehbar ist.

1.2 Montage mit Klemmblöcken



Abbildung 64: Klemmblock

Die Klemmblöcke sind für eine maximale Stärke des zu klemmenden Materials von 10 mm ausgelegt, minimal darf die Materialstärke 2 mm betragen.

Für das Anziehen bzw. Lösen der Schraube wird ein Innensechskantschlüssel (Gr. 3) benötigt. Das maximale Anzugsmoment des Klemmblockes beträgt 0,5 Nm.

Das Gerät muss an einer planen, sauberen und gratfreien Oberfläche montiert werden da Unebenheiten beim Anziehen der Schrauben zu Beschädigungen des Displays und zum Eindringen von Staub und Wasser führen können.

1.3 Einbaulagen

Ein PPC800 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.

1.3.1 Einbaulage 0° und +/- 45°



Abbildung 65: Einbaulage 0° und +/-45°

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 161 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.3.2 Einbaulage mit 5AC801.DVRS-00



Abbildung 66: Einbaulage mit 5AC801.DVRS-00

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 161 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.3.3 Einbaulage mit 5AC801.DVDS-00



Abbildung 67: Einbaulage mit 5AC801.DVDS-00

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 161 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

Inbetriebnahme

Kapitel 3

1.4 Luftzirkulationsabstände

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und rückseitig des Panel PC 800 ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden Zeichnungen entnommen werden. Dieser ist für sämtliche Panel PC 800 Varianten gültig.



Abbildung 68: Abstände für Luftzirkulation

Information:

Die angegebenen Luftzirkulationsabstände gelten für den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifizierten Umgebungstemperatur (siehe "Temperaturangaben" im Kapitel "Technische Daten").

Können die angegebenen Luftzirkulationsabstände nicht eingehalten werden, sind die maximal spezifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" im Kapitel "Technische Daten") vom Anwender zu überwachen und bei Überschreiten dieser Werte entsprechende Maßnahmen zu setzen.

2 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.



Abbildung 69: Biegeradius Kabelanschluss

Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist dem Automation Panel 800 bzw. dem Automation Panel 900 Anwenderhandbuch, welches in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden kann, zu entnehmen.

3 Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutzmaßnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Störfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Störungsableitung und nicht als Berührungsschutz für Personen.

Die Funktionserde des Gerätes besitzt 2 Anschlüsse:

- Spannungsversorgung
- Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Störungen zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf möglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.
- Ausführung der Kabel mit mind. 2,5 mm² pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhülse an der Feldklemme 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm² pro Anschluss möglich.
- Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerät angeschlossenen Datenkabel sind mit geschirmten Leitungen auszuführen.



Abbildung 70: Erdungskonzept

4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests

Zweck dieser Anleitung ist die allgemeine Vorgehensweise von applikationsspezifischen Temperaturtests mit B&R Industrie PCs oder Power Panels zu erklären. Diese Anleitung stellt jedoch lediglich eine Richtlinie dar.

4.1 Vorgehensweise

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Testbedingungen den Bedingungen im Feldeinsatz entsprechen. Dies bedeutet, dass während den Temperaturtests die Zielapplikation laufen sollte, der PC im später verwendeten Schaltschrankgehäuse montiert sein sollte, etc.

Weiters sollte ein Temperatursensor für das zu testende Gerät montiert werden, um die Umgebungstemperatur laufend zu überwachen. Um korrekte Werte zu erhalten, ist dieser in einem Abstand von ca. 5 bis 10 cm vom B&R Industrie PC, in der Nähe der Luftansaugung (nicht in der Nähe der Abgabeluft), anzubringen.

Jeder B&R Industrie PC oder jedes Power Panel ist mit internen Temperatursensoren ausgestattet. Je nach Gerätefamilie sind diese an verschiedenen Positionen angebracht. Die Anzahl und Temperaturgrenzen sind je nach Gerätefamilie unterschiedlich.

Angaben zur Lage der Temperatursensoren sowie deren maximal spezifizierte Temperaturen sind dem Abschnitt "Temperatursensorpositionen" im 2 "Technische Daten" zu entnehmen.

Zur optimalen Bestimmung und Beurteilung der Temperatursituation wird eine Mindesttestzeit von 8 Stunden empfohlen.

4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen

4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center

Zur Auswertung der Temperaturen kann das B&R Control Center verwendet werden. Die Temperaturen können im Reiter "Temperaturen" angesehen werden. Das B&R Control Center kann als freier Download von der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden. Das B&R Control Center verwendet das B&R Automation Device Interface (ADI).

Display Taste	endereinstellung en LEDs raturwerte des F	Tempe Tempe Cund vor	onkseinstellunger raturen Lüfte nangeschlossene	n versionen er Schalter en Panels werder	USV
CPU:	10 / 50	°C/°F	Panel	AP Link (0)	
Board Board I/O: Board ETH2: Board Netzteil: ETH2:	43 / 109 42 / 107 42 / 107 54 / 129	C/F *C/*F *C/*F *C/*F	Slide-In 1: Slide-In 2: IF Slot:	0 / 32 0 / 32 (n.v.)	*C/*F *C/*F *C/*F
Netzteil:	42/107	*C/*F			

Ist eine historische Aufzeichnung der Daten notwendig, so kann eine eigene Applikation erstellt werden.

Information:

Zur Erstellung einer eigenen Applikation sind auf der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) eigene SDK's verfügbar, wie z.B. das ADI .NET SDK.

4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark

Wird zur Temperaturauswertung keine eigene Applikation erstellt bzw. verwendet, so empfiehlt B&R die Verwendung des Softwaretools BurnIn Test der Firma Passmark.

Das Softwaretool BurnIn ist in einer Standard und Professional Version erhältlich. Zusätzlich zum Softwarepaket sind auch noch verschiedene Loopback Adapter (Seriell, Parallel, USB, …) und Test-CDs bzw. DVDs erhältlich. Je nach Ausbaustufe der Software und vorhandenen Loopback Adapter kann eine entsprechend hohe Systemund Peripherielast erzeugt werden.

Information:

Loopback Adapter können ebenfalls von der Firma Passmark bezogen werden. Mehr Informationen dazu sind unter <u>www.passmark.com</u> zu finden.

Die nachfolgenden Screenshots beziehen sich auf die Passmark BurnIn Pro Version V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD.



Abbildung 71: Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD

Burnin Teet VI 0 Pro	🖂 🍷 ધ	9 😻 🍕		
Dummitest V4.0 P10 - P	vesuit shi	eet		
Machine Name: CPU Manufacturer: CPU Speed: Start time: Duration: Temperature: (Min / Current / Max)	APC812 GenuineInte 2166.9 MHz - -	l / 2167.1 MHz	Con CPU Stoj	fig file: LastUsed.cfg J Type: Intel(R) Core(TM)2 CPU T7400 @ 2.16GHz p time: -
Test Name	Cycle	Operations	Errors	Last Error Description
🏟 CPU - Maths	0	0	0	No errors
🟟 CPU - MMX / SSE	0	0	0	No errors
Immory (RAM)	0	0	0	No errors
📕 2D Graphics	0	0	0	No errors
🖂 3D Graphics	0	0	0	No errors
🗇 Disk (C:)	0	0	0	No errors
m Network 1	0	0	0	No errors
Network 2	0	0	0	No errors
😔 CD/DVD (D:)	0	0	0	No errors
🐗 USB Plug 1	0	0	0	No errors
🐗 USB Plug 2	0	0	0	No errors
🐗 USB Plug 3	0	0	0	No errors
🐠 USB Plug 4	0	0	0	No errors
🎑 Video Playback	0	0	0	No errors
🆕 Serial Port 1	0	0	0	No errors
Serial Port 2	0	0	0	No errors

Abbildung 72: Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD

Je nach Verfügbarkeit der Loopback Adapter und DVDs muss eine entsprechende Feineinstellung in den jeweiligen Testproperties vorgenommen werden.

Information:

Stehen keine USB- Loopback Adapter zur Verfügung, so können auch USB Memory Sticks verwendet werden. Die USB Memory Sticks müssen unter Windows als formatiertes Laufwerk zur Verfügung stehen. Der Test USB ist dann abzuwählen und die USB Memory Stick Laufwerke müssen in den Diskproperties als Testdevice konfiguriert werden.



Information:

Serielle Loopback Adapter können relativ einfach selbst erstellt werden. Dazu sind lediglich einige Pins mit Drähten an der seriellen Schnittstelle zu verbinden.



4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.

Die Implementierungsanleitung beschreibt nur die gerätespezifischen Funktionen und nicht die Hauptfunktion der Beispielprogramme.

Wird der Code aus den Beispielprogrammen übernommen, sind die Hinweise in der Implementierungsanleitung zu den TODO Anweisungen, I/O Zugriffsfunktionen usw. zu beachten!

Information:

Für jeden B&R Industrie PC oder jedes Power Panel können Beispielprogramme und Implementierungsanleitungen von der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) kostenlos heruntergeladen werden.

4.4 Auswertung der Messergebnisse

Der aufgezeichnete maximale Temperaturwert jedes einzelnen Sensors darf die in den Anwenderhandbüchern spezifizierte Temperaturgrenze nicht überschreiten.

Wenn die Temperaturtests nicht in einer geregelten Klimakammer durchgeführt werden können, so können diese z.B. in Büroumgebung durchgeführt werden. Dabei ist allerdings die Erfassung der Umgebungstemperatur notwendig. Auf Grund der im Hause B&R gewonnenen Erfahrung, können bei passiven Systemen (Systeme ohne Lüfter Kit) die gemessenen Temperaturwerte linear zur Umgebungstemperatur hochgerechnet werden. Um auch die Temperaturwerte bei Systemen mit Lüfter Kit hochrechnen zu können, müssen die Lüfter laufen. Weiters ist dabei auf die Drehzahl, usw. zu achten.

Werden die Temperaturtests in einer geregelten Klimakammer mit Lüfter durchgeführt, so werden die zu testenden Geräte durch diesen Lüfter gekühlt und somit auch die Messergebnisse verfälscht. Bei passiven Geräten sind die Messergebnisse somit unbrauchbar. Um jedoch auch Temperaturtests in Klimakammern mit Lüfter durchführen zu können ohne die Messergebnisse zu verfälschen, ist der Lüfter der Klimakammer auszuschalten und eine entsprechend große Vorlaufzeit (mehrere Stunden) einzuhalten.

Beispiel anhand eines APC810 2 Slot

Nachfolgendes Beispiel ist nur unter Einhaltung der Montage- und Einbaulagenvorschriften laut Anwenderhandbuch gültig.

Temperatursensor	Gemessene Temperatur	Hochgerechnete Temperatur	
Umgebungstemperatur	20°C	35°C	45°C
CPU	48°C	63°C	73°C
CPU Board	51°C	66°C	76°C
Board I/O	51°C	66°C	76°C
Board ETH2	52°C	67°C	77°C
Board Netzteil	51°C	66°C	76°C
ETH2	65°C	80°C	90°C
Netzteil	51°C	66°C	76°C

Tabelle 120: Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot

5 Anschlussbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele bieten einen Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten, in welcher Art Automation Panel 900 Geräte und/oder Automation Panel 800 Geräte mit dem PPC800 verbunden werden können. Es sollen dabei unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie können Automation Panel 900 Geräte am Monitor/ Panel Ausgang des PPC800 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Wie können Automation Panel 800 Geräte am Monitor/ Panel Ausgang des PPC800 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Was bedeutet "Display Clone" und "Erweiterter Desktop" Betrieb?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können pro Strang angeschlossen werden?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können mit einem Automation Panel 800 Gerät pro Strang angeschlossen werden?
- Wie werden die angeschlossenen Geräte intern nummeriert?
- Gibt es Einschränkungen bei der Segmentlänge, wenn ja welche?
- Welche Kabel und Linkbaugruppen werden benötigt?
- Müssen BIOS Einstellungen für eine bestimmte Konfiguration geändert werden?

5.1 Auswahl der Displayeinheiten

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen, müssen die Geräte den gleichen Displaytyp besitzen. In der folgenden Tabelle werden die möglichen AP900 Geräte aufgelistet die mit einem AP800 Gerät an einem Strang angeschlossen werden können.

Automation Panel 800	Automation Panel 900
5AP820.1505-00	5AP920.1505-01
	5AP951.1505-01
	5AP980.1505-01
	5AP981.1505-01
5AP880.1505-00	5AP920.1505-01
	5AP951.1505-01
	5AP980.1505-01
	5AP981.1505-01

Tabelle 121: Auswahl der Displayeinheiten

5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard

An die integrierte DVI Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 mit max. SXGA Auflösung angeschlossen. Alternativ kann auch ein Office TFT mit DVI Schnittstelle oder ein analoger Monitor (über Adapter Best. Nr. 5AC900.1000-00) betrieben werden. Touch Screen und USB werden jeweils über eigene Kabel geführt. Sollen USB Geräte am Automation Panel 900 betrieben werden, so kann die Distanz max. 5 Meter betragen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.



Abbildung 73: Ein Automation Panel 900 über DVI

5.2.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Syste	Einschränkung	
	5PC820.1505-00	5PC820.1906-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	max. SXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	×	√	max. SXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	×	√	max. SXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	√	max. SXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	max. SXGA

Tabelle 122: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.2.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLDVI.1000-01	Automation Panel Link DVI Receiver Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 123: Linkbaugruppen

5.2.3 Kabel

Auswahl jeweils eines Automation Panel 900 Kabels aus den 3 benötigten Typen.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	5 m ±80 mm
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	10 m ±100 mm
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm

Tabelle 124: Kabel für DVI Konfigurationen

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	5 m ±80 mm
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	10 m ±100 mm
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	5 m ±50 mm

Tabelle 124: Kabel für DVI Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

Es können folgende Automation Panel 900 Geräte verwendet werden, wobei in seltenen Fällen eine Einschränkung der Segmentlänge in Abhängigkeit der Auflösung besteht.

Bestellnummer	Diagonale	Auflösung	Touchscreen	Tasten	max. Segmentlänge
5AP920.1043-01	10,4"	VGA	1	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1214-01	12,1"	SVGA	√	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1505-01	15,0"	XGA	√	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1706-01	17,0"	SXGA	1	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1906-01	19,0"	SXGA	√	-	5 m / 10 m ¹⁾

Tabelle 125: Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

1) Keine USB Unterstützung am Automation Panel 900 möglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Bei der Übertragunsart DVI ist kein Auslesen von Statistikwerten bei den Automation Panel 900 Geräten möglich.

5.2.5 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.



Abbildung 74: Ein Automation Panel 900 über SDL onboard

5.3.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 800/900 Gerätes).

CPU Board	mit Syste	Einschränkung	
	5PC820.1505-00	5PC820.1906-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	1	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 126: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.3.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver	für Automation Panel 900
	Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-	
	vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	

Tabelle 127: Linkbaugruppen

5.3.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm

Tabelle 128: Kabel für SDL Konfigurationen

Kapitel 3 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme • Anschlussbeispiele

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 128: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

5.3.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel	Auflösung					
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03		- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	-	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	-	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 129: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.3.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 800 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Extension Keyboard angeschlossen werden.



Abbildung 75: Ein Automation Panel 800 über SDL onboard

5.4.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 800/900 Gerätes).

CPU Board	mit Syste	Einschränkung	
	5PC820.1505-00	5PC820.1906-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	\checkmark	√	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	\checkmark	√	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	\checkmark	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	\checkmark	√	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	\checkmark	\checkmark	max. UXGA
5PC800.B945-05	1	✓	max. UXGA

Tabelle 130: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.4.2 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 800 SDL Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 25 m.	25 m ±230 mm
5CASDL.0300-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm

Tabelle 131: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

5.4.2.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Inbetriebnahme • Anschlussbeispiele

Kabel	Auflösung
Segmentlänge [m]	XGA 1024 x 768
1,8	5CASDL.0018-20
5	5CASDL.0050-20
10	5CASDL.0100-20
15	5CASDL.0150-20
20	5CASDL.0200-20
25	5CASDL.0250-20
30	5CASDL.0300-30
40	5CASDL.0400-30

Tabelle 132: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.4.3 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) sind ein Automation Panel 900 und ein Automation Panel 800 über SDL angeschlossen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur am ersten Display (front- und rückseitig), bis maximal 40 m, zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Automation Panel 900 bzw. am Extension Keyboard angeschlossen werden.



Abbildung 76: Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard

5.5.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 800/900 Gerätes).

CPU Board	mit Syste	Einschränkung	
	5PC820.1505-00	5PC820.1906-00	Auflösung
5PC800.B945-00 5PC800.B945-10	\checkmark	✓	max. UXGA
5PC800.B945-01 5PC800.B945-11	\checkmark	✓	max. UXGA
5PC800.B945-02 5PC800.B945-12	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-03 5PC800.B945-13	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-04 5PC800.B945-14	✓	✓	max. UXGA
5PC800.B945-05	✓ ✓	✓ ✓	max. UXGA

Tabelle 133: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.5.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 134: Linkbaugruppen

5.5.3 Kabel

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 171.

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 173.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehör".

5.5.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. An diesem Automation Panel werden bis zu drei weitere Automation Panel des selben Typs über SDL Kabel betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr am ersten Panel (front- und rückseitig) zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.



Abbildung 77: Vier Automation Panel 900 über SDL onboard

5.6.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von PPC800 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 800/900 Gerätes).

CPU Board	mit Syste	emeinheit	Einschränkung
	5PC820.1505-00	5PC820.1906-00	Auflösung
5PC800.B945-00	\checkmark	1	max. UXGA
5PC800.B945-10		•	
5PC800.B945-01	\checkmark	1	max. UXGA
5PC800.B945-11		v	
5PC800.B945-02	1	1	max. UXGA
5PC800.B945-12	v	•	
5PC800.B945-03	/	1	max. UXGA
5PC800.B945-13	v	•	
5PC800.B945-04	,	(max. UXGA
5PC800.B945-14	↓ ↓	V	
5PC800.B945-05	1	1	max. UXGA

Tabelle 135: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.6.2 Linkbaugruppen

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser- vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

5.6.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 137: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

5.6.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel	Auflösung					
Segmentlänge [m]	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03		- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	-	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	-	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 138: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.6.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter "Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices").

6 Touchkalibrierung

Die B&R Touch Screen Geräte sind mit einem Touch Controller, welcher eine Hardware Kalibrierung unterstützt, ausgestattet. D.h. diese Geräte sind bereits ab Werk vorkalibriert (pre calibration). Diese Eigenschaft bringt gerade im Ersatzteilfall große Vorteile, da bei einem Gerätetausch (identes Modell/Typ) in der Regel eine neuerliche Kalibrierung nicht mehr erforderlich ist. Um beste Resultate zu erzielen und den Touch Screen an die Bedürfnisse des Benutzers wieder anzupassen, empfehlen wir dennoch diesen zu kalibrieren.

Unabhängig davon erfordert der Touch Treiber während bzw. nach der Installation einmalig die Durchführung einer Kalibrierung.

6.1 Windows XP Professional

Nach der Installation von Windows XP Professional auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

6.2 Windows XP Embedded

Nach dem ersten Start (First Boot Agent) von Windows XP Embedded auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> der passende Treiber zum Download bereit.

6.3 Windows Embedded Standard 2009

Nach dem ersten Start (First Boot Agent) von Windows Embedded Standard 2009 auf einem Panel PC oder Power Panel wird der passende Touch Treiber automatisch installiert.

Auf allen anderen Geräten muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

6.4 Windows 7 Professional / Ultimate

Nach der Installation von Windows 7 auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

6.5 Windows Embedded Standard 7 Embedded / Premium

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert.

Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein Automation Panel 800/900/9x3/9xD nachträglich angeschlossen, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

6.6 Windows CE

In der Standardkonfiguration (Auslieferungsstand) startet Windows CE während des ersten Bootens die Touchkalibrierung.

6.7 Automation Runtime / Visual Components

Der Touch Screen muss bei Erstinbetriebnahme einmalig in der Kundenapplikation für das vorliegende Gerät und Projekt kalibriert werden.
7 Anschluss von USB Peripheriegeräten

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

7.1 Lokal am PPC800

An die 5 USB Schnittstellen am Panel PC 800 können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese maximal mit jeweils 1A belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.



Abbildung 78: Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am PPC800

Inbetriebnahme

7.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.

Information:

Am Automation Panel 900 kann kein HUB, sondern es können nur Endgeräte angeschlossen werden.



Abbildung 79: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI

7.3 Remote am Automation Panel 800/900 über SDL

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 bzw. USB Anschlüsse bei Automation Panel 800 Geräten können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 1.1.

Information:

Am Automation Panel 800/900 kann kein HUB, sondern es können nur Engeräte angeschlossen werden.



Abbildung 80: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL

8 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Information:

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist für die PCI SATA Controller 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5ACPCI.RAIC-06 gültig.

Für die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des "RAID Configuration Utility" einzusteigen. Nach dem POST <Strg+S> oder <F4> Drücken um das RAID BIOS aufzurufen.



Abbildung 81: Einstieg in das RAID Configuration Utility

RAID	Configuration	Utility -	Silicon Im	age Ir	nc. Copyr	right (C) 2006
Create Delete Rebuild Resolve Low Lev	RAID set RAID set Mirrored set Conflicts el Format				Press " set	'Enter" to create RAID
* 0 PM 1 SM	ST96023AS ST96023AS			55GB 55GB		
					†↓ ESC Enter Ctrl-E	Select Menu Previous Menu Select Exit
					*	First HDD

Abbildung 82: RAID Configuration Utility - Menü

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
Cursor ↑	Zum vorherigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Enter	Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermenüs.
ESC	Rücksprung zum vorherigen Menü.
Ctrl+E	Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 139: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility

8.1 Create RAID Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006					
Create RAID set Delete RAID set Rebuild Mirrored Resolve Conflict Low Level Format	set Striped Mirrored		Striped	. = RAID 0	
* 0 PM ST960232 1 SM ST960232	S S	55GB 55GB			
			†↓ ESC Enter Ctrl-E	Select Menu Previous Menu Select Exit	
			*	First HDD	

Abbildung 83: RAID Configuration Utility - Menü

Über das Menü "Create RAID set" ist es möglich das RAID System als "Striped" = RAID0 oder "Mirrored" = RAID1 neu zu erstellen.

8.2 Create RAID Set - Striped

RAID Configuration	Utility - Silicon Image I	nc. Copyright (C) 2006
Auto Configuration Manual Configuration		Press "Enter" to automatica- lly create a striped (RAID 0) set Striped size is 16K First drive is drive 0 Second drive is drive 1
* 0 PM ST96023AS 1 SM ST96023AS	55GB 55GB	↓ Select Menu ESC Previous Menu Enter Select Ctrl-E Exit * First HDD

Abbildung 84: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped

"Auto Configuration"

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

"Manual Configuration"

Es ist möglich die erste und zweite HDD zu bestimmen sowie die "Chunk Size" (=Blockgröße, applikationsabhängig) auszuwählen.

8.3 Create RAID Set - Mirrored

RAID Configuration Utility - Silicon Image :	Inc. Copyright (C) 2006
Auto Configuration Manual Configuration	Press "Enter" to automatica- lly create a mirrored (RAID 1) set For migrating single HDD into RAID 1 set, use Manual configuration instead
* 0 PM ST96023AS 55GB 1 SM ST96023AS 55GB	†↓ Select Menu ESC Previous Menu
	Enter Select Ctrl-E Exit * First HDD

Abbildung 85: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored

"Auto Configuration"

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

"Manual Configuration"

Es ist möglich die "Source" und "Target" HDD zu bestimmen, sowie ob sofort ein Rebuild (Spiegelung) durchgeführt werden soll (Dauer ca. 50 Minuten) oder nicht.

8.4 Delete RAID Set

RAID Configuration	Utility - Silicon Image I	nc. Copyright (C) 2006
Create RAID set Delete RAID set Rebuild Mirrored set Resolve Conflicts Low Level Format	Set0	
0 PM ST96023AS 1 SM ST96023AS	55GB 55GB	
* Set0 SiI Striped Set 0 ST96023AS 1 ST96023AS	<pm> 111GB Chunk Size 16k Chunk Size 16k</pm>	↑↓ Select Menu ESC Previous Menu Enter Select Ctrl-E Exit * First HDD

Abbildung 86: RAID Configuration Utility - Delete RAID set

Über das Menü "Delete RAID set" kann ein bestehender RAID Verbund aufgelöst werden.

8.5 Rebuild Mirrored Set



Abbildung 87: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set

Über das Menü "Rebuild Mirrored set" kann ein Rebuild Vorgang bei RAID 1 Verbund bei einem Fehlerfalle, nach vorheriger Unterbrechung des Rebuild Vorganges oder beim Tausch einer Hard Disk neu gestartet werden.

Bei der Auswahl "onlinerebuild" wird der Rebuild nach dem Hochfahren des Systems im laufenden Betrieb durchgeführt. Durch z.B. das installierte SATA RAID Konfigurationsprogramm wird ein Event Pop Up angezeigt: SA-TARaid detected a new event und der Rebuild wird gestartet. Dauer des kompletten Rebuilds beträgt ca. 50 Minuten.

Bei der Auswahl "offlinerebuild" wird sofort ein Rebuild vor dem Start des Beriebssystems durchgeführt (Dauer abhänging von der jeweiligen Speichergröße).

8.6 Resolve Conflicts

RAID Configuration	Utility - Silicon Image I	nc. Copyright (C) 2006
Create RAID set Delete RAID set Rebuild Mirrored set Resolve Conflicts Low Level Format		Help for resolving conflicts
0 PM ST96023AS 1 SM ST96023AS	55GB 55GB	
* Set0 SiI Mirrored Set 0 ST96023AS 1 ST96023AS	<pm> 55GB Current Current</pm>	↓ Select Menu ESC Previous Menu Enter Select Ctrl-E Exit * First HDD

Abbildung 88: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts

Über das Menü "Resolve Conflicts" kann man Konflikte eines RAID Verbundes lösen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Status der Festplatten "conflict" ist.

8.7 Low Level Format



Abbildung 89: RAID Configuration Utility - Low Level Format

Über das Menü "Low Level Format" können einzelne Hard Disks formatiert werden. Zu diesem Zweck darf kein RAID Verbund konfiguriert sein. Ein Low Level Format einer Festplatte dauert ca. 40 Minuten.

9 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer

9.1 Backlight

Die Lebensdauer des Backlight wird in "Half Brightness Time" angegeben. Eine Betriebszeit von 50.000 Stunden würde bedeuten, dass nach dieser Zeit die Displayhelligkeit immer noch 50% beträgt.

9.1.1 Wie kann die Lebenszeit von Backlights verlängert werden?

- Die Displayhelligkeit auf den geringsten, für die Augen angenehmen Wert einstellen
- Verwendung von dunklen Bildern
- Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann ca. eine 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

9.2 Image Sticking

Als Image Sticking wird das "Einbrennen" eines Bildes nach längerer Anzeige eines statischen Bildes auf einem Display bezeichnet. Es tritt jedoch nicht nur bei statischen Bildern auf. Image Sticking wird in technischer Literatur auch als burn-in effect, image retention, memory effect, memory sticking oder ghost image bezeichnet.

Es werden 2 verschiedene Arten unterschieden:

- Fläche (Area type): man kann diese Art bei einem dunkelgrauen Bild erkennen. Der Effekt verschwindet, wenn das Display eine längere Zeit ausgeschaltet wird.
- Linie (Line type): kann zu einem bleibenden Schaden führen.

9.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?

- Statische Bilder
- Kein Bildschirmschoner
- Scharfe Kontrastübergänge (z.B. schwarz/weiß)
- Hohe Umgebungstemperaturen
- Betrieb außerhalb der Spezifikation

9.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?

- · Laufendes wechseln zwischen statischen und dynamischen Bildern
- Verhindern von zu großen Helligkeitsunterschieden zwischen Vorder- und Hintergrunddarstellung
- Verwendung von Farben mit ähnlicher Helligkeit
- · Verwendung von Komplementärfarben bei den Folgebildern
- Verwendung von Bildschirmschonern

10 Pixelfehler

Information:

Displays können auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bildpunkte (Pixelfehler) enthalten. Diese stellen keinen Anspruch auf Reklamation oder Gewährleistung dar.

11 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Die nachfolgenden Punkte sind bei den PPC800 Geräten bekannt:

- Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.
- Im Daisy Chain Betrieb von mehreren AP800/AP900 Geräten via SDL kann es bei der Erkennung des Touchcontrollers zur Anzeige eines roten "X" beim Touchcontroller Status im Control Center Applet des Touchtreibers kommen. Die Funktion des Touchsystems ist dadurch nicht beeinträchtigt. Dies kann durch Einstellen einer Panel Sperrzeit von 50 ms vermieden werden. Die Panel Sperrzeit kann mit dem B&R Key Editor konfiguriert werden.
- Die Grafik Auflösung HD (1366x768) wird vom Intel VBIOS nicht vollständig unterstützt, weshalb es nach dem POST zu Anzeigefehlern kommt. Das Bild flackert und ist um eine Zeile nach unten verschoben. Der BIOS POST sowie das BIOS Setup werden noch korrekt dargestellt. Bei OS Systemen, für die kein Grafiktreiber verfügbar ist (z.B. MS-DOS) oder auch bevor der Grafiktreiber des OS gestartet ist (z.B. Bootlogo des Windows XP), tritt dieser Effekt auf. Bei einem korrekt gebooteten Windows XP bzw. Windows 7 mit installiertem Grafiktreiber, wird die HD Auflösung wieder richtig dargestellt.

Kapitel 4 • Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Menüpunkte einschließlich Beschreibungen beziehen sich auf die BIOS Version 1.18. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Version übereinstimmen.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für "Basic Input and Output System". Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS des American Megatrends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermöglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Drücken des Power Buttons wird das BIOS aktiviert. Es wird überprüft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM "OK" sind. Sind diese "OK", werden sie in das CMOS übertragen. Sind diese "nicht OK", werden die CMOS Daten auf Gültigkeit überprüft. Sind die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste <Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser "Vorbereitungen" durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und übergibt diesem die Kontrolle über die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die "Entf" Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedrückt werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (während POST): "Press DEL to run Setup"

AMIBIOS(C)2003 American Megatrends, Inc. [APC2R118] Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik H1.18 Sorial Number : 133453
CPU : Intel (R) Core (TM) 2 CPU T7400 @ 2.16GHz Speed : 2.16 Ghz
Press DEL to run Setup Press F11 for DDS FOPUP The MCH is operating with DDR2-677/CL5 in Dual-Channel Interleaved Mode Initializing USB Controllers Done 2048MB OK USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Hub Auto-Detecting Sec MasterIDE Hard Disk Auto-Detecting Sec SlaveIDE Hard Disk Sec Master: SILICONSYSTEMS INC 4GB 240-0230 Sec Slave : SILICONSYSTEMS INC 4GB 240-0230 Auto-Detecting USB Mass Storage Devices 00 USB mass storage devices found an configured.

Abbildung 90: Boot Screen

1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind während dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers angenommen.

Tasten	Funktion					
Entf	Einstieg in das BIOS Setup Menü.					
F12	Mit F12 kann vom Netzwerk gebootet werden.					
F11	Aufruf des Bootmenüs. Es werden sämtliche bootfähigen Geräte die mit dem System verbunden sind aufgelistet. Mit Cursor ↑ und Cursor ↓ und durch Bestätigen von <enter> wird von diesem Gerät gebootet.</enter>					
	Please select boot device: HDD:SM-SILICONSYSTEMS INC 512MB					
	<pre>↑ and ↓ to move selection ENTER to select boot device ESC to boot using defaults</pre>					
<pause></pause>	Mit der <pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Drücken jeder anderen beliebigen Taste läuft der POST weiter.</pause>					

Tabelle 140: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
F1	Generelle Hilfe.
Cursor ↑	Zum vorigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Cursor ←	Zum vorigen Objekt.
Cursor →	Zum nächsten Objekt.
+-	Ändert die Einstellung der ausgewählten Funktion.
Enter	In das ausgewählte Menü wechseln.
Bild ↑	Auf die vorherige Seite wechseln.
Bild ↓	Auf die nächste Seite wechseln.
Pos 1	Man springt zum ersten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
Ende	Man springt zum letzten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
F2 / F3	Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.
F7	Änderungen werden zurückgesetzt.
F9	CMOS Default Werte für alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10	Speichern und schließen.
Esc	Untermenü verlassen.

Tabelle 141: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü

1.3 Main

Unmittelbar nach Drücken der Taste "Entf" beim Systemstart erscheint das Hauptmenü des BIOS Setups:

Main Advanced	Boot	Security	Power	Exit
System Time System Date BIOS ID : APC2R11	[] [] .8	08:05:51] Wed 12/10/2009]	I	Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field.
Processor : Intel (F CPU Frequency : 2166MHZ	R) Core(T)	4)2 CPU T7400		Use [+] or [-] to configure system Time.
System Memory : 2048MB				
Board Information Product Revision : C.C Serial Number : 133 BC Firmware Rev. : 907 MAC Address (ETH1): 003 Boot Counter : 37 Running Time : 16b) 3448 7 13:95:00	:F2:90		 ↔ Select Screen ↓ Select Item +- Change Field Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Abbildung 91: 945GME BIOS Main Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
System Time	Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batte- rie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung der Systemzeit	Individuelle Einstellung der Systemzeit im For- mat Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).
System Date	Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung vom Systemdatum	Individuelle Einstellung des Systemdatums im Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).
BIOS ID	Anzeige der BIOS Erkennung.	keine	-
Processor	Anzeige des Prozessortyps.	keine	-
CPU Frequency	Anzeige der Prozessor Frequenz.	keine	-
System Memory	Anzeige der Arbeitsspeichergröße.	keine	-
Product Revision	Anzeige der HW-Revision des CPUBoards.	keine	-
Serial Number	Anzeige der Serialnummer des CPUBoards.	keine	-
BC Firmware Rev.	Anzeige der Firmware Revision des CPUBoard- controllers.	keine	-
MAC Address (ETH1)	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH1 Schnittstelle.	keine	-
Boot Counter	Anzeige des Boot Zählers - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins (max. 16777215).	keine	-
Running Time	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden. (max. 65535).	keine	-

Tabelle 142: 945GME Main Menü Einstellmöglichkeiten

1.4 Advanced

Main	Advanced	Boot	Security	Power	1	Sxit
Advanced	Settings					
►ACPI Conf	iguration					
▶ PCI Confi	guration					
► PCI Expre	ss Configura	tion				
▶ Graphics	Configuratio	n				
► CPU Confi	guration					
► Chipset C	onfiguration					
▶ I/O Inter	face Configu	ration				
Clock Con	figuration					
► IDE Confi	guration					
Kowboard/	Mouse Config	uration			↔	Select Sereen
Remote Ac	cess Configu	ration			t↓	Select Item
CPU Board	Monitor			1	Enter	Go to Sub Scree
▶ Baseboard	/Panel Featu	res		1	F1	General Help
				1	F10	Save and Exit
				1	ESC	Exit

Kapitel 4 Software

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ACPI Configuration	Konfiguration der ACPI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "ACPI Configuration" auf Seite 196
PCI Configuration	Konfiguration der PCI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Configuration" auf Seite 197
PCI Express Configurati- on	Konfiguration der PCI Express Configuration.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Configuration" auf Seite 200
Graphics Configuration	Konfiguration der Grafikeinstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Graphics Configuration" auf Seite 202
CPU Configuration	Konfiguration der CPU Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Configuration" auf Seite 204
Chipset Configuration	Konfiguration der Chipset Funktionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Chipset Configuration" auf Seite 205
I/O Interface Configurati- on	Konfiguration der I/O Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "I/O Interface Configuration" auf Seite 206
Clock Configuration	Konfiguration der Clock Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Clock Configuration" auf Seite 207
IDE Configuration	Konfiguration der IDE Funktionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IDE Configuration" auf Seite 207
USB Configuration	Konfiguration der USB Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB Configuration" auf Seite 213
Keyboard/Mouse Confi- guration	Konfiguration der Keyboard/Mouse Optionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Keyboard/Mouse Configuration" auf Sei- te 214
Remote Access Configu- ration	Konfiguration der Remote Access Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Remote Access Configuration" auf Seite 215
CPU Board Monitor	Zeigt die aktuellen Spannungen wie auch die ak- tuellen Temperaturen des verwendeten Prozes- sors an.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Board Monitor" auf Seite 216
Baseboard/Panel Fea- tures	Anzeige gerätespezifischer Informationen und Einstellung gerätespezifischer Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard/Panel Features" auf Seite 217

Abbildung 92: 945GME Advanced Menü

Tabelle 143: 945GME Advanced Menü

1.4.1 ACPI Configuration

ACPI Settings		Enable / Disable
ACPI Aware O/S	[Yes]	ACPI support for Operating System.
ACPI Version Features	[ACPI v2.0]	ENABLE: If OS
ACPI APIC support	[Enabled]	supports ACPI.
Suspend mode	[S1 (POS)]	
USB Device Wakeup from S3/S4 []	[Disabled]	DISABLE: If OS
		does not support
Active Cooling Trip Point	[Disabled]	ACPI.
Passive Cooling Trip Point	[Disabled]	
Critical Trip Point	[105°C]	
		← Select Screen
		↑↓ Select Item
		+- Change Option
		F1 General Help
		F10 Save and Exit
		ESC Exit

Abbildung 93: 945GME Advanced ACPI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ACPI Aware O/S	Über diese Funktion wird festgelegt, ob das Be-	Yes	Das Betriebssystem unterstützt ACPI.
	triebssystem die ACPI-Funktion (Advanced Con- figuration and Power Interface) unterstützt.	No	Das Betriebssystem unterstützt ACPI nicht.
ACPI Version Features	Option zum Einstellen der zu unterstützenden	ACPI v1.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v1.0
	Energieoptionsspezifikationen. Die Nutzung der	ACPI v2.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v2.0
	ACPI-Funktionen setzt eine entsprechende Un- terstützung in den Treibern sowie in den einge- setzten Betriebssystemen voraus.	e entsprechende Un- n sowie in den einge- voraus.	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v3.0
ACPI APIC support	Über diese Option wird die Unterstützung des	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Advanced Programmable Interrupt Controllers im Prozessor festgelegt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion
Suspend mode Auswahl des ACPI Status welcher bei Aktivierung des Suspend Modus verwendet werden soll.	S1 (POS)	Einstellung S1 als Suspend Mode. Es werden nur wenige Funktionen ausgeschaltet und diese stehen auf Tastendruck wieder zur Verfügung	
		S3 (STR)	Einstellung S3 als Suspend Mode. Hier wird der aktuelle Zustand des Betriebssystems in das RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit Strom versorgt.
USB Device Wakeup from	Mit dieser Option kann eine Aktivität an einem an-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
S3/S4	geschlossenen USB-Gerät das System aus dem S3/S4 Schlafzustand aufwecken.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Active Cooling Trip Point	Über diese Funktion wird ein optionaler CPU Lüf-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	ter über das Betriebssystem eingeschaltet, wenn die eingestellte CPU Temperatur erreicht ist.	50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C	Temperatureinstellung für den Active Cooling Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Passive Cooling Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	CPU Temperatur das Betriebssystem die CPU Geschwindigkeit drosselt.	50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C	Temperatureinstellung für den Passive Cooling Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Critical Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher CPU Temperatur das Betriebssystem das Sys- tem herunterfährt.	80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C, 105°C, 110°C	Temperatureinstellung für den Critical Trip Point. In 5 Grad Schritten einstellbar.

Tabelle 144: 945GME Advanced ACPI Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.2 PCI Configuration

Advanced PCI/PnP Settings		NO: lets the BIOS
		configure all the
Plug & Play O/S	[Yes]	device in the system
PCI Latency Timer	[64]	YES: lets the
Allocate IRQ to PCI VGA	[Yes]	operating system
Allocate IRQ to SMBUS HC	[Yes]	configure Plug and
Allocate IRQ to PCIEX2	[Yes]	Play (PnP) devices n required for boot if
▶ PCI IRQ Resource Exclusio	n	your system has a Pl and Play operating
▶ PCI Interrupt Routing		system.
		↔ Select Screen
		↑↓ Select Item
		+- Change Option
		F1 General Help
		F10 Save and Exit
		ESC Exit

Abbildung 94: 945GME Advanced PCI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Plug & Play O/S	Dem BIOS kann hier mitgeteilt werden ob das verwendete Betriebssystem Plug & Play-fähig ist.	Yes	Das Betriebssystem übernimmt die Verteilung der Ressourcen.
		No	BIOS übernimmt die Verteilung der Ressour- cen.
PCI Latency Timer	Diese Option kontrolliert, wie lange (in PCI-Ticks) eine Karte des PCI-Bus den Master noch für sich beanspruchen darf, wenn eine andere PCI-Karte bereits einen Zugriff angemeldet hat.	32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248	Manuelle Einstellung des Wertes in PCI-Ticks.
Allocate IRQ to PCI VGA Mit dieser Funktion wird festgelegt ob dem PCI VGA ein Interrupt zugewiesen wird.	Mit dieser Funktion wird festgelegt ob dem PCI	Yes	Automatische Zuweisung eines Interrupts.
	No	Keine Zuweisung eines Interrupts.	
Allocate IRQ to SMBUS	Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der SM	Yes	Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
HC	(System Management) Bus Controller einen PCI Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.	No	Keine Zuweisung eines Interrrupts.
Allocate IRQ to PCIEX2	Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der	Yes	Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
	PCIEX2 einen PCI Interrupt zugewiesen be- kommt oder nicht.	No	Keine Zuweisung eines Interrrupts.
PCI IRQ Resource Exclu- sion	Konfiguration der PCI IRQ Resource Einstellun- gen für ISA Legacy Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI IRQ Resource Exclusion" auf Seite 198
PCI Interrupt Routing	Konfiguration des PCI Interrupt Routings	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Interrupt Routing" auf Seite 199

Tabelle 145: 945GME Advanced PCI Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.2.1 PCI IRQ Resource Exclusion

PCI IRQ Resource Exclusion		Available: Specified
IRQ3 IRQ4 IRQ5	[Available] [Allocated] [Available]	used by PCI/PnP devices. Reserved: Specified
IRQ6 IRQ7 IRQ9 IRQ10 IRQ11 IR012	[Available] [Available] [Allocated] [Available] [Allocated] [Available]	use by Legacy ISA devices.
IRQ14 IRQ15	[Allocated] [Allocated]	 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Abbildung 95: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
IRQx	IRQ Interruptzuweisung für Legacy ISA Geräte.	Allocated	Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
			den.
		Available	Verfügbar - kann verwendet werden.
		Reserved	Reserviert - kann nicht verwendet werden.

Tabelle 146: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmöglichkeiten

1.4.2.2 PCI Interrupt Routing

PCI Interrupt Routing		Sele	ct fixed IRQ or
	2) [2···+-]	set i	AUTO to let the
PIRO A (VGA, PCIEX4, ETHZ, UHCIZ, HD	A) [Auto]	BIUS	and US route an
PIRO B (PCIEXI,ETHI)	[Auto]	IRQ	to this line.
PIRQ C (PCIEXZ, IF-SIOC)	[Auto]	Malaa	sums that the
PIRO D (SATA, OHCII, SMB, PCIERS)	[Auto]	Make	sure that the
PIRQ E (INTD, OHCI3, PATA)	[Auto]	Sele	cted IRQ is not
PIRQ F (INTA)	[Auto]	assi	gned to legacy 10
PIRQ G (INTB)	[Auto]		
PIRQ H (INTC, UHCIU, EHCI)	[Auto]		
1 st Exclusive PCI	[None]		
2 nd Exclusive PCI	[None]		
3 rd Exclusive PCI	[None]		
PCIEXn · PCI Express Root Port n		-	Select Screen
INTE · External DCT Bus INTE I.	ino	+1	Select Item
PATA : Parallel ATA in Enhance	d/Native Mode	+-	Change Option
SATA : Serial ATA in Enhanced/	Native Mode	F1	General Help
SMB · System Management Bus C	ontroller	F10	Save and Exit
ond . System Management bus c	ONCLOTTEL	ET0	Dave and Exit

Abbildung 96: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PIRQ A (VGA,PCIEX4, ETH2,UHCI2,HDA)	Option zum Einstellen des PIRQ A.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ B (PCIEX1, ETH1)	Option zum Einstellen des PIRQ B.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ C (PCIEX2,IF-Slot)	Option zum Einstellen des PIRQ C.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
	5,6,7,9,10,11,12	5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ D (SATA,UHCI1,SMB,	Option zum Einstellen des PIRQ D. Auto Automatische Zuordnung das Betriebssystem.	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.	
CIEX3)	5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.	
PIRQ E (INTD,UHCI3,PATA)	Option zum Einstellen des PIRQ E.	Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.	
	5,6,7,9,10,11,12	5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ F (INTA)	Option zum Einstellen des PIRQ F.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ G (INTB)	Option zum Einstellen des PIRQ G.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ H (INTC,UHCI0,EHCI)	Option zum Einstellen des PIRQ H.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
1 st Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
	PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird.	x	Zuweisung des PIRQ als 1st Exclusiv PCI IRQ.
	Information: Wird nur angezeigt wenn ein PIRQ ma- nuell eingestellt wird (z.B. 5).		

Tabelle 147: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
2 nd Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
	PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird.	x	Zuweisung des PIRQ als 2nd Exclusiv PCI IRQ.
	Information: Wird nur angezeigt wenn zwei PIRQ ma- nuell eingestellt werden.		
3 rd Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
	PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird.	x	Zuweisung des PIRQ als 3rd Exclusiv PCI IRQ.
	Information: Wird nur angezeigt wenn drei PIRQ ma- nuell eingestellt werden.		

Tabelle 147: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten

1.4.2.3 PCI Express Configuration

PCI Express Configuration		Enab	Enable/Disable	
		PCI	Express LOs and	
Active State Power-Management	[Disabled]		ink power	
PCIE PORT U (ETHZ)	[Auto]	state	es.	
PCIE PORT I				
PCIE Port 2 (IF-SIOT)	[Auto]			
PULE PORT 3	[Auto]			
PCIE Port 4	[Auto]			
PCIE Port 5 (ETHI)	[Auto]			
PCIE High Priority Port	[Disabled]			
es. PCIE Hotplug Resources	[No]			
		↔	Select Screen	
PCIE Port 0 IOxAPCI Enable	[Disabled]	↑↓	Select Item	
PCIE Port 1 IOxAPCI Enable	[Disabled]	+-	Change Option	
PCIE Port 2 IOxAPCI Enable	[Disabled]	F1	General Help	
PCIE Port 3 IOxAPCI Enable	[Disabled]	F10	Save and Exit	
		ESC	Exit	

Abbildung 97: 945GME Advanced PCI Express Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Active State Power- Ma-	Active State Power- Ma- Option zum Einstellen einer Energiesparfunktio	Enabled	Aktivierung der Funktion.
nagement	(L0s/L1) für PCIE Slots wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 0 (ETH2)	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
	L. L. C. L. L. C. L.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	INTORMATION: Verwenden Sie keine PCI-Express Gerä- te sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 1	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	INTORMATION: Verwenden Sie keine PCI-Express Gerä- te sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 148: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCIE Port 2 (IF-Slot)	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Gerä- te sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 3	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Gerä- te sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 4	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	INTORMATION: Verwenden Sie keine PCI-Express Gerä- te sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 5 (ETH1)	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	INTORMATION: Verwenden Sie keine PCI-Express Gerä- te sollten sie die Option deaktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE High Priority Port	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den Prioritätsport für den PCIE.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Port 0	Aktivierung des Port 0 als Prioritätsport.
		Port 1	Aktivierung des Port 1 als Prioritätsport.
		Port 2	Aktivierung des Port 2 als Prioritätsport.
	_	Port 3	Aktivierung des Port 3 als Prioritätsport.
		ETH2	Aktivierung des ETH2 Port als Prioritätsport.
		EIH1	Aktivierung des ETH1 Port als Prioritätsport.
Res. PCIE Hotplug Re- source	Mit dieser Option kann eine I/O und Memory Re- source für einen nicht benützten PCIE Port reser- viert werden. Einen PCIE Port auf Enabled zu set- zen und Resourcen zu reservieren ist für eine Ex- pressCard hot-plug Unterstützung am betreffen- den Port notwendig.	Yes No	Resource wird reserviert. Resource wird nicht reserviert.
PCIE Port 0 IOxAPIC	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Enable	Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 0. Bei aktiviertem APIC- Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 1 IOxAPIC	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Enable	Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 1. Bei aktiviertem APIC- Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 2 IOxAPIC	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Enable	Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 2. Bei aktiviertem APIC- Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 3 IOxAPIC	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 3. Bei aktiviertem APIC- Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 148: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.3 Graphics Configuration

Graphics Configuration		Selec	ct primary video
Primary Video Device	[Internal VGA]	adapt durii	ter to be used ng boot up.
Internal Graphics Mode Select	[Enabled, 8MB]		
DVMT Mode Select	[DVMT Mode]		
DVMT/FIXED Memory	[128MB]		
Boot Display Device	[Auto]		
Boot Display Preference	[LFP SDVO-B SDVO-C]		
Local Flat Panel Type	[Auto]		
Local Flat Panel Scaling	[Expacnd Text&Graph]		
		\leftrightarrow	Select Screen
SDVO Port B Device	[DVI]	t↓	Select Item
SDVO Port C Device	[None]	+-	Change Option
		F1	General Help
SDVO/DVI Hotplug Support	[Enabled]	F10	Save and Exit
Display Mode Persistence	[Enabled]	ESC	Exit

Abbildung 98: 945GME Advanced Graphics Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Video Device	Option zur Auswahl des primären Anzeigegerä- tes.	Internal VGA	Als Anzeigegerät wird der interne Grafikchip am CPU Board verwendet (Monitor / Panel An- schluss).
		PCI / Int. VGA	Als Anzeigegerät wird der Grafikchip einer ge- steckten Grafikkarte verwendet.
Internal Graphics Mode Select	Option zur Einstellung der Speichergröße, wel- che für den internen Grafikcontroller verwendet werden kann.	Disabled	Keine Reservierung - Deaktivierung des Grafik- controllers.
		Enabled, 1MB	1MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
		Enabled, 8MB	8MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
DVMT Mode Select	Option zur Festlegung des DVMT Mode (Dyna- mic Video Memory Technology) des DVMT Gra- fiktreibers.	Fixed Mode	Dem Grafikchip wird eine feste Speichergröße zugeteilt, die dann allerdings dem PC nicht mehr zur Verfügung steht.
		DVMT Mode	Es erfolgt eine dynamische Regelung des Spei- cherbedarfs durch den DVMT Grafiktreiber. Es wird nur der benötigte Speicher belegt.
		Combo Mode	Der DVMT Grafiktreiber reserviert mind. 64MB, kann aber bei Bedarf bis zu 224MB belegen.
DVMT/FIXED Memory	Option zur Einstellung der verwendeten Spei- chergröße für den DVMT Modus.	64MB	64MB Hauptspeicher können verwendet wer- den.
		128MB	128MB Hauptspeicher können verwendet wer- den.
		Maximum DVMT	Der restliche freie Hauptspeicher kann verwen- det werden.
Boot Display Device	Hier kann festgelegt werden, welcher Videokanal für ein Anzeigegerät beim Booten aktiviert wer- den soll.	Auto	Automatische Auswahl.
		CRT only	Nur den CRT (Cathode Ray Tube) Kanal benut- zen.
		SDVO only	Nur den SDVO (Serial Digital Video Out) Kanal benutzten.
		CRT + SDVO	CRT und SDVO Kanal benutzen.
		LFP only	Nur den LFP (Local Flat Panel) Kanal benutzen.
		CRT + LFP	CRT + LFP Kanal benutzen.
Boot Display Preference	Die Option legt die Reihenfolge fest, in welcher die Geräte an den angeschlossenen Kanälen	LFP SDVO-B SDVO-C	Local Flat Panel - Serial Digital Video B output - Serial Video C output.
	LFP und SDVO überprüft und gebootet werden sollen.	LFP SDVO-C SDVO-B	Local Flat Panel - Serial Digital Video C output - Serial Video B output.
		SDVO-B SDVO-C LFP	Serial Digital Video B output - Serial Digital Vi- deo C output - Local Flat Panel.
	Information:	SDVO-C SDVO-B LFP	Serial Digital Video C output - Serial Digital Vi- deo B output - Local Flat Panel.
	Die Einstellung macht nur Sinn, wenn die Option Boot Display Device auf "Au- to" gestellt ist.		

Tabelle 149: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Local Flat Panel Type	al Flat Panel Type Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Profil für den LVDS Kanal eingestellt werden.	Auto	Automatische Erkennung und Einstellung an-
			hand der EDID Daten.
		VGA 1x18 (002h)	640 x 480
		VGA 1x18 (013h)	640 x 480
		SVGA 1x18 (004h)	800 x 600
		XGA 1x18 (006h)	1024 x 768
		XGA 2X18 (007h)	1024 x 768
		XGA 1x24 (008fl)	1024 x 768
		SXGA 2x24 (01211)	1024 x 700 1280 x 1024
		SXGA 2x24 (018h)	1280 x 1024
		UXGA 2x24 (00Ch)	1600 x 1200
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 2	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 3	Benutzerdefiniertes Profil
Local Flat Panel Scaling	Option zur Ausgabemöglichkeit des Bildinhaltes in Abhängigkeit des eingestellten Local Flat Pa-	Centering	Der Bildinhalt wird zentriert am Display ausge- geben.
	nel Types.	Expand Text	Der Text wird auf die gesamte Größe des Dis- plays ausgedehnt dargestellt.
		Expand Graphics	Grafiken werden auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
		Expand Text & Graphics	Text und Grafiken werden auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
SDVO Port B Device	Option zur Auswahl des Anzeigegerätes welches	None	Kein Anzeigegerät angeschlossen.
	am SDVO Port B angeschlossen ist.	DVI	Videosignale werden für ein DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		TV	Videosignale werden für ein TV kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		CRT	Videosignale werden für ein CRT kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		LVDS	Videosignale werden für ein LVDS kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		DVI-Analog	Videosignale werden für ein analoges DVI kom- patibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
SDVO Port C Device	Option zur Auswahl des Anzeigegerätes welches am SDVO Port A angeschlossen ist.	None	Kein Anzeigegerät angeschlossen.
		DVI	Videosignale werden für ein DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		TV	Videosignale werden für ein TV kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		CRT	Videosignale werden für ein CRT kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		LVDS	Videosignale werden für ein LVDS kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		DVI-Analog	Videosignale werden für ein analoges DVI kom- patibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
SDVO/DVI Hotplug Sup- port	Ist die Option auf Enabled gestellt, so unterstützt der Windows XP Grafik Treiber "hotplug" und	Enabled	Aktivierung des "Hotplug"- und "Configuration mode persistence"- Modus.
	"configuration mode persistence" für DVI- Moni- tore, die an einen DVI SDVO Transmitter ange- schlossen sind. "Hotplug"-Unterstützung bedeu- tet, dass ein angeschlossener DVI Monitor wäh- rend laufendem Bestriebssystem automatisch er- kannt und aktiviert wird. "Configuration mode per- sistance" bedeutet, dass z.B. eine duale DVI Anzeigekonfiguration automatisch wiederherge- stellt wird wenn beide DVI Monitore wieder an- geschlossen sind auch wenn während eines frü- heren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor ange- schlossen und aktiviert wurde.	Disabled	Deaktivierung des "Hotplug"- und "Configurati- on mode persistence"- Modus.
Display Mode Persistence	Usplay Mode Persistance bedeutet, dass sich	Enabled	AKTIVIERUNG der Funktion.
	schlusskonfigurationen erinnern und wiederher- stellen kann. z.B. wird eine duale DVI An- zeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt wenn beide DVI Monitore wieder angeschlos- sen werden, auch wenn während eines früheren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlos- sen und aktiviert wurde.	Lisabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 149: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.4 CPU Configuration

Advanced	SIOS SETUP UTILITY	
Configure advanced CPU settin Module Version -13.04	ıgs	Select the revsion of the multi processor
Manufacturer:Intel Brand String:Intel(R) Core(TM Frequency :2.16GHz FSB Speed :667MHz	support interface that should be offered by the BIOS.	
Cache L1 :64 KB Cache L2 :4096 KB		
MPS Revision Max CPUID Value Limit Execute Disable Bit Core Multi-Processing Intel(R) SpeedStep(tm) tech. Max. CPU Frequency	[1.4] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Automatic] [2166 MHz]	 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
C1 Config. C2 Config. C3 Config. C4 Config.	[Standard] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	

Abbildung 99: 945GME Advanced CPU Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
MPS Revision	Diese Option unterstützt den Einsatz von mehre- ren CPUs (MPS=Multiprozessorsystem).	1.1	Einstellung der MPS Unterstützung Revision 1.1
		1.4	Einstellung der MPS Unterstützung Revision 1.4
Max CPUID Value Limit	Option zur Limitierung des CPUID Eingangswer- tes. Dies kann z.B. bei älteren Betriebssystemen notwendig sein.	Enabled	Der Prozessor limitiert bei Bedarf den maxima- len CPUID Eingangswert auf 03h wenn der Pro- zessor einen höheren Wert unterstützt.
		Disabled	Bei Anfrage des CPUID Eingangswertes liefert der Prozessor den aktuell maximalen Wert zu- rück.
Execute Disable Bit	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Hardwareunterstützung zur Unterbindung der Datenausführung.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Core Multi-Processing	Bei einem Dual Core Prozessor kann mit dieser Option ein Kern deaktiviert werden.	Enabled	Bei einem Dual Core Prozessor werden beide Kerne genutzt.
		Disabled	Bei einem Dual Core Prozessor wird nur ein Kern verwendet.
Intel(R) SpeedStep(TM) tech.	Option zum Regeln der Intel(R) SpeedStep(TM) Technologie. Der Prozessor wird entsprechend der Menge von auszuführenden Berechnungen hoch- oder heruntergetaktet. Dadurch hängt der Energieverbrauch stark von der Auslastung des Prozessors ab.	Automatic	Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das Betriebssystem geregelt.
		Maximum Speed	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Ma- ximum gesetzt.
		Minimum Speed	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Mi- nimum gesetzt.
		Disabled	Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
Max. CPU Frequency	Option zur Einstellung der maximalen Prozes- sorgeschwindigkeit wenn bei der Option "Intel(R) SpeedStep(TM) tech." die Werte "Automatic" oder "Maximum Speed" eingestellt ist.	xxxx MHz	Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf den ein- gestelllten Wert begrenzt.
C1 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozes- sores.	Standard	Standard C1 Unterstützung.
		Enhanced	Enhanced C1 Unterstützung.
C2 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozes-	Standard	Standard C2 Unterstützung.
	sores.	Enhanced	Enhanced C2 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C2 Unterstützung.
C3 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozes-	Standard	Standard C3 Unterstützung.
	sores.	Enhanced	Enhanced C3 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C3 Unterstützung.
C4 Config	Power Management des Intel Core Duo Prozes-	Standard	Standard C4 Unterstützung.
	sores.	Enhanced	Enhanced C4 Unterstützung.
		Disabled	Disabled C4 Unterstützung.

Tabelle 150: 945GME Advanced CPU Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.5 Chipset Configuration

Advanced Chipset Settings		Options
DRAM Frequency	[Auto]	Auto
DRAM Refresh Rate	[Auto]	Auto
Memory Hole	[Disabled]	400 MHz
DIMM Thermal Control	[Disabled]	533 MHz
DT in SPD	[Disabled]	667 MHz
TS on DIMM	[Disabled]	
High Precision Event Timer	[Disabled]	
IOAPIC	[Enabled]	
APIC ACPI SCI IRQ	[Disabled]	
C4 On C3	[Disabled]	
		← Select Screen
		↑↓ Select Item
		+- Change Option
		F1 General Help
		F10 Save and Exit
		ESC Exit

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
DRAM Frequency	Option zum Einstellen der Arbeitsspeicherfre- quenz.	Auto	Automatische Einstellung der Frequenz durch das BIOS.
		400, 533, 667 MHz	Manuelle Einstellung der gewünschten Taktfre- quenz.
DRAM Refresh Rate	Option zum Einstellen der DRAM Refresh Rate.	Auto	DRAM Refresh wird aus den SPD Daten des DRAM Moduls gelesen.
		7,8µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
		3,9µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
Memory Hole	Option interessant für ISA-Karten mit einem	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Framebuffer. Bei einem PPC800 nicht von Be- deutung.	15MB-16MB	Der Adressbereich wird reserviert.
DIMM Thermal Control	Option zum Einstellen der maximalen Oberflä- chentemperatur der DIMM Module. Wird die ein- gestellte Oberflächentemperatur erreicht, dann wird durch eine Limitierung der Speicherband- breite eine Kühlung des Modules erreicht.	Disabled	Keine Begrenzung der Oberflächentemperatur.
		40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 85°C, 90°C	Temperaturgrenzwert für die Limitierung.
DT in SPD	Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) die DT (Delta Temperature) im SPD (Serial Presence Detect) Management Al- gorithmus des DIMM Moduls unterstützt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
TS on DIMM	Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) den TS (Thermal Sensor) im Thermal Management Algorithmus des DIMM Moduls unterstützt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
High Precision Event Timer	r Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der La- ge einen Interrupt mit sehr hoher Präzision aus- zulösen und andere Programme können diverse Anwendungen besser synchronisieren.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Bei Mulitmedia An- wendungen wird empfohlen, die Funktion auf Enabled zu stellen.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IOAPIC Diese Option wird ven vanced Programmabl aktivieren oder zu dea	Diese Option wird verwendet, um den APIC (Ad- vanced Programmable Interrupt Controller) zu aktivieren oder zu deaktivieren.	Enabled	Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Res- sourcen erweitert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information: Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.		

Tabelle 151: 945GME Advanced	Chipset Einstellmöglichkeiten
------------------------------	-------------------------------

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
APIC ACPI SCI IRQ	Diese Option wird verwendet, um den SCI IRQ	Enabled	IRQ20 wird für SCI verwendet.
	bei APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Modus zu modifizieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
C4 On C3	Verfeinerung der Energiesparfunktion bei einem ACPI Betriebssystem.	Enabled	Prozessor wird in C4 gebracht, wenn das Be- triebssystem in einen C3 Zustand initiiert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 151: 945GME Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten

1.4.6 I/O Interface Configuration

B	IOS SETUP UTILITY	
Advanced		
I/O Interface Configuration		Options
Onboard Audio Controller	[HDA]	HDA AC97 Disabled
		 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Abbildung 101: 945GME Advanced I/O Interface Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Onboard Audio Controller	Hier kann der Audio Modus ausgewählt bzw. aus-	HDA	Aktivierung des High Definition Audio Sound.
	geschaltet werden.	AC97	Aktivierung des AC'97 Sound.
		Disabled	Deaktivierung des Audio Controllers.

Tabelle 152: 945GME Advanced I/O Interface Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.7 Clock Configuration

Clock Configuration		Enable clock
Spread Spectrum	[Disabled]	modulation to reduce EMI.
		 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item
		+- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Abbildung 102: 945GME Advanced Clock Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Spread Spectrum	Mit dieser Option kann der Takt geringfügig fre-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	quenzmoduliert werden, wodurch sich die elek- tromagnetische Störstrahlung verringert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 153: 945GME Advanced Clock Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.8 IDE Configuration

IDE Configuration			
ATA/IDE Configuration Legacy IDE Channels	[Compatible] [SATA Pri, PATA Sec]		
 Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave 	: [Hard Disk] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected]		
Hard Disk Write Protect IDE Detect Time Out (Sec) ATA(PI) 80Pin Cable Detection	[Disabled] [35] [Host & Device]	↓ ↑↓ +- F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit

Abbildung 103: 945GME Advanced IDE Configuration

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ATA/IDE Configuration	Option zum Configurieren der integrierten PATA und SATA Controller.	Compatible	Beide Controller arbeiten in Legacy oder Compatible Modus.
		Disabled	Deaktivierung beider Controller.
		Enhanced	Beide Controller arbeiten in Enhanced oder Na- tive Modus.
Legacy IDE Channels ¹⁾	Option zum Konfigurieren der Legacy IDE Kanäle im "Compatible" Modus.	SATA Pri, PATA Sec	SATA Laufwerke werden primär und PATA Laufwerke werden sekundär angesprochen.
		SATA only	Nur SATA Laufwerke verwenden.
		PATA only	Nur PATA Laufwerke verwenden.
Configure SATA as ²⁾	Hier können die von der Southbridge unterstütz- ten Serial ATA Anschlüsse eingestellt werden.	IDE	Die Serial ATA-Festplatte wird als Parallel ATA physikalisches Speicherlaufwerk benutzt.
			Hier kann RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix Storage Technologie mit der Serial ATA Fest- platte konfiguriert werden.
		AHCI	Mit der Einstellung AHCI kann man den inter- nen Speichertreiber der SATA-Funktionen akti- vieren, welche die Speicherleistung bei zufälli- gem Schreib-Lese-Zugriff erhöhen, indem das Laufwerk die Reihenfolge der Befehle selbst festlegt.
Configure SATA as Chan- nels ³⁾	Hier können SATA- bzw. PATA- Laufwerke als Primary Bzw. Secondary Device eingestellt wer-	Before PATA	Die SATA- Laufwerke sind die Primary Devices, und PATA somit die Secondary.
	den.	Behind PATA	Die PATA- Laufwerke sind die Primary Devices, und SATA somit die Secondary.
AHCI/RAID SATA Hotp-	Hier kann der Hotplug-Support für AHCI/RAID-	Enabled	Deaktiviert den Hotplug-Support.
lug ⁴⁾	Systeme eingestellt werden.	Disabled	Aktiviert den Hotplug-Support.
Primary IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Primary Master Port angeschlossen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Primary IDE Master" auf Seite 209
Primary IDE Slave	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Primary Slave Port angeschlossen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Primary IDE Slave" auf Seite 210
Secondary IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Sekundären Master Port angeschlos- sen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Secondary IDE Master" auf Seite 211
Secondary IDE Slave	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am IDE Sekundären Slave Port angeschlos- sen ist, parametriert.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Secondary IDE Slave" auf Seite 212
Hard Disk Write Protect	Hier kann der Schreibschutz für die Festplatte ak-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	tiviert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IDE Detect Time Out (Sec)	Einstellung des Zeitüberschreitungsgrenzwertes der ATA/ATAPI Geräteerkennung.	0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35	Zeiteinstellung in Sekunden.
ATA(PI) 80Pin Cable De- tection	Hier wird erkannt, ob ein 80Pin Kabel am Lauf- werk, am Controller oder am Laufwerk und Kon-	Host & Device	Verwendung beider IDE Controller. (mother- board, disk drive).
	troller angeschlossen ist.	Host	Verwendung des Motherboard IDE Controllers.
	Information: Diese Option ist beim PPC800 CPU Board nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung unrelevant.	Device	Verwendung des IDE disk drive Controllers.

Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Compatible eingestellt ist. 1) 2) 3) 4)

Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced eingestellt ist.

Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced und Configure SATA as auf IDE eingestellt ist. Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced und Configure SATA as auf RAID oder AHCI eingestelltist.

1.4.8.1 Primary IDE Master

Primary IDE Master		Sele	ct the type
Device :Not Detected		to the	evice connected ne system.
Туре	[Auto]		
LBA/Large Mode	[Auto]		
Block (Multi-Sector Transfer)	[Auto]		
PIO Mode	[Auto]		
DMA Mode	[Auto]		
S.M.A.R.T.	[Auto]		
32Bit Data Transfer	[Enabled]		
		↔	Select Screen
		↑↓	Select Item
		+-	Change Option
		F1	General Help
		F10	Save and Exit
		ESC	Exit

Abbildung 104: 945GME Primary IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Туре	Hier wird der Typ des am Primary Master ange-	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
	schlossenen Laufwerks parametriert.	Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addres-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	sing/Large Modus für IDE aktiviert.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Trans-	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
fer)	Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- on wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge- lesen.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest-	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
	latte.	0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsra- te.
	DMA-Mode muss unter Windows im Gerätema- nager aktiviert werden, erst dann ist die volle Per- formance garantiert. Kann nur bei manueller Ein- stellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
	(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nology).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Daten-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	transfer.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 154: 945GME Primary IDE Master Einstellmöglichkeiten

1.4.8.2 Primary IDE Slave

Primary IDE Slave		Select the type
Device :Not Detected		to the system.
Туре	[Auto]	
LBA/Large Mode	[Auto]	
Block (Multi-Sector Transf	fer) [Auto]	
PIO Mode	[Auto]	
DMA Mode	[Auto]	
S.M.A.R.T.	[Auto]	
32Bit Data Transfer	[Enabled]	
		↔ Select Screen ↓ Select Item
		+- Change Option
		F1 General Help
		F10 Save and Exit
		ESC Exit

Abbildung 105: 945GME Primary IDE Slave

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Туре	Hier wird der Typ des am Primary Master ange-	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
	schlossenen Laufwerks parametriert.	Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addres-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	sing/Large Modus für IDE aktiviert.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Trans-	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
fer)	Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- on wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge- lesen.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest-	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
	platte.	0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsra- te.
	DMA-Mode muss unter Windows im Gerätema- nager aktiviert werden, erst dann ist die volle Per- formance garantiert. Kann nur bei manueller Ein- stellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
	(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nology).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Da-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	tentransfer.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 155: 945GME Primary IDE Slave Einstellmöglichkeiten

1.4.8.3 Secondary IDE Master

Secondary IDE Master		Selea	ct the type
Device :Not Detected		of de to t	evice connected ne system.
Туре	[Auto]		
LBA/Large Mode	[Auto]		
Block (Multi-Sector Transfer)	[Auto]		
PIO Mode	[Auto]		
DMA Mode	[Auto]		
S.M.A.R.T.	[Auto]		
32Bit Data Transfer	[Enabled]		
		↔	Select Screen
		↑ ↓	Select Item
		+-	Change Option
		F1	General Help
		F10	Save and Exit
		ESC	Exit

Kapitel 4 Software

Abbildung 106: 945GME Secondary IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Туре	Hier wird der Typ des am Primary Master ange-	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
	schlossenen Laufwerks parametriert.	Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addres-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	sing/Large Modus für IDE aktiviert.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Trans-	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
fer)	Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- on wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge- lesen.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest-	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
	platte.	0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsra- te.
	DMA-Mode muss unter Windows im Gerätema- nager aktiviert werden, erst dann ist die volle Per- formance garantiert. Kann nur bei manueller Ein- stellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
	(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nology).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Daten-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	transfer.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 156: 945GME Secondary IDE Master Einstellmöglichkeiten

1.4.8.4 Secondary IDE Slave

Secondary IDE Slave		Select	the type
Device :Not Detected		of dev to the	system.
Туре	[Auto]		
BA/Large Mode	[Auto]		
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]		
PIO Mode	[Auto]		
MA Mode	[Auto]		
S.M.A.R.T.	[Auto]		
32Bit Data Transfer	[Enabled]		
			Select Screen
		1+	Select Item
		+-	Change Option
		Fl	General Help
		F.TO	Save and Exit

Abbildung 107: 945GME Secondary IDE Slave

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Туре	Hier wird der Typ des am Primary Master ange-	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
	schlossenen Laufwerks parametriert.	Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	arge Mode Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addres- sing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Trans-	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
fer)	Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- on wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge- lesen.	Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest-	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
	platte.	0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätema- nager aktiviert werden, erst dann ist die volle Per- formance garantiert. Kann nur bei manueller Ein- stellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsra- te.	
	Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.	
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
	(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nology).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Da-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	tentransfer.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 157: 945GME Secondary IDE Slave Einstellmöglichkeiten

1.4.9 USB Configuration

Advanced			
USB Configuration			Options
USB Devices Enabled :		Disab	oled
1 Keyboard, 1 Hub		2 USE	B Ports
		4 USE	B Ports
USB Functions	[8 USB Ports]	6 USE	B Ports
USB 2.0 Controller	[Enabled]	8 USI	B Ports
Legacy USB Support	[Enabled]		
USB Legacy POST-Always	[Enabled]		
USB Keyboard Legacy Support	[Enabled]		
USB Mouse Legacy Support	[Disabled]		
USB Storage Device Support	[Enabled]	↔	Select Screen
Port 64/60 Emulation	[Disabled]	↑↓	Select Item
USB 2.0 Controller Mode	[HiSpeed]	+-	Change Option
BIOS EHCI Hand-Off	[Disabled]	F1	General Help
USB Beep Message	[Enabled]	F10	Save and Exit
USB Stick Default Emulation	[Hard Disk]	ESC	Exit
USB Mass Storage Reset Delay	[20 Sec]		
Special Delay for USB HDDs	[Disabled]		

Abbildung 108: 945GME Advanced USB Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
USB Function	Hier können die USB-Ports aktiviert/deaktiviert	Disabled	Deaktivierung der USB-Ports.
	werden.	2 USB Ports	USB1, USB3 werden aktiviert.
	Die USB Nummern (z.B. USB1, USB3, usw.) sind am Gehäuse des PPC800 aufgedruckt.	4 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4 werden aktiviert.
		6 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4, USB5 werden ak-
			tiviert.
		8 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4, USB5, USB an ei- nem AP über SDL werden aktiviert.
USB 2.0 Controller	Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des USB 2.0 Modus.	Enabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 2.0 Mo- dus.
		Disabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 1.1 Mo- dus.
Legacy USB Support	Hier kann der Legacy USB Support aktiviert/de-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	aktiviert werden. Es funktioniert keine USB	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Schnittstelle während des Startens. Nach dem Betriebssystemstart steht der USB Support wie- der zur Verfügung. Eine USB Tastatur wird wäh- rend des POST noch erkannt	Auto	Automatische Aktivierung.
USB Legacy POST-Always Option um den Legacy USB Support w des POST (Power On Self Test) gleichgü Legacy USB Support Einstellung zu aktivi	Option um den Legacy USB Support während des POST (Power On Self Test) gleichgültig der	Enabled	Das BIOS Setup kann während des POST mit- tels einer USB Tastatur aufgerufen werden.
	Legacy USB Support Einstellung zu aktivieren.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Keyboard Legacy	Hier kann die USB-Keyboard Unterstützung akti- viert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Support		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Mouse Legacy Sup-	Hier kann die USB-Mouse Unterstützung akti-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
port	viert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Storage Device Sup-	Hier kann die USB-Massenspeichergerät Unter-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
port	stützung aktiviert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Port 64/60 Emulation	Hier kann die Port 64/60 Emulation aktiviert/de-	Enabled	USB-Keyboard funktioniert unter Windows NT.
	aktiviert werden.	Disabled	USB-Keyboard funktioniert unter allen Systemen außer Windows NT.
USB 2.0 Controller Mode	Hier können Einstellungen für den USBController	Full Speed	12 MBps
	vorgenommen werden.	Hi Speed	480 MBps
BIOS EHCI Hand- Off	Hier kann die Unterstützung für Betriebssysteme	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	ohne vollautomatische EHCIFunktion eingerich- tet werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Beep Message	Option zur Ausgabe jeweils eines Pieptones,	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	wenn ein USB Gerät während des POST vom BIOS erkannt wurde.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Stick Default Emulation	Hier kann eingestellt werden, wie ein USB-Gerät verwendet wird.	Auto	USB-Geräte, deren Speicherkapazität kleiner als 530MB ist werden als Diskettenlaufwerk und die anderen Geräte mit größerer Kapazität als Festplatte simuliert.

Tabelle 158: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
		Hard Disk	Ein als HDD formatiertes Laufwerk als FDD (z.B. ZIP-Laufwerk) kann zum Starten des Systems verwendet werden.
USB Mass Storage Reset Delay	Hier kann die Zeit, die der POST für USBSpei- chergeräte nach dem Gerätestartbefehl warten soll, eingestellt werden. Information: Die Meldung "No USB Mass Storage de- vice detected" (Kein USB Massenspei- chergerät entdeckt) wird angzeigt, wenn kein USB Massenspeichergerät instal- liert wurde.	10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 40 Sec	Manuelle Einstellung des Wertes.
Special Delay for USB HDDs	Option zum Einstellen eines Boot Delay (Boot- verzögerung) vor der USB 2.0 Geräteaufzählung,	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Boot Delay hinzugefügt.
um o Dev	um das Booten von langsam hochlaufenden USB Devices (z.B. USB Hard Disks) zu ermöglichen.	1 Sec, 2 Sec, 3 Sec, 4 Sec, 5 Sec, 7 Sec, 10 Sec	Es wird ein Boot Delay von 1, 2, 3, 4, 5, 7 bzw. 10 Sekunden hinzugefügt.
	Information: Diese Option sollte nur bei Bedarf ver- wendet werden, da der Bootvorgang dann immer um die eingestellte Zeit län- ger dauert.		

Tabelle 158: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.10 Keyboard/Mouse Configuration

Keyboard/Mouse Configur	ation	Select Power-on state
Bootup Num-Lock Typematic Rate	[On] [Fast]	for Numlock.
		 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option
		F1 General help F10 Save and Exit

Abbildung 109: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Bootup Num-Lock	Mit diesem Feld kann man den Zustand der Zeh-	Off	Vom numerischen Tastenblock sind lediglich
	nertastatur (NumLock) beim Booten des Systems		die Cursorfunktionen aktiviert.
	definieren.	On	Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
Typematic Rate	Hier wird die Tastenwiederholfunktion eingestellt.	Slow	Langsame Tastenwiederholung.
		Fast	Schnelle Tastenwiederholung.

Tabelle 159: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.11 Remote Access Configuration

Configure Remote Access t	ype and parameters	Select Remote Access
Remote Access	[Disabled]	type.
Serial Port BIOS Update	[Disabled]	
		↔ Select Screen
		+- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Abbildung 110: 945GME Advanced Remote Access Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Remote Access	Hier kann die Remote Access Funktion akti-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	viert/deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Serial Port number Unter dieser Option kann die serielle Schnittstel- le eingestellet werden, vorausgesetzt im Feld <i>Re-</i> <i>mote Access</i> ist nicht Disabled eingetragen.	Unter dieser Option kann die serielle Schnittstel- le eingestellet werden, vorausgesetzt im Feld <i>Re</i> -	COM1	Aktivierung der Schnittstelle COM1 als Remote Access Schnittstelle.
	COM2	Aktivierung der Schnittstelle COM2 als Remote Access Schnittstelle.	
Base Address, IRQ	Anzeige der logischen Adresse und des Inter- rupts für den seriellen Anschluss, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Access</i> ist nicht Disabled einge- tragen.	keine	-
Serial Port Mode	Hier kann die Übertragunsrate der seriellen Schnittstelle festgelegt werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Access</i> ist nicht Disabled eingetra- gen.	115200 8,n,1 57600 8,n,1 38400 8,n,1 19200 8,n,1	Manuelle Einstellung des Wertes.
		09600 8,n,1	
Flow Control	Diese Einstellung bestimmt, wie die Übertragung über die Schnittstelle gesteuert wird.	None	Die Schnittstelle wird ohne Übertragungssteue- rung betrieben.
	Information:	Hardware	Die Übertragungssteuerung der Schnittstelle erfolgt durch Hardware. Dieser Modus muss durch das Kabel unterstützt werden.
	Die Einstellung muss sowohl am Termi- nal als auch am Server gleich sein.	Software	Die Übertragungssteuerung der Schnittstelle erfolgt durch Software.
Redirection After BIOS F POST f t	Hier kann die Umlenkung nach dem Systemstart eingestellt werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remo-</i> <i>te Access</i> ist nicht Disabled eingetragen.	Disabled	Die Umlenkung wird nach dem Systemstart ab- gestellt.
		Boot Loader	Die Umlenkung ist während des Systemstarts und während der Aufladung aktiv.
		Always	Die Umlenkung ist immer aktiviert.
Terminal Type	Hier kann die Anschlussart ausgewählt werden, vorausgesetzt im Feld <i>RemoteAccess</i> ist nicht Disabled eingetragen.	ANSI, VT100, VT-UTF8	Manuelle Einstellung der Anschlussart.
VT-UTF8 Combo Key Sup-	Mit dieser Option kann die VT-UTF8 Combo Key	Enabled	Aktivierung der Funktion.
port	Support für die Anschlüsse ANSI und VT100 akti- viert werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Ac-</i> <i>cess</i> ist nicht Disabled eingetragen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Sredir Memory Display De-	Mit dieser Option kann die Verzögerung der Spei-	No Delay	Keine Verzögerung.
lay	cherausgabe eingestellt werden, vorausgesetzt im Feld <i>Remote Access</i> ist nicht Disabled einge- tragen (Sredir -> Serialredirection).	Delay 1 Sec, Delay 2 Sec, Delay 4 Sec	Manuelle Einstellung des Wertes.

Tabelle 160: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Serial Port BIOS Update Während dem Systemstart wird das Update über		Enabled	Aktivierung der Funktion.
	die serielle Schnittstelle in den Prozessor gela- den.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information:		
	lst diese Option auf Disabled wird die Zeit zum booten verkürzt.		

Tabelle 160: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.12 CPU Board Monitor

Information:

Die angezeigten Spannungswerte (z.B. Corespannung, Batteriespannung) auf dieser BIOS Setup Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlerzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

Hardware Health Configuration			Options
H/W Health Function Hardware Health Event Monitoria	[Enabled]	Disa Enab	bled led
Board Temperature CPU Temperature Top DIMM Environment Temp. Rettor DIMM Environment Temp	:63°C/145°F :47°C/116°F :53°C/161°F	_	
Bottom DIMM Environment remp.	.54 C/101 F		
CPU Fan Speed	:0 RPM	↔	Select Screen
VcoreA	:0.960 V	↑↓	Select Item
+3.3VSB	:3.351 V	+-	Change Option
+5VSB	:5.080 V	F1	General Help
+12Vin	:12.187 V	F10	Save and Exit
VRTC	:3.322 V	ESC	Exit

Abbildung 111: 945GME Advanced CPU Board Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
H/W Health Function	Option zum Anzeigen sämtlicher Werte auf dieser	Enabled	Anzeigen sämtlicher Werte.
	Seite.	Disabled	Es werden keine Werte auf dieser Seite ange-
			zeigt.
Board Temperature	Temperaturanzeige der Boardtemperatur in Grad	keine	-
	Celsius und Fahrenheit.		
CPU Temperature	Anzeige der Prozessortemperatur in Grad Celci- us und Fahrenheit.	keine	-
Top DIMM Enviroment Temp.	Anzeige der Temperatur des 1. DRAM Moduls.	keine	-
Bottom DIMM Enviroment Temp.	Anzeige der Temperatur des 2. DRAM Moduls.	keine	-
CPU Fan Speed	Anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit eines Prozessorlüfters.	keine	-
VcoreA	Anzeige der Prozessorkernspannung A in Volt.	keine	-
+3.3VSB	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 3,3 Volt Versorgung.	keine	-
+5VSB	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 5 Volt Versorgung.	keine	-
+12Vin	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 12 Volt Versorgung.	keine	-
VRTC	Anzeige der Batteriespannung in Volt.	keine	-

Tabelle 161: 945GME Advanced CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten
1.4.13 Baseboard/Panel Features

Baseboard/Panel Fo	eatures	
▶Panel Control		
▶Baseboard Monitor		
▶Legacy Devices		
Versions		
BIOS:	R118	
MTCX PX32:	V1.02	
MTCX FPGA:	V1.02	
CMOS Profil:	5h	
Device ID:	000AF21h	Select Screen
Compatibility ID:	0000h	↑↓ Select Item
Serial Number:	AF210168427	Enter Go to Sub Scree
Product Name:	5PC820.1505-00	F1 General Help
User Serial ID:	0000000h	F10 Save and Exit
		ESC Exit

Abbildung 112: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Panel Control	Hier können spezielle Einstellungen für ange- schlossene Panel (Displayeinheiten) vorgenom- men werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Panel Control" auf Seite 218
Baseboard Monitor	Anzeige verschiedener Temperaturwerte und Lüfterdrehzahlen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard Monitor" auf Seite 219
Legacy Devices	Hier können spezielle Einstellungen für die Schnittstellen vorgenommen werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Legacy Devices" auf Seite 220
BIOS	Anzeige der BIOS Version	keine	-
MTCX PX32	Anzeige der MTCX PX32 Firmwareversion.	keine	-
MTCX FPGA	Anzeige der MTCX FPGA Firmwareversion.	keine	-
CMOS Profil	Zeigt die CMOS Profil Nummer an.	keine	-
Device ID	Hexwertanzeige der Hardware-Geräte ID.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der glei- chen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Serialnummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hex- wert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen "B&R Control Center" über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-

Tabelle 162: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmöglichkeiten

1.4.13.1 Panel Control

Panel Control		Panel 0-14: connected
Select Panel Number	[15]	to Automation Panel Link or Monitor/Panel
Version:	V0.00	connector.
Brightness:	[100%]	Panel 15: connected or
Temperature:	00°C/32°F	Panel PC Link.
Fan Speed:	00 RPM	Note: DVI and PPC Link
Keys/Leds:	00/00	will show no valid
		values. On PPC Link
		only the brightness
		option will work.
		↔ Select Screen
		↑↓ Select Item
		+- Change Option
		F1 General Help
		F10 Save and Exit
		ESC Exit

Abbildung 113: 945GME Panel Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Select Panel Number	Auswahl der Panelnummer, bei dem Werte aus- gelesen bzw. geändert werden sollen.	015	Panelauswahl 0 15.
Version	Anzeige der Firmwareversion des SDLR Control- lers.	keine	-
Brightness	Einstellung der Helligkeit beim ausgewählten Pa- nel.	0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%	Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewähl- ten Panel. Änderungen werden sofort wirksam.
Temperature	Temperaturanzeige des ausgewählten Panels in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Fan Speed	Lüfterumdrehungsanzeige des ausgewählten Panels.	keine	-
Keys/Leds	Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs des ausgewählten Panels.	keine	-

Tabelle 163: 945GME Panel Control Einstellmöglichkeiten

1.4.13.2 Baseboard Monitor

Baseboard Monitor			
CMOS Battery:	Good		
Temperatures			
Board I/O:	45°C/113°F		
Board ETH2:	39°C/102°F		
Board Power:	43°C/109°F		
Power Supply:	39°C/102°F		
Slide-In Drive 1:	00°C/32°F		
IF-Slot:	00°C/32°F		
		↔	Select Screen
Fan Speeds		↑+	Select Item
Case 1:	00 RPM	F1	General Help
Case 2:	00 RPM	F10	Save and Exit
Case 3:	00 RPM	ESC	Exit
Case 4:	00 RPM		

Abbildung 114: 945GME Baseboard Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CMOS Battery	Zeigt den Status der Batterie an. n.a not available Good - Batterie ist in Ordnung. Bad - Batterie ist kaputt.	keine	-
Board I/O	Anzeige der Temperatur im I/O Bereich in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Board ETH2	Anzeige der Temperatur im ETH2 Controller Chipbereich in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Board Power	Anzeige der Netzteiltemperatur in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Power Supply	Anzeige der Temperatur im Netzteil in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Slide-In Drive 1	Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks 1 in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
IF-Slot	Anzeige der Temperatur des IF-Slots in Grad Cel- sius und Fahrenheit.	keine	-
Case 1	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 1.	keine	-
Case 2	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 2.	keine	-
Case 3	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 3.	keine	-
Case 4	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 4.	keine	-

Tabelle 164: 945GME Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten

1.4.13.3 Legacy Devices

Legacy Devices		Enable/Dis	able the
COM A:	[Enabled]	COM I port	
Base I/O address:	[3F8]		
Interrupt:	[IRQ 4]		
COM C:	[Enabled]		
Base I/O address:	[3E8]		
Interrupt:	[IRQ 11]		
COM D:	[Disabled]		
COM E:	[Disabled]		
		← Sele	ect Item
ETH2 LAN controller:	[Enabled]	↑↓ Sele	ect Screen
ETH2 MAC Address:	00:60:65:07:71:CF	+- Char	nge Option
		F1 Gene	eral Help
		F10 Save	and Exit
		ESC Exit	2

Abbildung 115: 945GME Legacy Devices

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COM A	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM1 im	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
	System.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM C	Einstellung des COM Ports für den TouchScreen	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
	am Monitor/Panel Stecker.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM D	Einstellung des COM Ports für den Touch Screen	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
	am AP Link Stecker.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM E	Einstellung des COM Ports der B&R Add-on	Enabled	Aktivierung der Schnittstelle.
	Schnittstellenoption.	Disabled	Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den CAN Port.	IRQ 10, NMI	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
ETH2 LAN controller	Hier kann der Onboard LAN Controller (ETH2)	Enabled	Aktivierung des Controllers.
	ein- bzw. ausgeschaltet werden.	Disabled	Deaktivierung des Controllers.
ETH2 MAC Address	Zeigt die MAC-Adresse des Ethernet 2 Control- lers.	keine	-

Tabelle 165: 945GME Legacy Devices Einstellmöglichkeiten

1.5 Boot

Main Advanced Boo	t Security Powe	er Exit
	-	
Boot Priority Selection Boot Device Priority	[Type Based]	The device based boot priority list allows to select from a list
1st Boot Device	[Primary Master]	devices.
2nd Boot Device	[Primary Slave]	The type based boot
3rd Boot Device	[USB Floppy]	priority list allows
4th Boot Device	[USB Removable Devi]	to select device type
5th Boot Device	[USB Harddisk]	even if a respective
6th Boot Device	[USB CDROM]	device is not (yet)
7th Boot Device	[Secondary Master]	present.
8th Boot Device	[Secondary Slave]	
Boot Settings Configuration		← Select Screen ↑↓ Select Item
		+- Change Option
Quick Boot	[Enabled]	F1 General Help
Quiet Boot	[Disabled]	F10 Save and Exit
Automatic Boot List Retry	[Disabled]	ESC Exit
AddOn ROM Display Mode	[Keep Current]	
Halt On Error	[Disabled]	
Hit 'DEL' Message Display	[Enabled]	
Interrupt 19 Capture	[Disabled]	
PXE Boot to LAN (ETH1)	[Disabled]	
Slide-In 2 Option-ROM	[Disabled]	
Power Loss Control	[Turn On]	

Abbildung 116: 945GME Boot Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Priority Selection	Hier kann eingestellt werden, nach welcher Me- thode die Laufwerke gebootet werden sollen.	Device Based	Es werden nur die vom System erkannten Ge- räte aufgelistet. Bei dieser Liste kann danach die Reihenfolge geändert werden.
			Information:
			Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwen- den. Ein Mischbetrieb ist nicht zuläs- sig.
		Type Based	Man kann die Bootreihenfolge einer Gerätety- penliste ändern. Es ist auch möglich nicht an- geschlossene Gerätetypen in dieser Liste anzu- geben.
			Information:
			Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwen- den. Ein Mischbetrieb ist nicht zuläs- sig.
1st Boot Device	Unter dieser Option können die Boot- Laufwerke	Disabled, Primary Master, Pri-	Auswahl der gewünschten Reihenfolge.
2st Boot Device	eingestellt werden.	mary Slave, Secondary Master,	
3st Boot Device	_	Secondary Slave, Legacy Flop-	
4st Boot Device		USB CDROM, USB Remove-	
5st Boot Device		able Device, Onboard LAN, Ex-	
6st Boot Device	_	ternal LAN, PCI Mass Storage	
7st Boot Device	_	PCI SCSI Card, Any PCI BEV	
8st Boot Device		ve, PCI RAID, Lacal BEV ROM	
Quick Boot	Diese Funktion verringert die Zeit zum Booten	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	durch überspringen von einigen POST Vorgän- gen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Quiet Boot	Bestimmt, ob POST Nachricht oder das OEM Logo (Default=schwarzer Hintergrund) angezeigt	Enabled	Anzeige des OEM Logos anstatt der POST Nachricht.
	wird.	Disabled	Anzeige der POST Nachricht.

Tabelle 166: 945GME Boot Menü Einstellmöglichkeiten

Kapitel 4 Software

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Automatic Boot List Retry	Mit dieser Option wird versucht, das Betriebssys-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	tem bei einem Fehlstart automatisch neu zu star- ten.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
AddOn ROM Display Mode	Setzt den Anzeigemodus für das ROM (während	Force BIOS	Ein weiterer BIOS Teil kann angezeigt werden.
	dem Bootvorgang).	Keep Current	BIOS Informationen werden angezeigt.
Halt On Error	Die Option legt fest, ob nach einem Fehler der Systemstart während des Power On Self Test	Enabled	System hält an. Bei jedem Fehler wird das System angehalten.
	(POST) fortgesetzt werden soll.	Disabled	System hält nicht an. Alle Fehler werden igno- riert.
Hit 'DEL' Message Display	Hier können Einstellungen für die Anzeige der	Enabled	Die Nachricht wird angezeigt.
	"Hit 'DEL' Message" vorgenommen werden.	Disabled	Die Nachricht wird nicht angezeigt.
	Information: Wenn Quiet Boot aktiviert ist wird die Nachricht nicht angezeigt.		
Interrupt 19 Capture	Mit dieser Funktion kann die BIOS Unterbre-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	chung eingeschlossen werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PXE Boot to LAN (ETH1)	Aktivierung/Deaktivierung der Funktion vom LAN	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	(ETH1) zu booten.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Slide-In 2 Option-ROM	Aktivierung/Deaktivierung der Funktion von ei-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	nem Option ROM für ein Slide-In 2 Laufwerk.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Loss Control	Stellt fest ob das System nach einem Leistungs-	Remain Off	Bleibt ausgeschaltet.
	abfall an/aus ist.	Turn On	Schaltet ein.
		Last State	Aktiviert den vorherigen Zustand.

Tabelle 166: 945GME Boot Menü Einstellmöglichkeiten

1.6 Security

Main Advance	d Boot	Security	Power	Exit
Security Settings				Install or Change the
Supervisor Passwo	d :Not Instal	lled		pubbhoru.
User Password	:Not Instal	lled		
Change Supervisor	Password			
Change User Passwo	ord			
Deet Geeten Witte	Duchoshi en fr	Diachladl		
BOOT SECTOR VIRUS	Protection [1	Disabled]		
Hard Disk Security	7			
Hard Disk Security	y User Passwoi	rds		++ Select Screen
Hard Disk Security Hard Disk Securit Hard Disk Securit	y User Passwoi Cy Master Passwoi	rds words		↔ Select Screen ↑↓ Select Item
Hard Disk Security Hard Disk Securit Hard Disk Securit	y User Passwor Cy Master Passwor	rds words		↔ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Change
Hard Disk Security Hard Disk Securit Hard Disk Securit	y User Passwor y Master Passw	rds words		 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Change F1 General Help F10 General Help
Hard Disk Security Hard Disk Securit Hard Disk Securit	y User Passwon y Master Passwon	rds words		 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
Hard Disk Security Hard Disk Securit Hard Disk Securit	y User Passwor y Master Passwor	rds words		 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
Hard Disk Security ▶ Hard Disk Securit ▶ Hard Disk Securit	y User Passwor cy Master Passw	rds words		 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
Hard Disk Security ▶ Hard Disk Securit ▶ Hard Disk Securit	y User Passwor cy Master Passw	rds words		 ↔ Select Sc: ↑↓ Select Iter Enter Change F1 General Hei F10 Save and E: ESC Exit

Abbildung 117: 945GME Security Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Supervisor Password	Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
User Password	Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
Change Supervisor Pass- word	Funktion zum Eingeben/Ändern eines Supervisor Passwortes. Nur mit dem Supervisor Passwort können alle BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Change User Password	Funktion zum Eingeben eines User Passwortes. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 167: 945GME Security Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Sector Virus Protec-	Boot Sector Virus Protec- Mit dieser Option wird beim Zugriff durch ein Pro-		Aktivierung der Funktion.
tion	gramm oder Virus auf den Bootsektor eine War- nung ausgegeben.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information:		
	Mit dieser Option wird nur der Bootsek- tor geschützt, nicht aber die gesamte Festplatte.		
Hard Disk Security User Passwords	Hier kann das Hard Disk Security User Passwort erstellt werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Security User Password" auf Seite 223
Hard Disk Security Mas- ter Passwords	Hier kann das Hard Disk Security Master Pass- wort erstellt werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Security Master Password" auf Seite 224

Tabelle 167: 945GME Security Menü Einstellmöglichkeiten

1.7 Hard Disk Security User Password

Primary Slave HDD User Password	Hard Disk Security User Passwords	
 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit 	Primary Slave HDD User Password	
F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit		↔ Select Screen ↑↓ Select Item
		FI General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Abbildung 118: 945GME Hard Disk Security User Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Slave HDD User Password	Mit dieser Funktion ist es möglich das User Pass- wort jeder Festplatte einzustellen oder zu ändern ohne das Gerät neu zu booten. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellun- gen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 168: 945GME Hard Disk Security User Password

Kapitel 4 Software

1.8 Hard Disk Security Master Password

Primary Slave HDD Master Passwo		
	↑ ↓	Select Screen Select Item
	F1 F10 ESC	Save and Exit
	ESC.	EXIC

Abbildung 119: 945GME Hard Disk Security Master Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Slave HDD Master	Mit dieser Funktion ist es möglich das Master	Enter	Passwort eingeben.
Password	Passwort jeder Festplatte einzustellen oder zu		
	ändern ohne das Gerät neu zu booten.		

Tabelle 169: 945GME Hard Disk Securitiy Master Password

1.9 Power

Congigure power management	and control	E	nable or disable
		A	PM.
Power Management/APM	[Enabled]		
Suspend Time Out	[Disabled]		
Video Power Down Mode	[Suspend]		
lard Disk Power Down Mode	[Suspend]		
Ceyboard & PS/2 Mouse	[MONITOR]		
TDC/LPT/COM Ports	[MONITOR]		
rimary Master IDE	[MONITOR]		
rimary Slave IDE	[MONITOR]		
Secondary Master IDE	[MONITOR]		
Secondary Slave IDE	[MONITOR]		
		•	→ Select Screen
Resume On Ring	[Disabled]	1	Select Item
Resume On PME#	[Disabled]	+	- Change Option
Resume On RTC Alarm	[Disabled]	F	1 General Help
		F	10 Save and Exit
Power Button Mode	[On/Off]	E	SC Exit

Abbildung 120: 945GME Power Menü

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Power Management/ APM	Diese Option schaltet die APM-Funktionalität ein	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	oder aus. Es handelt sich hierbei um eine erwei- terte Plug & Play- und Power Management-Funk- tionalität.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Suspend Time Out	Unter dieser Option stellen Sie ein, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität des Systems, dieses in den Suspend Modus (es werden alle Komponen-	1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 50 Min, 60 Min;	Manuelle Einstellung des Wertes.
ten, außer der CPU, soweit wie möglich abge- schaltet) gefahren wird.		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Video Power Down Mode	Unter dieser Option wird der Energiesparmodus	Disabled	Kein Ausschalten des Bildschirms.
	für den Bildschirm festgelegt.	Standby	Bildschirm geht in Standby Modus.
		Suspend	Bildschirm geht in Suspend Modus.
Hard Disk Power Down	Unter dieser Option wird der Energiesparmodus	Disabled	Kein Ausschalten des Bildschirms.
Mode	für die Festplatte festgelegt.	Standby	Bildschirm geht in Standby Modus.
		Suspend	Bildschirm geht in Suspend Modus.
Keyboard & PS/2 Mouse	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten wäh- rend des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am Keyboard oder der PS/2 Mouse kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zu- rück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
FDC/LPT/COM Ports	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten wäh- rend des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am Parallel Port, dem Serial 1&2 Port oder dem Floppy Port kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück
	-	IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert
Primary Master IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten wäh- rend des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlus- ses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu- stand zurück
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert
Primary Slave IDE Hier kann die Überwachung von Aktivitäten wäh- rend des Stromsparmodus festgelegt werden.		MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlus- ses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu- stand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Secondary Master IDE	Her kann die Überwachung von Aktivitäten wäh- end des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlus- ses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu- stand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Secondary Slave IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten wäh- rend des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlus- ses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu- stand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Resume On Ring	Bei einem eingehenden Anruf am Modem wird	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	der PC aus dem Stromsparmodus genolt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resume On PME#	Unter dieser Option können Sie die PME Weck-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Iurikuon ein- bzw. ausschalten.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resume On RTC Alarm	Unter dieser Option können Sie den Alarm akti-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	start eingeben.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Button Mode	Diese Funktion legt fest, welche Funktion der	On/Off	Power Taster schaltet Ein/Aus.
	Power Taster haben soll.	Suspend	Unterdrückt die Funktion.

Tabelle 170: 945GME Power Menü Einstellmöglichkeiten

1.10 Exit

Main	Advanced	Boot	Security	Power	Exit	
Exit Opti Save Chan	ons ges and Exit			E: a: cl	kit system fter saving hanges.	setup g the
Discard C	hanges and Ex	it				
Discard C	hanges			F. f	10 key can or this ope	be used eration.
				+ † E1 F1 F1 E3	 Selection Selection Generation Generation Save and a second sec	t Screen t Item Sub Screen al Help and Exit

Abbildung 121: 945GME Exit Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Save Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. Vorgenommene Änderungen werden nach Be- stätigung im CMOS gespeichert und das System wird rebootet.	OK / Cancel	
Discard Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, ohne die vorgenommenen Änderungen zu spei- chern. Das System wird zusätzlich rebootet.	OK / Cancel	
Discard Changes	Wurden Einstellungen vorgenommen und man weiß nicht mehr welche, so können diese (sofern sie nicht schon gespeichert wurden) wieder zu- rückgesetz werden.	OK / Cancel	
Load CMOS Defaults	Bei diesem Punkt werden die in Abhängigkeit der DIP Switch Stellungen definierten CMOS Default Werte geladen. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellungen geladen und eingestellt.	OK / Cancel	

Tabelle 171: 855GME (XTX) Exit Menü Einstellmöglichkeiten

1.11 BIOS Defaulteinstellungen

Mit Hilfe des CMOS Profile Hex Schalters lassen sich je nach Stellung vordefinierte BIOS Profileinstellungen laden.

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte für dieses System dar und sollte daher nicht geändert werden.

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausführen der Funktion "Load Setup Defaults" im BIOS Setup Hauptmenü "Exit" oder beim Drücken von <F9> bei den einzelnen BIOS Setup Seiten für diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

Profilnummer	Optimiert für	Schalterstellung	Anmerkung
Profil 0	Reserviert	0	
Profil 1	Systemeinheit 5PC810.SX01-00 / 5PC810.SX02-00 / 5PC810.SX03-00	1	Die Defaulteinstellungen für diese Profile befinden sich im APC810 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten-
Profil 2	Systemeinheit 5PC810.SX05-00	2	los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.
Profil 3	Systemeinheit 5PC820.SX01-00 / 5PC820.SX01-01	3	Die Defaulteinstellungen für dieses Profil befinden sich im APC820 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten- los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.
Profil 4	Reserviert	4	
Profil 5	Systemeinheit 5PC820.1505-00 / 5PC820.1906-00	5	Die Defaulteinstellungen für diese Profile befinden sich im PPC800 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten- los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Tabelle 172: Profilübersicht

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die BIOS Defaulteinstellungen abhängig von der CMOS Profil Schalterstellung. Gelb eingefärbte Einstellungen stellen die Abweichungen zum BIOS Defaultprofil (=Profil 0) dar.

1.11.1 Main

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
System Time	-	-	
System Date	-	-	
BIOS ID	-	-	
Prozessor	-	-	
CPU Frequency	-	-	
System Memory	-	-	
Product Revision	-	-	
Serial Number	-	-	
BC Firmware Rev.	-	-	
MAC Address (ETH1)	-	-	
Boot Counter	-	-	
Running Time	-	-	

Tabelle 173: 945GME Main Profileinstellungsübersicht

1.11.2 Advanced

1.11.2.1 ACPI Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
ACPI Aware O/S	Yes	Yes	
ACPI Version Features	ACPI v2.0	ACPI v2.0	
ACPI APIC support	Enabled	Enabled	
Suspend mode	S1 (POS)	S1 (POS)	
USB Device Wakeup from S3/S4	Disabled	Disabled	
Active Cooling Trip Point	Disabled	Disabled	
Passive Cooling Trip Point	Disabled	Disabled	
Critical Trip Point	105°C	105°C	

Tabelle 174: 945GME Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.2 PCI Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Plug & Play O/S	No	Yes	
PCI Latency Timer	64	64	
Allocate IRQ to PCI VGA	Yes	Yes	
Allocate IRQ to SMBUS HC	Yes	Yes	
Allocate IRQ to PCIEX2	Yes	Yes	
PCI IRQ Resource Exclusion			
IRQ3	Allocated	Available	
IRQ4	Allocated	Allocated	
IRQ5	Available	Available	
IRQ6	Available	Available	
IRQ7	Available	Available	
IRQ9	Allocated	Allocated	
IRQ10	Available	Available	
IRQ11	Allocated	Allocated	
IRQ12	Available	Available	
IRQ14	Allocated	Allocated	
IRQ15	Allocated	Allocated	
PCI Interrupt Routing			
PIRQ A (VGA,PCIEX4, ETH2,UHCI2,HDA)	Auto	Auto	
PIRQ B (PCIEX1, ETH1)	Auto	Auto	
PIRQ C (PCIEX2,IF-Slot)	Auto	Auto	
PIRQ D (SATA,UHCI1,SMB, PCIEX3)	Auto	Auto	
PIRQ E (INTD,UHCI3,PATA)	Auto	Auto	
PIRQ F (INTA)	Auto	Auto	
PIRQ G (INTB)	Auto	Auto	
PIRQ H (INTC,UHCI0,EHCI)	Auto	Auto	
1 st Exclusive PCI	-	-	
2 nd Exclusive PCI	-	-	
3 rd Exclusive PCI	-	-	

Tabelle 175: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.3 PCI Express Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Active State Power-Management	Disabled	Disabled	
PCIE Port 0 (ETH2)	Auto	Auto	
PCIE Port 1	Auto	Auto	
PCIE Port 2 (IF-Slot)	Auto	Auto	
PCIE Port 3	Auto	Auto	
PCIE Port 4	Auto	Auto	
PCIE Port 5 (ETH1)	Auto	Auto	
PCIE High Priority Port	Disabled	Disabled	
Res. PCIE Hotplug Resource	No	No	
PCIE Port 0 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	
PCIE Port 1 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	
PCIE Port 2 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	
PCIE Port 3 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	

Tabelle 176: 945GME Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.4 Graphics Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Primary Video Device	Internal VGA	Internal VGA	
Internal Graphics Mode Select	Enabled, 8MB	Enabled, 8MB	
DVMT Mode Select	DVMT Mode	DVMT Mode	
DVMT/FIXED Memory	128MB	128MB	
Boot Display Device	Auto	Auto	
Boot Display Preference	SDVO-B SDVO-C LFP	LFP SDVO-B SDVO-C	
Local Flat Panel Type	Auto	Auto	
Local Flat Panel Scaling	Centering	Expand Text & Graphics	
SDVO Port B Device	DVI	DVI	
SDVO Port C Device	DVI	None	
SDVO/DVI Hotplug Support	Enabled	Enabled	
Display Mode Persistance	Enabled	Enabled	

Tabelle 177: 945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.5 CPU Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
MPS Revision	1.4	1.4	
Max CPUID Value Limit	Disabled	Disabled	
Execute Disable Bit	Enabled	Enabled	
Core Multi-Processing	Enabled	Enabled	
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.	Automatic	Automatic	
Max. CPU Frequency	xxxx MHz	xxxx MHz	
C1 Config.	Standard	Standard	
C2 Config.	Disabled	Disabled	
C3 Config.	Disabled	Disabled	
C4 Config.	Disabled	Disabled	

Tabelle 178: 945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.6 Chipset Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
DRAM Frequency	Auto	Auto	
DRAM Refresh Rate	Auto	Auto	
Memory Hole	Disabled	Disabled	
DIMM Thermal Control	Disabled	Disabled	
DT in SPD	Disabled	Disabled	
TS on DIMM	Disabled	Disabled	
High Precision Event Timer	Disabled	Disabled	
IOAPIC	Enabled	Enbled	
APIC ACPI SCI IRQ	Disabled	Disabled	
C4 On C3	Disabled	Disabled	

Tabelle 179: 945GME Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.7 I/O Interface Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Onboard Audio Controller	AC97	HDA	

Tabelle 180: 945GME Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.8 Clock Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Spread Spectrum	Disabled	Disabled	

Tabelle 181: 945GME Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.9 IDE Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
ATA/IDE Configuration	Compatible	Compatible	
Legacy IDE Channels	SATA Pri, PATA Sec	SATA Pri, PATA Sec	
Configure SATA as	-	-	
Hard Disk Write Protect	Disabled	Disabled	
IDE Detect TIme Out (Sec)	35	35	
ATA(PI) 80Pin Cable Detection	Host & Device	Host & Device	
Primary IDE Master			
Туре	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	
Primary IDE Slave			
Туре	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	

Kapitel 4 Software

Software • BIOS Optionen

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Secondary IDE Master		1	
Туре	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	
Secondary IDE Slave			
Туре	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	

Tabelle 182: 945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.10 USB Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
USB Function	8 USB Ports	8 USB Ports	
USB 2.0 Controller	Enabled	Enabled	
Legacy USB Support	Enabled	Enabled	
USB Legacy POST-Always	Enabled	Enabled	
USB Keyboard Legacy Support	Enabled	Enabled	
USB Mouse Legacy Support	Disabled	Disabled	
USB Storage Device Support	Enabled	Enabled	
Port 64/60 Emulation	Disabled	Disabled	
USB 2.0 Controller Mode	HiSpeed	HiSpeed	
BIOS EHCI Hand-Off	Disabled	Disabled	
USB Beep Message	Enabled	Enabled	
USB Stick Default Emulation	Hard Disk	Hard Disk	
USB Mass Storage Reset Delay	20 Sec	20 Sec	

Tabelle 183: 945GME Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.11 Keyboard/Mouse Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Bootup Num-Lock	On	On	
Typematic Rate	Fast	Fast	

Tabelle 184: 945GME Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsübersicht

1.11.2.12 Remote Access Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Remot Access	Disabled	Disabled	
Serial Port BIOS Update	Disabled	Disabled	

1.11.2.13 CPU Board Monitor

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
H/W Health Function	Enabled	Enabled	

Tabelle 185: 945GME Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsübersicht

1.11.2.14 Baseboard/Panel Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Panel Control			
Select Panel Number	-	-	
Version	-	-	
Brightness	100%	100%	
Temperature	-	-	
Fan Speed	-	-	
Keys/Leds	-	-	
Baseboard Monitor			

Tabelle 186: 945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
CMOS Battery	-	-	
Board I/O	-	-	
Board ETH2	-	-	
Board Power	-	-	
Power Supply			
Slide-In Drive 1	-	-	
IF-Slot	-	-	
Case 1	-	-	
Case 2	-	-	
Case 3	-	-	
Case 4	-	-	
Legacy Devices			
COM A	Enabled	Enabled	
Base I/O address	3F8	3F8	
Interrupt	IRQ4	IRQ4	
COM C	Enabled	Enabled	
Base I/O address	3E8	3E8	
Interrupt	IRQ11	IRQ11	
COM D	Disabled	Disabled	
Base I/O address	-	-	
Interrupt	-	-	
COM E	Disabled	Disabled	
Base I/O address	-	-	
Interrupt	-	-	
Base I/O address	378	378	
ETH2 LAN Controller	Enabled	Enabled	
ETH2 MAC Adress	-	-	

Tabelle 186: 945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht

1.11.3 Boot

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Boot Priority Selection	Type Based	Type Based	
1st Boot Device	Onboard LAN	Primary Master	
2nd Boot Device	Primary Master	Primary Slave	
3rd Boot Device	Primary Slave	USB Floppy	
4th Boot Device	USB Floppy	USB Removable Device	
5th Boot Device	USB Removable Device	USB Harddisk	
6th Boot Device	USB CDROM	USB CDROM	
7th Boot Device	Secondary Master	Secondary Master	
8th Boot Device	Secondary Slave	Secondary Slave	
Quick Boot	Enabled Enabled		
Quiet Boot	Disabled	Disabled	
Automatic Boot List Retry	Disabled	Disabled	
AddOn ROM Display Mode	Keep Current	Keep Current	
Halt On Error	Disabled	Disabled	
Hit "DEL" Message Display	Enabled	Enabled	
Interrupt 19 Capture	Disabled	Disabled	
PXE Boot to LAN (ETH1)	Enabled	Disabled	
Slide-In 2 Option ROM	Enabled	Disabled	
Power Loss Control	Turn On	Turn On	

Tabelle 187: 945GME Boot Profileinstellungsübersicht

1.11.4 Security

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Supervisor Password	-	-	
User Password	-	-	
Boot Sector Virus Protection	Disabled	Disabled	
Hard Disk Security User Password	-	-	
Hard Disk Security Master Password	-	-	

Tabelle 188: 945GME Security Profileinstellungsübersicht

1.11.5 Power

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 5	Meine Einstellung
Power Management/APM	Enabled	Enabled	
Suspend Time Out	Disabled	Disabled	
Video Power Down Mode	Suspend	Suspend	
Hard Disk Power Down Mode	Suspend	Suspend	
Keyboard & PS/2 Mouse	MONITOR	MONITOR	
FDC/LPT/COM Ports	MONITOR	MONITOR	
Primary Master IDE	MONITOR	MONITOR	
Primary Slave IDE	MONITOR	MONITOR	
Secondary Master IDE	MONITOR	MONITOR	
Secondary Slave IDE	MONITOR	MONITOR	
Resume On Ring	Disabled	Disabled	
Resume On PME#	Disabled	Disabled	
Resume On RTC Alarm	Disabled	Disabled	
Power Button Mode	On/Off	On/Off	

Tabelle 189: 945GME Power Profileinstellungsübersicht

1.12 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)

Während des Booten eines B&R Industrie PCs können von Seiten des BIOS folgende Meldungen bzw. Fehler auftreten, die durch verschiedene Piepscodes signalisiert werden.

Piepsintervall	Bedeutung	erforderliche Benutzerreaktion
1x kurz	Speicher - Refresh ausgefallen.	BIOS Default Werte laden. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
2x kurz	Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist fehlerhaft).	Den korrekten Sitz der gesteckten Karten überprüfen. Falls der Feh- ler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
3x kurz	Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler innerhalb der ersten 64 KB.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
4x kurz	Timer not Operational: System - Timer.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
5x kurz	Prozessor Error: Prozessor defekt.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
6x kurz	8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt (8042- Baustein/ A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected Mode schalten.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
7x kurz	Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode Ausnahmefehler (CPU hat einen Interruptfehler generiert).	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
8x kurz	Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler).	Bei gesteckter Grafikkarte diese auf korrekten Sitz überprüfen und eventuell austauschen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
9x kurz	ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt, EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt oder nicht korrekt updated.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
10x kurz	CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht ge- lesen/geschrieben werden.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
11x kurz	Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem Mainboard defekt.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.

Tabelle 190: BIOS Postcode Meldungen BIOS 945GME

1.13 Ressourcenaufteilung

1.13.1 RAM-Adressbelegung

RAM Adresse	Adresse in Hex	Ressource
(TOM - 192 kB) – TOM ¹⁾	N.A.	ACPI reclaim, MPS und NVS area ²⁾
(TOM - 8 MB - 192 kB) – (TOM - 192 kB)	N.A.	VGA frame buffer ³⁾
1024 kB – (TOM - 8 MB - 192 kB)	100000h - N.A.	Extended memory
869 kB – 1024 kB	0E0000h - 0FFFFFh	Runtime BIOS
832 kB – 869 kB	0D0000h - 0DFFFFh	Upper memory
640 kB – 832 kB	0A0000h - 0CFFFFh	Video memory and BIOS
639 kB – 640 kB	09FC00h - 09FFFFh	Extended BIOS data
0 – 639 kB	000000h - 09FC00h	Conventional memory

Tabelle 191: RAM-Adressbelegung

1) TOM - Top of memory: max. installierter DRAM

2) Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf "YES" eingestellt ist.

3) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 1 MB reduziert werden.

1.13.2 I/O-Adressbelegung

1/O Adresse	Bassource
0000h - 00FFh	Motherboard Resourcen
0170h - 0177h	Secondary IDE Kanal
01F0h - 01F7h	Primary IDE Kanal
0238h - 023Fh	COM5
0278h - 027Fh	Hardware Security Key (LPT2)
02E8h - 02EFh	COM4
0376h - 0376h	Secondary IDE Kanal Kommando Port
0377h - 0377h	Secondary IDE Kanal Status Port
0378h - 037Fh	Hardware Security Key (LPT1)
0384h - 0385h	CAN Controller
03B0h - 03DFh	Video System
03E8h - 03EFh	COM3
03F6h - 03F6h	Primary IDE Kanal Kommando Port
03F7h - 03F7h	Primary IDE Kanal Status Port
03F8h - 03FFh	COM1
0480h - 04BFh	Motherboard Resourcen
04D0h - 04D1h	Motherboard Resourcen
0800h - 087Fh	Motherboard Resourcen
0CF8h - 0CFBh	PCI Config Address Register
0CFCh - 0CFFh	PCI Config Data Register
0D00h - FFFFh	PCI / PCI Express Bus ¹⁾
4100h - 417Fh	MTCX
FF00h - FF07h	IDE Bus Master Register

Tabelle 192: I/O-Adressbelegung

1) Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus I/O Resourcen von FFF0h abwärts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express fähige Geräte dürfendie I/O Resourcen in diesem Bereich nicht verwenden.

1.13.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NMI	NONE
Systemti	mer	•																	
Tastatur			•																
IRQ Kas	kade			•															
COM1 (8	Serial port A)				0	•	0	0	0			0	0	0					
ACPI ¹⁾											•								
Echtzeitu	ıhr									•									
Coproze	ssor (FPU)														•				
Primär II	DE Kanal															•			
Seconda	ry IDE Kanal																•		
	COM3 (COM C)				0	0	0	0	0			0	•	0					0
DAK	COM5 (COM D)				0	0	0	0	0			0	0	0					٠

Tabelle 193: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

1) Advanced Configuration and Power Interface.

• ... Standardeinstellung

∘ ... mögliche Einstellung

1.13.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Mode stehen ingesamt 23 IRQs zur Verfügung. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Windows Betriebssystems aktiviert wird.

IRQ		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	NMI	NO- NE
Systemti	mer	٠																									
Tastatur			•																								
IRQ Kas	kade			•																							
COM1 (8	Serial port A)				0	•	0	0	0			0	0	0													
ACPI ¹⁾											•																
Echtzeitu	ıhr									•																	
Coproze	ssor (FPU)														•												
Primary	IDE Kanal															•											
Seconda	ry IDE Kanal																٠										
	COM3 (COM C)				0	0	0	0	0			0	•	0													0
B&K	COM5 (COM D)				0	0	0	0	0			0	0	0													•
PIRQ A ²	i i																	•									
PIRQ B ³																			•								
PIRQ C ⁴)																			•							
PIRQ D⁵)																				•						
PIRQ E																						•					
PIRQ F7																							•				
PIRQ G ^a)																							•			
PIRQ H ⁹)																								•		

Tabelle 194: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

1) Advanced Configuration and Power Interface.

2) PIRQ A: für PCIe; UHCI Host Controller 2, VGA Controller, Intel High Definition Audio Controller, PCI Express Root Port 4

3) PIRQ B: für PCIe; PCI Express Root Port 1, onboard Gigabit LAN Controller

4) PIRQ C: für PCIe; PCI Express Root Port 2

5) PIRQ D: für PCle; UHCI Host Controller 1, SMBus Controller, PCI Express Root Port 3, Serial ATA Controller in enhanced/native Modus3

6) PIRQ E: PCI Bus INTD, UHCI Host Controller 3, Parallel ATA Controller in enhanced/native Modus

7) PIRQ F: PCI Bus INTA

8) PIRQ G: PCI Bus INTB

9) PIRQ H: PCI Bus INTC, UHCI Host Controller 0, EHCI Host Controller

• ... Standardeinstellung

o ... mögliche Einstellung



Abbildung 122: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC für CPU Boards 945GME BIOS Version ≥ 1.15

2 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geräten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue Versionen können von der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

 Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder Komponenten hinzuzufügen (Informationen über Änderungen können der Liesmich bzw. der Readme Datei des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:

Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen gelöscht.

Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen festzustellen.

2.1.1.1 Welche BIOS Version und Firmware ist bereits am PPC800 installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des PPC800 gelangt man mit "Entf" ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü "Advanced" den Unterpunkt "Baseboard/Panel Features" auswählen.

Baseboard/Panel	features	
▶Panel Control		
Baseboard Monitor	c	
Legacy Devices		
Versions		
BIOS:	R118 System BIOS	
MTCX PX32:	v1.02 MTCX PX32 Firmware	
MTCX FPGA:	V1.02 MTCX FPGA Firmware	
CMOS Profil:	Oh	
Device ID:	0000AC7h	↔ Select Screen
Compatibility ID	: 0000h	↑↓ Select Item
Serial Number:	A3C70168427	Enter Go to Sub Screen
Product Name:	5PC820.1505-00	F1 General Help
User Serial ID:	0000000h	F10 Save and Exit
		ESC Exit

Abbildung 123: Softwareversion

2.1.1.2 Welche Firmware ist am Automation Panel Link Transmitter installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des PPC800 gelangt man mit "Entf" ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü "Advanced" den Unterpunkt "Baseboard/Panel Features" und danach den Punkt "Panel Control" auswählen.

Information:

Die Version kann nur bei angeschlossenem Automation Panel mit AP Link SDL Transmitter (5AC801.SDL0-00) angezeigt werden.

Panel Control			Panel 0-14: connected
Select Panel Number Version: Brightness: Temperature: Fan Speed: Keys/Leds:	[0] V1.04 [100%] 41°C/105°F 00 RPM 128/128	Firmware des SDLR Controllers	to Automation Panel Link or Monitor/Panel connector. Panel 15: connected or Panel PC Link. Note: DVI and PPC Link will show no valid values. On PPC Link only the brightness option will work. Select Screen V Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Abbildung 124: Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter

2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS

- 1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
- 2. Bootfähiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile "sys a:" oder "format a: /s" bootfähig gemacht werden.

Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 241.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 243.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte für ein B&R Upgrade siehe Seite 244.

- 3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
- 4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
- 5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

1. Upgrade AMI BIOS for B945

```
2. Exit
```

zu Punkt 1:

Das BIOS wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 Sekunden).

zu Punkt 2: Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wird automatisch der Punkt 1 "Upgrade AMI BIOS for B945" ausgeführt und der Industrie PC selbstständig aktualisiert.

- 6. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
- 7. Reboot und Taste "Del" drücken um in das BIOS Setup Menü zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwählen.

2.2 Firmwareupgrade

Mit der "Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, USV)" Software ist es möglich, je nach Ausführung des PPC800 Systems die Firmware mehrerer Controller (MTCX, SDLR, USV) zu aktualisieren.

Ein aktuelles Firmware Upgrade kann direkt über den Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

Um einen Firmwareupgrade durchzuführen, sind folgende Schritte auszuführen:

- 1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
- 2. Bootfähiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile "sys a:" oder "format a: /s" bootfähig gemacht werden.

Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 241.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 243.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte für ein B&R Upgrade siehe Seite 244.

- 3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
- 4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
- 5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

Information:

Die nachfolgenden Bootmenüoptionen einschließlich Beschreibung beziehen sich auf die Version 1.02 der PPC800 Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) Disks. Es kann daher vorkommen, dass diese Beschreibungen nicht mit der vorliegenden Version übereinstimmen.

```
    Upgrade MTCX (PPC800) PX32 and FPGA
    Upgrade SDLR (AP800/AP900) on Monitor/Panel
    Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
    Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
    Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)
    Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
    S. Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
    6. Return to Main Menu
    Upgrade Add-on UPS (Firmware and Battery Settings)
    1. Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSI-00)
    3. Return to Main Menu
    Exit
```

zu Punkt 1:

Es wird automatisch der PX32 und FPGA des MTCX aktualisiert (Default nach 5 sec)

zu Punkt 2:

Es wird das Submenü 1 zum Upgrade der SDLR Controller am Monitor/Panel Stecker geöffnet.

2.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 0 aktualisiert.

2.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 1 aktualisiert.

2.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 2 aktualisiert.

2.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900) Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 3 aktualisiert.

2.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)

Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am Monitor/Panel aktualisiert (Default nach 5 sec).

Software • Upgradeinformationen

2.6 Return to Main Menu Zurück ins Hauptmenü.

zu Punkt 3:

Es wird das Submenü 3 zum Upgrade der Add-on USV Firmware und Upgrade der Batterie Settings geöffnet.

3.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00) Es wird automatisch die Firmware der Add-on USV aktualisiert.

3.2 Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00) Es werden automatisch die Battery Settings für 5AC600.UPSB-00 aktualisiert.

3.3 Return to Main Menu Zurück ins Hauptmenü.

zu Punkt 4: Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

• Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.

2.2.2 Mögliche Upgradeprobleme und Softwareabhängigkeiten (für V1.02)

- Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) möglich.
- Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 dürfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware größer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.
- Ist eine USV (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfähig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betätigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte Power Off/On durchgeführt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP

- 1. Eine leere 1,44MB HD Diskette in das Diskettenlaufwerk stecken
- 2. Windows Explorer öffnen
- 3. Mit der rechten Maustaste auf das 3½-Diskettenlaufwerk Symbol klicken und den Punkt "Formatieren..." auswählen.



Abbildung 125: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1

4. Danach die Checkbox "MS-DOS-Startdiskette erstellen" anhaken, "Starten" drücken und die nachfolgende Warnmeldung mit "OK" bestätigen.

Formatieren von 3½-Diskette (A:)
ACHTUNG: Beim Formatieren werden ALLE Daten auf diesem Datenträger gelöscht. Klicken Sie auf "OK", um den Datenträger zu formatieren. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Vorgang abzubrechen.

Abbildung 126: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2

Formatieren von 3½-Diskette (A:) 🔀
Formatieren abgeschlossen.
ОК

Abbildung 127: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3

Nach der Erstellung der Startdiskette müssen nun nachträglich einige Dateien dieser Diskette gelöscht werden, da dies wegen der Größe der Updates erforderlich ist.

Dazu müssen alle Dateien (versteckte Systemdateien,...) auf der Diskette angezeigt werden.

Im Explorer- Menüpunkt "Extras" die Option "Ordneroptionen…", Registrierkarte "Ansicht", Punkt "Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)" (ist standardmäßig aktiviert) nun deaktivieren und den Punkt "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren.

Kapitel 4 Software

	Vorher			Nach	her	
Name 🔺	Größe Typ	Geändert am	Name 🔺	Größe	Тур	Geändert am
1 DISPLAY	17 KB Systemdatei	08.06.2000 17:00	AUTOEXEC	1 KB	Stapelverarbeitungsdatei f	04.10.2004 15:14
EGA2.CPI	58 KB CPI-Datei	08.06.2000 17:00	COMMAND	91 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
EGA3.CPI	58 KB CPI-Datei	08.06.2000 17:00	CONFIG	1 KB	Systemdatei	04.10.2004 15:14
EGA.CPI	58 KB CPI-Datei	08.06.2000 17:00	DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
ЕКЕҮВ	22 KB Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00	EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
I KEYBOARD	34 KB Systemdatei	08.06.2000 17:00	EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
E KEYBRD2	32 KB Systemdatei	08.06.2000 17:00	EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
E KEYBRD3	31 KB Systemdatei	08.06.2000 17:00	IO	114 KB	Systemdatei	15.05.2001 18:57
E KEYBRD4	13 KB Systemdatei	08.06.2000 17:00	E KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
MODE	29 KB Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00	KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
-	-		KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
			T KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
			KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
			MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
			msdos	1 KB	Systemdatei	07.04.2001 13:40





Abbildung 129: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5

Es können nun alle Dateien (markiert) bis auf Command.com, IO.sys und MSDOS.sys gelöscht werden.

2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen USB Memory Sticks ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss der USB Memory Stick speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.4.1 Was wird benötigt

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen eines bootfähigen USB Memory Sticks benötigt:

- B&R USB Memory Stick
- B&R Industrie PC
- USB Media Drive
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.4.2 Vorgangsweise

- 1. Verbinden des USB-Memorysticks mit dem PC.
- Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl Laufwerke > Aktualisieren aktualisiert werden.
- 3. Markieren des USB-Memorysticks in der Laufwerksliste.
- 4. Wechseln auf die Registerkarte Aktion und als Aktionstyp Ein B&R Upgrade auf einen USB-Memorystick installieren auswählen.
- Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche Aus einem Verzeichnis... klicken.
- In die Textbox B&R Upgrade kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
- 7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche Aktion starten klicken.

📴 B&R Embedded OS Installer	1
Datei Laufwerke Extras ?	
Altuslisieren Betrachten Altion starten Image öffnen Image erzeugen Image wiederberstelen Erweiterte Erostelungen	
Ref Computer Computer	
Aktion Identifikations-Datei	
Aborshyp Wahlen Sie den Typ der Abors Ein B&R Ubgrade auf einen USB-Menorystick, installeren Erstellt einen bostbaren USB-Menorystick, installeren Erstellt einen bostbaren USB-Menorystick, installeren Sie benötigen ein Windows 50 oder Windows 54 KE-5005.	
Betriebssystem-Dateien	
Wählen Sie die Win/6(96)Me MS-005 Dateien aus: Aus einem Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei C:/MS-005\	
BBR Lipgrade Wählen Sie das ZIP-Archiv mit dem BBR Lipgrade aus: CLUPC_APC800_PPC800_BIOS8945GHE_V0114	

Abbildung 130: Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files

2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 241 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.5 So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen CompactFlash Karten ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss die CompactFlash Karte speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.5.1 Was wird benötigt?

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen einer bootfähigen CompactFlash benötigt:

- CompactFlash Karte
- B&R Industrie PC
- USB Media Drive
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.10)

2.5.2 Vorgangsweise

- 1. Einstecken der CompactFlash Karte in den CF-Slot des Industrie PCs.
- Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl Laufwerke > Aktualisieren aktualisiert werden.
- 3. Markieren der CompactFlash Karte in der Laufwerksliste.
- 4. Wechseln auf die Registerkarte Aktion und als Aktionstyp Ein B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installieren auswählen.
- Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche Aus einem Verzeichnis... klicken.
- 6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
- 7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche Aktion starten klicken.

Date Ladverte Extras ? Aktualiseren Betzehten Aktualiseren Date Extender Bill Computer Extender Extender Extender Aktualiseren Detatifisations-Dateil Extender Extender Extender Aktualiseren Detatifisations-Dateil Extender Extender Extender Aktualiseren Detatifisations-Dateil Extender Extender Extender Aktualiseren Extender Extender Extender Extender Beschreibung: Extender Extender Extender Extender Beschreibung: Extender Extender Extender Extender Extender Beschreibung: Extender Extender Extender Extender Extender Extender Beschreibung: Extender Extende
Attualseren Setachten Alson starten Image öffnen Image erzeugen Image wiederherstellen Erwelterte Einstellungen Attualseren Setachten Alson starten Image öffnen Image erzeugen Image wiederherstellen Erwelterte Einstellungen Attom Identifikations-Daten Image viederherstellen Erwelterte Einstellungen Alson dyp Image offnen Image viederherstellen Image viederherstellen Wahlens Be den Typ der Alton: Image viederherstellen Image viederherstellen Image Wahlens Se de funktion: Image viederherstellen Image viederherstellen Image Wahlens Se de funktion: Image viederherstellen Image viederherstellen Image Wahlens Se de funktion: Image viederherstellen Image viederherstellen Image Wahlens Se de funktion: Image viederherstellen Image viederherstellen Image Wahlens Se de funktion: Image viederherstellen Image viederherstellen Image Wiederherstellen: Image viederherstellen Image viederherstellen Image Wahlens Se de funktion: Image viederherstellen Image viederherstellen Image
Computer Ferdplatta (F-3), slikon Systems 4026 MB Truattic SSJ, 4029 MB/stes Alton It dentifications-Dates Alton It dentifications-Dates Alton It dentifications-Dates Malten Sie den Typ der Alton: ISin B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installeren Wahlen Sie den Typ der Alton: ISin B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installeren Wahlen Sie den Typ der Alton: ISin B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installeren Wahlen Sie den Typ der Alton: ISin B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installeren Wahlen Sie den Typ der Alton: ISin B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installeren Wahlen Sie de Funktion Timekerte Einstellungen" um de Konfiguration des Betriebssystems anapassen. Betriebssystem-Datein Wahlen Sie de WindS/RB(Me MS-DOS Datein aus: Aus einem Verseichnis Aus einer ZIP-Dateit [:(MS-DOS) Wahlen Sie de
Aktion Identifications-Date Aktionstyp Within Sie den Typ der Aktion: En BSR-Upgrade auf eine CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Beschreiburg: Erstellt eine bothare CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: CompactFlash Karte Installeren Image: Com
Aktor Identifiations-Datel Aktorotyp See Sender Typ der Aktor: See Senderburg: Errätel eine bockbare CompactFash Krate installeren Wahlen Sie der Funktion Trivetel eine bockbare CompactFash Krate, nik wehlter ein Upgrade durchgeführt werden kann. Sie benriebigen ein Windows 95, Windows 96 oder Windows 96 KE-DOS. Errätel eine bockbare CompactFash Krate, nik wehlter ein Upgrade durchgeführt werden kann. Betriebssystem-Dateien Sie die Funktion "Erweiterte Enstellungen" um die Konfiguration des Betriebssystems anzupassen. Betriebssystem-Dateien Sie die WinSt[SigNMe MS-DOS Dateien aus: Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die WinSt[SigNMe MS-DOS Dateien aus: Aus einer ZIP-Datei Errätel Funktion Sie die WinSt[SigNMe MS-DOS Dateien aus: Aus einer ZIP-Datei Erräteller
Aktionstyp Im BBR. Upgrade auf eine CompactFlash Karte installeren Im BBR. Upgrade auf eine CompactFlash Karte installeren Image: Seichreitung: Erstellt eine bootbare CompactFlash Karte, inst welcher ein Upgrade durchgefuhrt werden karn. Sie benötigen ein Windows 56, Windows 56 oder Windows 56 He-DOS. Image: Verweiten Sei de Funktion Torweiterte Einstellungen" um de Konfiguration des Betriebssystems anzupassen. Betriebssystem: Dateen Image: Verweiterte Einstellungen aus: Aus einem Verzeichnis CIVIE-OOS
Beschreibung: Erstellt eine bochsame CompactTahl furthe, mit werchter mit Upgrade durchgeführt werden kann. Sie benötigen ein Windows 96, Windows 96 oder Windows 96 HS-DOS. Verwenden Sie die Funktion "Erweiterte Einstellungen" um die Konfiguration des Betriebssystems anzupassen. Betriebssystem-Dakeien Wahlen Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einer ZIP-Datei Funktion Sie die Winf5/96/Me MS-DOS Me MS-DOS
Verwenden Sie die Funktion "Erweikerte Einstellungen" um die Konfiguration des Betriebssystems anzupassen. Betriebssystem: Dateien Werden Sie die Win56/98/Me MS-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei C:/MS-DOS\ BB/L tograde
Betriebssystem-Dateien Waten Sie die Win5(5)99(Me MS-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichnis Aus einer ZIP-Datei C:(MS-DOS)
Wählen Sie die Wen95/98/Me MS-DOS Datzien aus: Aus einem Verzeichnis Aus einer ZIP-Datzi C:/MS-DOS\
Registration of the control of
- BR Upgade
BBR Upgrade
Bak upgrade
Without the day TR hash and day TR hash and any
waters are used zim-word with ceremon explosion explosio

Abbildung 131: Erstellung einer CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files

2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 241 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

3 Microsoft DOS

3.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	MS-DOS	
9S0000.01-010	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	DOS622 Deutsch
9S0000.01-020	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	Perfection in Automation
		Recovery Diskette
		Darf nur für Backup oder Archivierungszwecke für B&R Automatisierungsgeräte verwendet werden!
		www.br-automation.com

Tabelle 195: 9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten

3.2 Bekannte Probleme

Für folgende Hardwarekomponenten stehen keine Treiber zur Verfügung oder sind mit Einschränkungen zu rechnen:

- HDA Sound keine Unterstützung
- USB 2.0 es kann nur USB 1.1 Geschwindigkeit erreicht werden.
- "Graphics Engine 2" und somit der Erweiterte Desktop Modus kann nicht genutzt werden.
- Einige "ACPI Control" Funktionen des BIOS können nicht verwendet werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die getesteten Auflösungen und Farbtiefen am Monitor / Panel Stecker mit 945GME CPU Boards.

	Farbtiefe					
Auflösungen bei DVI	8 Bit	16 Bit	24 Bit			
640 x 480	✓	√	√			
800 x 600	√	√	√			
1024 x 768	√	√	√			
1280 x 1024	✓	✓	✓			

Tabelle 196: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei DVI Signalen

	Farbtiefe				
Auflösungen bei RGB	8 Bit	16 Bit	24 Bit		
640 x 480	√	√	✓		
800 x 600	✓	√	\checkmark		
1024 x 768	√	√	✓		
1280 x 1024	✓	√	\checkmark		
1600 x 1200	√	√	✓		
1920 x 1440	✓	\checkmark	\checkmark		

Tabelle 197: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei RGB Signalen

4 Windows XP Professional

4.1 Allgemeines

Information:

Abkündigung des Supportes für Windows XP durch Microsoft:

Ab dem 08. April 2014 werden für Windows XP keine Sicherheitsupdates, Hotfixes, kostenloser oder bezahlter Support sowie technische Ressourcen mehr angeboten.

4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Microsoft
5SWWXP.0500-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Windows XP
5SWWXP.0500-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Professional
5SWWXP.0500-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Professional

Tabelle 198: 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL, 5SWWXP.0500-ENG, 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten

4.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Spei- cherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Ar- beitsspeicher
5SWWXP.0600-ENG	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600-GER	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC810 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PPC900 PPC900	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600-MUL	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Multilangua- ge	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-ENG	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Spei- cherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Ar- beitsspeicher
5SWWXP.0500-GER	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-MUL	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Multilangua- ge	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte

4.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows XP Professional Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

4.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06

Um Windows XP Professional auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

- 1. Herunterladen des RAID-Treibers von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> und die Dateien auf eine Diskette kopieren.
- 2. Das Media Drive (5MD900.USB2-02) an die USB-Schnittstelle anstecken.
- 3. Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.
- 4. Im Setup die Taste F6 drücken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.
- 5. Die Taste "s" drücken, wenn gefragt wird ob ein zusätzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. "Enter" drücken und den Treiber auswählen.
- 6. Den Setup Anweisungen folgen.
- 7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den B&R Industrie PC neu.

Information:

- Nicht alle USB-FDD Laufwerke werden vom Windows XP Setup unterstützt (siehe Microsoft KB 916196).
- Abhängig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.

4.5 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

5 Windows 7

5.1 Allgemeines

Windows® 7 bietet eine Vielzahl innovativer Features und Leistungsverbesserungen. Die 64 Bit Varianten nutzen die aktuelle PC Infrastruktur voll aus. Schnelleres Versetzen in den Energiesparmodus, schnelleres Wiederherstellen, geringere Speichernutzung und schnelleres Erkennen von USB-Geräten sind nur einige der Vorteile, die Windows® 7 bietet. In der Professional Ausführung steht Windows® 7 in den Sprachvarianten Deutsch und Englisch zur Verfügung, während Windows® 7 Ultimate bis zu 35 Sprachen (ab Service Pack 1 bis zu 36 Sprachen) unterstützt. Eine Produktaktivierung ist beim Einsatz auf B&R PCs nicht erforderlich, ein großer Vorteil für einfache logistische Abläufe im Zuge der Maschinenautomatisierung.

Alle von B&R angebotenen Windows® Betriebssysteme stammen von der Microsoft Embedded Division. Dies bedeutet eine gegenüber dem Consumermarkt erheblich längere Verfügbarkeit.

5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows 7 Professional/Ultimate	
5SWWI7.0100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	🗾 🚺 Windows 7
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Ge- rät.	
5SWWI7.0200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Ge- rät.	

Tabelle 199: 5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.0300-MUL, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.0200-ENG, 5SWWI7.1200-ENG, 5SWWI7.0200-GER, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.0400-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten

5.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architek- tur	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Spei- cherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Deutsch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architek- tur	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Spei- cherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Deutsch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Multilangua- ge	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.1300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Multilangua- ge	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.0200-ENG	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Englisch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.1200-ENG	Professional	APC810 APC910 PPC800 PPC900	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Englisch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.0200-GER	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Deutsch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.1200-GER	Professional	APC810 APC910 PPC800 PPC900	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Deutsch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.0400-MUL	Ultimate	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Multilangua- ge	auf Wunsch	20 GByte ¹⁾	2 GByte
5SWWI7.1400-MUL	Ultimate	APC810 APC910 PPC800 PPC900	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Multilangua- ge	auf Wunsch	20 GByte 1)	2 GByte

1) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

5.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows 7 Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

5.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06

Um Windows 7 auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

- 1. Herunterladen des Raid-Treibers für Windows 7 von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> und die Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.
- 2. Mit Windows 7 DVD booten.
- 3. Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo möchten Sie Windows installieren?" angezeigt wird.
- 4. Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.
- 5. Auf "Treiber laden" klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern gehen. Anschließend auf Weiter klicken.
- 6. Den USB Memory Stick entfernen.
- 7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgeführt werden.

Information:

Abhängig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.

5.5 Eigenheiten, Einschränkungen

- Die Ermittlung der Windows 7 Systembewertung (Systemklassifikation) wird aktuell nicht unterstützt (dies gilt nicht für PP500, APC510, APC511, APC910 und PPC800 mit NM10 Chipsatz).

5.6 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

6 Windows XP Embedded

6.1 Allgemeines

Windows XP Embedded ist die modularisierte Version des Desktop Betriebssystems Windows XP Professional. Windows XP Embedded basiert auf den gleichen Binaries wie Windows XP Professional und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows XP Professional liefert Windows XP Embedded in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Embedded	
5SWWXP.0427-ENG	Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash se- parat bestellen (mind. 512 MByte).	🗾 Windows ^{.xp}
	Erforderliches Zubehör	Emboddod
	CompactFlash	Empedded
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 200: 5SWWXP.0427-ENG - Bestelldaten

6.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0427-ENG	PPC800	945GME	Englisch	Ja	512 MByte	128 MByte

6.4 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows XP Embedded mit Feature Pack 2007 (FP2007).

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	√
File Based Write Filter	↓ ↓
Administrator Account	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	√
Registry Filter	√
Internet Explorer 6.0 + SP2	√
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	√
Windows Firewall	\checkmark
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	\checkmark
Remote Desktop	\checkmark
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Codepages/User Locale/Keyboard	\checkmark
Disk Management Service	\checkmark
Windows Installer Service	\checkmark
Class Installer	\checkmark
CoDevice Installer	\checkmark
Media Player	-
DirectX	-
Accessorries	1
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 201: Gerätefunktionen unter Windows XP Embedded mit FP2007

6.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows XP Embedded schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 512 MByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

6.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

6.6.1 Touchscreentreiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touchscreen Geräte betrieben werden, so muss der Touchscreentreiber manuell nachinstalliert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen möglich aktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.
7 Windows Embedded Standard 2009

7.1 Allgemeines

Windows® Embedded Standard 2009 ist die modulare Variante von Windows® XP Professional. Es kommt zum Einsatz wenn XP Applikationen bei minimierter Betriebssystemgröße ablaufen sollen. In Kombination mit Compact-Flash Speichern ermöglicht Windows® Embedded Standard 2009 den Einsatz des Microsoft Desktop Betriebssystems bei rauen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich zu bekannten Features von Windows® XP Professional ist Windows® Embedded Standard 2009 durch einen Write Filter für einzelne Speicherpartitionen in Bezug auf die Zuverlässigkeit verbessert worden. Durch den Schutz einzelner Partitionen, wie der Bootpartition kann das PC System auch nach einem Stromausfall wieder problemlos gestartet werden. Um den Einstieg bei Windows® Embedded Standard 2009 so einfach wie möglich zu gestalten bietet B&R komplette Images für Industrie PCs, Power Panel und Mobile Panel an. Neben Windows® Embedded Standard 2009 steht auch das Standard Betriebssystem Windows® XP Professional in den Varianten deutsch, englisch und multilanguage zur Verfügung.

Windows® Embedded Standard 2009 basiert auf den gleichen Binaries wie Windows® XP Professional mit Service Pack 3 und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows® XP Professional mit SP3 liefert Windows® Embedded Standard 2009 in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0727-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat be- stellen (mind. 1 GByte).	Windows Embedded Standard 2009
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 202: 5SWWXP.0727-ENG - Bestelldaten

7.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0727-ENG	PPC800	945GME	Englisch	Ja	1 GByte	256 MByte

7.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 2009.

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	\checkmark
File Based Write Filter (FBWF)	\checkmark
Pagefile	konfigurierbar
Administrator Account	\checkmark
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	\checkmark
Registry Filter	\checkmark
Internet Explorer 7.0	\checkmark
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	\checkmark
Windows Firewall	\checkmark
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	\checkmark
Remote Desktop	\checkmark
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Local Network Bridge	\checkmark

Tabelle 203: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

Software • Windows Embedded Standard 2009

Funktion	vorhanden
Codepages/User Locale/Keyboard	\checkmark
Disk Management Service	\checkmark
Windows Installer Service	\checkmark
Class Installer	\checkmark
CoDevice Installer	\checkmark
Media Player 6.4	\checkmark
DirectX 9.0c	\checkmark
Accessories	\checkmark
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 203: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

7.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 2009 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 1 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

7.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

7.6.1 Touch Screen Treiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touch Screen Geräte betrieben werden, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert bzw. im Geräte-Manager die Touch Screen Schnittstelle aktualisiert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen aktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

8 Windows Embedded Standard 7

8.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows® XP Embedded heißt in der neuen Variante Windows® Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von B&R Industrie PCs. Windows® Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows® 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot. Windows® Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows® Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt.

Bei Windows® Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows® Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version angeboten.³⁾ Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen.

8.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0527-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Eng- lisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	Windows Embedded Standard 7
5SWWI7.1527-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; Compact- Flash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.0627-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Eng- lisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1627-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; Compact- Flash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.0727-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32- Bit, Multilanguage; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; Com- pactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	
5SWWI7.1727-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32- Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.0827-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64- Bit, Multilanguage; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; Com- pactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1827-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64- Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	
	Optionales Zubehör	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0900-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Langua- ge Pack DVD	
5SWWI7.1000-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Langua- ge Pack DVD	
5SWWI7.1900-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	
5SWWI7.2000-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	

Tabelle 204: 5SWWI7.0527-ENG, 5SWWI7.1527-ENG, 5SWWI7.0627-ENG, 5SWWI7.1627-ENG, 5SWWI7.0727-MUL, 5SWWI7.1727-MUL, 5SWWI7.0827-MUL, 5SWWI7.1827-MUL - Bestelldaten

Kapitel 4 Software

8.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0527-ENG	Embedded	PPC800	945GME		32-Bit	Englisch	auf Wunsch	8 GByte	1 GByte
5SWWI7.1527-ENG	Embedded	PPC800	945GME	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0627-ENG	Embedded	PPC800	945GME Intel® Co- re™2 Duo		64-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1627-ENG	Embedded	PPC800	945GME Intel® Co- re™2 Duo	SP1	64-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	2 GByte
5SWWI7.0727-MUL	Premium	PPC800	945GME		32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	8 GByte 1)	1 GByte
5SWWI7.1727-MUL	Premium	PPC800	945GME	SP1	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte 1)	1 GByte
5SWWI7.0827-MUL	Premium	PPC800	945GME Intel® Co- re™2 Duo		64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.1827-MUL	Premium	PPC800	945GME Intel® Co- re™2 Duo	SP1	64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	2 GByte

1) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

8.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 7.

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Enhanced Write Filter (EWF)	1	1
File Based Write Filter (FBWF)	1	✓
Administrator Account	1	✓
User Account	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows Explorer Shell	1	√
Registry Filter	1	√
Internet Explorer 8.0	1	✓
Internet Information Service (IIS) 7.0	✓	√
AntiMalware (Windows Defender)	-	✓
Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)	-	✓
Windows Firewall	1	✓
.NET Framework 3.5	✓	√
32-Bit und 64-Bit Support	1	✓
Remote Dektop Protocol 7.0	√	√
File Compression Utility	✓	√
Windows Installer Service	√	√
Windows XP Mode	-	-
Media Player 12	√	√
DirectX	✓	√
Multilingual User Interface Packs im selben Image	-	√
International Components and Language Services	✓	√
Language Pack Setup	✓	√
Windows Update	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows PowerShell 2.0	√	√
Bitlocker	-	√
Applocker	-	√
Tablet PC Support	-	√
Windows Touch	-	√
Boot from USB Stick	✓	√
Accessorries	✓ <i>✓</i>	✓
Pagefile	konfigurierbar	konfigurierbar
Anzahl der Fonts	134	134

Tabelle 205: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

8.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 7 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (32-Bit: mind. 8 GByte bzw. 16 GByte; 64-Bit: mind. 16 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

Information:

Wenn der EWF verwendet werden soll, sind während des Setup oder SYSPREP alle Massenspeicher (außer dem Bootlaufwerk) aus dem System zu entfernen. Alternativ können die zusätzlichen Massenspeicher auch im BIOS deaktiviert werden.

8.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversionen installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

8.6.1 Touch Screen Treiber

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert. Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein B&R Automation Panel nachträglich angeschlossen, muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert oder in den Touch Screen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung die zusätzliche Touch Screen Schnittstelle ausgewählt werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein "Enhanced Write Filter (EWF)" oder "File Based Write Filter (FBWF)" aktiviert ist.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

9 Windows CE

9.1 Allgemeines

B&R Windows CE ist ein Betriebssystem, das für das von B&R angebotene Gerät optimal zugeschnitten ist, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Dadurch ist dieses Betriebssystem äußerst robust und stabil. Ein weiterer Vorteil den B&R Windows CE gegenüber anderen Betriebssystemen mit sich bringt sind die geringen Lizenzkosten.

9.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows CE 6.0	
5SWWCE.0827-ENG	Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; für PPC800 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestel- lon (mind 128 MB/to)	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	Microsoft
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	Windows CE
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	VVIIIUUWS CE
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 206: 5SWWCE.0827-ENG - Bestelldaten

9.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWCE.0827-ENG	PPC800	945GME	Englisch	Ja	128 MByte	128 MByte

9.4 Features Windows CE 6.0

Eine ausführliche Anleitung zu Windows CE für B&R Geräte kann im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

Ausstattung	Windows CE 6.0
Unterstützte Bildschirmauflösung	VGA (TFT), SVGA (TFT), XGA (TFT)
Chipset	Intel 945GME
Farbtiefe	16 Bit bzw. 65.536 Farben ¹⁾
Grafikkartentreiber	Intel(R) Embedded Graphics Driver
Hauptspeicher	Automatische Erkennung und Verwendung von bis zu 512 MByte RAM
Bootzeit / Hochlaufzeit	ca. 25 Sekunden
Screenrotation	wird nicht unterstützt
Webbrowser	Internet Explorer
.Net	Compact Framework
Imagegröße	ca. 38 MByte ²⁾ , nicht komprimiert
Kundenspezifische Tasten	werden unterstützt
PVI	wird unterstützt
Automation Device Interface	wird unterstützt
Remote Desktop Protokoll für Thin Client	wird unterstützt
B&R VNC Viewer	wird unterstützt
B&R Task Manager	wird unterstützt
B&R Picture Viewer	wird unterstützt
Kompatibel mit zenOn	Ja
Kompatibel mit Wonderware	Nein
Serielle Schnittstellen zur freien Verwendung	3
DirectX	Nein
Audio Schnittstellen	"Line OUT" und "Line IN" werden unterstützt. "MIC" wird nicht unterstützt

Tabelle 207: Eigenschaften Windows CE 6.0

1) Die Farbtiefe hängt auch vom verwendeten Display ab.

2) Verwenden Sie die Funktion "Windows CE Image komprimieren" des B&R Embedded OS Installers um die Imagegröße zu reduzieren.

9.5 Was wird benötigt

Das Gerät muss folgende Kriterien erfüllen um das Betriebssystem Windows CE zu betreiben.

- Mindestens 128 MByte Hauptspeicher
- Mindestens eine 128 MByte CompactFlash Karte (Größe ist bei der Bestellung mitanzugeben)

9.6 Installation

Generell wird Windows CE schon im Hause B&R vorinstalliert.

9.7 B&R Embedded OS Installer

Mit dem B&R Embedded OS Installer ist es möglich bestehende B&R Windows CE Images zu installieren. Es müssen dazu die 4 Dateien NK.BIN, BLDR, LOGOXRES.BMP und LOGOQVGA. BMP von einer bereits funktionierenden B&R Windows CE Installation vorliegen.

Der B&R Embedded OS Installer kann im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden. Weitere Informationen sind der Online Hilfe des B&R Embedded OS Installers zu entnehmen.

10 Automation Runtime

10.1 Allgemeines

Integraler Bestandteil des Automation Studio ist das Echtzeit Betriebssystem. Dieses Echtzeit Betriebssystem bildet den Softwarekern um Anwendungen auf einem Zielsystem laufen zu lassen.

- Garantiert höchst mögliche Leistung für die eingesetzte Hardware
- Läuft auf allen B&R Zielsystemen
- Macht die Anwendung hardwareunabhängig
- Anwendungen können einfach zwischen B&R Zielsystemen portiert werden
- Garantierter Determinismus durch zyklisches Laufzeitsystem
- Multitasking nach dem deterministischen Verfahren der Laufzeitgarantie
- · Konfiguration der Prioritäten, Zeitklassen und Jitter-Toleranz
- Bis zu 8 verschiedene Zeitklassen mit beliebigen Unterprogrammen
- Garantierte Reaktion auf Zeitverletzungen und Jitter-Überschreitung
- Ausnahmebehandlung
- Jitter-Toleranz in allen Task-Klassen konfigurierbar
- Unterstützung aller relevanten Programmiersprachen wie IEC 61131-3 und ANSI-C
- Umfangreiche Funktionsbibliothek nach IEC 61131-3 und zusätzlich die erweiterte Automation Bibliothek
- Zugriff auf alle Netzwerke und Bussysteme durch die Konfiguration in Automation Studio oder über Funktionsaufrufe

Das B&R Automation Runtime ist voll im entsprechenden Zielsystem (Hardware, auf der das Automation Runtime installiert wird) eingebettet. Es ermöglicht damit den Zugriff der Anwenderprogramme auf I/O Systeme (auch via Feldbus) und andere Geräte wie Schnittstellen und Netzwerke.

10.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Automation Runtime	
9A0003.02U	USB Port Button Holder DS9490B	
1A4600.10-5	B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber	
1A4600.10-2	B&R Automation Runtime ARwin, ARNC0	
1A4600.10-3	B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzauf-	
144600 10 4	Reper und Ropierschutz	
1A4000.10-4	Dar Automation Runtime Arwintarincute vicontiois	
1A4601.06-5	B&R Automation Runtime ARemb, inkl. Lizenzaufkleber	

Tabelle 208: 9A0003.02U, 1A4600.10-5, 1A4600.10-2, 1A4600.10-3, 1A4600.10-4, 1A4601.06-5 - Bestelldaten

10.3 Automation Runtime Windows (ARwin)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das ARwin auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 3.06 Upgrades.

Um ARwin auf einem Panel PC 800 zu betreiben, muss ein Automation Runtime Dongle (USB Port Button Holder mit Automation Runtime ARwin Dongle) angeschlossen sein, siehe "Bestelldaten" auf Seite 260.

Information:

Ab AS 3.0.90 / AR4.00 ist kein Automation Runtime Dongle mehr erforderlich.

10.4 Automation Runtime Embedded (ARemb)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das ARemb auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 4.00 Upgrades, es ist kein Automation Runtime Dongle erforderlich.

11 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center

ADI (Automation Device Interface) ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Die Einstellungen dieser Geräte können mit dem B&R Control Center Applet in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden.

can t	Control Center	selected device infom	auoninere, in	sreport		7 🔫	
CPU Board	Display Keys	LEDs Ten	peratures	Fans	Switches	UPS	
V Temperatu	Statistics	User Settings	actory Setting	v	ersions R	eport	
Memory In	S Firmwar	e installed on the PC a	and connected	devices		_	
BIOS vers	CPIL Board	Control Center					7
Baseboard	BIOS	Statistics	User Settings	Fac	tory Settings	Versions	Report
Firmware v	Dassbaard	Display Keys	LEDs	Tempe	ratures Fans	Switches	UPS
Factory se	MTC	Temper	ature values of	the PC an	id connected par	nels are displayed	here.
User settir	MTC	CPU Board			Panel		
	SDL	CPU:	36/96	*C/*F	Panel:	AP Link (0)	•
Set All	Panel	Board:	38 / 100	"C/"F	Display:	36 / 96	*C/*F
Jervi	Selec	Baseboard					
	SDL	Board I/O:	41 / 105	"C/"F	Slide-In 1:	0/32	*C/*F
	LIPS	Board ETH2:	39 / 102	*C/*F	Slide-In 2:	0/32	*C/*F
	Firmy	Board power:	40 / 104	"C/"F	IF slot:	(n.a.)	1°C/*F
		ETH2:	51 / 123	*C/*F			
			40 / 104	"C/"F			

Abbildung 132: ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto)

Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z.B. CPU Temperatur, Corespannung, Batteriespannung) auf der entsprechenden ADI Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

11.1 Funktionen

Information:

Die vom Automation Device Interface (ADI) - Control Center verfügbaren Funktionen sind von der Gerätefamilie abhängig.

- Ändern von displayspezifischen Parametern
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten
- Update der Tastenkonfiguration
- · Aktivierung von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur
- Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeräten (z.B. Schlüsselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstellungen
- Auslesen der Betriebsstunden (Power On hours)
- · Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware
- · Reporterstellung über das aktuelle System (Supportunterstützung)
- Einstellung des SDL Equalizerwertes für die SDL Kabelanpassung

• Ändern der User Serial ID

Unterstützt werden folgende Systeme:

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 725
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- angeschlossene Automation Panel 800
- angeschlossene Automation Panel 900

11.2 Installation

Eine detaillierte Beschreibung des Control Centers ist der integrierten Online Hilfe zu entnehmen. Der B&R Automation Device Interface (ADI) Treiber (beinhaltet auch Control Center) kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

- 1. Herunterladen und entpacken des ZIP Archives
- 2. Schließen aller Anwendungen
- 3. Starten der Setup.exe Datei (z.B. durch Doppelklick im Explorer)

Information:

In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Sollte eine aktuellere ADI Treiberversion existieren (siehe Downloadbereich der B&R Homepage), so kann diese nachinstalliert werden. Bei der Installation ist auf einen deaktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

11.3 SDL Equalizer Einstellung

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Die Registerkarte **Display** auswählen
- 3. Auf Einstellungen klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt:

al	You can adjust the equalizer for different cable lengths here. Use low values (strong equalizer setting) for long
	cables.
VU	Strong Equalizer Weak
12	

Abbildung 133: ADI Control Center - SDL Equalizer Einstellung

In diesem Dialog können Sie die SDL Equalizereinstellung des Displays ändern. Der Equalizer ist im Automation Panel eingebaut und passt das DVI Signal für unterschiedliche Kabellängen an. Der Equalizerwert wird automatisch anhand der Kabellänge ermittelt. Sie können einen anderen Equalizerwert einstellen, um die beste optische Darstellung auf dem Display zu erreichen (z.B. bei schlechter Kabelqualität oder schlechter DVI Signalqualität).

Bei der "Automatischen Einstellung" wird der Wert anhand der Kabellänge optimal eingestellt.

Der Equalizerwert kann nur geändert werden, wenn die Funktion vom Automation Panel 900 unterstützt wird (ab Panel Firmware Version 1.04 oder höher).

11.4 USV Parametrierung

Hier können die Statuswerte einer optional eingebauten B&R Add-on USV angezeigt und die Batterieeinstellungen der USV bearbeitet, aktualisiert und gesichert werden. Ebenfalls können die Systemeinstellungen der USV konfiguriert werden.

Eigenschaften von Automation	PC 810	<u>?</u> ×
Statistik Anwendereinstellung Display Tasten LEDs	gen Fabrikseinstellungen Versioner Temperaturen Lüfter Schalte	n Bericht r USV
Sie können hier Status Add-On USV ansehen	swerte einer eingebauten B&R APC US und Einstellungen bearbeiten.	∀ <u>M</u> onitor
Status Kommunikationsfehler Batteriebetrieb Batteriefehler Batteriefehler Batteriepolarität verkehrt Keine Pulferbereitschaft	Betriebsdaten Batteriespannung: 0.0 Batteriestrom: 0.00 Temperatur:	V A *C/*F
Batterieeinstellungen Status: Gültig USV Einstellungen Status: Gültig System B&R:USV	Bearbeiten Update Si Ändem Update Si Treiber ist aktiv. En	chern
	ОК	Abbrechen

Abbildung 134: ADI Control Center - USV Einstellungen

Vorsicht!

Die eingebaute USV muss in der Systemsteuerung mit Energieoptionen ausgewählt und konfiguriert werden, damit der Batteriebetrieb unterstützt wird.

Information:

Der USV Dienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.10 oder höher unterstützt.

11.4.1 Installation des USV Dienstes für die B&R Add-on USV

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Registerkarte USV auswählen.
- 3. Unter **USV Einstellungen** auf **System** klicken. Die **Energieoptionen** in der Systemsteuerung werden geöffnet. (Die **Energieoptionen** können auch direkt aus der **Systemsteuerung** geöffnet werden.)
- 4. Registerkarte USV auswählen und Auswählen klicken.
- Als Hersteller 'Bernecker + Rainer' und als Modell 'APC Add-on USV' auswählen und auf Fertig stellen klicken. Der Wert f
 ür den COM Anschluss wird nur f
 ür eine seriell angeschlossene USV ben
 ötigt und vom APC Add-on USV Treiber ignoriert.
- 6. Auf **Übernehmen** klicken, um den USV Dienst zu starten. Das dauert ein paar Sekunden und danach werden USV Status und Details angezeigt.
- 7. Klicken Sie auf OK.

Das Textfeld neben **System** (auf der **USV** Registerkarte im **Control Center**) zeigt ebenfalls an, ob der B&R USV Treiber aktiv ist.

Information:

Man benötigt Administratorrechte zum Ändern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Status.

11.4.2 Statuswerte der USV anzeigen

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Registerkarte USV auswählen.

Die angezeigten Werte werden automatisch aktualisiert.

Information:

Der "Batteriepolarität verkehrt" Zustand wird erst mit USV Firmware Version 1.08 oder höher angezeigt.

Bei USV Firmware Version 1.07 oder kleiner kann es beim Wechsel zwischen Batteriebetrieb und Normalbetrieb zu einem Kommunikationsfehler kommen.

 USV Monitor auswählen, um die Änderungen des USV Status seit dem letzten Start des Systems bzw. des USV Treibers anzuzeigen.

State	Count	Last at	Gone at	Total Time
Battery defe	1	10/14/2005 3:4	(active)	92 second
	_			
	-			

Abbildung 135: ADI Control Center - USV Monitor

Der Dialog wird bei Änderungen des Status automatisch aktualisiert.

Um die angezeigten Zustände aus der Liste zu entfernen, auf Löschen klicken.

Information:

Der aktuelle Zustand der USV wird auch bei gestartetem USV Dienst in der Windows Systemsteuerung auf der USV Seite bei den Energieoptionen angezeigt.

Information:

In einer deutschen Windows XP Professional Version wird der Batteriezustand in den Energieoptionen mit "Niedrig" angezeigt, auch wenn die Batterie in Ordnung ist (Windows Fehler). In einer englischen Version werden normalerweise drei Batteriezustände angezeigt: unbekannt, OK, zu ersetzen. Niedriger Batteriestand wird niemals angezeigt.

11.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Registerkarte USV auswählen.
- 3. Unter Batterieeinstellungen auf Bearbeiten klicken. Datei "Öffnen" Dialog wird geöffnet.
- 4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und öffnen der Datei.

Version: 1.03 Geräte-ID: 00002435 Bezeichnung: SAC600.UPS8-00 Nennkapazität: 5 Ladeschlussgpannung 1): 13.5 Jiefentladespannung 1): 13.5 Ladestrom: 0.5 Ladespitzenspannung: 15 V 3) 0 = keine Überprüfung; spezifisch für B8R USV Batterien. Min. Ladetemperatur 2): -40 Max. Ladetemperatur 2): 80 V 96 Monate	USV Batterieeinstellungen - 24 Sie können hier die K	4350103.BI Kenndaten de	N r USV Batte	rie ändern.
Nennkapazität: 5 Ah 1) Von USV nicht verwendet. Ladeschlussspannung 1): 13.5 V 2) USV Messbereich / Alarmgrenzen: -30 bis +60 °C. Ladestrom: 0.5 A 3) 0 = keine Überprüfung; spezifisch für B8R USV Batterien. Min. Ladetemperatur 2): -40 °C 4) bei 25 °C Max. Ladetemperatur 2): 80 °C 4) bei 25 °C Lebensgauer 1) 3) 4): 96 Monate 000	Version: Geräte-ID: Bezeichnung:	1.03 00002435 5AC600.UP	hex 58-00	
	Nennkapazität: Ladeschlussgpannung 1): Tjefentladespannung 1): Ladestrom: Ladestrom: Ladespitzenspannung: Min. Ladetemperatur 2): Max. Ladetemperatur 2): Lebensgauer 1) 3) 4):	5 13.5 11.1 0.5 15 -40 80 96	Ah V A V °C OC Monate	 1) Von USV nicht verwendet. 2) USV Messbereich / Alarmgrenzen: -30 bis +60 °C. 3) 0 = keine Überprüfung; spezifisch für B&R USV Batterien. 4) bei 25 °C

Abbildung 136: ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen

In diesem Dialog kann man Einstellungen für die verwendete USV Batterie bearbeiten.

Durch Klicken auf **OK** werden die geänderten Einstellungen in die Datei geschrieben. Anschließend können die Batterieeinstellungen der USV mit dieser Datei aktualisiert werden.

Information:

Wenn Einstellungen für nicht von B&R gelieferte Batterien gemacht werden sollen, kopiert man am Besten eine Datei mit Batterieeinstellungen von B&R mit einem neuen Namen ab und passt die Einstellung dieser Datei für die verwendete Batterie an.

Aktuelle Dateien mit Einstellungen für die von B&R gelieferten Batterien können über die B&R "Upgrade PPC800 MTCX" Software aktualisiert werden.

Information:

- Ladeschlussspannung, Tiefentladespannung, Lebensdauer und Tiefentladezyklen werden von der aktuellen USV Firmware Version 1.10 nicht verwendet.
- Lebensdauer ist erst ab Version 2 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur g
 ültig f
 ür B&R USV Batterien bei 25°C Umgebungstemperatur.
- Tiefentladezyklen ist erst ab Version 3 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur gültig für B&R USV Batterien.

Information:

Wenn die auf der USV aktuell vorhandenen Batterieeinstellungen bearbeitet werden sollen, müssen diese vorher in einer Datei gesichert werden.

11.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Registerkarte USV auswählen.
- 3. Unter Batterieeinstellungen auf Update klicken. Datei "Öffnen" Dialog wird geöffnet.
- 4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und öffnen der Datei. Der "Download" Dialog wird geöffnet.

Die Übertragung kann durch Klicken auf **Abbrechen** im Download Dialog abgebrochen werden. Abbrechen ist während des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

- Während der Aktualisierung der Batterieeinstellungen ist kein USV- Betrieb möglich.
- Wenn die Übertragung abgebrochen wurde, muss der Vorgang so lange wiederholt werden, bis die Batterieeinstellungen erfolgreich aktualisiert wurden. Andernfalls ist anschließend kein Batteriebetrieb mehr möglich.

Das Löschen der Daten im Flashspeicher kann, abhängig vom verwendeten Speicherbaustein, mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Die USV wird nach erfolgreichem Download automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu einem Ausfall der USV- Kommunikation kommen.

11.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Registerkarte USV auswählen.
- 3. Unter Batterieeinstellungen auf Sichern klicken. "Speichern unter" Dialog wird geöffnet.
- 4. Dateiname eingeben oder eine bestehende Datei auswählen und auf **Speichern** klicken.

Information:

Das Sichern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt.

Die Übertragung kann durch klicken auf **Abbrechen** im "Download" Dialog abgebrochen werden.

11.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren

- 1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Registerkarte USV auswählen.
- 3. Unter USV Einstellungen auf Ändern klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

USV Einstellungen
Stromüberwachung 8 A Strombegrenzung (8 A) ausschalten (nicht UL-konform) Bei Überstrom (> 8 A): Image: Innerhalb 1 Minute gusschalten (UL-konform) Image: Innerhalb 1 Minute gusschalten (IL-konform) Image: Innerhalb
OK Abbrechen

Abbildung 137: ADI Control Center - USV Einstellungen

Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen der USV finden Sie in der Windows Hilfe.

- Das Ändern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt. Wenn auf der USV keine geänderten Einstellungen vorhanden sind, werden Fabriks- oder Defaulteinstellungen verwendet.
- Die USV wird nach dem Ändern von USV Einstellungen automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu einem Ausfall der Kommunikation mit der USV kommen.
- Man benötigt Administratorrechte zum Ändern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Status.

11.4.6.1 Ausschalten der 8 A Strombegrenzung

Information:

Ein Ausschalten der 8 A Strombegrenzung bei Geräten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Ein "Low Battery" Shutdown bei einem Überstrom von > 8 A bei Geräten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Strombegrenzung (8 A) ausschalten.

Wenn die Strombegrenzung eingeschaltet ist (Kontrollkästchen ist deaktiviert), prüft die USV im Batteriebetrieb, ob die USV Batterie länger als 16 Sekunden mit mehr als 8 A entladen wird. In diesem Fall wird ein Überstromalarm zum PC signalisiert.

Information:

Die Strombegrenzung wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt.

Durch Aktivieren einer der beiden folgenden Optionen können Sie auswählen, wie sich die USV bei einem Überstromalarm verhält:

Mit innerhalb 1 Minute ausschalten schaltet die USV bei Überstrom innerhalb einer Minute ab.

Warnung!

Das Betriebssystem wird dann bei einem Überstrom Alarm nicht ordnungsgemäß niedergefahren!

Mit **"Low Battery" Shutdown durchführen** signalisiert die USV zusätzlich zum Überstromalarm einen "Low Battery" Alarm und schaltet sich nach der eingestellten **"Low Battery" Abschaltzeit** aus. Dadurch wird das Betriebssystem bei aktiviertem USV Dienst ordnungsgemäß niedergefahren.

11.4.6.2 Ändern der Abschaltzeit der USV bei niedrigem Batteriepegel

Geben Sie die **"Low Battery" Abschaltzeit** in Sekunden an. Das ist die Zeit, die von der USV bei niedrigem Batteriepegel gewartet wird, bevor sie die Stromversorgung abschaltet.

Damit wird verhindert, dass die USV Batterie zu sehr entladen wird, wenn der Windows USV Dienst nicht aktiv ist und die USV daher nicht vom Betriebssystem ausgeschaltet wird.

Wenn der USV Dienst aktiv ist, wird die USV bei niedrigem Batteriepegel vom Betriebssystem mit der Windows USV Dienst **Abschaltzeit** (siehe "Weitere USV Einstellungen ändern" auf Seite 268) abgeschaltet. Die **"Low Battery" Abschaltzeit** wird dann ignoriert.

Information:

- Die "Low Battery" Abschaltzeit muss mit mindestens 60 Sekunden angegeben werden, damit das Betriebssystem genug Zeit hat, um bei niedrigem Batteriestand den Abschaltbefehl an die USV zu senden (erfolgt normalerweise nach ca. 30 Sekunden).
- Die "Low Battery" Abschaltzeit kann erst ab USV Firmware Version 1.10 eingestellt werden. USV Firmware Version 1.08 verwendet fix 180 Sekunden als Abschaltzeit. USV Firmware Versionen kleiner 1.08 schalten bei niedrigem Batteriepegel nicht selbständig ab.

11.4.7 Weitere USV Einstellungen ändern

1. Über die Systemsteuerung das Control Center öffnen.

- 2. Registerkarte USV auswählen.
- 3. Unter USV Einstellungen auf Erweitert klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

E	rweiterte USY Einstellungen 🔋 🗙
	Windows USV Dienst
	Abschaltzeit: 180 🕂 Sek.
	Ändern Sie diesen Wert nur, wenn Ihr System länger zum Niederfahren benötigt.
	B&R USV Treiber
	Nachrichten für USV Status ausgeben
	USV Status mit USV Monitor anzeigen
	OK Abbrechen

Abbildung 138: ADI Control Center - Erweiterte USV Einstellungen

Man benötigt Administratorrechte zum Anzeigen dieses Dialoges.

11.4.7.1 Abschaltzeit der USV ändern

Unter **Windows USV Dienst** kann die **Abschaltzeit** in Sekunden angegeben werden. Das ist die Zeit, in der gewartet wird, bis die USV die Stromversorgung abschaltet. Dazu wird vom Windows USV Dienst bei einem kritischen Alarm (z.B. bei niedrigem Batteriestand) ein Shutdown Kommando mit der Abschaltzeit an die USV gesendet und das System heruntergefahren.

Information:

Diese Zeit wird vom Windows USV Dienst ausgewertet, kann aber in den USV Systemeinstellungen der Energieoptionen nicht eingestellt werden. Dieser Wert sollte nur geändert werden, wenn das System länger als die standardmäßig eingestellten 180 Sekunden zum Niederfahren benötigt.

Vorsicht!

Die angegebene Zeit muss größer sein als die für das Niederfahren des Betriebssystems benötigte Zeit.

11.4.7.2 Benachrichtigungen der USV aktivieren

Unter **B&R USV Treiber** das Kontrollkästchen **Nachrichten für USV Status ausgeben** aktivieren. Es wird dann vom B&R USV Treiber bei jeder Änderung des USV Status eine Meldung ausgegeben.

Information:

Das Niederfahren des Systems wird nur vom Windows USV Dienst gemeldet. Vom USV Dienst werden auch weitere Benachrichtigungen gesendet, wenn diese in den USV Systemeinstellungen der Energieoptionen aktiviert sind. Diese Benachrichtigungen werden nur ausgegeben, wenn der Windows Nachrichtendienst (Messenger)⁴⁾ gestartet ist und der PC an einem Netzwerk angeschlossen ist. Außerdem werden einige Zustände der B&R Add-on USV vom Windows USV Dienst nicht erkannt und daher nicht gemeldet, z.B. wenn keine Batterieeinstellungen auf der USV vorhanden sind. Die Windows Dienste sind in der Systemsteuerung unter Verwaltung in Dienste zu finden.

Ist zusätzlich das Kontrollkästchen **USV Status mit USV Monitor anzeigen** aktiviert, so wird nicht bei jeder Änderung eine neue Meldung ausgegeben, sondern nur eine allgemeine Meldung und Aufforderung zum Starten des B&R USV Monitors. Solange der USV Monitor aktiv ist, werden keine neuen Meldungen ausgegeben.

⁴⁾ Der Windows Nachrichtendienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.20 oder höher unterstützt.

269

Alle Änderungen des USV Status werden unabhängig von diesen Optionen im Windows Ereignisprotokoll (unter "Anwendung") eingetragen.

11.4.8 Ablauf bei einem Powerfail

11.4.8.1 Over Current Shutdown

Wenn im Batteriebetrieb für eine Dauer von 16 Sekunden ein Überstrom >8 A erreicht wird, wird der Over Current Shutdown eingeleitet. Dem System steht insgesamt eine Abschaltzeit von einer Minute zur Verfügung.

Wird während dieser Zeit die Versorgung wieder hergestellt wird der Abschaltvorgang abgebrochen.

Information:

Der Over Current Shutdown hat die höchste Priorität.

11.4.8.2 Low Battery Shutdown

Wird bei einem Spannungsausfall das LowBatteryFlag gesetzt wird der "Low Battery" Shutdown eingeleitet, er verhindert die Totentladung des Akkus. Nach Ablauf der Ausschaltzeit (per Default 3 Minuten) schaltet die USV aus.

Sollte während dem Abschaltvorgang ein "Overcurrent" Shutdown oder ein "Standard" Shutdown erkannt werden, wird der "Low Battery" Shutdown durch den jeweiligen Vorgang ersetzt.

11.4.8.3 Standard Shutdown

Der Standard Shutdown wird bei aktiviertem USV Dienst schlagend, die Ausschaltzeit beträgt per Default 3 Minuten.

Wenn die Versorgungsspannung während der Ausschaltzeit wiederkehrt, wird der Shutdown abgebrochen.

Wenn die Versorgungsspannung während des Abschaltvorganges wiederkehrt läuft der Shutdowntimer solange bis der B&R Industrie PC den Standby Modus erreicht hat und führt dann einen Reboot des Systems aus.

12 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z.B. mit folgenden Entwicklungsumgebungen erstellt wurden:

- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer)



Abbildung 139: ADI Development Kit Screenshots (Version 3.60)

Features:

- Ein Microsoft Visual Basic Modul mit Deklarationen der ADI Funktionen
- Header Dateien und Import Libraries für Microsoft Visual C++
- Hilfedateien für Visual Basic und Visual C++
- Beispielprojekte für Visual Basic und Visual C++
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 3.60):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400

Kapitel 4 Software

- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamile installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

13 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer) erstellt wurden.

Unterstützte Programmiersprachen:

- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#

Systemvoraussetzungen:

- Entwicklungssystem: PC mit Windows XP/7 mit
 - Microsoft Visual Studio 2005 oder neuer
 - ° Microsoft .NET Framework 2.0 und / oder Microsoft .NET Compact Framework 2.0 oder neuer



Abbildung 140: ADI .NET SDK Screenshots (Version 2.00)

Features (ab Version 2.00):

- ADI .NET Class Library.
- Hilfedateien im HTML Help 1.0 Format (.chm Datei) und MS Help 2.0 Format (.HxS Datei). (Hilfe ist in Englisch)
- Beispielprojekte und Code Snippets für Visual Basic, Visual C++, Visual C#.
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist).

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 2.00):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50

• Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamile installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das ADI .NET SDK kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

14 B&R Key Editor

Eine häufig auftretende Anforderung bei Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware. Mit dem B&R Key Editor ist die individuelle Anpassung an die Applikation schnell und problemlos möglich.



Abbildung 141: B&R Key Editor Screenshots Version 3.40 (Symbolfoto)

Features:

- Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
- Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste
- Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
- LEDs Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)
- 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
- Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel 900 Geräte bei Automation PCs und Panel PCs.

Unterstützt werden folgende Systeme (Version 3.40):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Automation Panel 800
- Automation Panel 830

- Automation Panel 900
- Automation Panel 9x3
- IPC2000, IPC2001, IPC2002
- IPC5000, IPC5600
- IPC5000C, IPC5600C
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs ist in der Online Hilfe des B&R Key Editors zu finden. Der B&R Key Editor kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden. Weiters ist dieser auf der B&R HMI Treiber- und Utilities- DVD (Best. Nr. 5SWH-MI.0000-00) zu finden.

Kapitel 5 • Normen und Zulassungen

1 Richtlinien und Erklärungen

1.1 CE- Kennzeichnung



Alle für die gültigen Richtlinien harmonisierten EN-Normen werden für B&R Produkte erfüllt.

1.2 EMV-Richtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 61000-6-2:2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestig- keit für Industriebereich
EN 61000-6-4:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Fachgrund- norm Störaussendung für Industriebereich

1.3 Niederspannungsrichtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 60204-1:2006 +	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemei-
A1:2009	ne Anforderungen

2 Zulassungen

Gefahr!

Ein Gesamtgerät kann nur eine Zulassung erhalten, wenn ALLE darin verbauten und angeschlossenen Einzelkomponenten die entspechende(n) Zulassungen besitzen. Wird eine Einzelkomponente verwendet, welche KEINE entsprechende Zulassung besitzt, so enthält auch das Gesamtgerät KEINE Zulassung.

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

Sofern nicht anders angegeben liegen folgende Zulassungen vor:

2.1 UL Zulassung



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equiment" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL508 - 17th Edition Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 142-M1987

2.2 GOST-R



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle zertifiziert und dürfen in die Russische Föderation eingeführt werden.

Kapitel 6 • Zubehör

Nachfolgendes Zubehör ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerät funktionsgeprüft und kann mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich des Betriebs mit anderen Einzelkomponenten als Gesamtgerät zu achten. Für den Betrieb des Gesamtgerätes gilt, dass sämtliche Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitätstests unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Für nicht freigegegebenes Zubehör kann B&R keine Funktionsgarantie übernehmen.

1 Ersatz CMOS Batterien

1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000

1.1.1 Allgemeines

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten und der Echtzeituhr (RTC) benötigt.

Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und muss bei nicht ausreichender Batteriekapazität, Status "Bad", ausgetauscht werden.

1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as "partly regulated". Handle with care. If the package is dama- ged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	Contraction of the second
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 209: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten

1.1.3 Technische Daten

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000			
Allgemeines					
Lagerzeit	max. 3 Jahre bei 30°C				
Zertifizierungen					
CE	Ja				
cULus	Ja				
Elektrische Eigenschaften					
Kapazität	950 mAh				

Tabelle 210: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

Kapitel 6 Zubehör

Zubehör • Ersatz CMOS Batterien

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000	
Selbstentladung	<1% pro Jahr (bei 23°C)		
Spannungsbereich	3V		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Lagerung	-20 bis 60°C		
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	0 bis 95%		
Lagerung	0 bis 95%		
Transport	0 bis 95%		

Tabelle 210: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

2 Spannungsversorgungsstecker

2.1 0TB103.9x

2.1.1 Allgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	and parts
OTB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 211: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0TB103.9	0TB103.91
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja	a 1)
GL	Ja	1)
Feldklemme		
Anmerkung	Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Nenndaten nach UL	
Anzahl der Pole	3 (female)	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Federzugklemme ³⁾
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Kontaktabstand	5,08 mm	
Anschlussquerschnitt		
AWG-Leiter	AWG 26 bis 14	AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,20 bis 1,50 mm ²	
eindrähtig	0,20 bis 2,50 mm ²	
feindrähtig	0,20 bis 1,50 mm²	0,20 bis 2,50 mm²
mit Aderendhülse	0,20 bis 1,50 mm ²	
Anzugsmoment	0,4 Nm	-
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	300 V	
Nennstrom ²⁾	10 A / Kontakt	
Durchgangswiderstand	≤5 mΩ	

Tabelle 212: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!

3) Die Feldklemme in Federzugausführung ist nicht anreihbar.

Kapitel 6 Zubehör

3 DVI - Monitor Adapter

3.1 5AC900.1000-00

3.2 Allgemeines

Mit diesem Adapter ist es möglich, an der DVI-I Schnittstelle einen Standard-Monitor anzuschließen.

3.3 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Sonstiges	
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	

Tabelle 213: 5AC900.1000-00 - Bestelldaten

4 USB Schnittstellenabdeckung

4.1 5AC900.1201-00

4.1.1 Allgemeines

Frontseitige, flache USB Schnittstellenabdeckung für Automation Panel 900, Power Panel 500, Panel PC 700 und Panel PC 800 Geräte.

4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC900.1201-00	USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 flach	

Tabelle 214: 5AC900.1201-00 - Bestelldaten

4.2 5AC900.1201-01

4.2.1 Allgemeines

Frontseitige, bombierte USB Schnittstellenabdeckung mit Rändelung und Verlierschutz für Automation Panel 900, Power Panel 500, Panel PC 700 und Panel PC 800 Geräte.

4.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	dilla.
5AC900.1201-01	USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 bombiert	

Tabelle 215: 5AC900.1201-01 - Bestelldaten

5 Klemmblöcke

5.1 5AC900.BLOC-00

5.1.1 Allgemeines

Diese Ersatz-Klemmblöcke dienen zur Befestigung von B&R Panel Geräten.

5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC900.BLOC-00	Klemmblock mit Schwingen, 10Stk; Ersatzteil	

Tabelle 216: 5AC900.BLOC-00 - Bestelldaten

6 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Der B&R Industrie PC sorgt mit der optionalen integrierten USV dafür, dass das PC System auch nach einem Spannungsausfall Schreibvorgänge zu Ende führen kann. Erkennt die USV einen Spannungsausfall wird unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb umgeschaltet. Alle laufenden Programme werden durch die USV Software korrekt beendet. Inkonsistente Daten sind damit ausgeschlossen (funktioniert nur wenn die USV bereits konfiguriert wurde und der Treiber aktiviert ist).

Information:

- Das Panel / der Monitor wird von der USV nicht gepuffert und fällt somit bei einem Stromausfall aus.
- Genauere Informationen zur Unterbrechungsfreien Stromversorgung können im USV-Anwenderhandbuch (der externen USV) nachgelesen werden. Dieses kann von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Durch die Integration der Ladeschaltung in das Gehäuse des B&R Industrie PC, reduziert sich die Installation auf das Anschließen des Verbindungskabels zur Batterieeinheit die neben dem PC montiert wird.

Bei der Konstruktion der Batterieeinheit wurde auf die Wartungsfreundlichkeit besonderer Wert gelegt. Die Batterien sind frontseitig optimal zugänglich und im Servicefall in wenigen Augenblicken getauscht.



Abbildung 142: USV Prinzip

6.1 Features

- Wartungsfreie Akkus mit langer Lebensdauer
- Kommunikation über integrierte Schnittstelle
- Temperatursensor
- Treibersoftware
- Tiefentladeschutz

6.2 Was wird benötigt

- · Eine passende Systemeinheit.
- Add-on USV Modul 5AC600.UPSI-00
- Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00
- USV Verbindungskabel 0,5 Meter (5CAUPS.0005-00) oder 3 Meter (5CAUPS.0030-00)
- Parametrierung der B&R USV mittels ADI Control Center.

<apitel (
Zubehöi</pre>

6.3 5AC600.UPSI-00

6.3.1 Allgemeines

Das Add-on USV Modul kann leicht bei einer geeigneten Systemeinheit (benötigte Revision siehe Abschnitt 6.2 "Was wird benötigt" auf Seite 285) integriert werden.

6.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinhei- ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Erforderliches Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	

Tabelle 217: 5AC600.UPSI-00 - Bestelldaten

6.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC600.UPSI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja ¹⁾
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	max. 7,5 Watt
Netzausfallüberbrückung	max. 20 min bei 150 W Last
Tiefentladeschutz	Ja, bei 10 V der Batterieeinheit
kurzschlussfest	Nein
Ladekenndaten Batterie	
Ladestrom	max. 0,5 A
Umschaltschwelle	
Batteriebetrieb	13 V
Netzbetrieb	15 V

Tabelle 218: 5AC600.UPSI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

6.3.4 Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Weitere Informationen zur Montage sind im Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" zu finden.



Abbildung 143: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial

6.4 5AC600.UPSB-00

6.4.1 Allgemeines

Die Batterieeinheit stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) erneuert werden.

6.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	

Tabelle 219: 5AC600.UPSB-00 - Bestelldaten

6.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC600.UPSB-00		
Revision	D0	E0	
Allgemeines			
Batterie			
Тур	Enersys Cyclon 12 V 5 Ah (6 Stk. in Serie geschaltet)		
Lebensdauer	10 Jahre ¹⁾		
Ausführung	Single Cell		
Temperatursensor	NTC Widerstand		
Wartungsintervall bei Lagerung	alle 6 Monate	alle 6 Monate 1 mal laden	
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja		
Ladedauer bei Low Battery	typ. 15 Stunden		
Elektrische Eigenschaften			
Nennspannung	12	V	
Batteriestrom	max. 8 A		
Kapazität	5 Ah		
Sicherung ²⁾	nein ³⁾ ja		
Tiefentladespannung	10 V		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Ladebetrieb	-30 bis 60°C		
Betrieb	-40 bis 80°C		
Lagerung	-65 bis 80°C		
Transport	-65 bis 80°C		
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend		
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend		
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend		
Meereshöhe			
Betrieb	max. 3	000 m	

Tabelle 220: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten
Zubehör • Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Produktbezeichnung	5AC600.UPSB-00
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	104 mm 4)
Länge	170,5 mm
Höhe	87,5 mm
Gewicht	ca. 3200 g

Tabelle 220: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten

1) bei 25°C (bis 80% Batteriekapazität)

2) 25 A Sicherung. Ersatzsicherungen können bei Bedarf separat nachbestellt werden.

4) Abmessung ohne Montagelaschen.

6.4.4 Temperatur Lebensdauerdiagramm bis 20% Batteriekapazität



Abbildung 144: Temperatur Lebensdauerdiagramm

6.4.5 Tiefentladezyklen



Abbildung 145: Tiefentladezyklen

6.4.6 Abmessungen



Abbildung 146: 5PC600.UPSB-00 - Abmessungen

6.4.7 Bohrschablone



Abbildung 147: 5PC600.UPSB-00 - Bohrschablone

6.4.8 Montagevorschriften

Auf Grund der speziellen Bauweise dieser Akkumulatoren können diese in jeder beliebigen Lage betrieben so wie auch gelagert werden.

6.5 5CAUPS.00xx-00

6.5.1 Allgemeines

Das USV Verbindungskabel stellt die Verbindung zwischen dem Add-on USV Modul 5AC600.UPSI-00 und der Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 her. Es ist in den Längen 0,5 m und 3 m erhältlich.

6.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	

Tabelle 221: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Bestelldaten

6.5.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CAUPS.0005-00	5CAUPS.0030-00	
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	J	a	
GOST-R	J	а	
GL	Ja	1)	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	2x 0,5 mm ²	² (AWG 20)	
	4x 2,5 mm ²	2 (AWG 13)	
Leiterwiderstand	bei 0,5 mm² r	nax. 39 Ω/km	
	bei 2,5 mm² m	ax. 7,98 Ω/km	
Außenmantel			
Material	thermoplastischer Kur	nststoff auf PVC Basis	
Farbe	fenstergrau (äh	nlich RAL 7040)	
Steckverbindung			
Тур	Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig /	Buchsenleiste Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig	
Elektrische Eigenschaften			
Betriebsspannung	max.	300 V	
Betriebsspitzenspannung	typ. 12 VDC /	max. 15 VDC	
Prüfspannung			
Ader/Ader	150	0 V	
Strombelastbarkeit	10 A bei 20°C		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
bewegt	-5 bis	80°C	
ruhend	-30 bis 80°C		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	0,5 m	3 m	
Durchmesser	8,5 mm ±0,2 mm		
Biegeradius			
bewegt	10x Leitungsdurchmesser		
feste Verlegung	5x Leitungsdurchmesser		
Gewicht	ca. 100 g	ca. 470 g	

Tabelle 222: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Kapitel 6 Zubehör

6.6 5AC600.UPSF-00

6.6.1 Allgemeines

Das USV Sicherungs Kit dient zur Nachrüstung einer Sicherung für die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00.

Eine Montageanleitung des Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 findet sich unter "Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit" auf Seite 360.

Information:

Das USV Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 wird nur für Batterieeinheiten bis einschließlich Revision D0 benötigt. Ab Revision E0 ist bereits eine 25 A Sicherung auf der Steckerpaltine der Batterieeinheit integriert.

6.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSF-00	USV Sicherungs Kit für Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision D0.	

Tabelle 223: 5AC600.UPSF-00 - Bestelldaten

6.7 5AC600.UPSF-01

6.7.1 Allgemeines

Diese 25 A Sicherungen dienen als Ersatzteil für die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 ab Revision E0 sowie für das Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00.

6.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Image not found for 5AC600.UPSF-01!
5AC600.UPSF-01	USV Sicherung, 5 Stück	

Tabelle 224: 5AC600.UPSF-01 - Bestelldaten

7 Externe USV



Abbildung 148: Blockschaltbild des Gesamtsystems

7.1 Allgemeines

Für die Versorgung mit einer Externen USV wird eine USV Ladeeinheit, eine Batterieeinheit und ein Nullmodemkabel benötigt.

Im Normalbetrieb wird die 24 VDC-Netzspannung direkt am Lastsystem durchgestellt. Tritt ein Ausfall der Netzspannung auf, so wird das Lastsystem aus der Batterieeinheit der USV gespeist, um ein kontrolliertes Herunterfahren ohne Datenverlust zu ermöglichen.

Der Austausch von Daten und Kommandos zwischen USV und Lastsystem erfolgt über die Handshakeleitungen einer RS232-Schnittstelle.

Mehr Informationen zur Externen USV sind dem USV Anwenderhandbuch, das auf der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden kann, zu entnehmen.

7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	USV Modul 24 VDC
9A0100.11	USV 24 VDC, 24 VDC Eingang, 24 VDC Ausgang, seriel
	Schnittstelle
	Batterieeinheiten
9A0100.12	USV Batterieeinheit Typ A, 24 V, 7 Ah, inkl. Batteriekäfig
	Ersatzbatterien
9A0100.13	USV Batteriesatz Typ A (Ersatzteil), 2x 12 V, 7 Ah, für Batterie einheit 9A0100.12
9A0100.14	USV Batterieeinheit Typ B, 24 V, 2,2 Ah, inkl. Batteriekäfig
9A0100.15	USV Batteriesatz Typ B (Ersatzteil), 2x 12 V, 2,2 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.14
9A0100.16	USV Batterieeinheit Typ C, 24 V, 4,5 Ah, inkl. Batteriekäfig
9A0100.17	USV Batteriesatz Typ C (Ersatzteil), 2x 12 V, 4,5 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.16
	Erforderliches Zubehör
	Batterieeinheiten
9A0100.12	USV Batterieeinheit Typ A, 24 V, 7 Ah, inkl. Batteriekäfig
9A0100.14	USV Batterieeinheit Typ B, 24 V, 2,2 Ah, inkl. Batteriekäfig
9A0100.16	USV Batterieeinheit Typ C, 24 V, 4,5 Ah, inkl. Batteriekäfig
	Kabel
9A0017.01	Nullmodem Kabel RS232, 0,6 m, zur Verbindung von USV un
	IPC (9-polige D-Sub Buchse - 9-polige D-Sub Buchse)
9A0017.02	Nullmodem Kabel RS232, 1,8 m, zur Verbindung von USV un
	IPC (9-polige D-Sub Buchse - 9-polige D-Sub Buchse)

Tabelle 225: 9A0100.11, 9A0100.12, 9A0100.13, 9A0100.14, 9A0100.15, 9A0100.16, 9A0100.17 - Bestelldaten

Zubehör • Externe USV

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Optionales Zubehör
	Ersatzbatterien
9A0100.13	USV Batteriesatz Typ A (Ersatzteil), 2x 12 V, 7 Ah, für Batterie- einheit 9A0100.12
9A0100.15	USV Batteriesatz Typ B (Ersatzteil), 2x 12 V, 2,2 Ah, für Batte- rieeinheit 9A0100.14
9A0100.17	USV Batteriesatz Typ C (Ersatzteil), 2x 12 V, 4,5 Ah, für Batte- rieeinheit 9A0100.16

Tabelle 225: 9A0100.11, 9A0100.12, 9A0100.13, 9A0100.14, 9A0100.15, 9A0100.16, 9A0100.17 - Bestelldaten

8 PCI Einsteckkarten

8.1 5ACPCI.ETH1-01

8.1.1 Allgemeines

Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über einen 10/100 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- PCI Ethernet Karte
- 1 Netzwerkanschluss (10/100 MBit/s)



Abbildung 149: 5ACPCI.ETH1-01 - PCI Ethernet Card 10/100

8.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung	
	Zubehör		
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100		Kapitel 6 Zubehör

Tabelle 226: 5ACPCI.ETH1-01 - Bestelldaten

8.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH1-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$A58A
Diagnose	
Datenübertragung	Ja, per Status LED

Tabelle 227: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

Zubehor • PCI Einsteckkarten		
Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH1-01	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾	
GOST-R	Ja	
GL	Ja ¹⁾	
Schnittstellen		
Ethernet		
Anzahl	1	
Controller	Intel 82551ER	
Ausführung	geschirmter RJ45 Port	
Übertragungsrate	10/100 MBit/s	
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)	

Tabelle 227: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

8.1.3.1 Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

		Ethernet Anschl	JSS
Controller	Intel 82	551ER	
Versorgung	Universalkarte (2 Kerl	ben) für 3,3V bzw. 5V	
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)	
Übertragungsgeschwindig- keit	10/100	MBit/s	Speed Act/Link
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)	
LED	Ein	Aus	
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s	
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netz- werk ist vorhanden)	Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)	ETH

Tabelle 228: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

8.1.4 Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82551ER ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Embedded und DOS) im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

8.1.5 Abmessungen



Abbildung 150: 5ACPCI.ETH1-01 - Abmessungen

8.2 5ACPCI.ETH3-01

8.2.1 Allgemeines

Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über drei 10/100 MBit/s Netzwerkanschlüsse und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- PCI Ethernet Karte
- 3 Netzwerkanschlüsse (10/100 MBit/s)



Abbildung 151: 5ACPCI.ETH3-01 - PCI Ethernet Card 10/100

8.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 229: 5ACPCI.ETH3-01 - Bestelldaten

8.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH3-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$A58B
Diagnose	
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja 1)
GOST-R	Ja
GL	Ja 1)

Tabelle 230: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH3-01
Schnittstellen	
Ethernet	
Anzahl	3
Controller	Intel 82551ER
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Tabelle 230: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

8.2.3.1 Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

		Ethernet Anschlü	sse		
Controller	jeweils Intel 82551ER		David Antillink		Speed Act/Link
Versorgung	Universalkarte (2 Ker	ben) für 3,3V bzw. 5V	Speed Act/Link	Speed Act/Link	
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)			
Übertragungsgeschwindig-	10/100	MBit/s		Contractory of Contra	The second se
keit					
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)			
LED	Ein	Aus			
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s			
Orange	Link (Eine Verbindung	Activity (Blinkt) (Daten			
	zu einem Ethernet Netz-	werden übertragen)			and the second division of the second divisio
	werk ist vorhanden)		ETH1	ETH2	ETH3

Tabelle 231: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

8.2.4 Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82551ER ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Embedded und DOS) im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

8.2.5 Abmessungen



Abbildung 152: 5ACPCI.ETH3-01 - Abmessungen

9 CompactFlash Karten

9.1 Allgemeines

CompactFlash Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegenüber Umwelt-(Temperatur) und Umgebungseinflüssen (Schock, Vibration, etc...) bieten CompactFlash Karten optimale Werte für den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

9.2 Grundlagen

CompactFlash Karten, welche für den Einsatz in der Industrieautomation geeignet sind, müssen eine besonders hohe Zuverlässigkeit haben. Um diese erreichen zu können sind folgende Punkte sehr wichtig:

- Verwendete Flashtechnologie
- Effizienter Algorithmus zur Maximierung der Lebenszeit
- · Gute Mechanismen zur Erkennung und Behebung von Fehlern des Flash Speichers

9.2.1 Flashtechnologie

Aktuell sind CompactFlash Karten mit MLC (Multi Level Cell) und SLC (Single Level Cell) Flashbausteinen erhältlich.

SLC Flashes haben eine um Faktor 10 höhere garantierte Lebenszeit als MLC Flashes, wodurch für den industriellen Einsatz nur CompactFlash Karten mit SLC Flashbausteinen zum Einsatz kommen.

9.2.2 Wear Leveling

Unter Wear Leveling versteht man einen Algorithmus, welcher zur Maximierung der Lebenszeit einer Compact-Flash eingesetzt werden kann. Zwischen folgenden Algorithmen wird unterschieden:

- Kein Wear Leveling
- Dynamic Wear Leveling
- Static Wear Leveling

Der grundlegende Gedanke von Wear Leveling ist, dass Daten über einen breiten Bereich an Blöcken bzw. Zellen auf dem Datenträger verteilt werden, damit nicht immer die gleichen Bereiche gelöscht und neu programmiert werden müssen.

9.2.2.1 Kein Wear Leveling

Erste CompactFlash Karten hatten keinen Algorithmus implementiert welcher zur Maximierung der Lebenszeit beitrug. Die Lebenszeit der CompactFlash war hier einzig und allein durch die garantierte Lebenszeit der Flashblöcke definiert.

9.2.2.2 Dynamic Wear Leveling

Dynamisches Wear Leveling bietet die Möglichkeit beim Schreiben auf ein File, noch nicht benutzte Flashblöcke für die Verteilung zu verwenden.

Wenn der Datenträger schon zu 80% mit Files voll ist, können nur 20% für das Wear Leveling verwendet werden. Die Lebensdauer der CompactFlash hängt hier also ursächlich von nicht benutzten Flashblöcken ab.

9.2.2.3 Static Wear Leveling

Statisches Wear Leveling überwacht zusätzlich, welche Daten nur selten verändert werden. Diese werden dann vom Controller von Zeit zu Zeit in Blöcke verschoben, welche schon häufig programmiert wurden um eine weitere Abnutzung der Zellen zu vermeiden.

9.2.3 Fehlerkorrektur ECC

Bei Inaktivität oder Betrieb einer bestimmten Zelle können Bitfehler entstehen. Durch ein per Hard- oder Software implementiertes Error Correction Coding (ECC) lassen sich viele derartige Fehler erkennen und korrigieren.

9.2.4 S.M.A.R.T. -Support

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (kurz S.M.A.R.T., System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) ist ein Industriestandard für Massenspeicher der eingeführt wurde, um wichtige Parameter zu überwachen und drohende Ausfälle frühzeitig zu erkennen. Durch die Überwachung und Speicherung von kritischen Leistungs- und Kalibrierdaten wird versucht, die Wahrscheinlichkeit von Fehlerzuständen vorherzusagen.

9.2.5 Maximale Zuverlässigkeit

CompactFlash Karten welche von B&R eingesetzt werden, erzielen durch Verwendung von SLC Flashes in Verbindung mit statischem Wear Leveling gemeinsam mit einem performanten ECC Algorithmus einen Maximalwert an Zuverlässigkeit.

9.3 5CFCRD.xxxx-06

9.3.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 314

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

9.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash	
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	Community
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	Mart Flast
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	850 512 Mard
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 232: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CF-CRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten

9.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06	5CFCRD. 1024-06	5CFCRD. 2048-06	5CFCRD. 4096-06	5CFCRD. 8192-06	5CFCRD. 016G-06	5CFCRD. 032G-06
Allgemeines							
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte	32 GByte
Datenerhaltung		10 Jahre					
Datenverlässlichkeit			< 1 nichtbehebba	arer Fehler in 1014	Bit Lesezugriffen		
Lifetime Monitoring	Ja						
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)						
Wartung	keine						
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4						

Tabelle 233: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Zubehör • CompactFlash Karten

Produktbezeichnung	5CFCRD.	5CFCRD.	5CFCRD.	5CFCRD.	5CFCRD.	5CFCRD.	5CFCRD.
kentinuiarliahaa Laaan	0512-06	1024-06	2048-06	4096-06	8192-06	016G-06	032G-06
typisch	33 MBvte/s	33 MBvto/s	33 MBvto/s	33 MBvte/s	33 MBvte/s	36 MBvto/s	36 MByte/s
maximal	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	34 MByte/s	34 MByte/s	37 MByte/s	37 MByte/s
kontinuierliches Schreiben		00 1112 9 10/0	00 1112 9 10/0	o i indytoro	0 T 112 J 10/0	or indytoro	or indytore
typisch	15 MByte/s	15 MByte/s	15 MByte/s	14 MByte/s	14 MByte/s	28 MByte/s	28 MByte/s
maximal	18 MByte/s	18 MByte/s	18 MByte/s	17 MByte/s	17 MByte/s	30 MByte/s	30 MByte/s
Zertifizierungen							
CE				Ja			
CULUS		I	I	Ja	I		I
ATEX Zone 22	-	-	-	-	-	Ja ''	-
GOST-R		I	I	Ja		04	I
GL				Ja ¹⁾			
Endurance							-
garantierte Datenmenge							
garantiert ²⁾	50 TByte	100 TByte	200 TByte	400 TByte	800 TByte	1600 TByte	3200 TByte
ergibt bei 5 Jahren 2)	27,40	54,79	109,59	219,18 CDute/Tea	438,36	876,72	1753,44
Lösch- / Schreihzyklen	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag	GByte/Tag
garantiert				100 000			
SLC-Flash				Ja			
Wear Leveling				statisch			
Error Correction Coding (ECC)				Ja			-
S.M.A.R.T. Support				Ja			
Unterstützung							
Hardware		PP300/400, PP50	00, PPC300, PPC	700, PPC725, PF	2C800, APC620, APC600, APC620, APC60, APC600, APC620, APC60, APC60, APC60, APC60, APC60, APC60, APC60, APC60,	APC810, APC820)
Betriebssysteme						I .	ı .
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows 7 64-Bit Windows Embedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Nein	Inein	Nein Ia	Ja
32-Bit	INCIII	INCIII	INCIII	INCIII	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
64-Bit Windows XP Professional	Noin	Noin	Noin	12	la	la.	12
Windows XP Embedded	INCIII			l Ja Ja	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³⁾	Ja ³⁾
Windows CE 5.0				Nein			
Software							
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8	≥ V3.2.3.8	≥ V3.2.3.8	≥ V3.2.3.8	≥ V3.2.3.8	≥ V3.6.8.40	≥ V4.0.0.8 (Teil
	PVI Develop-	PVI Develop-	PVI Develop-	PVI Develop-	PVI Develop-	PVI Develop-	lopment Setup
	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	≥ V3.0.2.3014)
	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V3.0.0.3020)	
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20	≥ V3.21
Umgebungsbedingungen							-
Betrieb				0 bis 70°C			
Lagerung				-65 bis 150°C			
Transport				-65 bis 150°C			
Luftfeuchtigkeit							
Betrieb			r	nax. 85% bei 85°(C		
Lagerung			r	nax. 85% bei 85°0	2		
Transport			r	nax. 85% bei 85°0	2		
Vibration		00				(h l D. 100)	
Betrieb		20 g peak, 2	5 35 a RMS	15 min pro Ebene	DEC JESD22, Me	thode B103)	
Lagerung	20 g neak 20 bis 2000 Hz 4 pro Richtung (JEDEC JESD22 Methode R103)						
	5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)						
Transport	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)						
Sobook	5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)						
Betrieb	1.5 kg neak 0.5 ms 5 mal (JEDEC JECD22 Matheda B110)						
	30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)						
Lagerung	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)						
			30 g, 1	1 ms 1 mal (IEC 6	8-2-27)		
Iransport		1,5	kg peak, 0,5 ms 5	mal (JEDEC JES	SD22, Methode B	110)	
Meereshöhe	1		50 g, 1		~]		
Betrieb	max. 4.572 m						

Tabelle 233: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06	5CFCRD. 1024-06	5CFCRD. 2048-06	5CFCRD. 4096-06	5CFCRD. 8192-06	5CFCRD. 016G-06	5CFCRD. 032G-06
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Breite	42,8 ±0,10 mm						
Länge	36,4 ±0,15 mm						
Höhe	3,3 ±0,10 mm						
Gewicht	10 g						

Tabelle 233: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)

3) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

9.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 153: 5CFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

9.3.5 Abmessungen



Abbildung 154: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

9.3.6 Benchmark







Abbildung 156: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

9.4 5CFCRD.xxxx-04

9.4.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 314

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

9.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash	
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	Community
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	Pract Flash
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	STOCKTONE CONCERNMENT STOCKTONE CONCERNMENT STOCKTONE STOCKTONE CONCERNE STOCKTONE STOCKTONE STOCKTONE STOC

Tabelle 234: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten

9.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
Allgemeines				~	~	
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre					
Datenverlässlichkeit		< 1 ni	chtbehebbarer Fehle	er in 1014 Bit Lesezug	griffen	
Lifetime Monitoring	Ja					
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)					
Wartung	keine					
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4					

Tabelle 235: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CF-CRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Zubehör • CompactFlash Karten

Due de lathere ei als anns a		5050DD 4004 04	5050DD 0040 04		5050DD 0400 04	5050DD 0400 04
Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
kontinuierliches Lesen						
typisch	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	33 MByte/s	27 MByte/s	36 MByte/s
movimal	(240A) ''	(240A) ^{1/}	(240A) ¹ /	(220A) ¹ /		(240A) ''
maximai	(260X) 1)	(260X) 1)	(260X) 1)	(226X) 1)		(247X) 1)
kantinujarliahaa Sahraihan	(2007)	(2007)	(2007)	(220X)	(1007)	(2477) /
tuningh	17 MPsto/o	17 MPsto/o	17 MPsto/o	16 MPsto/o	15 MDuto/o	19 MButo/o
typisch	(110X)	(110X)	(110X)	(1062)	(100)	(120X)
maximal	20 MByto/c	20 MByto/c	20 MByto/c	18 MByto/c	17 MByto/c	(120A) 10 MByto/s
IIIdAIIIIdi	(133X)	(133X)	(133X)	(120X)	(110X)	(126X)
Zertifizierungen	(100/()	(1007)	(10077)	(12077)	(110/()	(12077)
CE				2		
			J	a 2		
		10	J			la
GUST-R	-	Ja	j Ja	Ja 2)	Ja	Ja
GL			Jc	1 -/		
Endurance						
garantierte Datenmenge				400 TD 4-		
garantiert 3)	50 TByte	100 I Byte	200 TByte	400 I Byte	800 I Byte	1600 TByte
ergibt bei 5 Jahren ³⁾	27,40 GByte/Tag	54,79 GByte/Tag	109,59 GByte/Tag	219,18 GByte/Tag	438,36 GByte/Tag	876,72 GByte/Tag
Lösch- / Schreibzyklen						
typisch 4)			2.000	0.000		
garantiert			100	.000		
SLC-Flash			J	а		
Wear Leveling			stat	isch		
Error Correction Coding (ECC)			J	а		
S.M.A.R.T. Support			Ne	ein		
Unterstützung						
Hardware	PP	300/400 PP500 PF	C300 PPC700 PP	C725 PPC800 APC	620 APC810 APC	320
Retriebssysteme						
Windows 7 32-Bit	Noin	Nein	Noin	Nein	Nein	el
Windows 7 52-bit	INCIII					Ja
Windows 7 04-Bit	Main	l Nata			l 1-	1
Windows Embedded Standard /	inein	inein	inein	Nein	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7	Noin	Noin	Noin	Noin	Noin	la
64-Bit	INCILL	INCILL	INCIL	INCIII	INCIII	Ja
Windows XP Professional	Noin	Noin	Noin	12	12	la.
Windows XP Frolessional	INCIII			Ja	Ja	Ja
Windows XP Embedded	Main	. I.	J	a I Ia	l 1-	1
Windows Embedded Standard 2009	inein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja Ja	j Ja	Ja	Ja Ja	Ja ³⁾
Windows CE 5.0			Ne	ein		
Software				1		
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.2.3.8 (Teil	≥ V3.6.8.40 (Teil
	von PVI Develop-	von PVI Develop-	von PVI Develop-	von PVI Develop-	von PVI Develop-	von PVI Deve-
	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	ment Setup ≥	lopment Setup
	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	V2.06.00.3011)	2 V3.0.0.3020)
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	2 V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20
Umgebungsbedingungen						
Temperatur						
Betrieb			0 bis	70°C		
Lagerung			-65 bis	150°C		
Transport			-65 bis	150°C		
Luftfeuchtigkeit						
Betrieb			max. 85%	bei 85°C		
Lagerung			max. 85%	bei 85°C		
Transport			max. 85%	bei 85°C		
Vibration						
Betrieb		20 g peak, 20 bis	2000 Hz, 4 pro Richt	tung (JEDEC JESD2	2, Methode B103)	
		5,	35 g RMS, 15 min p	ro Ebene (IEC 68-2-	6)	
Lagerung	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)					
	5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Transport	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)					
		5,	35 g RMS, 15 min p	ro Ebene (IEC 68-2-	6)	
Schock						
Betrieb	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)					
	30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Lagerung	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)					
			30 g, 11 ms 1 m	al (IEC 68-2-27)		
Transport		1,5 kg pea	ak, 0,5 ms 5 mal (JEI	DEC JESD22, Metho	ode B110)	
			<u>30 g, 11 ms 1 m</u>	al (IEC 68-2-27)		
Meereshöhe						
Betrieb		max. 4.572 m				

Tabelle 235: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CF-CRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
Mechanische Eigenschaften						
Abmessungen						
Breite			42,8 ±0	,10 mm		
Länge	36,4 ±0,15 mm					
Höhe	3,3 ±0,10 mm					
Gewicht	10 g					

Tabelle 235: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CF-CRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

- 1) Geschwindigkeitsangaben mit 1X = 150 kByte/s. Alle Angaben beziehen sich auf die Samsung Flash Chips, CompactFlash Karte in UDMA Mode 4, Zykluszeit 30 ns in True-IDE Mode mit sequentiellem Schreiben/Lesen- Test.
- 2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)

4) Abhängig von der durchschnittlichen Filegröße.

5) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

9.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 157: 5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

9.4.5 Abmessungen



Abbildung 158: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

9.4.6 Benchmark



Abbildung 159: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04



Abbildung 160: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04

9.5 5CFCRD.xxxx-03

9.5.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von Western Digital CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx- 03 und Compact-Flash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 314

Information:

Auf Windows CE 5.0 Geräten werden die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 bis zu 1GB unterstützt.

Information:

Bei den CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 hat sich lediglich der Aufkleber und die Beschreibung geändert. Die technischen Daten sind unverändert.

9.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash	10.0
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	CHINES.
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONT
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	CONTRACTOR OF THE OWNER OF
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	Sili
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	SiliconD
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	64 MB DUFIVe
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	NO CEAM TA
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	All and the second seco

Tabelle 236: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten

9.5.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, empfiehlt B&R die Verwendung einer USV.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Zubehör • CompactFlash Karten

Produktbezeichnung	5CFCRD.	5CFCRD. 0128-03	5CFCRD. 0256-03	5CFCRD. 0512-03	5CFCRD.	5CFCRD.	5CFCRD.	5CFCRD. 8192-03
Allgemeines	0004-00	0120-00	0200-00	0012-00	1024-00	2040-00	4000-00	0102-00
Kapazität	64 MByte	128 MByte	256 MByte	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte
Datenerhaltung				10 J	ahre	-		
Datenverlässlichkeit			< 1 nichtbe	ehebbarer Fehle	er in 1014 Bit Le	sezugriffen		_
Lifetime Monitoring				J	а			
MTBF			:	> 4.000.000 Stu	inden (bei 25°C	;)		_
Wartung				ke	ine			_
unterstützte Betriebsmodi			PIO	Mode 0-4, Multi	word DMA Mod	le 0-2		_
kontinuierliches Lesen typisch				8 ME	Bvte/s			
kontinuierliches Schreiben				6 MF	svte/s			-
Zertifizierungen				0 1112	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
CE				J	а			
cULus				J	a			
GOST-R				J	a			
GL	Ja 1)	Ja 1)	Ja	Ja 1)	Ja 1)	Ja 1)	Ja 1)	Ja 1)
Endurance	L	,	,		L		1	
Lösch- / Schreibzyklen								
typisch				> 2.00	00.000			
SLC-Flash				J	а			
Wear Leveling				stat	isch			_
Error Correction Coding (ECC)				J	а			
S.M.A.R.T. Support				Ne	ein			_
Unterstützung								_
Hardware		MP100	0/200, PP100/2	00, PP300/400,	PP500, PPC3	00, PPC700, P	PC725,	_
		PPC8	800, Provit 2000), Provit 5000, A	PC620, APC68	80, APC810, A	PC820	
Betriebssysteme								
Windows 7 32-Bit				Ne	ein			
Windows 7 64-Bit				N	ein			
Windows Embedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
32-Bit				l	l <u>.</u>			
Windows Embedded Standard /				Ne	ein			
04-Bil Windows XB Brofossional	Noin	Noin	Noin	Noin	Noin	Noin		
Windows XP Embedded	Nein	Nein	Nein				Ja Ja	Ja
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja la	Ja	Ja Ja	Ja
Windows CE 6.0	la	la	la	la	la	la	la	la 2)
Windows CE 5.0	.la	Ja	Ja	, la	.la	Nein	Nein	Nein
Software								
PVI Transfer Tool			≥ V2.57 (Teil	von PVI Develo	opment Setup ≥	V2.5.3.3005)		
B&R Embedded OS Installer				≥ V	2.21	12:0:0:0000)		
Umaebunasbedingungen								_
Temperatur								
Betrieb				0 bis	70°C			
Lagerung				-50 bis	100°C			
Transport				-50 bis	100°C			
Luftfeuchtigkeit								_
Betrieb				8 bis 95%, nich	t kondensieren	d		
Lagerung				8 bis 95%, nich	t kondensieren	d		
Transport				8 bis 95%, nich	t kondensieren	d		
Vibration								
Betrieb				max. 16,3 g (1	59 m/s² 0-peak))		
Lagerung				max. 30 g (29	4 m/s ² 0-peak)			
Transport				max. 30 g (29	4 m/s ² 0-peak)			
Schock								
Betrieb			ı	max. 1000 g (98	310 m/s² 0-peał	()		
Lagerung			n	nax. 3000 g (29	430 m/s² 0-pea	k)		
Transport			n	nax. 3000 g (29	430 m/s² 0-pea	k)		
Meereshöhe					-			_
Betrieb				max. 24	4.383 m			
Mechanische Eigenschaften								
Abmessungen								_
Breite				42,8 ±0	,10 mm			
Länge				36,4 ±0	,15 mm			
Höhe				3,3 ±0,	10 mm			
Gewicht				11,	4 g			

Tabelle 237: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CF-CRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt. 1)

2)

9.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 161: 5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

9.5.5 Abmessungen



Abbildung 162: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

9.6 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Der nachfolgende Punkt ist bei Geräten mit zwei CompactFlash Slots bekannt:

 Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.

10 USB Memory Sticks

10.1 5MMUSB.2048-00

10.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein "fdisk / mbr" auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

10.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-00	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte	

Tabelle 238: 5MMUSB.2048-00 - Bestelldaten

10.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-00
Allgemeines	
Datenerhaltung	10 Jahre
LEDs	1 LED (grün) 1)
MTBF	100.000 Stunden (bei 25°C)
Тур	USB 1.1, USB 2.0
Wartung	keine
Zertifizierungen	
CE	Ja
Schnittstellen	
USB	
Тур	USB 1.1, USB 2.0
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
sequentielles Lesen	max. 8,7 MByte/s
sequentielles Schreiben	max. 1,7 MByte/s
Unterstützung	
Betriebssysteme	
Windows XP Professional	Ja
Windows XP Embedded	Ja
Windows ME	Ja
Windows 2000	Ja
Windows CE 5.0	Ja
Windows CE 4.2	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Stromaufnahme	650 µA Schlafmodus, 150 mA Lesen/Schreiben

Kapitel 6 Zubehör

Zubehör • USB Memory Sticks

	1	
Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-00	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 45°C	
Lagerung	-20 bis 60°C	
Transport	-20 bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	10 bis 90%, nicht kondensierend	
Lagerung	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Transport	5 bis 90%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute	
Lagerung	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute	
Transport	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s ² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute	
Schock		
Betrieb	max. 40 g (392 m/s ² 0-peak) und 11 ms Dauer	
Lagerung	max. 80 g (784 m/s ² 0-peak) und 11 ms Dauer	
Transport	max. 80 g (784 m/s ² 0-peak) und 11 ms Dauer	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3048 m	
Lagerung	max. 12192 m	
Transport	max. 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	19 mm	
Länge	52,2 mm	
Höhe	7,9 mm	

Tabelle 239: 5MMUSB.2048-00 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

10.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 163: 5MMUSB.2048-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

10.2 5MMUSB.xxxx-01

10.2.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein "fdisk / mbr" auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

10.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	
		Perfection in Automation

Tabelle 240: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten

10.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01	
Allgemeines			
Kapazität	2 GByte	4 GByte	
Datenerhaltung	> 10 .	Jahre	
LEDs	1 LED (grün) 1)	
MTBF	> 3.000.00	0 Stunden	
Тур	USB 1.1,	USB 2.0	
Wartung	kei	ne	
Formatierung ab Werk	FAT16	FAT32	
Zertifizierungen			
CE	j.	a	
GOST-R	J	a	
Schnittstellen			
USB			
Тур	USB 1.1, USB 2.0		
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle		
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)		
sequentielles Lesen	Full Speed max. 1 MByte/s,		
	High Speed ma	ax. 32 MByte/s	
sequentielles Schreiben	Full Speed max	x. 0,9 MByte/s,	
	High Speed ma	ax. 23 MByte/s	
Unterstützung			
Betriebssysteme			
Windows 7	j.	а	
Windows XP Professional	j.	а	
Windows XP Embedded	;ل	а	
Windows ME	Ja		
Windows 2000	Ja		
Windows CE 5.0	Ja		
Windows CE 4.2	Ja		
Elektrische Eigenschaften			
Stromaufnahme	max. 500 µA Schlafmodus, m	ax. 120 mA Lesen/Schreiben	

Tabelle 241: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

Zubehör • USB Memory Sticks

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01	
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis	; 70°C	
Lagerung	-50 bis	s 100°C	
Transport	-50 bis	s 100°C	
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	85%, nicht k	ondensierend	
Lagerung	85%, nicht k	ondensierend	
Transport	85%, nicht k	ondensierend	
Vibration			
Betrieb	20 bis 2000 H	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Lagerung	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)		
Transport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)		
Schock			
Betrieb	max. 1500 g (peak)		
Lagerung	max. 1500 g (peak)		
Transport	max. 1500 g (peak)		
Meereshöhe			
Betrieb	max.	3048 m	
Lagerung	max. 12192 m		
Transport	max. 12192 m		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Breite	17,97 mm		
Länge	67,85 mm		
Höhe	8,3	5 mm	

Tabelle 241: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

10.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 164: 5MMUSB.xxxx-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

11 USB Media Drive

11.1 5MD900.USB2-02

11.1.1 Allgemeines

Das USB Media Drive besitzt ein DVD-R/RW DVD+R/RW- Laufwerk, einen CompactFlash Slot sowie einen rückund frontseitigen USB Anschluss. Es wird an den USB Anschluss des B&R Industrie PCs angeschlossen.

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- Integriertes DVD-R/RW DVD+R/RW Laufwerk
- Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug fähig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss
- Versorgung, +24 VDC rückseitig
- USB 2.0 Anschluss rückseitig
- optionale Frontklappe

11.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestel- len)	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Sonstiges	
5SWUTI.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD- RW Laufwerk erhältlich.	
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 242: 5MD900.USB2-02 - Bestelldaten

11.1.3 Schnittstellen



Abbildung 165: 5MD900.USB2-02 - Schnittstellen

11.1.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Allgemeines	
max. Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja

Tabelle 243: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Schnittstellen	
CompactElash Slot 1	
	ΤνοΙ
Anschluss	IDE/ATAPI
Activity LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte
USB	
Тур	USB 2.0
Ausführung	Typ A frontseitig
	Typ B rückseitig
Ubertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA
CD / DVD Lautwerk	0.00.4-
Datenpunerkapazitat	2 MByte
	max. 33,3 MByte/s
	$\frac{111}{1100}$
Kompatible Formate	CD_DA_CD_ROM Mode 1/ Mode 2
Rompatible i offiate	CD-ROM XA Mode 2 (Form 1 Form 2)
	Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video
	DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
Less discus	DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	
	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Hochlautzeit	may 14 Calcundan (yan 0 ram auf Lanamyariff)
	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
	max. 13 Sekunden (von orpin auf Lesezughin)
CD	tvn 140 ms (24x)
	typ. 150 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm. 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	10 bis 24x
CD-RW	10 bis 24x
DVD+R	3,3 bis 8x
DVD+R (Double Layer)	2,4 DIS 4X
	3,5 DIS 6X
DVD-R (Double Laver)	2 bis 6x 2 bis 4x
DVD-RAM	2 bis 5x
DVD-RW	2 bis 6x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65 frontseitig (nur mit optionaler Frontklappe), IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾	
Betrieb	5 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 60°C
Luttreuchtigkeit	00.11.000/
Betrieb	20 bis 80%
Lagerung	5 DIS 90%
Vibration	ວ ມາຮ 95%
Betrieh	5 his 500 Hz $0.3 a / 2.0 m/c^2 0 - nack)$
	10 hjs 100 Hz. 0,0 y (2,9 H/s υ-μεακ)
Transport	$10 \text{ bis 100 Hz} \cdot 2 \text{ g} (13,0 \text{ Hz} - 9 \text{ cak})$ 10 bis 100 Hz · 2 a (19.6 m/s ² 0-neak)
Schock	10 010 100 112. 2 9 (10,0 1180 0 pour)
Betrieb	5 g. 11 ms
Lagerung	60 g, 11 ms
Transport	60 g, 11 ms

Tabelle 243: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	156 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	ca. 1100 g (ohne Frontklappe)

Tabelle 243: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

1) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.

11.1.5 Abmessungen



Abbildung 166: 5MD900.USB2-02 - Abmessungen





Abbildung 167: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

11.1.7 Einbau in Wanddurchbrüche



Abbildung 168: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

11.1.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	USB Media Drive Gesamtgerät
2	Hutschienenwinkel

Tabelle 244: 5MD900.USB2-02 - Lieferumfang

11.1.9 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschienenwinkel werden beigepackt) geeignet.

11.1.9.1 Einbaulagen



Abbildung 169: 5MD900.USB2-02 - Einbaulage

11.2 5A5003.03

11.2.1 Allgemeines

Diese Frontklappe kann optional an der Vorderseite des USB Media Drive Laufwerks (Best.Nr. 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 bzw. 5MD900.USB2-02) zum Schutz der Schnittstellen montiert werden.

11.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	



11.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5A5003.03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Front	
Dekorfolie	
Farbe heller Hintergrund	ähnlich Pantone 427CV
Abmessungen	
Breite	196 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	8 mm



11.2.4 Abmessungen



Abbildung 170: 5A5003.03 - Abmessungen

11.2.5 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Frontklappe 5A5003.03 für das USB Media Drive
4	M3 Sicherungsmutter
4	Haube Halteklammer

Tabelle 247: 5A5003.03 - Lieferumfang

11.2.6 Montage

Die Frontklappe wird mittels den 2 Hutschienenwinkel (beigepackt beim USB Media Drive) und den 4 M3 Sicherungsmuttern befestigt. Mit den 4 beiliegenden Halteklammern kann das Gesamtgerät (USB Media Drive + Frontklappe) z.B. in einer Schaltschranktür montiert werden.



Abbildung 171: Frontklappenmontage und Klemmdicke

11.2.6.1 Einbau in Wanddurchbrüche



Abbildung 172: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe
12 HMI Drivers & Utilities DVD

12.1 5SWHMI.0000-00

12.1.1 Allgemeines

Diese DVD beinhaltet Treiber, Utilities, Softwareupgrades und Anwenderhandbücher für B&R Panel System Produkte (siehe B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> - Bereich Industrie PCs bzw. Visualisieren und Bedienen).

Der Inhalt der DVD ist zum Zeitpunkt der Erstellung mit denen unter dem Downloadbereich auf der B&R Homepage (unter Service - "Produktbezogene Downloads") befindlichen Dateien ident.

12.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Sonstiges	
5SWHMI.0000-00	HMI Drivers & Utilities DVD	HMI Drivers & Utilities DVD HMI Drivers & Utilities DVD

Tabelle 248: 5SWHMI.0000-00 - Bestelldaten

12.1.3 Inhalt (V2.20)

BIOS Upgrades für die Produkte

- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 815E und 855GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board X855GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 945GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 945GME N270 BIOS
- Automation PC 680
- Automation PC 810 / Automation PC 820 / Panel PC 800 B945GME BIOS
- Automation PC 810 / Panel PC 800 945GME N270 CPU Board BIOS
- Automation PC 810 / Panel PC 800 GM45 CPU Board BIOS
- Provit 2000 Produktfamilie IPC2000/2001/2002
- Provit 5000 Produktfamilie IPC5000/5600/5000C/5600C
- Power Panel 100 BIOS Geräte
- Mobile Panel 100 BIOS Geräte
- Power Panel 100 / Mobile Panel 100 User Boot Logo
- Power Panel 100 / Mobile Panel 100 REMHOST Utility
- Power Panel 300/400 BIOS Geräte
- Power Panel 300/400 BIOS User Boot Logo
- Power Panel 500 / Automation PC 510 / Automation PC 511 BIOS
- Panel PC 310

Treiber für die Geräte

- Automation Device Interface (ADI)
- Audio
- Chipset
- CD-ROM
- LS120

- Grafik
- Netzwerk
- PCI / SATA RAID Controller
- Touch Screen
- Touch Pad
- Schnittstellenkarte

Firmware Upgrades

- Automation PC 620 / Panel PC 700 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Automation PC 810 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Automation PC 820 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Mobile Panel 100 (SMCX)
- Panel PC 300 (MTCX)
- Power Panel 100 (aPCI)
- Power Panel 300/400 (aPCI)
- Power Panel 300/400 (MTCX)
- Power Panel 500 / Automation PC 510 / Automation PC 511 (MTCX, SDLR, I/O Board)
- Panel PC 800 (MTCX, SDLR, SDLT)
- USV Firmware

Utilities / Tools

- B&R Embedded OS Installer
- Windows CE Tools
- User Boot Logo Konvertierungsprogramm
- SATA RAID Installations Utility
- Automation Device Interface (ADI)
- CompactFlash Lebensdauerrechner (Silicon Systems)
- Miscellaneous
- MTC Utilities
- Key Editor
- MTC & Mkey Utilities
- Mkey Utilities
- USV Konfigurationsoftware
- ICU ISA Konfiguration
- Intel PCI NIC Boot ROM
- Diagnoseprogramme

Windows

- Windows CE 6.0
- Windows CE 5.0
- Windows CE 4.2
- Windows CE 4.1
- Windows CE Tools
- Windows Embedded Standard 2009
- Windows Embedded Standard 7
- Thin Client
- Windows NT Embedded
- Windows XP Embedded
- VNC Viewer

MCAD Vorlagen für

Industrie PCs

- Visualisieren und Bedienen Geräte
- Einschubstreifenvordrucke
- Kundenspezifische Designs

ECAD Vorlagen für

- Industrie PCs
- Automation PCs
- Automation Panel 900
- Panels (Power Panel)

Dokumentationen für

- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 680
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation Panel 800
- Automation Panel 900
- Panel PC 310
- Panel PC 700
- Panel PC 725
- Panel PC 800
- Power Panel 15/21/35/41
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Mobile Panel Anschlussbox
- Provit 2000
- Provit 3030
- Provit 4000
- Provit 5000
- Provit Benchmark
- Provit Mkey
- Windows CE 5.0 Hilfe
- Windows CE 6.0 Hilfe
- Windows NT Embedded Applikation Guide
- Windows XP Embedded Applikation Guide
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Implementierungsanleitungen
- B&R Hilscher Feldbus Karten (CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET)

Service Tools

- Acrobat Reader 5.0.5 (Freeware in Deutsch, Englisch und Französisch)
- Power Archiver 6.0 (Freeware in Deutsch, Englisch und Französisch)
- Internet Explorer 5.0 (Deutsch und Englisch)
- Internet Explorer 6.0 (Deutsch und Englisch)

13 Kabel

13.1 DVI Kabel

13.1.1 5CADVI.0xxx-00

13.1.1.1 Allgemeines

Die DVI Kabel 5CADVI.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

13.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	DVI Kabel	
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	

Tabelle 249: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten

13.1.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CADVI.0018-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0100-00			
Allgemeines			·			
Zertifizierungen						
CE		Ja				
cULus		Ja				
GOST-R		Ja				
GL		Ja 1)				
Kabelaufbau						
Drahtquerschnitt		AWG 28				
Schirm	Ka	belpaare einzeln, sowie Kabel gesa	mt			
Gesamtschirmung	verzinnt	es Cu-Geflecht, optische Bedeckung	g > 86%			
Außenmantel						
Material		PVC				
Farbe	beige					
Bedruckung	AWM STYLE 20276 80°C 30V VW1 DVI DIGITAL SINGLE LINK DER AN					
Steckverbindung						
Тур	2x DVI-D (18+1), male					
Steckzyklen	100					
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben		max. 0,5 Nm				
Elektrische Eigenschaften						
Leiterwiderstand		max. 237 Ω/km				
Isolationswiderstand	min. 100 MΩ/km					
Mechanische Eigenschaften						
Abmessungen						
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm			
Durchmesser	max. 8,5 mm					
Biegeradius	≥ 5x Kabelo	lurchmesser (Stecker - Ferrit und Fe	errit - Ferrit)			
Gewicht	ca. 260 g ca. 460 g ca. 790 g					

Tabelle 250: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

13.1.1.4 Biegeradiusspezifikation



Abbildung 173: Biegeradiusspezifikation

13.1.1.5 Abmessungen



Abbildung 174: 5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen

13.1.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.



Abbildung 175: 5CADVI.0xxx-00 - Belegung

13.2 SDL Kabel

13.2.1 5CASDL.0xxx-00

13.2.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel 5CASDL.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert. Für eine flexible Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) ist der Einsatz der SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 erforderlich.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

13.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	

Tabelle 251: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten

13.2.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-00	5CASDL. 0050-00	5CASDL. 0100-00	5CASDL. 0150-00	5CASDL. 0200-00	5CASDL. 0250-00	5CASDL. 0300-00
Allgemeines		1					
Zertifizierungen							
CE				Ja			
cULus				Ja			
GOST-R				Ja			
GL				Ja 1)			
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWG	G 28			AWG 24		
Schirm			Kabelpaare	einzeln, sowie K	abel gesamt		
Gesamtschirmung			verzinntes Cu-Ge	eflecht, optische E	Bedeckung > 85%		
Außenmantel							
Material				PVC			
Farbe				schwarz			
Bedruckung	E74020-C (UL) AWM STYLE 20176 80°C 30V VW-1 DVI DIGITAL LINK						
Steckverbindung							
Тур			2x	: DVI-D (24+1), m	ale		
Steckzyklen				100			
Kontakte				vergoldet			
mechanischer Schutz			Metallhaube	mit vercrimpter Z	lugentlastung		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben				max. 0,5 Nm			
Elektrische Eigenschaften							
Leiterwiderstand							
AWG 24		-			≤ 93 Ω/km		
AWG 28	≤ 237	Ω/km			-		
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km						
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±30 mm	10 m ±50 mm	15 m ±100 mm	20 m ±100 mm	25 m ±100 mm	30 m ±100 mm
Durchmesser	typ. 8,6 ±0,2 mm typ. 11 ±0,2 mm						
	max.	9 mm			max. 11,5 mm		
Biegeradius		≥ 5	5x Kabeldurchmes	sser (Stecker - Fe	rrit und Ferrit - Fe	rrit)	
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute)						
Gewicht	ca. 300 g	ca. 580 g	ca. 1500 g	ca. 2250 g	ca. 2880 g	ca. 4800 g	ca. 5520 g

Tabelle 252: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Kapitel 6 Zubehör

13.2.1.4 Biegeradiusspezifikation



Abbildung 176: Biegeradiusspezifikation

13.2.1.5 Abmessungen



Abbildung 177: 5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen

13.2.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.



Abbildung 178: 5CASDL.0xxx-00 - Belegung

13.3 SDL Kabel mit 45° Stecker

13.3.1 5CASDL.0xxx-01

13.3.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel mit 45° Stecker 5CASDL.0xxx-01 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

13.3.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel 45° Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	

Tabelle 253: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten

13.3.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0018-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0150-01		
Allgemeines						
Zertifizierungen						
CE		J	а			
cULus		J	а			
GOST-R		J	а			
GL		Ja	l ¹⁾			
Kabelaufbau						
Drahtquerschnitt	AW	G 28	AWG	G 24		
Schirm		Kabelpaare einzeln,	sowie Kabel gesamt			
Gesamtschirmung		verzinntes Cu-Geflecht, o	ptische Bedeckung > 85%			
Außenmantel						
Material		P\	/C			
Farbe		schv	warz			
Steckverbindung						
Тур	2x DVI-D (24+1), male					
Steckzyklen		10	00			
Kontakte		verg	oldet			
mechanischer Schutz		Metallhaube mit verci	impter Zugentlastung			
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben		max. (),5 Nm			
Elektrische Eigenschaften						
Leiterwiderstand						
AWG 24		-	≤ 93	Ω/km		
AWG 28	≤ 237	Ω/km	-	-		
Isolationswiderstand		min. 10	MΩ/km			
Mechanische Eigenschaften						
Abmessungen						
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm	10 m ±100 mm	15 m ±100 mm		
Durchmesser	max. 9 mm max. 11,5 mm					
Biegeradius						
feste Verlegung		≥ 5x Kabeldurchmesser (Stee	cker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)			
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt vo	on Ferrit - Ferrit (getestet 100 Z	yklen bei 5x Kabeldurchmesse	er, 20 Zyklen / Minute)		
Gewicht	ca. 300 g	ca. 590 g	ca. 2800 g	ca. 2860 g		

Tabelle 254: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

13.3.1.4 Biegeradiusspezifikation



Abbildung 179: Biegeradiusspezifikation

13.3.1.5 Abmessungen



Abbildung 180: 5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen

13.3.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.



Abbildung 181: 5CASDL.0xxx-01 - Belegung

13.4 SDL Kabel flex

13.4.1 5CASDL.0xxx-03

13.4.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

13.4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	

Tabelle 255: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten

13.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03		
Allgemeines									
Zertifizierungen									
CE				Ja					
cULus				Ja					
GOST-R				Ja					
GL				Ja 1)					
Kabelaufbau									
Drahtquerschnitt			AV	VG 24 (Steuerade	ern)				
			AWC	G 26 (DVI, USB, D	Daten)				
Eigenschaften			ha	logen- und silikor	frei				
Schirm			Kabelpaare	e einzeln, sowie K	abel gesamt		_		
Gesamtschirmung			alukaschierte	Folie + verzinntes	Kupfergeflecht				
Außenmantel									
Material			Spez	zial-TMPU - seide	nmatt				
Farbe				schwarz					
Bedruckung		(1	B&R) SDL Cable	(UL) AWM 20236	80°C 30V E 6321	16			
Steckverbindung									
Тур	2x DVI-D (24+1), male								
Steckzyklen	min. 200								
Kontakte	vergoldet								
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung								
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben				max. 0,5 Nm					
Elektrische Eigenschaften									
Betriebsspannung				≤ 30 V					
Prüfspannung									
Ader/Ader				1 kV					
Ader/Schirm	0,5 kV								
Wellenwiderstand	100 ±10 Ω								
Leiterwiderstand									
AWG 24	≤ 95 Ω/km								
AWG 26	≤ 145 Ω/km								
Isolationswiderstand	> 200 MΩ/km								
Einsatzbedingungen									
Approbation			UL /	AWM 20236 80°C	: 30V				
Flammwidrigkeit			gemäß UL	758 (cable vertica	I flame test)				
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10								

Tabelle 256: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

Zubehör • Kabel

Produktbezeichnung	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.
Umgebungsbedingungen	0010-03	0000-00	0100-03	0130-03	0200-03	0230-03	0300-03
Temperatur							
				-20 his 80°C			
feste Verlegung				-20 bis 80°C			
flexible Verlegung				-5 bis 60°C			
Mechanische Eigenschaften				0.010 00 0			-
Abmessungen							
Länge	1,8 m ±20 mm	5 m ±45 mm	10 m ±90 mm	15 m ±135 mm	20 m ±180 mm	25 m ±225 mm	30 m ±270 mm
Durchmesser			1	max. 12 mm	I	I	I
Biegeradius							
feste Verlegung			≥ 6x Kabeldu	rchmesser (von S	tecker - Ferrit)		
			≥ 10x Kabelo	lurchmesser (von	Ferrit - Ferrit)		
flexible Verlegung			≥ 15x Kabelo	lurchmesser (von	Ferrit - Ferrit)		
Beweglichkeit	flexibel; g	ilt von Ferrit - Fe	errit (getestet 300	000 Zyklen bei 15:	x Kabeldurchmes	ser, 4800 Zyklen	/ Stunde)
Schleppkettendaten							
Biegewechsel				300.000			
Geschwindigkeit		4800 Zyklen/Stunde					
Biegeradius	180 mm; 15x Kabeldurchmesser						
Hub	460 mm						
Gewicht	ca. 460 g ca. 1020 g ca. 1940 g ca. 2840 g ca. 3740 g ca. 4560 g ca. 5590 g						
Zugbelastbarkeit							
in Betrieb	≤ 50 N						
bei Verlegung	≤ 400 N						

Tabelle 256: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

13.4.1.4 Biegeradiusspezifikation



Abbildung 182: Biegeradiusspezifikation

13.4.1.5 Abmessungen



Abbildung 183: 5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen

13.4.1.6 Aufbau

Element	Belegung	Querschnitt	
	TMDS Daten 0	26 AWG	TMDS Daten 2 TMDS Daten 1
DVI	TMDS Daten 1	26 AWG	
DVI	TMDS Daten 2	26 AWG	TMDS Takt
	TMDS Takt	26 AWG	
LISB	XUSB0	26 AWG	Steueradern
USB	XUSB1	26 AWG	
Daten	SDL	26 AWG	- DDC Daten
	DDC Takt	24 AWG	YUSB1
	DDC Daten	24 AWG	- Masse
Steueradern	+5 V	24 AWG	- Hot Plug Detect
	Masse	24 AWG	XUSR0 3DL
	Hot Plug Detect	24 AWG	

Tabelle 257: Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03

13.4.1.7 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.



Abbildung 184: 5CASDL.0xxx-03 - Belegung

13.5 SDL Kabel flex mit Extender

13.5.1 5CASDL.0xx0-13

13.5.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel flex mit Extender 5CASDL.0xx0-13 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

13.5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	

Tabelle 258: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten

13.5.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Allgemeines		·	
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus		Ja	
GOST-R		Ja	
GL		Ja 1)	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 24 (Steueradern)		
	AWG 26 (DVI, USB, Daten)		
Eigenschaften		halogen- und silikonfrei	
Schirm	ĸ	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesan	nt
Gesamtschirmung	aluk	aschierte Folie + verzinntes Kupfergef	echt
Außenmantel			
Material		Spezial-TMPU - seidenmatt	
Farbe		schwarz	
Bedruckung	(B&R) S	DL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V	E63216
Steckverbindung			
Тур	2x DVI-D (24+1), male		
Steckzyklen	min. 200		
Kontakte		vergoldet	
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm		
Elektrische Eigenschaften			
Betriebsspannung		≤ 30 V	
Prüfspannung			
Ader/Ader	1 kV		
Ader/Schirm	0,5 kV		
Wellenwiderstand	100 ±10 Ω		
Leiterwiderstand			
AWG 24	≤ 95 Ω/km		
AWG 26	≤ 145 Ω/km		
Isolationswiderstand	> 200 MΩ/km		
Einsatzbedingungen			
Approbation	UL AWM 20236 80°C 30V		
Flammwidrigkeit	gemäß UL758 (cable vertical flame test)		
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Lagerung		-20 bis 60°C	
feste Verlegung		-20 bis 60°C	
flexible Verlegung	-5 bis 60°C		

Tabelle 259: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

Zubehör • Kabel

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	30 m ±280 mm	40 m ±380 mm	43 m ±410 mm
Durchmesser		max. 12 mm	
Extender Box			
Breite		35 mm	
Länge		125 mm	
Höhe		18,5 mm	
Biegeradius			
feste Verlegung	≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit)		
	≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)		
flexible Verlegung	≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)		
Beweglichkeit	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)		
Schleppkettendaten			
Biegewechsel	300.000		
Geschwindigkeit	4800 Zyklen/Stunde		
Biegeradius	180 mm; 15x Kabeldurchmesser		
Hub	460 mm		
Gewicht	ca. 5430 g	ca. 7200 g	ca. 7790 g
Zugbelastbarkeit			
in Betrieb	≤ 50 N		
bei Verlegung	≤ 400 N		

Tabelle 259: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

13.5.1.4 Biegeradiusspezifikation



Abbildung 185: Biegeradiusspezifikation mit Extender

13.5.1.5 Abmessungen



Abbildung 186: 5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen

13.5.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.



Abbildung 187: 5CASDL.0xx0-13 - Belegung

13.5.1.7 Kabelanschluss

Das SDL Kabel flex mit Extender muss in richtiger Richtung zwischen B&R Industrie PC und Automation Panel Displayeinheit angeschlossen werden. Zu diesem Zweck ist die Signalrichtung auf der Extender Unit abgebildet.





13.6 USB Kabel

13.6.1 5CAUSB.00xx-00

13.6.1.1 Allgemeines

Die USB Kabel sind für eine Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0 konzipiert.

13.6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 260: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten

13.6.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAUSB.0018-00	5CAUSB.0050-00
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ji	a
cULus	Ji	a
GOST-R	Ji	a
Kabelaufbau		
Drahtquerschnitt	AWG 24, 28	
Schirm	Kabel gesamt	
Außenmantel		
Farbe	beige	
Steckverbindung		
Тур	USB Typ A male und USB Typ B male	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm
Durchmesser	max. 5 mm	
Biegeradius	min. 100 mm	

Tabelle 261: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten

13.6.1.4 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.



Abbildung 189: 5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel

13.7 RS232 Kabel

13.7.1 9A0014.xx

13.7.1.1 Allgemeines

Die RS232 Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232 Schnittstellen.

13.7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	RS232 Kabel	
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Dis- playeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Dis- playeinheit mit Touch Screen, 5 m.	
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Dis- playeinheit mit Touch Screen, 10 m.	

Tabelle 262: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten

13.7.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	9A0014.02	9A0014.05	9A0014.10
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
GOST-R	-	J	la
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt		AWG 26	
Schirm	Kabel gesamt		
Außenmantel			-
Farbe	beige		
Steckverbindung			
Тур	9-polige DSUB Buchse, male / female		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm
Durchmesser		max. 5 mm	
Biegeradius	min. 70 mm		

Tabelle 263: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten

13.7.1.4 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.



Abbildung 190: 9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel

13.8 Versorgungskabel intern

13.8.1 5CAMSC.0001-00

13.8.1.1 Allgemeines

Dieses Versorgungskabel dient zur internen Versorgung von z.B. speziellen PCI Karten. Es wird dabei an das Basisboard angesteckt.

Vorraussetzungen und Vorgangsweise siehe dazu "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 371.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

13.8.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5CAMSC.0001-00	Versorgungskabel intern	

Tabelle 264: 5CAMSC.0001-00 - Bestelldaten

13.8.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAMSC.0001-00	
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
GOST-R	Ja	
Kabelaufbau		
Drahtquerschnitt	AWG 22	
Steckverbindung		
Тур	1x Disk Drive Power Stecker 4-polig male, 1x Steckergehäuse 4-polig female	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Länge	100 mm ±5 mm	
Beweglichkeit	flexibel	

Tabelle 265: 5CAMSC.0001-00 - Technische Daten

Kapitel 7 • Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

1 Batteriewechsel

Die Lithiumbatterie stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und der CMOS Daten sicher.

Information:

- Das Design des Produktes gestattet das Wechseln der Batterie sowohl in spannungslosem Zustand als auch bei eingeschaltetem B&R Gerät. In manchen Ländern ist der Wechsel unter Betriebsspannung jedoch nicht erlaubt.
- Beim Wechseln der Batterie in spannungslosem Zustand bleiben vorgenommene BIOS Einstellungen erhalten (werden in einem spannungssicheren EEPROM gespeichert). Datum und Uhrzeit sind nachträglich wieder einzustellen, da diese Daten beim Wechseln verloren gehen.
- Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Es sind folgende Lithium Ersatzbatterien verfügbar: 4A0006.00-000 (1 Stk.) und 0AC201.91 (4 Stk.).

1.1 Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 266: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

1.2 Vorgangsweise

- Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos (Netzkabel abstecken) machen.
- Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Abdeckung des Batteriefaches entfernen und Batterie mittels Ausziehstreifen vorsichtig herausziehen.



Abbildung 191: Batterie entfernen

• Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Einsetzen kann auch eine isolierte Pinzette verwendet werden.



Abbildung 192: Batteriehandhabung

• Neue Batterie in richtiger Polarität einstecken.



Abbildung 193: Batteriepolarität

- Beim Einstecken auf den korrekten Sitz des Ausziehstreifens achten, damit ein erneuter Tausch einfach zu bewerkstelligen ist!
- Den B&R Industrie PC wieder unter Spannung setzen Netzstecker anstecken.
- Datum und Uhrzeit im BIOS neu einstellen.

Warnung!

Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

2 Reinigung

Gefahr!

Die Reinigung des Gerätes darf nur in ausgeschaltenem Zustand durchgeführt werden, um so, durch Berühren des Touch Screens oder Drücken von Tasten, das Auslösen unbeabsichtigter Funktionen zu vermeiden.

Zum Reinigen des Gerätes ist ein feuchtes Tuch zu verwenden. Zum Befeuchten des Reinigungstuches nur Wasser mit Spülmittel, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) verwenden. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät sprühen, sondern zuerst auf das Tuch! Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel, Druckluft oder Dampfstrahler verwenden.

Information:

Displays mit Touch Screen sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

3 CompactFlash Tausch

Vorsicht!

Ein Tauschen der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

Das Tauschen der CompactFlash Karte ist durch Betätigung des Auswerfers (siehe Abbildung) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) schnell und sicher möglich.



Abbildung 194: CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto)

4 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

4.1 Vorgangsweise

1. 2 Schnellverschlussschrauben der Schutzabdeckung bzw. des Slide-in compact Laufwerks lösen und entfernen.



Abbildung 195: Schnellverschlussschrauben lösen

2. Compact SATA Laufwerk einschieben und mit den Schnellverschlussschrauben befestigen.



Abbildung 196: Compact SATA Laufwerk einschieben

5 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Slide-in Laufwerke können bei Systemeinheiten mit 1 Card Slot oder 2 Card Slot Expansion eingebaut und getauscht werden.

5.1 Vorgangsweise

- 1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Entfernung des Slide-in Blindmodules bzw. Slide-in Laufwerks durch Lösen der 2 Schnellverschlussschrauben.



Abbildung 197: Schnellverschlussschrauben lösen

4. Slide-in Laufwerk einstecken und mit den beiden Schnellverschlussschrauben fixieren.



Abbildung 198: Slide-in Laufwerkseinbau

6 Slide-in compact Adapter Montage

Slide-in compact Adapter können bei Systemeinheiten mit 1 Card Slot oder 2 Card Slot Expansion eingebaut und getauscht werden. Mit dem Slide-in compact Adapter kann ein Slide-in compact Laufwerk (z.B. Slide-in compact HDD) in einem Slide-in Slot montiert werden.

6.1 Vorgangsweise

- 1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Entfernung des Slide-in Blindmodules bzw. Slide-in Laufwerks durch Lösen der 2 Schnellverschlussschrauben.



Abbildung 199: Schnellverschlussschrauben lösen

4. Silde-in compact Adapter einstecken und mit den beiden Schnellverschlussschrauben fixieren.



Abbildung 200: Slide-in compact Adapter Einbau

5. Nach der Montage kann ein Slide-in compact Laufwerk montiert werden.



Abbildung 201: Slide-in compact Laufwerk montieren

7 Lüfter Kit Einbau / Tausch

Information:

Der folgende Abschnitt ist beispielhaft an einem PPC800 Modell ohne Expansion dargestellt. Bei Modellen mit Expansion unterscheidet sich der Vorgang lediglich in der Anzahl der zu lösenden Kombitorxschrauben.

7.1 Vorgangsweise

1. Markierte Kombitorxschrauben (T10) lösen und Lüfter Kit Abdeckung entfernen.



Abbildung 202: Lüfter Kit Abdeckung entfernen

2. Den Lüfter Kit Rahmen einlegen und nach unten drücken bis er vollständig in die Klemmen eingerastet ist.



Abbildung 203: Lüfter Kit einlegen

3. Staubfilter in die Lüfter Kit Abdeckung einlegen und mit der Filterspange fixieren.



Abbildung 204: Staubfilter und Filterspange fixieren

4. Lüfter Kit Abdeckung im Gehäuse einsetzen und mit den zuvor gelösten Torxschrauben befestigen.

Information:

Regelmäßige Kontrolle des Staubfilters je nach Einsatzgebiet und Verschmutzungsgrad.

8 Montage des USV Moduls

Die Montage erfolgt mit dem beigelegten Montagematerial beim USV Modul.



Abbildung 205: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial

8.1 Montageanleitung

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 366).
- 2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.



Abbildung 206: USV Modulabdeckung entfernen

 Die USV-Isolierung an die Unter-/Rückseite des USV Moduls anlegen und beides mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben bzw. die Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.



Abbildung 207: USV Modul montieren

4. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).



Abbildung 208: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.



Abbildung 209: Steckerverriegelung

5. Seitendeckel montieren.

9 Montage des USV Sicherungs Kit an der Batterieeinheit

Information:

Das USV Sicherungs Kit 5AC600.UPSF-00 wird nur für Batterieeinheiten bis einschließlich Revision D0 benötigt. Ab Revision E0 ist bereits eine 25 A Sicherung auf der Steckerpaltine der Batterieeinheit integriert.

9.1 Vorgangsweise

- 1. Die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 durch Abstecken des USV Verbindungskabel vom B&R Industrie PC trennen.
- 2. Die Abdeckung der Batterieeinheit entfernen. Dazu sind die beiden gekennzeichneten Torxschrauben (T10) zu lösen und anschließend die Abdeckung durch Schieben in Richtung des orangen Steckers abzunehmen.



Abbildung 210: Abdeckung der Batterieeinheit entfernen

3. Um die Sicherung montieren zu können muss das rote Kabel von der Batterieplatine gelöst werden.



Abbildung 211: Kabel abstecken
4. Der Stecker des Sicherungs Kit ist mit der Buchse des roten Kabels zu verbinden (1). Die Buchse des Sicherungs Kit muss an dem Stecker der Batterieplatine angeschlossen werden (2).



Abbildung 212: Sicherung anschließen

5. Anschließend kann die Sicherung in der Batterieeinheit verstaut werden.



Abbildung 213: Sicherung verstauen

- 6. Die Abdeckung der Batterieeinheit wieder montieren. Dazu die Zapfen der Abdeckung in die Nut der Batterieeinheit stecken und die Abdeckung mit den zu Beginn gelösten Torxschrauben befestigen.
- 7. Abschließend die Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 wieder mit dem B&R Industrie PC verbinden.

10 Buseinheit Einbau / Tausch

Buseinheiten können bei Systemeinheiten mit 1 Card Slot oder 2 Card Slot Expansion eingebaut bzw. getauscht werden.

10.1 Vorgangsweise

- 1. Zuleitung zum Panel PC 800 spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 366).
- 4. Die am Basisboard vormontierten Torxschrauben (T10) lösen.



Abbildung 214: Schrauben lösen

5. Buseinheit im Buseinheitensteckplatz einstecken und mit drei Torxschrauben (T10) fixieren.



Abbildung 215: Buseinheit montieren

6. Seitendeckel montieren.

11 Adapter Einbau / Tausch

- 1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 366).
- 2. Eventuell 1 Card Slot bzw. 2 Card Slot Expansion entfernen.

11.1 Vorgangsweise bei dem Adapter 5AC803.BC01-00

1. Die am Basisboard vormontierten Torx Schrauben (T10) lösen.



Abbildung 216: Schrauben lösen

2. Adapter und Führungsschiene an die vorgesehenen Positionen anbringen und mit den zuvor gelösten Torx Schrauben (T10) fixieren.



Abbildung 217: 5AC803.BC01-00 Adapter montieren

3. Seitendeckel montieren.

11.2 Vorgangsweise bei dem Adapter 5AC803.BC02-00

1. Adapter am vorgesehenen Steckplatz einstecken.



Abbildung 218: 5AC803.BC02-00 Adapter montieren

2. Seitendeckel montieren.

12 PCIec Einsteckkarte Einbau / Tausch

12.1 Vorgangsweise

1. Schnellverschlussschraube lösen und PCIec Modulabdeckung entfernen.



Abbildung 219: PCIec Modulabdeckung entfernen

2. PClec Einsteckkarte einschieben.



Abbildung 220: PCIec Einsteckkarte einbauen

3. PClec Einsteckkarte mit Schnellverschlussschraube fixieren.

13 Seitendeckeldemontage

Die Seitenabdeckung kann einfach durch lösen von Torx (T10) Schrauben entfernt werden. Je nach System variiert die Anzahl der Torxschrauben.

13.1 PPC800 ohne Expansion

- 1. Zuleitung zum Panel PC 800 spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Markierte Kombitorxschrauben (T10) lösen.
- 4. Nach dem Lösen der Schrauben kann die Seitenabdeckung (durch wegschieben vom Kühlkörper) entfernt werden.



Abbildung 221: PPC800 Seitendeckeldemontage ohne Expansion

13.2 PPC800 mit Expansion

- 1. Zuleitung zum Panel PC 800 spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Markierten Kombitorxschrauben (T10) lösen.
- 4. Nach dem Lösen der Schrauben kann die Seitenabdeckung (durch wegschieben vom Kühlkörper) entfernt werden.



Abbildung 222: PPC800 Seitendeckeldemontage mit Expansion (Beispielfoto 1 Slot Expansion)

14 Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1

Als Beispiel wird angenommen, dass bei einer RAID 1 Konfiguration die Secondary Hard Disk (HDD1) defekt ist. In diesem Fall ist es möglich, die defekte Hard Disk durch eine Ersatz SATA Hard Disk zu ersetzen.

Bestellnummer PCI SATA RAID Controller	Bestellnummer benötigte Ersatz SATA-HDD	Anmerkung
5ACPCI.RAIC-01	5ACPCI.RAIC-02	60 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-03	5ACPCI.RAIC-04	160 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-05	5MMHDD.0250-00	250 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-06	5MMHDD.0500-00	500 GByte Hard Disk

Tabelle 267: Übersicht benötigte Ersatz SATA-HDD für PCI SATA HDD RAID Controller

Für den Tausch der Hard Disk wird ein Torx Schraubendreher der Größe 10 benötigt.

14.1 Vorgangsweise

- 1. Zuleitung zum Gerät spannungslos machen.
- 2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- 3. Entfernung des Seitendeckels.
- 4. Entfernung des SATA RAID Einschubes.
- 5. Lösen der richtigen 4 Befestigungsschrauben (M3x5).



Abbildung 223: Rückseite des SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 Schraubenzuordnung

- 6. Vorderseitig die Hard Disk nach unten hin wegschieben (Hard Disk Tausch linkes Bild).
- 7. Neue Hard Disk vorsichtig in die Steckverbindung (Hard Disk Tausch rechtes Bild) aufstecken und dabei die Hard Disk nur an der Stirnseite, nicht an der Oberseite, berühren.

Wartung / Instandhaltung • Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1



Abbildung 224: Hard Disk Tausch

- 8. Hard Disk mit den zuvor gelösten 4 Befestigungsschrauben (M3x5) wieder fixieren.
- 9. Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
- 10.Nach dem Starten des Systems wird eine Fehlermeldung durch das RAID BIOS ausgegeben "RAID1 set is in Rebuild status The rebuild will continue after boot sequence is complete".
- 11. Es kann über das SATA RAID BIOS sofort ein Rebuild durchgeführt werden, oder der Rebuild wird nach dem Hochstarten des PCs automatisch durchgeführt siehe "Rebuild Mirrored Set" auf Seite 187.

Anhang A

1 Maintenance Controller Extended (MTCX)

Der MTCX Controller (FPGA-Prozessor) befindet sich auf der Basisboardplatine (Bestandteil jeder Systemeinheit).



Abbildung 225: Position des MTCX Controllers

Der MTCX ist für folgende Überwachungs- und Steuerfunktionen zuständig:

- · Power On (Power OK Sequencing) und Power Fail Logik
- Watch Dog Handling (NMI und Resethandling)
- Temperaturüberwachung
- Lüfterregelung
- Tastenbehandlung/Koordination (Matrixtastatur von Automation Panel 900 Geräten mittels B&R Key Editor konfigurierbar, PS/2 Keyboard)
- LED Behandlung (Matrixtastatur mit LEDs von Automation Panel 900 Geräten mittels B&R Key Editor konfigurierbar)
- Erweiterter Desktop Betrieb (USB Weiterleitung)
- Daisy Chain Display Betrieb (Touch Screen, USB Weiterleitung)
- Panel Sperrmechanismus (konfigurierbar über B&R Control Center ADI Treiber)
- Backlight Steuerung eines angeschlossenen B&R Displays
- SDL Datenübertragung (Display, Matrixtastatur, Touch Screen, Servicedaten, USB)
- Status LEDs (HDD, Link, Run)

Die Funktionen des MTCX können per Firmwareupgrade¹⁾⁾ erweitert werden. Die Version kann im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

1.1 Temperaturüberwachung Lüfterregelung

Der MTCX überwacht mit Hilfe von Temperatursensoren ständig die Temperatur, in deren Abhängigkeit die Lüfter geregelt werden. Die Drehzahl ist von der gemessenen Temperatur abhängig. Die Grenzwerte sind abhängig von der verwendeten MTCX Firmware Version.

¹⁾⁾ Kann im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

Anhang A • Maintenance Controller Extended (MTCX)

Sensorbereich	Einschalttemperatur	max. Lüfterdrehzahl bei:
Board I/O	60°C	76°C
Board ETH2	60°C	76°C
Board Power	60°C	76°C
Power Supply	60°C	76°C
Slide-in Drive 1	44°C	60°C
IF-Slot	65°C	81°C

Tabelle 268: Temperaturgrenzen der Lüfterregelung (MTCX PX32 V1.01)

Ab der Einschalttemperatur wird mit minimaler Lüfterdrehzahl gestartet. Die maximale Lüfterdrehzahl wird bei Einschalttemperatur + 16°C erreicht. In diesem Bereich wird die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der Temperatur geregelt.

z.B. bei Slide-in 1: 44°C + 16°C = 60°C --> maximale Lüfterdrehzahl

Die Lüfter werden erst wieder ausgeschaltet, wenn die Bewertungstemperatur im Zeitraum von 30 Minuten (=Nachlaufzeit) mehr als 6°C unter der Einschalttemperatur liegt.

2 Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard

Ein Stecker auf dem Basisboard ermöglicht, zur internen Versorgung von z.B. speziellen PCI Karten, die Abzweigung von +5 VDC und +12 VDC.

Mit dem "5CAMSC.0001-00" auf Seite 347 kann die Spannung abgegriffen werden. Der Stecker liegt in der Nähe des Reset bzw. Power Tasters (siehe Abbildung). Zum Erreichen des Steckers sind der PPC800 Seitendeckel (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 366) sowie eventuelle Slide-in Laufwerke, PCIec und PCI Steckkarten zu entfernen.



Abbildung 226: Position Stecker für externen Verbraucher

Stecker für den externen Verbraucher				
Pin	Belegung	Leistung	4-polige Stiftleiste, male	
1	+12 VDC	max. 10 Watt		
2	GND			
3	GND	max. 5 Watt		
4	+5 VDC			

Tabelle 269: Pinbelegung Stecker am Basisboard

Anschlüsse sind über eine 1A Multifuse abgesichert.

3 Touch Screen AMT 5-Draht

3.1 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	Touch Screen AMT 5-Draht			
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE	Ja			
c-UL-us	Ja			
Hersteller	AMT			
Auslösedruck	<1N			
Lichtdurchlässigkeit	81 ±3%			
Umgebungsbedingungen				
Temperatur				
Betrieb	- 20 bis 70°C			
Lagerung	- 40 bis 80°C			
Transport	- 40 bis 80°C			
Luftfeuchtigkeit				
Betrieb	90% bei max. 50°C			
Lagerung	90% RH bei max. 60°C für 504 Stunden			
Transport	90% RH bei max. 60°C für 504 Stunden			
Einsatzbedingungen				
Lebensdauer	36 Millionen Berührungen an der gleichen Stelle (Auslösedruck: 250 g, Intervall: 2x pro Sekunde)			
Chemische Widerstandsfähigkeit ¹⁾	Aceton, Methylen Chlorid, Methyl Ethyl Keton, Isopropylalkohol, Hexan, Terpentin, Mineralspiritus, blei- freier Benzin, Diesel, Motoröl, Getriebeöl, Frostschutzmittel, Ammoniak basierende Glasreiniger, che- mische Reinigungsmittel, Haushalts-Reinigungsmittel, Essig, Kaffee, Tee, Schmiermittel, Speiseöl, Salz			
Aktivierung	Finger, Stift, Kreditkarte, Handschuh			
Treiber	Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Download- bereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) zum Download bereit.			



1) Der aktive Bereich des Touch Screens ist gegenüber diesen Chemikalien für einen Zeitraum von einer Stunde bei 25°C resistent.





Abbildung 227: Temperatur Luftfeuchtediagramm AMT Touch Screen 5-Draht

3.3 Reinigung

Gefahr!

Die Reinigung des Gerätes darf nur in ausgeschaltenem Zustand durchgeführt werden, um so, durch Berühren des Touch Screens oder Drücken von Tasten, das Auslösen unbeabsichtigter Funktionen zu vermeiden.

Zum Reinigen des Gerätes ist ein feuchtes Tuch zu verwenden. Zum Befeuchten des Reinigungstuches nur Wasser mit Spülmittel, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) verwenden. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät sprühen, sondern zuerst auf das Tuch! Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel, Druckluft oder Dampfstrahler verwenden.

Information:

Displays mit Touch Screen sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

4 Dekorfolie

Die Dekorfolie ist beständig nach DIN 42115 Teil 2 gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von mehr als 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen:

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen.

Äthanol Cyclohexanol Diacetonalkohol Glykol Isopropanol Glyzerin Methanol Triacetin Dowandol DRM/PM	Formaldehyd 37 bis 42% Acetaldehyd Aliphatische Kohlenwasserstoffe Toluol Xylol Verdünner (white spirit)	Trichloräthan Ethylacetat Diethyläther N-Butyl Acetat Amylacetat Butylcellosolve Äther
Aceton Methyl-Äthyl-Keton Dioxan Cyclohexanon MIBK Isophoron	Ameisensäure <50% Essigsäure <50% Phosphorsäure <30% Salzsäure <36% Salpetersäure <10% Trichloressigsäure <50% Schwefelsäure <10%	Chlornatron <20% Wasserstoffperoxid <25% Kaliseife Waschmittel Tenside Weichspüler Eisenchlor (FeCl ₂)
Ammoniak <40% Natronlauge <40% Kaliumhydroxid Alkalikarbonat Bichromate Blutlaugensalz Acetonitril Natriumbisulfat	Bohremulsion Dieselöl Firnis Paraffinöl Ricinusöl Silikonöl Terpentinölersatz Bremsflüssigkeit Flugzeugkraftstoff Benzin Wasser Salzwasser Decon	Eisenchlor (FeCl ₃) Dibutyl Phthalat Dioctyl Phthalat Natriumkarbonat

Tabelle 271: Chemische Beständigkeit der Dekorfolie

Die Dekorfolie ist nach DIN 42115 Teil 2, bei einer Einwirkung von weniger als einer Stunde, gegenüber Eisessig ohne sichtbaren Schaden beständig.

5 Blickwinkel

Die Blickwinkelangaben (R, L, U, D) der Displaytypen können den technischen Daten der Einzelkomponenten entnommen werden.



6 Einbaukompatibilitäten

Dieser Abschnitt beschreibt die Kompatibilität der Einbaumaße bei Power Panel 100/200, Power Panel 300/400, Power Panel 500, Automation Panel 900, Panel PC 700 und Panel PC 800 Geräten in Abhängigkeit der jeweiligen Gerätediagonalen.

Die Außenabmessungen der Gerätetypen der jeweiligen Diagonalen sind identisch.

Die verschiedenen Gerätetypen werden wie folgt abgekürzt:

Gerätetyp	Kurzform
Power Panel 100/200	PP100/200
Power Panel 300/400	PP300/400
Power Panel 500	PP500
Automation Panel 900	AP900
Panel PC 700	PPC700
Panel PC 800	PPC800

Tabelle 272: Produktabkürzungen

6.1 Kompatibilitätsübersicht

Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Geräte PP100/200, PP300/400, PP500, AP900, PPC700 und PPC800. Detaillierte Informationen sind dem Abschnitt 6.2 "Kompatibilitätsdetails" auf Seite 377 zu entnehmen.

Kompatibilitäten zwischen den Gerätetypen werden zeilenweise mit gleichen Symbolen dargestellt.

Größe	Format	kompatibel	PP100/200	PP300/400	PP500	AP900	PPC700	PPC800
	Quert	Außenmaß				-	-	-
	Queri	Einbaumaß	•	•	•	-	-	-
5 7"	Quar2	Außenmaß	•	•		-	-	-
5,7	Querz	Einbaumaß	•	•	•	-	-	-
	Hoch1	Außenmaß				-	-	-
	TIOCITI	Einbaumaß	•	•	▲	-	-	-
	Quer 1	Außenmaß		-		-		-
	Queri	Einbaumaß	•	•	•	•	•	-
10.4"	0	Außenmaß						-
10,4	Querz	Einbaumaß	•	•		A	A	-
	Lloop1	Außenmaß						-
	HOCHI	Einbaumaß	•	•	A	A	A	-
10.1"	Quart	Außenmaß	•	•		•		-
12,1	Queri	Einbaumaß	•	•	▲	▲	▲	-
	Quart	Außenmaß	•	•		•	•	•
		Einbaumaß	•	•	A	•	•	•
15"								
	Hooh1	Außenmaß	•	•		•	•	-
	HOCHT	Einbaumaß	•	•	A	•	•	-
47"	Ouer 1	Außenmaß	-	-	-	•	•	
17	Queri	Einbaumaß	-	-	-	A	A	
10"	Quer 1	Außenmaß	-	-	-			
19		Einbaumaß	-	-	-	A	-	
04.0"	Ouer 1	Außenmaß	-	-	-		-	-
21,3" Q		Einbaumaß	-	-	-	A	-	-

Tabelle 273: Gerätekompatibilitätsübersicht

6.2 Kompatibilitätsdetails

6.2.1 Beispiel

In den nachfolgenden Abbildungen haben die Maßangaben (alle in mm) folgende Bedeutung.



Abbildung 228: Kompatibilitätsdetails Abbildungsaufbau



Abbildung 229: Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Quer1

Die 5,7" Power Panel 500, Power Panel 300/400 und Power Panel 100/200 Geräte Format Quer1 sind zu 100% einbaukompatibel.

6.2.2 5,7" Geräte

		000 107		
PP100/200/300/400	6,5	302 x 187	6,5	5 6,5
PP500		289 x 174 ±0,5		
l				6,5
-		Außenkontur Gerät		
		Ausschnitt Gerät		

Abbildung 230: Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Quer2

Die 5,7" Power Panel 500, Power Panel 300/400 und Power Panel 100/200 Geräte Format Quer2 sind zu 100% einbaukompatibel.



Abbildung 231: Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Hoch1

Die 5,7" Power Panel 500 sind mit den Power Panel 300/400 und Power Panel 100/200 Geräten Format Hoch1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500 Geräte benötigen einen um 5,2 mm höheren (Unterkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

• Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200 und PP300/400 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.

6.2.3 10,4" Geräte



Abbildung 232: Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer1

Die 10,4" Power Panel 500, Power Panel 300/400 und Power Panel 100/200 Geräte Format Quer1 sind zu 100% einbaukompatibel.



Abbildung 233: Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer2

Die 10,4" Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte sind mit den Power Panel 300/400 bzw. Power Panel 100/200 Geräten Format Quer2 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte benötigen einen um 4,5 mm höheren (Unterkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

• Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200 und PP300/400 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.



Abbildung 234: Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Hoch1

Die 10,4" Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte sind mit den Power Panel 300/400 bzw. Power Panel 100/200 Geräten Format Hoch1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte benötigen einen um 5 mm höheren (Unterkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

• Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200/300/400 Geräte möglichst mittig/zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.

6.2.4 12,1" Geräte





Die 12,1" Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte sind mit den Power Panel 300/400 bzw. Power Panel 100/200 Geräten Format Quer1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 300/400 bzw. Power Panel 100/200 Geräte benötigen einen um 1,5 mm breiteren (links und rechts) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

• Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP500, AP900 und PPC700 Geräte möglichst mittig/zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden.

6.2.5 15" Geräte



Abbildung 236: Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Quer1

Die 15" Power Panel 500 Geräte sind mit den Power Panel 100/200, Power Panel 300/400, Automation Panel 900, Panel PC 700 bzw. Panel PC 800 Geräten Format Hoch1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500 Geräte benötigen einen um 0,5 mm höheren (Unter- und Oberkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

 Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200, PP300/400, AP900, PPC700 und PPC800 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.



Abbildung 237: Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Hoch1

Anhang A • Einbaukompatibilitäten

Die 15" Power Panel 500 Geräte sind mit den Power Panel 100/200, Power Panel 300/400, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräten Format Hoch1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500 Geräte benötigen einen um 0,5 mm höheren (Unter- und Oberkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

 Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200, PP300/400, AP900 und PPC700 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.

6.2.6 17" Geräte



Abbildung 238: Einbaukompatibilität 17" Geräte Quer1

17" Automation Panel 900 und Panel PC 700 Format Quer1 sind zu 100% einbaukompatibel.

6.2.7 19" Geräte

	8,5	527 x 421	8,5
AP900/PPC700		510 x 404 ±0,5	8,5
PPC800			85
	·	Außenkontur Gerät	0,0
		Ausschnitt Gerät	

Abbildung 239: Einbaukompatibilität 19" Geräte Quer1

19" Automation Panel 900, Panel PC 700 und Panel PC 800 Format Quer1 sind zu 100% einbaukompatibel.

6.2.8 21,3" Geräte



Abbildung 240: Einbaukompatibilität 21,1" Geräte Quer1

7 Glossar

ACPI	Advanced Configuration and Power Interface > Konfigurationsschnittstelle, die es dem Betriebssystem gestattet, die Stromversorgung für jedes an den PC angeschlossene Gerät zu kontrollieren. Mit ACPI ist das BIOS des Rechners nur noch für die Details der Kommunikation mit der Hardware verantwortlich.
Adresse	Zeichenfolge zur Kennzeichnung eines Speicherplatzes oder eines Speicherbereichs, wo Daten hinterlegt und wiedergeholt werden können oder, wie z.B. bei numerischen Steuerungen, ein Symbol zur Kennzeichnung einer Funktionseinheit für die die dem Symbol folgenden Geometrie- oder Technologiedaten bestimmt sind.
Algorithmus	nach DIN 19226: vollständig festgelegte endliche Folge von Vorschriften, nach denen aus zulässigen Eingangs- größen eines Systems gewünschte Ausgangsgrößen erzeugt werden. Er beschreibt, wie etwas zu tun ist. Um im Sinne der Mathematik als Algorithmus zu gelten, muss ein Verfahren mindestens den folgenden Ansprüchen genügen.
	Diskretheit > ein Algorithmus besteht aus einer endlichen Folge von Schritten.
	Determiniertheit > unter gleichen Startbedingungen erzeugt er stets dasselbe Endergebnis.
	<i>Eindeutigkeit</i> > die Reihenfolge der Schritte ist eindeutig festgelegt.
	Endlichkeit > er endet nach endlich vielen Schritten.
	Mengentheoretisch betrachtet ist ein Algorithmus eindeutig bestimmt durch eine Menge von Größen [Eingangs-, Zwischen- und Ausgangsgrößen], eine Menge von Elementaroperationen sowie durch eine Vorschrift, die an- gibt, in welcher Reihenfolge welche Operationen wann auszuführen sind. Aus funktionaler Sicht überführt er ei- ne Menge von Eingangsgrößen [Eingabemenge] in eine Menge von Ausgangsgrößen [Ausgabemenge]. Seine Darstellung kann textuell in einer natürlichen oder künstlichen formalen Sprache oder mittels grafischer Darstel- lungen [Graph, Programmablaufplan, Struktogramm, Petri-Netze u.ä.] erfolgen.
Analoges Signal	Signal, dessen Informationsparameter innerhalb technisch bedingter Grenzen beliebig viele Werte annehmen kann. Sie haben theoretisch ein unendlich hohes Auflösungsvermögen. Praktisch ist es jedoch auf einen Bereich von höchstens 1 zu 104 beschränkt. Darüber hinaus bereitet die Langzeitspeicherung sowie die Verechnung vieler Größen Probleme. In der modernen Automatisierungstechnik werden daher überwiegend digitale Signale verwendet.
ANSI	American National Standards Institute > Amerikanisches Normeninstitut fördert und verwaltet amerikanische In- dustrienormen.
APC	Automation PC
Ausiali	ren. In bezug auf sicherheitsgerichtete Systeme wird, je nach dem ein Ausfall das System in einen gefährlichen oder ungefährlichen Zustand versetzt, zwischen gefährlichen [dangerous] und ungefährlichen [safe] Ausfällen unterschieden. Die Ausfallursache kann dabei belastungs- oder alterungsbedingt rein zufälliger Natur sein, man spricht dann von einem zufälligen Ausfall, oder durch einen systemimmanenten Mangel bedingt sein. In diesem Fall spricht man von einem systematischen Ausfall.
Automation Runtime	Einheitliches Laufzeitsystem für alle B&R Automatisierungskomponenten.
B&R Automation Runtime	MS-Windows basiertes Programm zur Erstellung von Installationsdisketten um B&R Automation Runtime™ auf dem Zielsystem zu installieren.
Baudrate	Maß für die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Sie gibt die Anzahl der Zustände eines übertragenen Signals pro Sekunde an und wird in der Einbeit Baud gemessen. 1 Baud = 1 Bit/s bzw. 1 bps.
BIOS	Basic Input/Output System > zu deutsch »grundlegendes Eingabe-Ausgabe-System «. Kernsoftware bei Compu- tersystemen mit grundlegenden Routinen um Ein- und Ausgabevorgänge an Hardwarekomponenten zu steuern, nach dem Systemstart Tests durchzuführen und das Betriebssystem zu laden. Der Anwender kommt mit dem BIOS gewöhnlich nicht in Berührung, wenngleich es für die Leistung eines Systems mitbestimmend ist
Bit	Binary Digit > Binärstelle, Binärzeichen, Binärziffer kleinste diskrete Informationseinheit. Ein Bit kann mit dem Wert 0 oder 1 belegt sein.
Byte	Datenformat [1 Byte = 8 Bit] bzw. Einheit zur Charakterisierung von Informationsmengen und Speicherkapazitä- ten. Geläufige Steigerungsstufen sind: KB, MB, GB.
Cache	Hintergrundspeicher > auch Schattenspeicher oder Schnellpufferspeicher genannt, der den schnellen Hauptspei- cher eines Rechners entlastet. Daten, die z.B. vom Arbeitsspeicher an langsamere Komponenten wie Platten- speicher oder Drucker ausgegeben werden sollen, werden im Cache zwischengelagert und von dort mit einer für die Zielgeräte angemessenen Geschwindigkeit ausgegeben.
CAN	Controller Area Network > Ist ein serielles Bussystem. Aufbau nach ISO 11898; Bus-Medium: verdrilltes Leiter- paar. Gute Übertragungseigenschaften im Kurzstreckenbereich unterhalb 40 m bei 1 MBit/s Datenübertragungs- rate. Maximale Anzahl der Teilnehmer: theoretisch unbegrenzt, praktisch bis zu 64. Echtzeitfähig, d.h. definierte maximale Wartezeiten für Nachrichten hoher Priorität. Hohe Zuverlässigkeit durch Fehlererkennung, Fehlerbe- handlung, Fehlereingrenzung. Hamming-Distanz.
CMOS	akkugespeister Speicher > in ihm werden fundamentale Parameter eines IBM Personal Computers oder eines kompatiblen Computers gespeichert. Die Informationen werden vor allem beim Booten des Computers benötigt und umfassen u.a. den Typ der Festplatte, die Größe des Arbeitsspeichers sowie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum. Der Speicher basiert, wie es der Name andeutet, in aller Regel auf der CMOS-Technologie.
СОМ	Ist im Betriebssystem MS-DOS ein Gerätename, mit dem die seriellen Ports angesprochen werden. Der erste serielle Port ist dabei unter COM1 zu erreichen, der zweite unter COM2 usw. An einem seriellen Port wird typi- scherweise ein Modern eine Maus oder ein serieller Drucker angeschlossen.
COM1	Gerätename für den ersten seriellen Port in einem PC-System. Der Eingabe-Ausgabe-Bereich von COM1 befin- det sich gewöhnlich an der Adresse 03F8H. In der Regel ist dem COM1-Port der IRQ 4 zugewiesen. In vielen Systemen wird an COM1 eine serielle RS232-Maus angeschlossen.
COM2	Gerätename für den zweiten seriellen Port in einem PC-System. Der Eingabe-Ausgabe-Bereich von COM2 be- findet sich gewöhnlich an der Adresse 02F8H. In der Regel ist dem COM2-Port der IRQ 3 zugewiesen. In vielen Systemen wird an COM2 ein Modem angeschlossen.
СОМЗ	Gerätename für einen seriellen Port in einem PC-System. Der Eingabe-Ausgabe-Bereich von COM3 befindet sich gewöhnlich an der Adresse 03E8H. In der Regel ist dem COM3-Port der IRQ 4 zugewiesen. In vielen Systemen wird COM3 als Alternative für COM1 oder COM2 verwendet, falls an COM1 und COM 2 bereits Peripheriegeräte angeschlossen sind.
Controller	Eine Gerätekomponente, über die andere Geräte auf ein Subsystem des Computers zugreifen. Ein Disk-Control- ler steuert z.B. den Zugriff auf Festplatten- und Diskettenlaufwerke und ist dabei sowohl für die physikalischen als auch die logischen Laufwerkszugriffe verantwortlich.

CDU	On start Desension Units Die Deskan und Otsussiskeit singe Osmanten die Einkeit die Defekte internetiert
CPU	und ausführt. Wird auch als Zentraleinheit oder Mikroprozessor bezeichnet. Eine CPU besitzt die Fähigkeit, Be- fehle zu laden, zu dekodieren und auszuführen, sowie Informationen von und zu anderen Ressourcen zu über-
	tragen.
CRT	Cathode-Ray Tube > zu deutsch »Kathodenstrahlröhre«. Hauptbestandteil eines Fernsehgeräts oder eines Stan- dard-Computerbildschirms. Eine Kathodenstrahlröhre besteht aus einer Vakuumröhre, in die eine oder mehre- re Elektronenkanonen eingebaut sind. Jede Elektronenkanone erzeugt einen horizontalen Elektronenstrahl, der auf der Vorderseite der Röhre - dem Schirm auftrifft. Die Innenfläche des Schirms ist mit einer Phosphorschicht versehen, die durch das Auftreffen der Elektronen zum Leuchten gebracht wird. Jeder der Elektronenstrahlen bewegt sich zeilenweise von oben nach unten. Um ein Flimmern zu verhindern, wird der Bildschirminhalt min- destens 25 Mal pro Sekunde aktualisiert. Die Schärfe des Bildes wird durch die Anzahl der Leuchtpunkte (Pixel) auf dem Schirm bestimmt
CTS	Clear To Send > zu deutsch »Sendebereitschaft«. Ein Signal bei der seriellen Datenübertragung, das von einem Modem an den angeschlossenen Computer gesendet wird, um damit die Bereitschaft zum Fortsetzen der Über- tragung anzuzeigen. CTS ist ein Hardwaresignal, das über die Leitung Nummer 5 nach dem Standard RS-232-
DCD	C ubertragen wird. Data Carrier Detected > In der seriellen Kommunikation verwendetes Signal, das ein Modem an den eigenen Computer sendet um anzuzeigen dass es für die Übertragung bereit ist
DIMM	Double In-line Memory Modul > Speichermodul, bestehend aus einem oder mehreren RAM-Chips auf einer klei- nen Platine, die über eine Steckverbindung mit dem Motherboard eines Computers verbunden ist.
DMA	Direct Memory Access > Beschleunigter Direktzugriff auf den Arbeitsspeicher eines Rechners unter Umgehung des Zentralprozessors.
DRAM	Dynamic Random Access Memory > Dynamische RAMs stellen integrierte Halbleiterschaltungen dar, die Infor- mationen nach dem Kondensator-Prinzip speichern. Kondensatoren verlieren in relativ kurzer Zeit ihre Ladung. Deshalb müssen dynamische RAM-Platinen eine Logik zum ständigen »Auffrischen« (zum Wiederaufladen) der RAM-Chips enthalten. Da der Prozessor keinen Zugriff auf den dynamischen RAM hat, wenn dieser gerade aufgefrischt wird, können ein oder mehrere Wartezustände beim Lesen oder Schreiben auftreten. Dynamische RAMs werden häufiger eingesetzt als statische RAMs, obwohl sie langsamer sind, da die Schaltung einfacher konstruiert ist und viermal so viele Daten wie ein statischer RAM-Chip speichern kann.
DSR	Data Set Ready > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal, das von einem Modem an den eigenen Computer gesendet wird um die Arbeitsbereitschaft anzuzeigen. DSR ist ein Hardwaresignal, das in Verbindungen nach dem Standard RS-232-C über die Leitung 6 gesendet wird.
DTR	Data Terminal Ready > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal, das von einem Computer an das angeschlossene Modem gesendet wird, um die Bereitschaft des Computers zur Entgegennahme eingehen- der Signale anzuzeigen.
DVI	Digital Visual Interface > Ist eine Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Videodaten.
DVI-A	nur analog
DVI-D	nur digital
DVI-I	integrated, d.h. analog und digital
ECAD	<i>ElektrischesCAD</i> > ECAD-Systeme sind Projektierungswerkzeuge, welche die effiziente Erstellung und Bearbei- tung elektrischer Schalt- und Schemapläne sowie davon ausgehend die automatische Generierung von Quer- verweislisten, Kabel- und Klemmenplänen, Stücklisten u.a. Bestell- und Fertigungsunterlagen ermöglichen.
Echtzeit	ein System arbeitet in Echtzeit bzw. ist echtzeitfähig, wenn es Eingangsgrößen [z.B. Signale, Daten) in einer definierten Zeitspanne aufnimmt, verarbeitet und die Ergebnisse rechtzeitig für ein Partnersystem oder die Systemungebung bereitstellt. Hierzu siehe auch Echtzeitanforderungen und Echtzeitsystem.
EDID Daten	<i>Extended Display Identification Data</i> > Die EDID Daten enthalten die Kenndaten von Monitoren/ TFT Displays, die über den Display Data Channel (DDC) als 128 kB-Datenblock an die Grafikkarte übermittelt werden. Anhand dieser EDID Daten kann sich die Grafikkarte auf die Monitoreigenschaften einstellen.
Elektromagnetische Verträglichkeit	electromagnetic compatibility > Gemäß EMVG: Fähigkeit eines Gerätes, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für andere in dieser Umwelt vorhandene Geräte unannehmbar wären [IEV 161-01-07].
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit > Fähigkeit eines Gerätes, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstel- lend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für andere in dieser Um- welt vorhandene Geräte unannehmbar wären [IEV 161-01-07].
EN	Europäische Norm > siehe CENELEC
EPROM	Erasable PROM > (mit ultraviolettem Licht vollständig) löschbarer PROM
Erde	Im Zusammenhang mit elektrotechnischen Sachverhalten versteht man darunter das mehr oder weniger elek- trisch gut leitende Erdreich, das ausserhalb des Einflussbereichs von Erdern oder anderen elektrischen Phäno- menen keine Potentialunterschiede aufweist)
ESD	<i>Electrostatic Discharge</i> > elektrostatische Entladung, (korrekt: Entladung statischer Elektrizität. Vorgang des La- dungsausgleichs zwischen festen, flüssigen oder gasförmigen Medien, die unterschiedlich elektrostatisch aufge- laden sind. Er ist meistens von einer Gleit-, Büschel-, Funken- oder auch blitzähnlichen Entladungserscheinung begleitet, kann aber auch ausschließlich leitungsgebunden über eine Kontaktstelle ablaufen, und zwar dann, wenn die Potentialdifferenz vor der Berührung 330 Volt nicht überschreitet. Bei Funkenbildung können brenn- bare Gase und Dämpfe oder explosible Gemische gezündet und durch die mit einer Entladung einhergehen- den Ströme und Felder elektronische Bauelemente geschädigt, zerstört oder elektronische Betriebsmittel in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Die erstgenannten Wirkungen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Brand- und Explosionsschutzes bzw. der technischen Sicherheit, die letzteren dagegen in die Bereiche des Schutzes elektrostatisch gefährdere Bautelle (EGB) und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Von besonderer Bedeutung beim Umgang mit elektronischer Gerätetechnik sind die von Personen auf Schaltkreise, Leiterplatten, Bedienelemente, und Gefäßoberflächen im Rahmen von Transport-, Montage-, Prüf-, Bedien-, Reparatur- und Servicehandlungen möglichen elektrostatischen Körperentladungen. Mit folgenden elektrischen Werten ist dabei zu rechnen: Energieinhalt 10 bis 30 mJ, elektrostatische Spannung 0,1 bis 20 kV, Entladungsstromstärke bis 30 A (Pulsamplitude, Stromänderungsgeschwindigkeit bis 100 A/ns, elektrische Feldstärke 1 bis 4 kV/mmagnetische
Ethernet	Basisband-Bussystem > von RANK XEROX Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ursprünglich für die Verknüpfung von Minicomputern entwickelt. Es basiert auf dem CSMA/CD-Zugriffsverfahren. Als Übertragungsmedium dienen Koaxialkabel bzw. Twisted-Pair-Leitungen [verdrillte Kupferdoppeladern], Übertragungsgeschwindigkeiten: 10 Mbps [Ethernet], 100 Mbps [Fast Ethernet] sowie 1Gbps bzw. 10 Gbps [Gigabit Ethernet], weit verbreitete Technik zum Vernetzen von Rechnern in einem LAN, seit 1985 genormt [IEEE 802.3 und ISO 8802-3]. Die Ethernet-Technologie hat sich im Bürobereich allgemein durchgesetzt. Nach Ermöglichung auch sehr harter Echtzeitanforderungen und Anpassung der Gerätetechnik [Buskabel, Patchfelder, Anschlussdosen] an die gegenüber den Bürobereichen wesentlich rauheren Einsatzbedingungen des industriellen Umfeldes dringt sie zunehmend in die Feldbereiche der Automatisierungstechnik vor.

FDD	Floppy Disk Drive > Auch Diskettenlaufwerk; Lesegerät für wechselbare magnetische Massenspeicher aus der Frühzeit der PC Technik. Auf Grund der Empfindlichkeit und der bewegten Teile werden diese in modernen Automatisierungslösungen fast ausschließlich durch CompactFlash Speicher ersetzt.
Fehler	Fault > nach IEC 61508: nicht normale Bedingung, die eine Verminderung oder den Verlust der Fähigkeit einer Funktionseinheit verursachen kann, eine geforderte Funktion auszuführen.
Feldbus	Bussytem im prozeßnahen Bereich zum direkten Anschluß von Sensoren und Aktuatoren mit eigener Intelligenz. Auf einem Feldbus werden kleinere Datenmengen zwischen Sensorik, Aktorik und Steuereinrichtung in digitaler Form übertragen. Die Übertragung muß dabei möglichst schnell, d.h. echtzeitnah erfolgen. Zudem muß eine fes- te minimale und maximale Antwortzeit garantiert sein. In modernen Automatisierungssystemen ersetzen zuneh- mend serielle Feldbusse die konventionelle parallele Feldverkabelung. Die serielle Vernetzung der Komponenten spart Zeiten bei der Planung und Installation, außerdem werden Schaltschrankausmaße reduziert sowie Ausfall- und Wartungszeiten verkürzt und damit eine bessere Anlagenverfügbarkeit erzielt. Systemerweiterungen, -än- derungen und –ergänzungen sind einfach zu realisieren.
FIFO	First In First Out > Organisationsprinzip einer Warteschlange, bei dem die Entnahme der Elemente in der gleichen Reihenfolge wie beim Einfügen abläuft - das zuerst hinzugefügte Element wird auch als Erstes wieder entnom- men. Eine derartige Anordnung ist typisch für eine Liste von Dokumenten, die auf ihren Ausdruck warten.
Filter	Filter im Sinne der Entstörtechnik sind Bausteine zur Dämpfung leitungsgeführter Störgrößen. Ihre sinnvolle An- wendung setzt voraus, dass sich die spektralen Anteile der Nutz- und Störgrößen hinreichend voneinander un- terscheiden. Dies ermöglicht bei geeigneter Auslegung der Filterparameter eine selektive Dämpfung von Stör- größen ohne merkliche Beeinträchtigung der Nutzgrößen. Der eigentliche Dämpfungseffekt wird dabei im we- sentlichen durch Spannungsteilung erreicht und die dadurch erzielbare Filterwirkung durch die sogenante Ein- fügungsdämpfung beschrieben. Filter können sowohl an einer Störquelle zur Verhinderung der Aussendung lei- tungsgeführter Störgrößen als auch an einer Störsenke zur Erhöhung der Störfestigkeit gegenüber leitungsge- führten Störgrößen eingesetzt werden. Neben den hauptsächlich verwendeten passiven Filtern, die sich aus pas- siven Bauelementen konfigurieren, gibt es auch aktive Filter, in denen Bauelemente eingesetzt werden, die einer Stromversorgung bedürfen. Aktive Filter sind als Signalfilter weit verbreitet. In Stromversorgungsnetzen kommen sie nur in Sonderfällen zur Anwendung.
Firewall	<i>wörtlich: Brandmauer, Feuerschutzwand</i> > Bezeichnet ein elektronisches, hardware- und/oder softwarebasiertes Sicherheitssystem zwischen zwei Netzen, beispielsweise zwischen Intranet und Internet, das die Computer bzw. das interne Netz eines Unternehmens vor unbefugtem Zugriff aus dem Internet schützt. Nur Daten für bestimmte, berechtigte Dienste dürfen an einem fest definierten Punkt die Sicherheitsbarriere passieren.
Firmware	Programme, die in Festwertspeichern fest eingebrannt sind, Software für den Betrieb von computergesteuerten Geräten, die im allgemeinen während der Gerätelebensdauer oder über einen längeren Zeitraum konstant bleibt. z.B. Betriebssysteme für CPUs und Applikationsprogramme für Industrie-PCs und speicherprogrammierbare Steuerungen, beispielsweise die Software in einer Waschmaschinensteuerung. Sie ist in einem Festwertspeicher [ROM, PROM, EPROM] hinterlegt und kann nicht ohne weiteres ausgetauscht werden.
Floppy	<i>Diskette</i> > Eine runde Kunststoffscheibe mit einer Eisenoxid-Beschichtung, die ein Magnetfeld speichern kann. Wenn die Floppy Disk in ein Diskettenlaufwerk eingelegt wird, rotiert sie, sodass die verschiedenen Bereiche (oder Sektoren) der Disk-Oberfläche unter den Schreib-Lese-Kopf gelangen, der die magnetische Orientierung der Partikel verändern und aufzeichnen kann. Die Orientierung in eine Richtung stellt eine binäre 1, die entge- gengesetzte Orientierung eine binäre 0 dar.
GB	Gigabyte > 1 GB = 1.024 MB bzw. 1.073.741.824 Bytes
Gerät	Der Begriff "Gerät" steht umgangssprachlich als Synonym für Apparat, Instrument, Ausrüstungs- bzw. Gebrauchs- gegenstand, Vorrichtung, Werkzeug oder Utensil. Dabei handelt es sich in erster Linie um fest installierte oder mobile Einrichtungen relativ kleiner räumlicher Abmessungen, deren spezifische Funktion oder spezieller Ein- satzbereich in der Regel durch einen entsprechenden Wortvorsatz gekennzeichnet ist wie z.B. in den Wortverbin- dungen Sportgerät, Gartengerät, Küchengerät, Hörgerät, Funksprechgerät, Faxgerät, Diktiergerät, Kopiergerät, Messgerät, Steuergerät, Automatisierungsgerät, Peripheriegerät u.v.a. Darüber hinaus gibt es festes und mobiles Großgerät, beispielsweise militärisches [Panzer, Flugzeuge, Schiffe], medinisches wie Computertomographen, geologisches wie Erdbohrer, Großraumbagger und Förderbrücken und solches für die Forschung wie z.B. Teil- chenbeschleuniger. Technisch gesehen [DIN 40150] sind Geräte aus Bauelementen, Bauteilen und Baugruppen zusammengesetzt. Als Geräte im Sinne des EMVG, d.h. in juristischem Sinn, gelten alle elektrischen und elek- tronischen Apparate, Systeme, Anlagen und Netze, die elektrische oder elektronische Bauteile enthalten. Diese Gerätedefinition steht im Widerspruch zur gewachsenen und auch im DIN-Vorschriftenwerk [siehe oben] mani- festierten Vorstellungswelt des Ingenieurs zum Gerätebegriff und ist demzufolge Ursache vieler Mißverständnis- se bei der Anwendung des EMVG.
HDD	Hard Disk Drive > Nicht wechselbarer magnetischer Massenspeicher mit hoher Kapazität z.B. 120GB.
Host	<i>Gastgeber, Wirt</i> > bei Computersystemen, die über mehrere CPUs und Bus Master verfügen, versteht man dar- unter diejenige Einheit, die über die Arbitration Unit und die Host-CPU verfügt oder die die Kontrolle über das Gesamtsystem besitzt. Im Zusammenhang mit dem Internet wird ein ständig verfügbarer Netzserver als Host bezeichnet. <i>Hot Swap</i> > Heißes Wechseln (Wechseln von Rechnerkomponenten während des laufenden Betriebs. Es wer- den drei unterschiedliche Stufen unterschieden: Basic Hot Swap, Full Hot Swap und das High Avaibility Modell. Beim Basic Hot Swap, der einfachsten Form des "Heißen Wechselns" muß über die Tastatur des Computers die zu wechselnde Baugruppe zunächst deaktiviert bzw. die Rechnerkonfiguration angepaßt werden. Hierfür sind in der Regel Computerspezialisten erforderlich. Beim Full Hot Swap dagegen übernimmt eine auf der zu ziehen- den oder zu steckenden Komponente installierte Software die Aktivierung bzw. Deaktivierung. Über einen inte- grierten Schalter an der Frontseite der Steckeinheit wird dem Rechner der Beginn des Aushebe- oder das Ende des Einhebevorgangs signalisiert. Im Gegenzug zeigt eine LED an der Frontseite an, daß der Aushebevorgang gestartet werden kann bzw. die eingesetzte Baugruppe eingegliedert ist. Das High Availability Modell kommt in hochverfügbaren Computersystemen zur Anwendung. Hier erfolgt die Hot Swap Softwaresteuerung nicht durch jede einzelne Komponente, sondern zentral über einen separaten Hot Swap Controller [HSC]. Dadurch können ausgefallene Boards automatisch deaktiviert und Rechnerabstürze vermieden werden.
HTML	Hyper Text Markup Language > Programmiersprache mit Hypertextmarken. Sprache in der die meisten Web- Seiten geschrieben sind. Sie beruht auf der SGML-Definition.
	www.w3.org/MarkUp
НТТР	Hyper Text Transfer Protocol > Datenübertragungsprotokoll für die Übertragung von HTML-Seiten und den daran gekoppelten Dateien aller Art. Es ist das Protokoll, auf dem das gesamte WWW beruht. Das heißt, es regelt das Zusammenspiuel zwischen Web-Browser und Web-Server. Es wird bei jedem Mausklick auf einen Hyperlink aktiv und sorgt dafür, dass dem Browser die jeweils nächste gewünschte Information zur Verfügung gestellt wird.

Hub	Steht im Englischen für Radnabe, Mittelpunkt, Zentrum. Hier: zentrales Verbindungsgerät in einem Netz mit stern- förmiger Topologie, das ankommende Datenpakete [ähnlich wie eine Mehrfachsteckdose die Spannung] an alle angeschlossenen Endgeräte verteilt.
IDE	Integrated Device Electronics > Schnittstelle für Massenspeicher, wie HDD, bei der sich die Controller-Elektronik im Laufwerk selbst befindet.
IEC	International Electrotechnical Commission > Internationale Elektrotechnische Kommission (internationale Nor- mungsorganisation, die alle Nationalen Elektrotechnischen Komitees umfaßt. Sie arbeitet und verabschiedet auf weltweiter Ebene elektrotechnische Normen; Sitz: Genf. www.iec.ch
IEEE	The Institute of Electrical and Electronics Engineers > (amerikanischer)Verband der Elektro- und Elektronik-In- genieure (1884 gegründet, weit über 300.000 Mitglieder in etwa 150 Ländern).
Interface	Schrittstelle
Internet	International Network > weltweiter Verbund von Rechnern und Rechnernetzen unterschiedlicher Größe und Ar- chitektur, die mit den verschiedensten Betriebssystemen arbeiten. Dabei werden dezentral auf Rechnern [Ser- vern] Informationen hinterlegt, die von jedermann jederzeit mit seinem Rechner [Client] abgerufen werden kön- nen. Es entstand schrittweise in den letzten Jahrzehnten und bildet gegenwärtig die Basis für den weltweiten In- formations-, Daten- und Dokumentenaustausch z.B. per E-Mail. Populärstes Netz der Welt, zur Zeit schätzungs- weise 500 Millionen Nutzer.
IP	Internet Protocol > Protokoll [Methode, Verfahrensweise] nach der Daten innerhalb eines Netzwerks, z.B. im Internet oder Intranet von einem Computer zu einen anderen gelangen. Jeder im Netz vorhandene Computer ist eindeutig durch seine IP-Adresse gekennzeichnet. Werden Daten von einem Computer zu einem anderen gesendet, werden sie in kleine Informationspakete zerlegt, von denen jedes sowohl die Adresse des Senders wie auch des Empfängers enthält. Diese Pakete können über das Netz auf unterschiedlichen Wegen in von der Sendesequenz abweichender Reihenfolge am Bestimmungsort ankommen. Dort werden sie von einem anderen Protokoll, dem sogenannten Transmission Control Protocol [TCP] wieder in die richtige Reihenfolge gebracht.
IPC	Industrie-PC
ISA	Industry Standard Architecture > Frühes Bussystem für Erweiterungssteckplätze für PC Einsteckkarten. In mo- dernen PC Architekturen weitgehend durch PCI-Bus ersetzt.
ISO	International Organization for Standardization > Internationale Organisation für Normung (weltweite Föderation nationaler Normungsinstitutionen von über 130 Ländern). Die Bezeichnung ISO ist kein Akronym des Namens der Organisation, sondern entspricht den ersten drei Buchstaben des griechischen Wortes isos, was soviel wie "gleich" im Sinne von Gleichheit bedeutet.
Jitter	Jitter ist ein Begriff zur Kennzeichnung zeitlicher Schwankungen zyklischer Ereignisse. Soll beispielsweise ein solches Ereignis alle 200µs auftreten und tritt es tatsächlich in den Grenzen von 198 bis 203µs in Erscheinung, dann ist für dieses Beispiel der Jitter 5µs. Jitter hat mannigfaltige Ursachen. Er entsteht in den Komponenten und Übertragungswegen von Netzen durch Rauschen, Übersprechen, elektromagnetische Interferenzen und zahlreiche andere zufällige Vorgänge. Speziell in der Automatisierungstechnik ist Jitter ein Maß für die Qualität von Synchronisation und Timing.
Laufzeitsystem	In der Computertechnik: Gesamtheit aller Routinen, die zur Ausführung eines in einer speziellen Programmier- sprache geschriebenen Programms auf einer speziellen Plattform erforderlich sind [Interaktionen mit dem Be- triebssystem, Speichermanagement, Fehlerbehandlungroutinen u.v.a.m.]. In der Automatisierungstechnik gibt es zur Zeit praktisch für jeden Steuerungstyp [SPS, CNC, PC-basierte Systeme, Robotersteuerungen u.a.] eine gro- ße Zahl an herstellerspezifischen Laufzeitsystemen. In verteilten Automatisierungssystemen sind dadurch Flexi- bilität, Funkionalität und Leistungsfähigkeit der einzelnen Geräte oft nur eingeschränkt nutzbar. Abhilfe scheint sich hier durch den Einsatz der .Net-Technologie von Microsoft, wozu das CLR-Laufzeitsystem gehört, anzubah- nen. In der Nachrichtentechnik bezeichnet ein Laufzeitsystem einen Filter zur Signalentzerrung, der Störungen beseitigt, die dadurch zustande kommen, dass sich, wie z.B. über Funk, Signalteile über verschieden lange Wege mit unterschiedlichen Laufzeiten ausbreiten, was beim Empfänger zu Signalverzerrungen führt.
LED	Light Emitting Diode> lichtemittierende Diode (Leuchtdiode, Luminiszenzdiode)
LPT	Line Printer > Logischer Gerätenamen bei PC Systemen für Drucker.
MB Mkey	Megabyte > 1 MB = 220 bzw. 1.048.576 Bytes Module Keyblock > Ist ein Sammelbegriff für die auf den Provit Displayeinheiten befindlichen Tasten. Diese können mit den Mkey Utilities frei parametriert werden.
Modem	Modulator/Demodulator > Modulations-/Demodulations-Einrichtung (Zusatzkarte oder externes Gerät, das durch Digital/Analog- bzw. Analog/Digital-Wandlung der Signale den Informationsaustausch zwischen Rechnern über das Telefonnetz ermöglicht
Motherboard	Mutterplatine > Leiterplatte, auf der die Hauptkomponenten eines Computers wie CPU-Schaltkreis, Co-Prozes- soren, Arbeitsspeicher, Festwertspeicher für Firmware, Interface-Schaltkreise und Erweiterungs-Slots für Hard- ware- Erweiterungen untergebracht sind
МТВF	Mean Time Between Failures > mittlere fehlerfreie Betriebszeit, mittlerer Ausfallabstand (mittlere Zeitspanne zwischen zwei Ausfällen bei reparierbaren Objekten, Zuverlässigkeitskenngröße).
МТС	Maintenance Controller > Eigenständiges Prozessorsystem in B&R Industrie-PCs, das zusätzliche Funktionen zur Systemüberwachung und Verfügbarkeit zur Verfügung stellt.
мтсх	Maintenance Controller EXtended > Der MTCX ist ein eigenständiges Prozessorsystem, das zusätzliche Funk- tionen, die in einem "normalen" PC nicht vorhanden sind, bei einem B&R Industrie PC zur Verfügung stellt. Der MTC kommuniziert mit dem B&R Industrie PC über den ISA-Bus (mittels Koppelregister).
Multitasking	Betriebsart in einem Betriebssystem bei der in einem Computer mehrere Aufgaben quasi gleichzeitig parallel ausgeführt werden.
Nennstrom	Der Nennstrom ist der Effektivwert des Phasenstroms (Strom in der Motorzuleitung) für die Entwicklung des Nennmoments bei Nenndrehzahl. Bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen kann dies beliebig lang abgege- ben werden.

Niederspannungsrichtlinie	Ziel der Richtlinie ist es, die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten und Unfallgefahren zu minimieren. Be- troffen sind alle elektrischen Betriebsmittel zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Umsetzen und Ver- brauchen elektrischer Energie wie z.B. Generatoren, Kabel, Schalter, Steckdosen, Akkumulatoren, Transforma- toren, Leuchten, Haushaltsgeräte und Motoren zur Verwendung bei einer Nennspannung zwischen 50 und 1000 Volt für Wechselstrom und zwischen 75 und 1500 Volt für Gleichstrom. Ausnahmen sind im Anhang II der Richtli- nie geregelt. Solche Betriebsmittel dürfen entsprechend der Richtlinie nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie entsprechend dem in der europäischen Gemeinschaft gegebenen Stand der Sicherheitstechnik hergestellt sind, sie bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung sowie bestimmungsgemäßer Verwendung Menschen, Nutztiere und Sachwerte nicht gefährden, sie seitens des Herstellers einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurden, eine entsprechende Konformitätserklärung vorliegt und sie mit der CEKennzeichnung ver- sehen sind.
Objekt	Gegenstand oder Sache der realen Welt bzw. Gegenstand, Sache oder Person der/die Ziel einer Handlung ist oder der/die eine solche erduldet. In Verbindung mit Software eine abgeschlossene Einheit, die bestimmte Daten [Attribute] und Funktionen [Operationen] enthält.
OEM	Original Equipment Manufacturer > Unternehmen, das fremd- und eigengefertigte Komponenten in das eigene Erzeugnissortiment integriert und diese Produkte unter eigenem Namen vertreibt .
PCI-Bus	Peripheral Component Interconnect Bus > von Intel als Zwischen-/Local-Bus für die neuesten PC-Generationen entwickelt. Es handelt sich um einen synchronen Bus. Zur Synchronisation wird der Haupttakt der CPU verwen- det. Der PCI-Bus ist Mikroprozessor-unabhängig, 32 Bit- und 64 Bit-kompatibel und unterstützt 3,3 V- sowie 5 V-Karten/Geräte. Siehe auch PCI SIG.
PnP	Plug and Plug > Ein Satz mit Spezifikationen, die von Intel entwickelt wurden. Der Einsatz von Plug and Play ermöglicht es, dass ein PC sich automatisch selbst konfigurieren kann, um mit Peripheriegeräten (z.B. Bildschir- men, Modems und Druckern) zu kommunizieren. Benutzer können ein Peripheriegerät anschließen (plug) und es anschließend sofort ausführen (play), ohne das System manuell konfigurieren zu müssen. Ein Plug and Play- PC benötigt ein BIOS, das Plug and Play unterstützt, sowie eine entsprechende Expansion Card.
POST	Power on Hoard States Sin Setz von Poutinon, die im Nur Loss Speicher (POM) des Computers abgelest and
POWERLINK	Power - On Sein Test > Ein Satz von Rodurien, die im Nul-Lese-Speche (ROM) des Computers abgelegt sind und verschiedene Systemkomponenten testen, z.B. den RAM, die Diskettenlaufwerke und die Tastatur, um deren ordnungsgemäße Verbindung und Betriebsbereitschaft festzustellen. Bei auftauchenden Problemen alarmieren die POST-Routinen den Benutzer durch mehrere Signaltöne oder Anzeigen einer häufig von einem Diagnosewert begleiteten Meldung auf der Standardausgabe oder dem Standardfehlergerät (in der Regel dem Bildschirm). Verläuft der Post erfolgreich, geht die Steuerung an den Urlader des Systems über.
	www.ethernet-powerlink.org
Power Panel	Geräte dieser B&R Produktfamilie integrieren Visualisierung, Steuerung und Ein-/Ausgabekomponenten kompakt in einem Gerät.
Programmiersprachen	Sind künstliche Sprachen mit strenger Syntax, Semantik, sowie eindeutigen Symbolen und speziellen Wörtern zur Umsetzung [Notation] von Lösungsalgorithmen in ein von einem Computer ausführbares Programm. Seit dem Bau des ersten funktionsfähigen programmgesteuerten Rechners Z3 im Jahre 1941 wurden für die ver- schiedensten Anwendungbereiche über tausend Programmiersprachen entwickelt. Eine Übersicht zu Evolution, Stand und Zukunft der Programmiersprachen geben die folgende Websites.
Protokoll	Umgangssprachlich: 1. Synonym für Aufzeichnung, Niederschrift [Sitzungs-, Tagungs-, Verhandlungsbericht], 2. festgeschriebenes Zeremoniell im diplomatischen Verkehr. Fachsprachlich im Bereich der Informationstechnik: Übereinkunft bezüglich der Datenformate und Steuerungsprozeduren für die Kommunikation zwischen zwei Ge- räten oder Prozessen. Das Protokoll kann hardware- oder softwaremäßig implementiert sein und betrifft im we- sentlichen folgende Aspekte: die Art der Fehlererkennung, die angewandt wird, die Datenkompressionsmethode, sofern eine zur Anwendung kommt sowie die Art und Weise wie von der sendenden Einrichtung Sendungsende und von der empfangenden Einrichtung der Erhalt einer Nachricht angezeigt werden.
Provit	Prozessvisualisierung Terminal > Produktfamilienbezeichnung der B&R Industrie- PCs.
Provit 2000	Ist eine Produktfamilienbezeichnung für die B&R Industrie PCs. Wird in folgende Produkte unterteilt: IPC2000, IPC2001. Compact IPC (IPC2002) und dazugehörige Displayeinheiten.
Provit 5000	Ist eine Produktfamilienbezeichnung für die B&R Industrie PCs. Wird in folgende Produkte unterteilt: IPC5000, IPC5600, IPC5600C, IPC5600C und dazugehörige Displayeinheiten.
Prozess	Ablauf, Vorgang oder Verfahren, in dem zeitlich kontinuierlich oder diskontinuierlich quantitative oder qualitative Veränderungen der Parameter bzw. des Zustandes eines realen oder virtuellen Betrachtungsobjekts oder Medi- ums vollzogen werden. Jeder Prozess hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Je nach dem, was in einem Prozess geschieht bzw. welche Objekte das Prozessgeschehen zu erdulden haben, sind speziell in den Wirtschafts- und Industriebereichen eine Vielzahl von Prozessen zu unterscheiden wie z.B. Wertschöpfungs- prozesse [Produktions- und Fertigungsprozesse], Dienstleistungsprozesse [Logistik-, Wartungs- und Instandhal- tungsprozesse], Managementprozesse [Planungs- und Lenkungsprozesse] u.v.a.m. Speziell bei technologischen Prozessen unterscheidet man je nach der Kontinuität des Hauptprozeßgeschehens kontinuierliche Prozesse, diskontinuierliche Prozesse und Chargenprozesse.
RAM	Random Access Memory > Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Ein Halbleiterspeicher, der vom Mikroprozessor oder anderen Hardwarebausteinen gelesen und beschrieben werden kann. Auf die Speicherorte läßt sich in jeder beliebigen Reihenfolge zugreifen. Zwar erlauben auch die verschiedenen ROM-Speichertypen einen wahlfreien Zugriff, diese können aber nicht beschrieben werden. Unter dem Begriff RAM versteht man dagegen im allge- meinen einen flüchtigen Speicher, der sowohl gelesen als auch beschrieben werden kann.
Regelung	Die Regelung bzw. das Regeln ist nach DIN 19226 ein Vorgang, bei dem eine Größe, die zu regelnde Größe [Regelgröße] fortlaufend erfasst, mit einer anderen Größe [Führungsgröße] verglichen und abhängig vom Ergeb- nis des Vergleichs im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst wird. Der sich dabei ergebende Wirkungsablauf findet in einem geschlossenen Kreis, dem sogenannten Regelkreis statt.
Robustheit	Widerstandsfähigkeit > Fähigkeit eines Betrachtungsobjekts, auch bei Verletzung spezifizierter Randbedingun- gen vereinbarte Funktionen zu erbringen bzw. seine Funktionsfähigkeit zu erhalten. Qualitativer Begriff, da keine exakten Bewertungskriterien existieren.
ROM	Read Only Memory > Nur-Lese-Speicher, Festwertspeicher, nicht-flüchtiger Speicher. Speicherinhalt wird beim Chiphersteller im letzen Maskenschritt eingeprägt [daher auch maskenprogrammierter ROM]. Er kann nur gelesen werden und bleibt ständig in gleicher Form erhalten.
RS232	Recommended Standard Number 232 > älteste und am weitesten verbreitete Schnittstellen-Norm, auch V.24- Schnittstelle genannt; alle Signale sind auf Masse bezogen, so dass es sich um eine erdunsymmetrische Schnitt- stelle handelt. High-Pegel: -330 V, Low-Pegel: +3 +30 V; zulässige Kabellänge bis 15 m, Übertragungsraten bis 20 kbit/s; für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen 2 Teilnehmern.
RTS	Request To Send > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal zur Anforderung der Sendeerlaub- nis. Es wird z.B. von einem Computer an das angeschlossene Modem ausgegeben. Dem Signal RTS ist nach der Hardware-Spezifikation der Norm RS-232- C. der Anschluss 4 zugeordnet

RXD	<i>Receive (RX) Data</i> > Eine Leitung für die Übertragung der empfangenen, seriellen Daten von einem Gerät zu einem anderen - z.B. von einem Modem zu einem Computer. Bei Verbindungen nach der Norm RS-232-C wird RXD auf den Anschluss 3 des Steckverbinders geführt.
Schnittstelle	Aus Sicht der Hardware kennzeichnet eine Schnittstelle/Interface die Verbindungsstelle zweier Baugruppen/ Ge- räte/Systeme. Die beiderseits der Schnittstelle liegenden Einheiten sind über Schnittstellenleitungen miteinander verbunden, über die Daten, Adressen und Steuersignale ausgetauscht werden. Der Begriff Schnittstelle/ Inter- face umfaßt dabei die Gesamtheit der funktionellen, elektrischen und konstruktiven Bedingungen [Kodierung, Signalpegel, Steckerbelegung], welche die Verbindungstelle zwischen den Baugruppen, Geräten bzw. Systemen charakterisiert. Je nach Art der Datenübertragung ist zwischen parallelen [z.B. Centronics, IEEE 488] und se- riellen Schnittstellen [z.B. V.24, TTY, RS232, RS422, RS485] zu unterscheiden, die für unterschiedliche Über- tragungsgeschwindigkeiten und Übertragungsentfernungen ausgelegt sind. Softwaremäßig gesehen bezeichnet der Begriff Schnittstelle/Interface den Übergang an der Grenze zwischen Programmbausteinen mit den dafür vereinbarten Regeln für die Übergabe von Programmdaten.
SDRAM	<i>Synchronic Dynamic Random Access Memory</i> > Eine Bauform dynamischer RAM Halbleiterbausteine, die mit höheren Taktraten betrieben werden kann.
Sensor	Einrichtung, die eine physikalische Größe auf der Grundlage eines physikalischen Effekts in ein weiterverarbeit- bares elektrisches, pneumatisches oder auch hydraulisches Signal umwandelt. In modernen Sensoren ist in vie- len Fällen eine Signalvorverarbeitung zur Ausschaltung störender Umgebungseinflüsse oder Nichtlinearitäten integriert. In der Automatisierungstechnik dienen Sensoren der Gewinnung der zur Prozeßführung notwendigen Informationen. Beispielsweise der Erfassung von Aggregat- und Maschinenzuständen oder zur Erfassung von Prozeßdaten wie Temperatur Druck Drehzahl Füllstand Durchfluß. Wene Winkel u ä
Sicherheit	nach Brockhaus: das Nichtvorhandensein von Gefahr bzw. die Gewißheit eines Einzelnen, einer Gruppe oder eines Gemeinwesens, vor möglichen Gefahren geschützt zu sein. In Verbindung mit technischen Sachverhalten versteht man unter Sicherheit die Eigenschaft eines Betrachtungsobjekts [Komponente, Gerät, Maschine, An- lage] bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine nicht hinnehmbare Gefahr für Menschen, andere Einrichtungen oder die Umgebung darzustellen. Die Behandlung der Sicherheitsproblematik erfolgt unter zwei Gesichtspunkten: erstens unter der Prämisse, dass das Betrachtungsobjekt in beabsichtigter Weise funktioniert und betrieben wird, zweitens unter der Maßgabe, dass das Betrachtungsobjekt nicht ordnungsgemäß arbeitet bzw. einem Vollausfall unterliegt. Der erste Aspekt betrifft in erster Linie den Problemkreis des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschut- zes und ist Gegenstand zahlreicher einschlägiger Gesetze Verordnungen und Vorschriften. Der zweite Aspekt dagegen ist Gegenstand technischer Sicherheitsbetrachtungen und Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, das Zustandekommen gefährlicher Systemzustände möglichst zu vermeiden bzw. das mit einem Funktionsausfall der Betrachtungseinheit verbundene Risiko, gemessen an Ausfallwahrscheinlichkeit und möglichem Schadensaus- maß, so klein wie möglich, mindestens aber unterhalb eines vertretbaren Grenzrisikos zu halten. Diese Proble- matik wird unter der Überschrift funktionale Sicherheit thematisiert. Für die Automatisierungstechnik sind hier die Normen IEC 61508 bzw. EN 954-1 von Belang. Im übrigen gibt es weder in der Technik noch in der Natur eine absolute Sicherheit ohne jegliches Risiko.
Signal	Zeitlich veränderliche physikalische Größe, z.B. eine Spannung oder ein Strom, die einen Parameter hat [Ampli- tude, Frequenz, Phasenlage], der konkrete Aussagen über den Werteverlauf einer anderen physikalischen Größe zuläßt. Der entsprechende Parameter wird als Informationsparameter bezeichnet. Beispielsweise kann mit Hilfe eines Tachogenerators die Drehzahl einer mechanischen Welle gemessen, d.h. auf der Amplitude der Genera- torausgangsspannung abgebildet werden. Die Amplitude der Ausgangsspannung ist hier der Informationspara- meter, der im Sinne der gegebenen Signaldefinition Aussagen über den zeitlichen Werteverlauf der Drehzahl der Maschinenwelle zuläßt. Je nach Wertevorrat, zeitlicher Verfügbarkeit und Anzahl der Informationsparameter lassen sich verschiedene Signal-Grundtypen unterscheiden. Wichtig für die Automatisierungstechnik sind ana- loge, binäre und digitale Signale.
Software	wörtlich: weiche Ware; konkret: die Gesamtheit aller Programme einschließlich der dazu gehörenden Dokumen- tationen, die für den Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen, Rechnersystemen sowie computerbasierten Be- triebsmitteln und Geräten jeglichen Couleurs zur Verfügung stehen. Die Software ist ergänzend zur Hardware der Träger der nichtapparativen funktionellen Bestandteile eines jeden Rechnersystems. Der Begriff Software als Bezeichnung für Computerprogramme wurde 1958 durch den Mathematiker John Tukey, Princeton University, geprägt. Software gliedert sich in Systemsoftware und Anwendungssoftware.
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung > rechnerbasiertes Steuergerät, dessen Funktionalität durch ein sogenann- tes Anwenderprogramm festgelegt wird. Das Anwenderprogramm ist relativ einfach mittels genormter Fachspra- chen [AWL, FBS, KOP, AS, ST] zu erstellen. Infolge ihrer seriellen Arbeitsweise sind ihre Reaktionszeiten ver- gleichsweise langsamer als bei VPS. SPS beherrschen heute in Form von Gerätefamilien mit abgestuften leis- tungsmäßig aufeinander abgestimmten Komponenten alle Ebenen einer Automatisierungshierarchie.
SRAM	Static Random Access Memory > Ein schneller RAM Halbleiterspeichertyp, der in Computern meist für den Ca- che-Speicher eingesetzt wird. Mittels Batteriepuffer kann der Inhalt dieses Speichers auch bei Stromausfall er- halten werden.
SVGA	Super Video Graphics Array > Grafikstandard mit einer Auflösung von mindestens 800x600 Bildpunkten [Pixels] und mindestens 256 Farben.
Switch	Gerät, ähnlich einem Hub, das in in einem Netz empfangene Datenpakete im Gegensatz zum Hub nicht an alle Netzknoten sondern nur an den jeweiligen Adressaten weiterleitet. Das heißt, im Gegensatz zu den Hubs sorgt ein Switch für eine gezielte Kommunikation innerhalb eines Netzes, die sich nur zwischen Sender und Empfänger einer Nachricht abspielt. Unbeteiligte Netzknoten bleiben dabei unberührt.
SXGA	Super Extended Graphics Array > Grafikstandard mit einer Bildauflösung von 1280 × 1024 Bildpunkten (Seitenverhältnis 5:4).
Task	Programmeinheit, der vom Echtzeitbetriebssystem eine eigene Priorität zugeteilt wurde. Sie enthält einen abge- schlossenen Prozeß und kann aus mehreren Moduln bestehen.
Touch Screen TXD	Bildschirm mit Berührungssensoren zur Aktivierung eines angebotenen Menüs durch Antippen mit dem Finger. <i>Transmit (TX) Data</i> > Eine Leitung für die Übertragung der gesendeten, seriellen Daten von einem Gerät zu einem anderen - z.B. von einem Computer zu einem Modem. Bei Verbindungen nach dem Standard RS-232-C wird TXD auf den Anschluss 2 des Steckverbinders geführt.
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter > universeller asynchroner Sende-/Empfangsbaustein
UDMA	Ultra Direct Memory Access > Ein spezieller IDE-Datenübertragungsmodus der hohe Datenübertragungsraten von Laufwerken ermöglicht. Es gibt mittlerweile einige Variationen. Der UDMA33 Modus überträgt 33 Megabyte pro Sekunde. Der UDMA66 Modus überträgt 66 Megabyte pro Sekunde. Der UDMA100 Modus überträgt 100 Megabyte pro Sekunde.
UPS	Uninterruptible Power Supply > siehe USV

USB	Universal Serial Bus > universeller serieller Bus, preiswerte serielle Schnittstelle für PCs; IBM-Standard unter- stützt von Intel, Compaq und Microsoft u.a.bekannten Firmen; bis zu 127 periphere Geräte [Maus, Tastatur, Dru- cker, Scanner, digitale Kameras, Modems, CDROM-Laufwerke, Telefone u.ä.] können an einen einzigen USB- Port angeschlossen werden. Über das vieradrige Buskabel werden die angeschlossenen Geräte auch mit Strom versorgt. Die seit 2001 auf dem Markt befindliche Version USB 2.0 erlaubt Datentransferraten bis 480 Mbps und ist damit auch zur Übertragung von Videodaten und für schnelle Festplatten geeignet.
USV	unterbrechungsfreie Stromversorgung > USV-Geräte und -Anlagen sind Anordnungen aus Schaltern, Gleich- und Wechselrichtern und insbesondere Batterien, die bei Netzspannungsausfall eine kontinuierliche Versorgung der Verbraucher über eine mehr oder weniger lange Zeit sicherstellen und ggfs. auch die Spannungsqualität verbessern.
UXGA	Ultra Extended Graphics Array > Üblicherweise eine Bildauflösung von 1600 × 1200 Bildpunkten (Seitenverhältnis 4:3, 12:9).
VDE	Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
	www.vde.de
Verfügbarkeit	[V] Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich eine Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt in funktionsfähigem Zustand befindet. Zuverlässigkeitskenngröße für reparierbare Systeme. Die stationäre Verfügbarkeit wird durch folgen- de Formel beschrieben: V= 1/[1 + MDT/MTBF]. Maßnahmen zur Erzielung möglichst hoher Verfügbarkeitswer- te zielen auf die Perfektionierung der Gesamtheit aller Qualitätssicherungsmaßnahmen hinsichtlich der Zuver- lässigkeit. Diese Verfahrensweise hat jedoch unter gegebenen Produktionsbedingungen ihre technischen und ökonomischen Grenzen. Wo sie bei Automatisierungsvorhaben zum Erreichen der geforderten Zuverlässigkeits- kennwerte nicht ausreicht, kommt das Prinzip der Fehlertoleranz zur Anwendung, das auf der Basis kürzester
	Fehlererkennungs- und Rekonfigurationszeiten eine wesentliche Erhöhung der Verfugbarkeitswerte ermöglicht.
VGA	Video Graphics Adapter
Windows CE	Kompaktes 32-Bit-Betriebssystem mit Multitasking und Multithreading, das die Firma Microsoft speziell für den OEM-Markt entwickelt hat. Es ist auf unterschiedliche Prozessortypen portierbar und hat hohe Echtzeitfähigkeit. Die Entwicklungsumgebung verwendet bewährte, weit verbreitete Entwicklungswerkzeuge. Es ist eine offene und skalierbare Windows-Betriebssystem-Plattform für eine Vielzahl von Geräten. Beispiele für solche Geräte sind Handheld-PCs, digitale Funkrufempfänger, intelligente Handys, Multimediakonsolen u.ä. In embedded systems ist Windows CE hervorragend auch für den Einsatz in der Automatisierungstechnik geeignet.
XGA	eXtended Graphics Array > Ein erweiterter Standard für Grafik-Controller und die Bildschirmdarstellung, der 1990 von IBM eingeführt wurde. Dieser Standard unterstützt die Auflösung 640 * 480 mit 65.536 Farben oder die Auflösung 1024 * 768 mit 256 Farben. Dieser Standard wird hauptsächlich in Workstation-Systemen eingesetzt.
ХТХ	eXpress Technologoy for ETX > Ist die konsequente Weiterführung des etablierten ETX® Standards. Bei XTX werden neueste I/O Technologien auf einen bewährten Formfaktor implementiert. Durch Verzicht auf den kaum mehr verwendeten ISA-Bus wird der ETX® Stecker X2 mit neuen seriellen Bussen wie PCI Express™ und Serial ATA® belegt. Alle anderen Signale auf den Steckern X1, X3 und X4 bleiben mit dem ETX® Standard (Rev. 2.7) vollständig kompatibel. Werden ISA Signale dennoch benötigt lässt sich auf dem Baseboard eine PCI-ISA Bridge implementieren. Wesentlich preisgünstiger als eine Bridge-Lösung ist die Verwendung des bei XTX™ bereits vorhanden LPC Busses.
Zuverlässigkeit	Repräsentiert sich in technischem Kontext als Verläßlichkeit im Hinblick auf ein kontinuierliches korrektes Erbrin- gen vereinbarter Leistungen innerhalb definierter Wahrscheinlichkeitsgrenzen und Zeitabschnitte. Charakteris- tische Zuverlässigkeitskennwerte sind: bei Anlagen die Verfügbarkeit V, bei reparierbaren Geräten die mittlere fehlerfreie Betriebszeit MTBF, bei nicht reparierbaren Systemen die mittlere Lebensdauer MTTF und bei Bauele- menten bzw. Komponenten die sogenannte Ausfallrate.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Konfiguration - Grundsystem	26
Abbildung 2:	Konfiguration - optionale Komponenten	27
Abbildung 3:	Temperatursensorpositionen	31
Abbildung 4:	Blockschaltbild Spannungsversorgung	33
Abbildung 5:	Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX01-00	36
Abbildung 6:	Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX01-01	37
Abbildung 7:	Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX02-00	38
Abbildung 8:	Blockschaltbild mit Buseinheit 5AC803.BX02-01	39
Abbildung 9:	Serialnummernaufkleber Rückseite	40
Abbildung 10:	Beispiel Serialnummernsuche	. 40
Abbildung 11:	Erdungsanschluss	41
Abbildung 12:	5PC820.1505-00 - Vorderansicht	56
Abbildung 13:	5PC820.1505-00 - Rückansicht	56
Abbildung 14:	5PC820.1505 - Abmessungen	59
Abbildung 15:	5PC820.1505-00 - Wanddurchbruch	59
Abbildung 16:	5PC820.1906-00 - Vorderansicht	62
Abbildung 17:	5PC820.1906-00 - Rückansicht	62
Abbildung 18:	5PC820.1906-00 - Abmessungen	65
Abbildung 19:	5PC820.1906-00 - Wanddurchbruch	65
Abbildung 20:	5AC803.SX01-00, 5AC803.SX02-00 - Einschübe	71
Abbildung 21:	5AC803.SX01-00 - Abmessungen	72
Abbildung 22:	5AC803.SX02-00 - Abmessungen	73
Abbildung 23:	Abmessungen Standard half-size PCI Karte	73
Abbildung 24:	Abmessungen Standard half-size PCIe Karte	74
Abbildung 25:	1 Slot Buseinheiten	76
Abbildung 26:	2 Slot Buseinheiten	76
Abbildung 27:	PCI express compact Einsteckkarten - Abmessungen	. 79
Abbildung 28:	POWERLINK Card 2port Kartennummernschalter	85
Abbildung 29:	Einbinden der POWERLINK Einsteckkarte in Automation Studio	85
Abbildung 30:	5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	88
Abbildung 31:	5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	90
Abbildung 32:	5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	93
Abbildung 33:	5AC801.HDDI-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	95
Abbildung 34:	5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	98
Abbildung 35:	5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen	99
Abbildung 36:	5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben	99
Abbildung 37:	5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	102
Abbildung 38:	5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	105
Abbildung 39:	5AC801.SSDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	107
Abbildung 40:	5AC801.SSDI-04 Rev. ≤ C0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	110
Abbildung 41:	5AC801.SSDI-04 Rev. ≥ D0 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	110
Abbildung 42:	5AC801.SSDI-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	113
Abbildung 43:	5MMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	115
Abbildung 44:	5MMSSD.0060-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	117
Abbildung 45:	5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≤ C0	119
Abbildung 46:	5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≥ D0	120
Abbildung 47:	5MMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	122
Abbildung 48:	5MMSSD.0256-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	124
Abbildung 49:	5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	128
Abbildung 50:	5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	130
Abbildung 51	5AC801 DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	134
Abbilduna 52:	PCI SATA RAID Controller	135
Abbildung 53	5ACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	137
Abbildung 54	5ACPCI RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	140
Abbildung 55	PCI SATA RAID Controller	141
Abbildung 56	5ACPCL RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	143
Abbilduna 57:	PCI SATA RAID Controller	144

Abbildung 58:	5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	. 146
Abbildung 59:	5MMHDD.0250-00 - Temperatur Lutttreuchtediagramm	. 148
Abbildung 60:	5MMHDD.0500-00 - Temperatur Luttreuchtediagramm	. 151
Abbildung 61:	5AC803.FA01-00 - Lufter Kit	. 152
Abbildung 62:	5AC803.FA02-00 - Lutter Kit.	. 153
Abbildung 63:	SAC803.FA03-00 - Lutter Kit	. 155
Abbildung 64:		151
Abbildung 65:	Einbaulage U Uliu +/-45	150
Abbildung 65:	Einbaulage mit 5AC801.DVRS-00	159
Abbildung 67:	Abstände für Luftzirkulation	100
Abbildung 60:		160
Abbildung 70:		162
Abbildung 70.	Fulktionserdesymbol	162
Abbildung 71.	Einstellungen für Passmark Burnin Bre V/4 anhand eines APC810.2 Slot mit DVD	165
Abbildung 72:	Testübersicht eines APC810.2 Slot mit DVD	166
Abbildung 73.	Fin Automation Panel 000 über DVI	160
Abbildung 75:	Fin Automation Panel 900 über SDL onboard	171
Abbildung 75:	Fin Automation Panel 800 über SDL onboard	173
Abbildung 70.	Ein AD000 und ein AD800 über SDL onboard	175
Abbildung 78:	Vier Automation Panel 900 über SDL onboard	177
Abbildung 70:	Anschluss von USB Perinheriegeräten lokal am PPC800	181
Abbildung 79.	Anschluss von USB Perinheriegeräten remote am AP000 über D\/I	182
Abbildung 81:	Anschluss von USB Perinheriegeräten remote am AP800/900 über SDI	183
Abbildung 82:	Finsting in das RAID Configuration Litility	184
Abbildung 83	RAID Configuration Litility - Menü	184
Abbildung 84:	RAID Configuration Utility - Menü	185
Abbildung 85:	RAID Configuration Utility - Create RAID set - Strined	185
Abbildung 86:	RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored	186
Abbildung 87:	RAID Configuration Utility - Delete RAID set	186
Abbildung 88:	RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set	187
Abbildung 89:	RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts	187
Abbildung 90:	RAID Configuration Utility - Low Level Format	188
Abbildung 91	Boot Screen	192
Abbildung 92	945GME BIOS Main Menü	194
Abbildung 93	945GME Advanced Menü	195
Abbildung 94	945GME Advanced ACPI Configuration	196
Abbildung 95	945GME Advanced PCI Configuration	197
Abbildung 96:	945GME Advanced PCI IRO Resource Exclusion	198
Abbildung 97	945GME Advanced PCI Interrupt Routing	199
Abbildung 98:	945GME Advanced PCI Express Configuration	200
Abbildung 99	945GME Advanced Graphics Configuration	202
Abbildung 100:	945GME Advanced CPU Configuration	. 204
Abbildung 101:	945GME Advanced Chipset Configuration	
Abbildung 102:	945GME Advanced I/O Interface Configuration	
Abbildung 103:	945GME Advanced Clock Configuration	207
Abbildung 104:	945GME Advanced IDE Configuration	207
Abbildung 105:	945GME Primary IDE Master	209
Abbildung 106:	945GME Primary IDE Slave	210
Abbildung 107:	945GME Secondary IDE Master	
Abbildung 108:	945GME Secondary IDE Slave	
Abbilduna 109:	945GME Advanced USB Configuration	213
Abbildung 110:	945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration	214
Abbilduna 111:	945GME Advanced Remote Access Configuration	215
Abbildung 112:	945GME Advanced CPU Board Monitor.	216
Abbildung 113:	945GME Advanced Baseboard/Panel Features	217
Abbildung 114:	945GME Panel Control	218

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 115:	945GME Baseboard Monitor	219
Abbildung 116:	945GME Legacy Devices	220
Abbildung 117:	945GME Boot Menü	221
Abbildung 118:	945GME Security Menü	222
Abbildung 119:	945GME Hard Disk Security User Password	223
Abbildung 120:	945GME Hard Disk Security Master Password	. 224
Abbildung 121:	945GME Power Menü	. 224
Abbildung 122:	945GME Exit Menü	226
Abbildung 123:	PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC für CPU Boards 945GME BIOS Version ≥ 1.15	5.235
Abbildung 124:	Softwareversion	236
Abbildung 125:	Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter.	
Abbildung 126:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1	.241
Abbildung 127	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2	241
Abbildung 128:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3	
Abbildung 129	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4	242
Abbildung 130:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5	242
Abbildung 131	Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files	243
Abbildung 132	Erstellung einer CompactFlash Karte für B&R Ungrade Files	244
Abbildung 133:	ADI Control Center Screenshots - Beisniele (Symbolifoto)	261
Abbildung 134:	ADI Control Center - SDI Equalizer Einstellung	263
Abbildung 135:	ADI Control Center - USV Einstellungen	264
Abbildung 136:	ADI Control Center - USV Monitor	265
Abbildung 137:	ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen	266
Abbildung 137.	ADI Control Center - USV Einstellungen	200
Abbildung 130:	ADI Control Center - DOV Einstellungen	260
Abbildung 139.	ADI Development Kit Screenshots (Version 3.60)	. 203
Abbildung 140.	ADI Development Rit Screenshots (Version 3.00)	271
Abbildung 141.	REP Kov Editor Screenshots Version 3.40 (Symbolfoto)	275
Abbildung 142.	Bar Rey Editor Screenshols Version 3.40 (Symbolioto)	ZIU
Abbildung 143.	54 C600 LIBSLOO Add on LISY Modul Montagemeterial	200
Abbildung 144.	Temperatur Lebenadauerdiagramm	. 201
Abbildung 145.		. 209
Abbildung 140.		. 209
Abbildung 147.	5PC600 LIDSP 00 - Abhreshellene	290
Abbildung 140.	SPC000.0PSB-00 - BOIIISCIIdDIOIIE	290
Abbildung 149:	EACDOL ETH1.01 DOL Ethernet Cord 10/100	293
Abbildung 150:	SACPCI.ETH1-01 - PCI Ethemet Card 10/100	295
Abbildung 151:	5ACPCI.ETH1-01 - ADMessungen	297
Abbildung 152:	5ACPCI.ETH3-01 - PCI Ethernet Card 10/100	298
Abbildung 153:	5ACPCI.ETH3-01 - Abmessungen	300
Abbildung 154:	5GFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luttreuchtediagramm CompactFlash Karten	305
Abbildung 155:	Abmessungen CompactFlash Karre Typ I	305
Abbildung 156:	ATTO Disk Benchmark V2.34 Vergleich Lesen - 5GFCRD.xxxx-04 mit 5GFCRD.xxxx-06.	306
Abbildung 157:	ATTO DISK Benchmark V2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04	mit
	50F0RD.xxxx-00	. 300
Abbildung 158:	5GFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luttreuchtediagramm CompactFlash Karten	309
Abbildung 159:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I	309
Abbildung 160:	ATTO Disk Benchmark V2.34 Vergleich Lesen - 50FCRD.xxxx-03 mit 50F0RD.xxxx-04.	
Abbildung 161:	ATTO DISK Benchmark V2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.XXXX-03	
	50FCRD.XXXX-04	. 310
Abbildung 162:	Abmoogungon CompactElash Karta Turk	JIJ
Abbildung 103:	Abmessungen Compactriash Kalle Typ I	210
Abbildung 164:		316
Abbildung 165:		318
Abbildung 166:		319
ADDIIGUNG 167:		. 321
ADDIIGUNG 168:	Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe	321
Abbildung 169:	EINDAUAUSSCHNITT USB MIEDIA DRIVE MIT FRONTKIAPPE	322

Abbildung 170:	5MD900.USB2-02 - Einbaulage	322
Abbildung 171:	5A5003.03 - Abmessungen	323
Abbildung 172:	Frontklappenmontage und Klemmdicke	324
Abbildung 173:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe	324
Abbildung 174:	Biegeradiusspezifikation	329
Abbildung 175:	5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen	329
Abbildung 176:	5CADVI.0xxx-00 - Belegung	330
Abbildung 177:	Biegeradiusspezifikation	332
Abbildung 178:	5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen	332
Abbildung 179:	5CASDL.0xxx-00 - Belegung	333
Abbildung 180:	Biegeradiusspezifikation	335
Abbildung 181:	5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen	335
Abbildung 182:	5CASDL.0xxx-01 - Belegung	336
Abbildung 183:	Biegeradiusspezifikation	338
Abbildung 184:	5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen	338
Abbildung 185:	5CASDL.0xxx-03 - Belegung	339
Abbildung 186:	Biegeradiusspezifikation mit Extender	341
Abbildung 187:	5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen	341
Abbildung 188:	5CASDL.0xx0-13 - Belegung	342
Abbildung 189:	Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender	343
Abbildung 190:	5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel	344
Abbildung 191:	9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel	346
Abbildung 192:	Batterie entfernen	349
Abbildung 193:	Batteriehandhabung	349
Abbildung 194:	Batteriepolarität	349
Abbildung 195:	CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto)	351
Abbildung 196:	Schnellverschlussschrauben lösen	352
Abbildung 197:	Compact SATA Laufwerk einschieben	352
Abbildung 198:	Schnellverschlussschrauben lösen	353
Abbildung 199:	Slide-in Laufwerkseinbau	353
Abbildung 200:	Schnellverschlussschrauben lösen.	354
Abbildung 201:	Slide-in compact Adapter Finbau	354
Abbildung 202:	Slide-in compact Laufwerk montieren	355
Abbildung 203	Lüfter Kit Abdeckung entfernen	356
Abbildung 200:	Lüfter Kit einlegen	
Abbildung 205	Staubfilter und Filterspange fixieren	356
Abbildung 206:	5AC600 UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial	
Abbildung 200:	USV Modulabdeckung entfernen	358
Abbildung 208:	USV Modul montieren	
Abbildung 200:	Verbindungskabel anstecken	359
Abbildung 200:	Steckerverriegelung	359
Abbildung 210.	Abdeckung der Batterieeinheit entfernen	360
Abbildung 212:	Kabel abstecken	360
Abbildung 212:	Sicherung anschließen	361
Abbildung 210:	Sicherung verstauen	361
Abbildung 214.	Schrauben lösen	362
Abbildung 216:	Buseinheit montieren	362
Abbildung 217:	Schrauben lösen	363
Abbildung 217.	5AC803 BC01 00 Adapter montieren	363
Abbildung 210.	54C803 BC02-00 Adapter montieren	267
Abbildung 220	PClec Modulahdeckung entfernen	285
Abbildung 220.	PClac Finsterkkarte einhauen	265
Abbildung 221.	DDC800 Saitendeckeldemontage obno Evnansion	366
Abbildung 222.	PPC900 Seitendeckeldementage mit Expansion (Poissielfets 4 Stat Expansion)	300
Abbildung 223.	Processite des SATA PAID Controllors 5ACDCI PAIC 02 Sobreubonzuordoung	267
Abbildung 225:	Hard Dick Tausch	307 260
Abbildung 220:	Desition des MTCV Controllers	308
ADDIIGUNG 226:		309

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 227: Abbildung 228: Abbildung 229: Abbildung 230: Abbildung 231: Abbildung 232: Abbildung 233: Abbildung 234: Abbildung 235: Abbildung 236: Abbildung 237: Abbildung 238: Abbildung 239: Abbildung 240:	Position Stecker für externen Verbraucher Temperatur Luftfeuchtediagramm AMT Touch Screen 5-Draht Kompatibilitätsdetails Abbildungsaufbau Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Quer1 Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Quer2 Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer1 Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer2 Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer2 Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer2 Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer2 Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer1 Einbaukompatibilität 12,1" Geräte Format Quer1 Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Quer1 Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Hoch1 Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Hoch1 Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Hoch1 Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Quer1 Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Hoch1 Einbaukompatibilität 15" Geräte Quer1 Einbaukompatibilität 15" Geräte Quer1 Einbaukompatibilität 19" Geräte Quer1	371 372 377 377 378 378 378 379 379 380 380 381 381 382 382
Abbildung 240: Abbildung 241:	Einbaukompatibilität 19" Geräte Quer1 Einbaukompatibilität 21,1" Geräte Quer1	382 383

Tabelle 1:	Handbuchhistorie	13
Tabelle 2:	Umweltgerechte Werkstofftrennung	18
Tabelle 3:	Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise	19
Tabelle 4:	Nennmaßbereiche	19
Tabelle 5:	Umgebungstemperaturen	29
Tabelle 6:	Umgebungstemperaturen	30
Tabelle 7:	Temperatursensorpositionen	31
Tabelle 8:	Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten	32
Tabelle 9:	Leistungskalkulation PPC800 15"	34
Tabelle 10:	Leistungskalkulation PPC800 19"	35
Tabelle 11:	Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC	41
Tabelle 12:	Monitor / Panel Anschluss - RGB. DVI. SDL	42
Tabelle 13:	Pinbelegung DVI Anschluss	42
Tabelle 14:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	42
Tabelle 15:	Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung	43
Tabelle 16:	Pinbelegung COM1	44
Tabelle 17:	Ethernet Anschluss (ETH1)	45
Tabelle 18:	Ethernet Anschluss (ETH2)	46
Tabelle 19:	USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss	47
Tabelle 20:	USB5 Anschluss	47
Tabelle 21:	CompactFlash Slot (CF1).	48
Tabelle 22:	CompactFlash Slot (CF2)	48
Tabelle 23:	MIC. Line IN. Line OUT	49
Tabelle 24:	Add-on USV Steckplatz	49
Tabelle 25:	Power Taster	50
Tabelle 26:	Reset Taster	50
Tabelle 27	Status I EDs	51
Tabelle 28:	CMOS Profile Schalter	51
Tabelle 29	Batterie	52
Tabelle 30	Bedeutung Batteriestatus	52
Tabelle 31:	Slide-in compact Slot	53
Tabelle 32:	PClec Stecknlatz	53
Tabelle 32.	5PC820 1505-00 - Bestelldaten	54
Tabelle 34:	5PC820 1505-00 - Destendation	56
Tabelle 35:	5PC820 1006-00 - Restelldaten	60
Tabelle 36:	5PC820 1006-00 - Destendaten	62
Tabelle 37:	5PC800 B045-00 5PC800 B045-01 5PC800 B045-02 5PC800 B045-03 5PC800 B045-	02 M
	5PC800.B945-05 - Bestelldaten	, - , 66
Tabelle 38:	5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - E	le-
	stelldaten	66
Tabelle 39:	5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02, 5PC800.B945-03, 5PC800.B945-0)4,
	5PC800.B945-05 - Technische Daten	67
Tabelle 40:	5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14	
	Technische Daten	67
Tabelle 41:	5AC803.HS00-00, 5AC803.HS00-01, 5AC803.HS00-02 - Bestelldaten	69
Tabelle 42:	5AC803.HS00-00, 5AC803.HS00-01, 5AC803.HS00-02 - Technische Daten	69
Tabelle 43:	5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten	70
Tabelle 44:	5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten	70
Tabelle 45:	5AC803.SX01-00, 5AC803.SX02-00 - Bestelldaten	71
Tabelle 46:	5AC803.SX01-00, 5AC803.SX02-00 - Technische Daten	71
Tabelle 47:	Slide-in Slot 1	75
Tabelle 48:	5AC803.BX01-00, 5AC803.BX01-01, 5AC803.BX02-00, 5AC803.BX02-01 - Bestelldaten	76
Tabelle 49:	5AC803.BX01-00, 5AC803.BX01-01, 5AC803.BX02-00, 5AC803.BX02-01 - Technische Daten	76
Tabelle 50:	5AC803.BC01-00 - Bestelldaten	78
Tabelle 51:	5AC803.BC02-00 - Bestelldaten	78
Tabelle 52:	5ACPCC.ETH0-00 - Bestelldaten	80
Tabelle 53:	5ACPCC.ETH0-00 - Technische Daten	80
Tabelle 54:	5ACPCC.ETH0-00 - Ethernet Schnittstelle	81
Tabellenverzeichnis

Tabelle 55:	5ACPCC.MPL0-00 - Bestelldaten.	. 82
Tabelle 56:	5ACPCC.MPL0-00 - Technische Daten	.82
Tabelle 57:	5ACPCC.MPL0-00 - POWERLINK Schnittstelle	.83
Tabelle 58:	Status/Error LED - Betriebsmodus Ethernet TCP/IP	. 83
Tabelle 59:	Status/Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V1	83
Tabelle 60:	Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V2	.83
Tabelle 61:	Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK	. 84
Tabelle 62:	Status/Error LED als Error LED - System Stopp Fehlercodes	. 84
Tabelle 63:	POWERLINK Stationsnummer (x1, x16)	. 85
Tabelle 64:	5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten	. 86
Tabelle 65:	5AC801.HDDI-00 - Technische Daten	.86
Tabelle 66:	5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten	. 89
Tabelle 67:	5AC801.HDDI-02 - Technische Daten	.89
Tabelle 68:	5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten	. 91
Tabelle 69:	5AC801.HDDI-03 - Technische Daten	.91
Tabelle 70:	5AC801.HDDI-04 - Bestelldaten	. 94
Tabelle 71:	5AC801.HDDI-04 - Technische Daten	.94
Tabelle 72:	5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten	.96
Tabelle 73:	5AC801.SSDI-00 - Technische Daten	. 96
Tabelle 74:	5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten	100
Tabelle 75:	5AC801.SSDI-01 - Technische Daten1	100
Tabelle 76:	5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten	103
Tabelle 77:	5AC801.SSDI-02 - Technische Daten1	103
Tabelle 78:	5AC801.SSDI-03 - Bestelldaten	106
Tabelle 79:	5AC801.SSDI-03 - Technische Daten	106
Tabelle 80:	5AC801.SSDI-04 - Bestelldaten	108
Tabelle 81:	5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten	108
Tabelle 82:	5AC801.SSDI-05 - Bestelldaten	111
Tabelle 83:	5AC801.SSDI-05 - Technische Daten1	111
Tabelle 84:	5MMSSD.0060-00 - Bestelldaten	114
Tabelle 85:	5MMSSD.0060-00 - Technische Daten	114
Tabelle 86:	5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten	116
Tabelle 87:	5MMSSD.0060-01 - Technische Daten	116
Tabelle 88:	5MMSSD.0128-01 - Bestelldaten	118
Tabelle 89:	5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten	118
Tabelle 90:	5MMSSD.0180-00 - Bestelldaten	121
Tabelle 91:	5MMSSD.0180-00 - Technische Daten	121
Tabelle 92:	5MMSSD.0256-00 - Bestelldaten	123
Tabelle 93:	5MMSSD.0256-00 - Technische Daten	123
Tabelle 94:	5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten	125
Tabelle 95:	5AC801.ADAS-00 - Technische Daten	125
Tabelle 96:	5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten	126
Tabelle 97:	5AC801.HDDS-00 - Technische Daten 1	126
Tabelle 98:	5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten	129
Tabelle 99:	5AC801.DVDS-00 - Technische Daten	129
Tabelle 100:	5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten	132
Tabelle 101:	5AC801.DVRS-00 - Technische Daten	132
Tabelle 102:	5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten	136
Tabelle 103:	5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten	136
Tabelle 104:	5ACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten	139
Tabelle 105:	5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten	139
Tabelle 106:	5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten	141
Tabelle 107:	5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten	142
Tabelle 108:	5ACPCI.RAIC-06 - Bestelldaten	144
Tabelle 109:	5ACPCI.RAIC-06 - Lechnische Daten	145
Tabelle 110:	5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten	147
i abelle 111:	SMIMIHUD.0250-00 - Technische Daten	147

Tabelle 112:	5MMHDD.0500-00 - Bestelldaten	149
Tabelle 113:	5MMHDD.0500-00 - Technische Daten	149
Tabelle 114:	5AC803.FA01-00 - Bestelldaten	152
Tabelle 115:	5AC803.FA01-00 - Technische Daten	152
Tabelle 116:	5AC803.FA02-00 - Bestelldaten	153
Tabelle 117:	5AC803.FA02-00 - Technische Daten	153
Tabelle 118:	5AC803.FA03-00 - Bestelldaten	155
Tabelle 119:	5AC803.FA03-00 - Technische Daten	155
Tabelle 120:	Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot	167
Tabelle 121:	Auswahl der Displayeinheiten	168
Tabelle 122:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	169
Tabelle 123:	Linkbaugruppen	169
Tabelle 124:	Kabel für DVI Konfigurationen	169
Tabelle 125:	Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen	170
Tabelle 126:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	171
Tabelle 127:	Linkbaugruppen	171
Tabelle 128:	Kabel für SDL Konfigurationen	171
Tabelle 129:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	172
Tabelle 130:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	173
Tabelle 131:	Kabel für SDL Konfigurationen	173
Tabelle 132:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung	174
Tabelle 133:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.	175
Tabelle 134:	Linkbaugruppen	175
Tabelle 135:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board	
Tabelle 136	Linkbaugruppen	177
Tabelle 137	Kabel für SDI Konfigurationen	178
Tabelle 138:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.	
Tabelle 139	BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility	184
Tabelle 140	Biosrelevante Tasten beim POST	193
Tabelle 141	Biosrelevante Tasten im BIOS Menü	193
Tabelle 142	945GMF Main Menü Finstellmöglichkeiten	194
Tabelle 143	945GME Advanced Menü	195
Tabelle 144	945GME Advanced ACPI Configuration Finstellmöglichkeiten	196
Tabelle 145	945GME Advanced PCI Configuration Einstellmöglichkeiten	197
Tabelle 146	945GME Advanced PCI IRO Resource Exclusion Einstellmödlichkeiten	198
Tabelle 147	945GME Advanced PCI Interrupt Routing Finstellmöglichkeiten	199
Tabelle 148	945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten	200
Tabelle 149	945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten	202
Tabelle 150	945GME Advanced CPUI Configuration Einstellmöglichkeiten	204
Tabelle 151	945GME Advanced Chinset Finstellmöglichkeiten	205
Tabelle 152	945GME Advanced I/O Interface Configuration Finstellmöglichkeiten	206
Tabelle 153	945GME Advanced Clock Configuration Einstellmöglichkeiten	207
Tabelle 154	945GME Primary IDE Master Einstellmöglichkeiten	209
Tabelle 155	945GME Primary IDE Slave Einstellmöglichkeiten	210
Tabelle 156:	945GME Secondary IDE Master Einstellmöglichkeiten	211
Tabelle 157	945GME Secondary IDE Slave Einstellmöglichkeiten	212
Tabelle 158:	945GME Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten	213
Tabelle 150:	945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmöglichkeiten	214
Tabelle 160	945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellmöglichkeiten	215
Tabelle 161	945GMF Advanced CPU Board Monitor Finstellmödlichkeiten	216
Tahelle 162	945GME Advanced Baseboard/Panel Features Finstellmöglichkeiten	210
Tabelle 163	945GME Panel Control Finstellmödlichkeiten	<u>2</u> 17 218
Tabelle 164	945GME Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten	210
Tabelle 165	945GME Legacy Devices Finstellmöglichkeiten	220
Tabelle 166	945GME Boot Menü Finstellmöglichkeiten	220
Tabelle 167	945GMF Security Menü Einstellmöglichkeiten	
Tahelle 168	945GME Hard Disk Security User Password	<u>222</u> 222
	oroome hard blak occurry oser i assword	223

Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 169:	945GME Hard Disk Securitiy Master Password	224
Tabelle 170:	945GME Power Menü Einstellmöglichkeiten	225
Tabelle 171:	855GME (XTX) Exit Menü Einstellmöglichkeiten	226
Tabelle 172:	Profilübersicht	227
Tabelle 173:	945GME Main Profileinstellungsübersicht	227
Tabelle 174:	945GME Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsübersicht	227
Tabelle 175:	945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht	228
Tabelle 176:	945GME Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsübersicht	228
Tabelle 177:	945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht	228
Tabelle 178:	945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht	229
Tabelle 179:	945GME Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht	229
Tabelle 180:	945GME Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsübersicht	229
Tabelle 181:	945GME Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsübersicht	229
Tabelle 182:	945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht	229
Tabelle 183:	945GME Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht	230
Tabelle 184:	945GME Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsübersicht	230
Tabelle 185:	945GME Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsübersicht	230
Tabelle 186:	945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht	230
Tabelle 187:	945GME Boot Profileinstellungsübersicht	231
Tabelle 188:	945GME Security Profileinstellungsübersicht	231
Tabelle 189:	945GME Power Profileinstellungsübersicht	232
Tabelle 190:	BIOS Postcode Meldungen BIOS 945GME	233
Tabelle 191:	RAM-Adressbelegung	234
Tabelle 192:	I/O-Adressbelegung	234
Tabelle 193:	IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode	234
Tabelle 194:	IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode	235
Tabelle 195:	9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten	245
Tabelle 196:	Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei DVI Signalen	245
Tabelle 197:	Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei RGB Signalen	245
Tabelle 198:	5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL, 5SWWXP.0500-ENG, WXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten	, 5SW- 246
Tabelle 199:	5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER,	5SW-
	WI7.0300-MUL, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.0200-ENG, 5SWWI7.1200-ENG,	5SW-
	WI7.0200-GER, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.0400-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bes	stellda-
T I II 000		248
Tabelle 200:	5SWWXP.0427-ENG - Bestelldaten	251
	Geratefunktionen unter Windows XP Embedded mit FP2007	251
Tabelle 202:	5SWWXP.0/27-ENG - Bestelldaten	253
Tabelle 203:		253
Tabelle 204:	55VVVVI/.U52/-ENG, 55VVVVI/.I52/-ENG, 55VVVVI/.U62/-ENG, 55VVVVI/.I62/-ENG,	-VVCC
	ten	255
Tabelle 205 [.]	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7	256
Tabelle 200:	5SWWCE 0827-ENG - Bestelldaten	258
Tabelle 200:	Figenschaften Windows CE 6.0	258
Tabelle 208:	9A0003 02U 1A4600 10-5 1A4600 10-2 1A4600 10-3 1A4600 10-4 1A4601 06-5 - Bes	stellda-
	ten	
Tabelle 209:	0AC201.91. 4A0006.00-000 - Bestelldaten	279
Tabelle 210:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten	279
Tabelle 211:	0TB103.9. 0TB103.91 - Bestelldaten	281
Tabelle 212:	0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten	281
Tabelle 213:	5AC900.1000-00 - Bestelldaten	282
Tabelle 214:	5AC900.1201-00 - Bestelldaten	283
Tabelle 215:	5AC900.1201-01 - Bestelldaten	283
Tabelle 216:	5AC900.BLOC-00 - Bestelldaten	284
Tabelle 217:	5AC600.UPSI-00 - Bestelldaten	286
Tabelle 218:	5AC600.UPSI-00 - Technische Daten	286
Tabelle 219:	5AC600.UPSB-00 - Bestelldaten	288

Tabelle 220: Tabelle 221:	5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Bestelldaten	288 291
Tabelle 222:	5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Technische Daten	.291
Tabelle 223:	5AC600.UPSF-00 - Bestelldaten	292
Tabelle 224:	5AC600.UPSF-01 - Bestelldaten	292
Tabelle 225:	9A0100.11, 9A0100.12, 9A0100.13, 9A0100.14, 9A0100.15, 9A0100.16, 9A0100.17 - Beste ten	llda- 293
Tabelle 226:	5ACPCI.ETH1-01 - Bestelldaten	295
Tabelle 227:	5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten	295
Tabelle 228:	5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten	296
Tabelle 229:	5ACPCI.ETH3-01 - Bestelldaten	298
Tabelle 230:	5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten	298
Tabelle 231:	5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten	299
Tabelle 232:	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192	2-06,
	5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten	303
Tabelle 233:	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192	2-06,
	5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten	.303
Tabelle 234:	5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten	2-04, .307
Tabelle 235:	5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192	2-04,
	5CFCRD.016G-04 - Technische Daten	307
Tabelle 236:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024	-03,
	5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten	311
Tabelle 237:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten	-03, .312
Tabelle 238:	5MMUSB.2048-00 - Bestelldaten	.315
Tabelle 239:	5MMUSB.2048-00 - Technische Daten	315
Tabelle 240:	5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten	317
Tabelle 241:	5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten	.317
Tabelle 242:	5MD900.USB2-02 - Bestelldaten	319
Tabelle 243:	5MD900.USB2-02 - Technische Daten	.319
Tabelle 244:	5MD900.USB2-02 - Lieferumfang	322
Tabelle 245:	5A5003.03 - Bestelldaten	323
Tabelle 246:	5A5003.03 - Technische Daten	323
Tabelle 247:	5A5003.03 - Lieferumfang	.323
Tabelle 248:	5SWHMI.0000-00 - Bestelldaten	.325
Tabelle 249:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten	.328
Tabelle 250:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten	328
Tabelle 251:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200	-00,
	5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten	.331
Tabelle 252:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200	-00,
	5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten	331
Tabelle 253:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten	.334
Tabelle 254:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische ten	Da- 334
Tabelle 255:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten)-03, .337
Tabelle 256:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten)-03, 337
Tabelle 257:	Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03	339
Tabelle 258:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten	.340
Tabelle 259:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten	340
Tabelle 260:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten	344
Tabelle 261:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten	.344
Tabelle 262:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten	.345
Tabelle 263:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten	345
Tabelle 264:	5CAMSC.0001-00 - Bestelldaten	347
Tabelle 265:	5CAMSC.0001-00 - Technische Daten	.347

Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 266:	Bedeutung Batteriestatus	348
Tabelle 267:	Übersicht benötigte Ersatz SATA-HDD für PCI SATA HDD RAID Controller	367
Tabelle 268:	Temperaturgrenzen der Lüfterregelung (MTCX PX32 V1.01)	370
Tabelle 269:	Pinbelegung Stecker am Basisboard	371
Tabelle 270:	Technische Daten Touch Screen AMT 5-Draht	372
Tabelle 271:	Chemische Beständigkeit der Dekorfolie	374
Tabelle 272:	Produktabkürzungen	376
Tabelle 273:	Gerätekompatibilitätsübersicht	376

0AC201.91	279
0TB103.9	281
0TB103.91	281
184600 10-2	260
14/600.10.3	260
1A4600.10-4	
1A4600.10-5	260
1A4601.06-5	
440006 00-000	279
5,5003,03	272
5AC600.0PSB-00	
5AC600.UPSF-00	292
5AC600.UPSF-01	292
5AC600 UPSI-00	286
5402801 4045 00	125
	123
5AC801.DVDS-00	
5AC801.DVRS-00	
5AC801.HDDI-00	86
5AC801.HDDI-02	
	Q1
SAC801.HDD1-04.	
5AC801.HDDS-00	
5AC801.SSDI-00	
5AC801 SSDI-01	
54C801 SSDI-02	103
5AC801.55DI-03.	
5AC801.SSDI-04	108
5AC801.SSDI-05	
5AC803.BC01-00	
5AC803 BC02-00	78
54 Co03 DX01-00	
5AC803.BX01-01	
5AC803.BX02-00	76
5AC803.BX02-01	76
5AC803 FA01-00	152
	152
5AC803.FA03-00	
5AC803.HS00-00	69
5AC803.HS00-01	69
5AC803 HS00-02	69
54/2803 \$201 00	71
5AC803.SX02-00	
5AC900.1000-00	
5AC900.1201-00	
5AC900.1201-01	283
54C900 BLOC-00	28/
	204
SACPCC.ETHU-00.	80
5ACPCC.MPL0-00	82
5ACPCI.ETH1-01	
5ACPCI.ETH3-01	
SACECI RAIC-03	136
	120
5ACPCI.RAIC-05	141
5ACPCI.RAIC-06	144
5CADVI.0018-00	328
5CADVI.0050-00	328
	200
5CASDL.0018-00	331
5CASDL.0018-01	334
5CASDL.0018-03	
5CASDI 0050-00	221

Bestellnummernindex

Bestellnummernindex

5CASDL.0050-01	334
5CASDL.0050-03	337
5CASDL.0100-00	331
5CASDL.0100-01	334
5CASDL.0100-03	337
5CASDL.0150-00	331
5CASDL.0150-01	334
5CASDL.0150-03	337
5CASDL.0200-00	331
5CASDL.0200-03	337
5CASDL.0250-00	331
5CASDL.0250-03	337
5CASDL.0300-00	331
5CASDL.0300-03	337
5CASDL.0300-13	340
5CASDL.0400-13	340
5CASDL.0430-13	
5CAUPS.0005-00	
5CAUPS.0030-00	
5CAUSB.0018-00.	
5CAUSB 0050-00	344
5CFCRD 0064-03	
5CFCRD 0128-03	
5CFCRD 016G-04	307
5CFCRD 016G-06	303
5CECRD 0256-03	311
5CECRD 032G-06	303
5CECRD 0512-03	311
5CECRD 0512-04	307
5CECRD 0512-04	303
5CECRD 1024-03	311
5CECRD 1024-04	307
50F CRD 1024-04	303
50F CRD 2048-03	311
50F CRD 2048-04	307
50F CRD 2048-06	303
50F CRD 4096-03	311
50F CRD 4096-04	307
50F CRD 4006-06	303
50F CRD 8192-03	311
50F CRD 8102-03	307
50F CND.0192-04	303
501 CND.0192-00	310
5MMDDD 0512 01	
5MM55D.0060-00	
5MM55D.0060-01	
5MM55D.0128-01	
5MM55D.0180-00	
21VIIVIのしていたので、1000000000000000000000000000000000000	
5MMUSB.4096-01	
5PC800.B945-00	
5PC800.B945-01	66
5PC800.B945-02	66
5PC800.B945-03	66
5PC800.B945-04	66
5PC800.B945-05	

5PC800.B945-10	66
5PC800.B945-11	
5PC800.B945-12	66
5PC800.B945-13	66
5PC800.B945-14	66
5PC820.1505-00	54
5PC820.1906-00	60
5SWHMI.0000-00	
5SWWCE.0827-ENG	258
5SWWI7.0100-ENG	
5SWWI7.0100-GER	
5SWWI7.0200-ENG	
5SWWI7.0200-GER	
5SWWI7.0300-MUL	248
5SWWI7.0400-MUL	248
5SWWI7.0527-ENG	
5SWWI7.0627-ENG	
5SWWI7.0727-MUL	
5SWWI7 0827-MUI	255
5SWWI7 1100-ENG	248
5SWWI7 1100-GER	248
5SWWI7 1200-ENG	248
5SWWI7 1200-GER	248
5SWWI7 1300-MLI	248
5SWWI7 1400-MUI	248
5SWWI7 1527-FNG	255
5SWWI7 1627-ENG	255
5SWWI7 1727-MUI	255
5SWWI7 1827-MUI	255
5SWWXP.0427-ENG	
5SWWXP 0500-ENG	246
5SWWXP 0500-GER	246
5SWWXP 0500-MUI	246
5SWWXP 0600-ENG	246
5SWWXP 0600-GER	246
5SWWXP 0600-MU	246
5SWWXP 0727-ENG	253
940003 021	260
9A0014 02	345
940014.05	345
940014 10	345
QAN100 11	203
9A0100.11	203
QA0100.12	203
9A0100.13 0A0100.14	
0/0/100.1 -	
αλητής του το ποιοιογία αλητής του το ποιοιογία	
שהי ויט. ויט מגמות 17	
370 100. 17 DS0000 01 010	
30000.01-010	
92000.01-020	245

Olicitwortverzeichnis

~	•
•	

GME

Α

Abkürzung	
Abmessungen	
5A5003.03	
5MD900.USB2-02	
Abmessungen PPC800 15"	59
Abmessungen PPC800 19"	
ACPI	
Adapter	
Adapter Einbau / Tausch	
Add-on USV Modul	
Add-on USV Steckplatz	
ADI	
.NET SDK	273
Development Kit	271
SDL Equalizer Einstellung	
Allgemeintoleranz	19
Anleitung Temperaturtest	164
Anschluss externer Verbraucher	
Anschluss von Kabeln	162
ARemb	
ARwin	
Auflösung	
Auflösung DVI	43
Auflösung SDL	
Auswertung Temperaturen	
Automation Runtime	
Automation Runtime Embedded	
Automation Runtime Windows	

В

3&R Automation Device Interface	261
3&R CompactFlash	307
3&R Control Center	261
3&R Embedded OS Installer 244,	259
3&R Key Editor	275
Backlight	189
Batterie	. 52
Batteriepolarität verkehrt	265
Satteriestatusermittlung	348
Batteriewechsel	348
Beep Codes	233
Beispielprogramme	167
Bemaßungsnorm	. 19
Betriebssystem	
Windows 7	248
Windows CE	258
Windows Embedded Standard 2009	253
Windows Embedded Standard 7	255
Windows XP Embedded	251
Windows XP Professional	246
Biegeradius	162
Biegeradiusspezifikation	162
BIOS Fehlersignale	233
BIOS Setup Tasten	193
BIOS Upgrade	236

Blickwinkel	375
Blockschaltbilder	36
Blockschaltbild Spannungsversorgung	33
Buseinheit Einbau / Tausch	. 362
Buseinheiten7	3, 76

С

Card Slot	53
CE- Kennzeichnung	277
CF1	48
CF2	
Chemische Beständigkeit	
CMOS Profile Schalter	51
COM1	44
CompactFlash	
Benchmark	310
CompactFlash Karten	
CompactFlash Slot	
CompactFlash Tausch	
Control Center	164, 261
CPU Board	
CPU Board 945GME	

D

Dekorfolie	374
Displaylebensdauer	189
Dual-Channel Memory	70
DVI Kabel	328
Dynamic Wear Leveling	301

Ε

Einbaukompatibilitäten	376
Einbaulagen	158
Einbrenneffekt	189
Einschübe	41, 71
Einsteckkarte	79, 295
Elektromagnetische Verträglichkeit	277
Embedded OS Installer	244
EMV-Richtlinie	277
Entsorgung	18, 18
Erdung	
Erdungsanschluss	41, 163
Erdungskonzept	163
ESD.	16
Einzelbauteile	
Elektrische Baugruppen mit Gehäuse	16
Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse	16
gerechte Handhabung	16
Verpackung	16
ETH1	45
ETH2	46
Ethernet	45, 46
Expansions	
Externer Verbraucher	371

F

fehlerhafte Bildpunkte	Features W	√indows CE 6.0	258
	fehlerhafte	Bildpunkte	189

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Firmwareupgrade	239
Freiraum	161
Funktionserde 41,	163

G

Geräteschnittstellen und Einschübe	. 41
Gesamtgerät	28
GOST-R	278
Gosudarstwenny Standart	278

Η

Handbuchhistorie	13
Hauptspeicher	. 70
HDA Sound	. 49
HMI Drivers & Utilities DVD.	325

I

I/O-AdressbelegungI/O-Adressbelegung	234
Image Sticking.	189
Implementierungsanleitung	167
Interrupt- Zuweisung	234

Κ

Kabel DVI Kabel	328 328 331
SDL Kabel	337
SDL Kabel flex mit Extender	340
SDL Kabel mit 45° Stecker	334
USB Kabel	344
Key Editor	275
Klemmblöcke	284
Klimakammer	167
Konfiguration	
Grundsystemoptionale Komponenten	26 27
Kühlkörper	. 69

L

Laufwerke		86
Leistungskalkulation		ł. 35
Loopback Adapter		166
Low Battery	268,	270
Lüfter Kit.		152
Lüfter Kit Einbau / Tausch		356
Lüfterregelung		369
Luftfeuchtigkeitsangaben		. 32
Luftzirkulation	161,	161

Μ

Maintenance Controller Extended	369
Monitor / Panel Anschluss	. 42
Montage	
mit Klemmblöcken	157
Montage des USV Moduls	358

Montage USV Sicherungs Kit	360
MS-DOS	245
MTCX	369
MTCX Upgrade	

Ν

liederspannungsrichtlinie 277

Ρ

Parity Error. 233 PCI 295 PClec 79 PClec Einsteckkarte Einbau / Tausch. 365 PClec Steckplatz. 53 Prikefehler 189 Power Fail 270 POWer Fail 270 POWER Fail 270 POWER Fail 271 POWERLINK 85 LED STATUS 83 Link LED 83 Speed LED 83 Stationsnummer. 85 System Stopp Fehlercodes 84 POWer Taster. 59 Leistungskalkulation 34 Schnittstellen 59 Leistungskalkulation 59 PPC800 13" 65 Wanddurchbruch 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leixtungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leixtungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leixtungskalkulation 35		
PCI. 295 PClec. 79 PClec Einsteckkarte Einbau / Tausch. 365 PClec Steckplatz. 53 Pixelfehler. 189 Powerfail. 270 Power Fail. 270 Power Fail. 270 Power Fail. 51 POWERLINK 51 Kartennummernschalter. 85 LED STATUS. 83 Link LED. 83 Speed LED. 83 Stationsnummer. 85 System Stopp Fehlercodes. 84 Power Taster. 50 PPC800 15" 50 Abmessungen. 59 Leistungskalkulation. 54 Schnittstellen. 56 Wanddurchbruch. 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation. 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation. 59 Zerchnische Daten. 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 65 Leistungskalkulation. 35 </th <th>arity Error 23</th> <th>33</th>	arity Error 23	33
PClec. 79 PClec Einsteckkarte Einbau / Tausch 365 PClec Steckplatz 53 Pixelfehler. 189 Powerfail. 270 Power Fail. 51 POWERLINK 85 LED STATUS. 83 Link LED. 83 Stationsnummer. 85 System Stopp Fehlercodes. 84 Power Taster. 50 PPC800 15" 54 Abmessungen. 59 Leistungskalkulation. 56 Technische Daten. 56 Vanddurchbruch. 56 Leistungskalkulation. 56 Venddurchbruch. 57	°CI) 5
PClec Einsteckkarte Einbau / Tausch	Clec	79
PClec Steckplatz. 53 Pixelfehler. 189 Powerfail. 270 Power Fail. 51 POWERLINK 51 Kartennummernschalter. 85 LED STATUS. 83 Link LED. 83 Speed LED. 83 System Stopp Fehlercodes. 84 Power Taster. 50 PPC800 15" 59 Leistungskalkulation. 34 Schnittstellen 56 Technische Daten. 56 Wanddurchbruch. 59 PPC800 19" 65 Abmessungen. 56 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen 56 Technische Daten. 56 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen 62 Technische Daten. 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 62 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 6	Clec Einsteckkarte Einbau / Tausch	35
Pixelfehler 189 Powerfail 270 Power Fail 51 POWERLINK 83 Kartennummernschalter 85 LED STATUS 83 Link LED 83 Speed LED 83 Stationsnummer 85 System Stopp Fehlercodes 84 Power Taster 50 PPC800 15" 74 Abmessungen 59 Leistungskalkulation 34 Schnittstellen 56 Technische Daten 56 Wanddurchbruch 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 62 Technische Daten 62 Leistungskalkulation 35	Clec Steckplatz	53
Powerfail 270 Power Fail 51 POWERLINK 85 Kartennummernschalter 85 LED STATUS 83 Link LED 83 Speed LED 83 Stationsnummer 85 System Stopp Fehlercodes 84 Power Taster 50 PPC800 15" 74 Abmessungen 59 Leistungskalkulation 34 Schnittstellen 56 Technische Daten 56 Wanddurchbruch 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 62 Technische Daten 62 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 62 Technische Daten <td>vixelfehler</td> <td>39</td>	vixelfehler	39
Power Fail 51 POWERLINK 85 LED STATUS 83 Link LED 83 Speed LED 83 Stationsnummer 85 System Stopp Fehlercodes 84 Power Taster 50 PPC800 15" 59 Leistungskalkulation 34 Schnittstellen 56 Technische Daten 56 Vanddurchbruch 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 56 Technische Daten 56 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 62 Technische Daten 62 Manddurchbruch 62	owerfail	70
POWERLINK 85 Kartennummernschalter 85 LED STATUS 83 Link LED 83 Speed LED 83 Stationsnummer 85 System Stopp Fehlercodes 84 Power Taster 50 PPC800 15" 59 Leistungskalkulation 59 Leistungskalkulation 34 Schnittstellen 56 Technische Daten 56 Wanddurchbruch 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 65 Leistungskalkulation 35 Schnittstellen 62 Vanddurchbruch 62 Vanddurchbruch 62 Vanddurchbruch 65 Leistungskalkulation 65 Schnittstellen 62 Technische Daten 62	ower Fail	51
Kartennummernschalter.85LED STATUS.83Link LED.83Speed LED.83Stationsnummer.85System Stopp Fehlercodes.84Power Taster.50PPC800 15"7Abmessungen.59Leistungskalkulation.34Schnittstellen.56Technische Daten.56Wanddurchbruch.59PPC800 19"65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.56Technische Daten.56Wanddurchbruch.59PPC800 19"65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.62Technische Daten.62Wanddurchbruch.65	OWERLINK	
LED STATUS83Link LED.83Speed LED.83Stationsnummer.85System Stopp Fehlercodes.84Power Taster.50PPC800 15"7Abmessungen.59Leistungskalkulation.34Schnittstellen.56Technische Daten.56Wanddurchbruch.59PPC800 19"65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.56Technische Daten.56Wanddurchbruch.59PPC800 19"65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.62Technische Daten.62Monddurchbrueh.62	Kartennummernschalter	35
Link LED.83Speed LED.83Stationsnummer.85System Stopp Fehlercodes.84Power Taster.50PPC800 15"59Abmessungen.59Leistungskalkulation.34Schnittstellen.56Technische Daten.56Wanddurchbruch.59PPC800 19"59Abmessungen.65Leistungskalkulation.59Technische Daten.56Technische Daten.56Dessungen.65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.62Technische Daten.62Manddurchbruch.62Schnittstellen.62Schnittstellen.62Schnittstellen.62Schnittstellen.62Technische Daten.62	LED STATUS	33
Speed LED.83Stationsnummer.85System Stopp Fehlercodes.84Power Taster.50PPC800 15"59Leistungskalkulation.59Leistungskalkulation.34Schnittstellen.56Technische Daten.56PPC800 19"59Abmessungen.56Leistungskalkulation.56Technische Daten.56Schnittstellen.56Technische Daten.59PPC800 19"65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.65Leistungskalkulation.35Schnittstellen.62Technische Daten.62Technische Daten.62	Link LED	33
Stationsnummer. 85 System Stopp Fehlercodes. 84 Power Taster. 50 PPC800 15" 59 Leistungskalkulation. 59 Leistungskalkulation. 34 Schnittstellen. 56 Technische Daten. 56 Wanddurchbruch. 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation. 65 Usingskalkulation. 35 Schnittstellen. 65 Vanddurchbruch. 62 Technische Daten. 62 Manddurchbruch. 62 Schnittstellen. 62 Technische Daten. 62 Wanddurchbruch. 62	Speed LED	33
System Stopp Fehlercodes. 84 Power Taster. 50 PPC800 15" 59 Abmessungen. 59 Leistungskalkulation. 34 Schnittstellen. 56 Technische Daten. 56 Wanddurchbruch. 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation. 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 65 Vanddurchbruch. 65 Marken Schnittstellen. 65 Schnittstellen. 65 Schnittstellen. 62 Technische Daten. 62 Wanddurchbruch. 65	Stationsnummer	35
Power Taster. 50 PPC800 15" 59 Abmessungen. 59 Leistungskalkulation. 34 Schnittstellen. 56 Technische Daten. 56 Wanddurchbruch. 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation. 59 Schnittstellen. 56 Technische Daten. 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation. 55 Schnittstellen. 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 62 Technische Daten. 62 Wanddurchbruch 62 Wanddurchbruch 65	System Stopp Fehlercodes	34
PPC800 15" 59 Abmessungen	ower Taster.	50
Abmessungen	PC800 15"	
Leistungskalkulation	Abmessungen	59
Schnittstellen. 56 Technische Daten. 56 Wanddurchbruch. 59 PPC800 19" 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 62 Technische Daten. 62 Wanddurchbruch 62	Leistungskalkulation.	34
Technische Daten. 56 Wanddurchbruch. 59 PPC800 19" 65 Abmessungen. 65 Leistungskalkulation. 35 Schnittstellen. 62 Technische Daten. 62 Wanddurchbruch 62 Fechnische Daten. 62	Schnittstellen	56
Wanddurchbruch	Technische Daten	56
PPC800 19" Abmessungen	Wanddurchbruch	59
Abmessungen	PC800 19"	
Leistungskalkulation	Abmessungen	35
Schnittstellen	Leistungskalkulation	35
Technische Daten	Schnittstellen 6	32
Wanddurchbruch	Technische Daten	32
	Wanddurchbruch	35
Produktabkürzungen 376	roduktabkürzungen	76

R

Reinigung Relative Luftfeuchtigkeit	350, 373
Reporterstellung	
Reset Taster	50
Ressourcenaufteilung I/O-Adressbelegung	234
Richtlinien	19
Richtlinien und Erklärungen RS232 Kabel	277 345

S

Schnittstellen	
Schnittstellen PPC800 15"	
Schnittstellen PPC800 19"	
SDL	
SDL Kabel	
SDL Kabel flex	
SDL Kabel flex mit Extender	

Stichwortverzeichnis

SDL Kabel mit 45° Stecker	
	40, 40
Serielle Schnittstelle	
Sicherheitshinweise	
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Betrieb	
Montage	1/
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	
Iransport und Lagerung	
Umgebungsbedingungen	
Umweltgerechte Entsorgung	
Vorschriften und Maßnahmen	
Werkstofftrennung	
Sicherungs Kit USV	
Slide-in compact Adapter Montage	354
Slide-in compact Laufwerkseinbau bzwtausch	352
Slide-in compact Slot	53
Slide-in Slot	
Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzwtausch	353
Smart Display Link / DVI	
Softwareversionen	261
Spannungsversorgung	41, 163
Spannungsversorgungsstecker	281
Static Wear Leveling	301
Status LEDs	51
Störfestigkeit	163
Störungsableitung	163

Т

auschen einer PCI SATA RAID Hard Disk	367
echnische Daten PPC800 15"	. 56
echnische Daten PPC800 19"	. 62
emperaturangaben	. 28
emperaturauswertung	165
emperatursensorpositionen	. 31
emperaturtest	164
emperaturüberwachung	369
emperaturüberwachung Lüfterregelung	369
ouchkalibrierung	180

U

UL Zulassung	278
Umgebungstemperatur	
maximal	
minimal	31
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	285
Upgrade	
BIOS	236
Firmware	239
Upgradeinformationen	236
USB Kabel	344
USB Media Drive	319
USB Memory Stick	
USB Peripheriegeräte	181
USB Schnittstellen	47
User Serial ID	
USV	285
Abschaltzeit der USV	
Ändern der Abschaltzeit	

E	3atterieeinstellungen aktualisieren	266
E	Batterieeinstellungen bearbeiten	265
E	Batterieeinstellungen sichern	267
I	nstallation des USV Dienstes	264
L	_ow Battery Shutdown	270
(Over Current Shutdown	270
F	² owerfail	270
S	Standard Shutdown	270
S	Statuswerte der USV anzeigen	265
S	Systemeinstellungen der USV	267
ι	JSV Parametrierung	264
US	V Parametrierung	264
US	V Sicherungs Kit	360

V

Vorgehensweise	Temperaturtest	164
----------------	----------------	-----

W

59
35
53
56
48
58
53
55
51
46

Ζ

Zubehör	279
Zulassungen	278
GOST-R	278
UI	278